목 차

사 업 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 11
3. 자본금 변동사항 17
4. 주식의 총수 등 18
5. 정관에 관한 사항 23
II. 사업의 내용 25
1. 사업의 개요 25
2. 주요 제품 및 서비스 27
3. 원재료 및 생산설비 28
4. 매출 및 수주상황 35
5. 위험관리 및 파생거래 40
6. 주요계약 및 연구개발활동 48
7. 기타 참고사항 53
III. 재무에 관한 사항 74
1. 요약재무정보 74
2. 연결재무제표 77
2-1. 연결 재무상태표 77
2-2. 연결 손익계산서 79
2-3. 연결 포괄손익계산서 80
2-4. 연결 자본변동표 81
2-5. 연결 현금흐름표 82
3. 연결재무제표 주석 84
1. 일반적 사항 (연결) 84
2. 중요한 회계처리방침 (연결) 86
3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결) 95
4. 범주별 금융상품 (연결) 99
5. 금융자산의 양도 (연결) 102
6. 공정가치금융자산 (연결) 103
7. 매출채권 및 미수금 (연결) 106
8. 재고자산 (연결) 108
9. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결) 109
10. 유형자산 (연결) 116
11. 무형자산 (연결) 118
12. 차입금 (연결) 119
13. 사채 (연결) 125
14. 순확정급여부채(자산) (연결) 126
15. 충당부채 (연결) 131
16. 우발부채와 약정사항 (연결) 133
17. 계약부채 (연결) 133
18. 자본금 (연결) 134
19. 연결이익잉여금 (연결) 135
20. 기타자본항목 (연결) 136

21. 비용의 성격별 분류 (연결) 137
22. 판매비와관리비 (연결) 137
23. 기타수익 및 기타비용 (연결) 138
24. 금융수익 및 금융비용 (연결) 139
25. 법인세비용 (연결) 140
26. 주당이익 (연결) 144
27. 현금흐름표 (연결) 145
28. 재무위험관리 (연결) 148
29. 부문별 보고 (연결) 169
30. 특수관계자와의 거래 (연결) 171
31. 비지배지분 (연결) 173
32. 사업결합 (연결) 175
33. 매각예정분류(처분자산집단) (연결) 176
4. 재무제표 177
4-1. 재무상태표 177
4-2. 손익계산서 179
4-3. 포괄손익계산서 180
4-4. 자본변동표 181
4-5. 현금흐름표 182
5. 재무제표 주석 183
1. 일반적 사항 183
2. 중요한 회계처리방침 183
3. 중요한 회계추정 및 가정 191
4. 범주별 금융상품 195
5. 금융자산의 양도 197
6. 공정가치금융자산 198
7. 매출채권 및 미수금 201
8. 재고자산 204
9. 관계기업 및 공동기업 투자 205
10. 유형자산 207
11. 무형자산 209
12. 차입금 210
13. 사채 212
14. 순확정급여부채(자산) 213
15. 충당부채 217
16. 우발부채와 약정사항 218
17. 계약부채 219
18. 자본금 220
19. 별도이익잉여금 221
20. 기타자본항목 224
21. 비용의 성격별 분류 224
22. 판매비와관리비 225
23. 기타수익 및 기타비용 226
24. 금융수익 및 금융비용 227
25. 법인세비용 228
26. 주당이익 231
27. 현금흐름표 232

28. 재무위험관리 235
29. 부문별 보고 250
30. 특수관계자와의 거래 251
6. 배당에 관한 사항 262
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 265
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 265
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 269
8. 기타 재무에 관한 사항 270
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 294
V. 회계감사인의 감사의견 등 315
1. 외부감사에 관한 사항 315
2. 내부통제에 관한 사항 322
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 323
1. 이사회에 관한 사항 323
2. 감사제도에 관한 사항 340
3. 주주총회 등에 관한 사항 346
VII. 주주에 관한 사항 352
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 362
1. 임원 및 직원 등의 현황 362
2. 임원의 보수 등 416
IX. 계열회사 등에 관한 사항 430
X. 대주주 등과의 거래내용 453
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 457
1. 공시내용 진행 및 변경사항 457
2. 우발부채 등에 관한 사항 457
3. 제재 등과 관련된 사항 460
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 469
XII. 상세표 475
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 475
2. 계열회사 현황(상세) 488
3. 타법인출자 현황(상세) 504
4. 연구개발실적(상세) 511
【 전문가의 확인 】 537
1. 전문가의 확인 537
2. 전문가와의 이해관계 537

사 업 보 고 서

(제 55 기)

사업연도	2023년 01월 01일	부터
	2023년 12월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 12일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인
면제사유발생 :	해당사항 없음
회 사 명 :	삼성전자주식회사
대 표 이 사 :	한 종 희
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) (전 화) 031-200-1114 (홈페이지) https://www.samsung.com/sec
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱 (전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 2023년 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2024. 3. 12

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 희 _____

신고업무 담당임원: 박 학 규 _____

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적・상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며,
1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.
당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를
삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
전화번호: 031-200-1114
홈페이지: https://www.samsung.com/sec

라. 주요 사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이㈜ 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 경영을 하고 있습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄, DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산・판매법인 및 SDC, Harman 산하 종속기업 등 232개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주 요 제 품
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
SDC	스마트폰용 OLED 패널 등
Harman	디지털 콕핏(Digital Cockpit),카오디오, 포터블스피커 등

※ 당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[DX 부문]

DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 스마트폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품 등을 생산・판매하는 사업을 영위하고 있습니다. Neo QLED TV 등 프리미엄 기술력을 바탕으로 한 프리미엄 TV, 변화하는 라이프스타일에 대한 깊은 이해를 바탕으로 Lifestyle TV 및 소비자들의 다양한 요구에 맞춘 비스포크(BESPOKE) 제품 등 차별화된 제품, 기술 및 디자인으로 글로벌 시장을 이끌고 있으며 특히 TV는 2023년까지 18년 연속으로 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 핵심제품인 스마트폰은 '갤럭시(GALAXY)' 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 시장 상황에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 당사는 앞으로도 프리미엄 TV와 Lifestyle TV 시장에서의 혁신 노력을 계속하고, AI 기능 및 에너지 절감 기술로 비스포크(BESPOKE) 라인업 강화와 새로운 폼팩터가 적용된 신가전 제품의 지속적인 연구를 통해 시장 패러다임 변화를 선도해 나가겠습니다. 또한 보다 강력한 보안성을 바탕으로 초연결 사회에서 소비자에게 안전한 On-device AI 및 멀티 디바이스 사용 환경을 제공하기 위해 노력하겠습니다. 당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인
기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산・판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계・판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고, 고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, On-Device AI 적용, 고성능 IP 탑재 등 제품의 차별화를 통해 고객과 협력 강화 및 응용처를 다변화하여 시장 지배력을 확대하는 한편, 차세대 기술 개발도 지속 추진하고 있습니다.

Foundry 사업은 글로벌 시장 수요 회복 지연에 따른 부진 장기화 극복을 위해 Advanced 공정에서 지속적인 기술 경쟁력 강화를 통해 중장기 수요 확보에 집중하고 있으며, Mature 공정에서는 고객 중심의 디자인 인프라를 제공하고, 고수익 응용처 확대에 집중하고 있습니다.

[SDC]

SDC의 중소형 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편 폴더블・IT(태블릿/노트북)・Auto 등 다양한 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고, 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

[Harman]

Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 디자인하고 개발하는 전장부품 사업과 소비자 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업으로 구성되어 있습니다. Harman은 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편, 오디오 시장에서도 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. Harman은 시장 인지도가 높은 브랜드와 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 삼성전자와의 협업을 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 자체 개발 및 전략적 인수 등을 통해 각 사업 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2023년말 현재 232개사입니다. 전년말 대비 6개 기업이 증가하고 6개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	232	6	6	232	146
합계	232	6	6	232	146

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(당기 연결대상회사의 변동내용)

구 분	자회사	사 유
신규 연결	SVIC 62호 신기술투자조합	설립
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	설립
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	설립
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	설립
	eMagin Corporation	지분취득
	Roon Labs, LLC.	지분취득
연결 제외	Dacor Holdings, Inc.	합병
	Dacor, Inc.	합병
	Red Bend Software Ltd.	청산
	Harman Finance International GP S.a.r.l	청산
	Harman Finance International, SCA	청산
	Harman Automotive UK Limited	청산

바. 중소기업 해당 여부

당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		미해당

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 Moody's(미국) 및 S&P(미국)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.
2023년말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa2, 전망치는 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 전망치는 안정적(Stable)입니다.

평가대상 유가증권	평가일	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	비고
회사채 US$ Bond ('97년 발행, '27년 만기)	2021.07	AA-	S&P	정기평가
	2021.08	Aa3	Moody's	정기평가
	2022.08	AA-	S&P	정기평가
	2022.09	Aa2	Moody's	정기평가
	2023.07	AA-	S&P	정기평가
	2023.08	Aa2	Moody's	정기평가

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa~C), S&P (AAA~D)

구 분	Moody's		S&P	
	등 급	정 의	등 급	정 의
투자적격 등급	Aaa	채무상환능력 최상, 신용위험 최소	AAA	채무상환능력이 극히 높음, 최고등급
	Aa1/Aa2/Aa3	채무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음	AA+/AA/AA-	채무상환능력이 매우 높음
	A1/A2/A3	채무상환능력 중상, 신용위험 낮음	A+/A/A-	채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함
	Baa1/Baa2/ Baa3	채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나 투기적 요소가 있음	BBB+/BBB/ BBB-	채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에 좀 더 취약함
투기 등급	Ba1/Ba2/Ba3	투기적 성향, 신용위험 상당함	BB+/BB/BB-	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼
	B1/B2/B3	투기적 성향, 신용위험 높음	B+/B/B-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음
	Caa	투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음	CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함
	Ca	투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내 부도발생 가능, 원리금 상환가능성 존재	CC	채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만 사실상 부도가 예상됨
	C	부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음	C	현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무보다 낮게 추정됨
			D	금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태

☞ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 주권상장(또는 등록・지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 1975년 6월 11일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

주권상장 (또는 등록・지정)현황	주권상장 (또는 등록・지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	1975년 06월 11일	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다.
공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사의 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성되며 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 2023년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(한종희, 경계현, 노태문, 박학규,이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희) 등 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.

당사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 각자 회사를 대표합니다. 2023년말 현재 당사의 대표이사는 한종희 사내이사(2022년 2월 선임, 2023년 3월 재선임)와 경계현 사내이사(2022년 3월 선임) 입니다.

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2019.03.20	정기주총	사외이사 김한조 사외이사 안규리	사외이사 박재완	사외이사 이인호 사외이사 송광수
2019.10.26	-	-	-	사내이사 이재용
2020.03.18	정기주총	사내이사 한종희 사내이사 최윤호	-	-
2021.03.17	정기주총	-	사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 박병국 사외이사 김종훈 (감사위원회 위원이 되는) 사외이사 김선욱	-
2021.03.17	-	-	대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진	-
2022.02.15	-	대표이사 한종희	-	대표이사 김기남(사임) 대표이사 김현석(사임) 대표이사 고동진(사임)

2022.03.16	정기주총	사내이사 경계현 사내이사 노태문 사내이사 박학규 사내이사 이정배 사외이사 한화진 사외이사 김준성	사외이사 김한조	-
2022.03.16	-	대표이사 경계현	-	-
2022.11.03	임시주총	사외이사 허은녕 사외이사 유명희	-	-
2023.03.15	정기주총	-	사내이사 한종희	-
2023.03.15	-	-	대표이사 한종희	-

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 모두 대표이사 직에서 사임(사내이사 직은 2022년 3월 16일 사임)하고

같은 날 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

또한 2022년 3월 16일 주주총회에서 신규 선임된 경계현 사내이사가 당일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 상반기에 한화진 사외이사가 사임하고, 박병국 사외이사가 퇴임하여

2022년 11월 3일 임시주주총회에서 허은녕 사외이사, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 주주총회에서 한종희 사내이사가 이사로 재선임되었고 당일 이사회를 통해 대표이사로 재선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동

2021년 4월 29일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 삼성생명보험㈜으로 변동되었습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2021.04.29	삼성생명보험㈜	1,263,050,053	21.16%	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며,
의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

2019년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Greece S.A. (SEGR) 사명이 Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)로 변경되었습니다.

2021년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Portuguesa S.A. (SEP) 사명이 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)로 변경되었습니다.

2023년 중에는 종속기업 Emerald Intermediate, Inc. 사명이 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)로 변경되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

마. 합병 등에 관한 사항

2019년 중 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)은 Corephotonics Ltd. 지분을 인수하였으며, 당사는 관계기업인 삼성전기㈜의 PLP(Panel Level Package) 사업을 양수하였습니다. 또한, 종속기업 Duran Audio B.V.가 종속기업 HarmanBecker Automotive Systems Manufacturing Kft에 합병되었으며, 종속기업 Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited (SBSC)가 종속기업 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)에 합병되었습니다.

2021년 중 종속기업 Viv Labs, Inc.는 종속기업 Samsung Research America, Inc (SRA)에 합병되었습니다. 또한, 종속기업 Prismview, LLC는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었습니다.

2023년 중 종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 eMagin Corporation 지분을 인수하였습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

연도	내용
2019	'갤럭시 S10 5G' 5G 스마트폰 출시
	소비자 라이프스타일 맞춤형 냉장고 '비스포크(BESPOKE)' 출시
	'엑시노스 980' 5G 모바일 프로세서 공개
	'갤럭시 폴드' 새로운 폼팩터 폴더블폰 공개
2020	'그랑데 AI' 인공지능 기반 세탁기・건조기 출시
	AI・차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 출시
	'갤럭시 Z 플립' 폴더블폰 공개
	세계 최대 규모 평택 반도체 2라인 가동
2021	'Neo QLED TV' 공개
	전세계 반도체 업체 최초 전 사업장 '탄소/물/폐기물 저감' 인증
	업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산
	미국 테일러市에 신규 파운드리 라인 투자 발표
2022	비스포크 인피니트 라인 공개
	세계 최초 3나노 GAA 파운드리 양산
	차세대 반도체 R&D단지 기공식
	1Tb 8세대 V낸드 양산
2023	초고화소 기술 집약된 2억 화소 이미지센서 '아이소셀 HP2' 출시
	'갤럭시 S23' 시리즈 공개
	업계 최초 고용량 메모리 처리를 위한 'CXL 2.0 D램' 개발
	업계 최선단 12나노급 D램 양산
	체험형 플래그십 스토어 '삼성 강남' 오픈
	업계 최초 그래픽용 고성능 GDDR7 D램 개발
	'갤럭시 Z 폴드5', '갤럭시 Z 플립5' 공개
	현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발
	업계 최초 차세대 D램LPCAMM 개발
	생성형 AI '삼성 가우스' 공개

(2) 조직의 변경

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

<table>
<tr><th></th><th>변경전</th><th>변경후</th></tr>
<tr><td rowspan="5">사업
조직</td><td>CE 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기)</td><td rowspan="2">DX 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기,
Mobile eXperience, 네트워크)</td></tr>
<tr><td>IM 부문
(무선, 네트워크)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry,
디스플레이 패널)</td><td>DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry)</td></tr>
<tr><td>SDC
(디스플레이 패널)</td></tr>
<tr><td>Harman 부문</td><td>Harman</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지역
총괄</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td></tr>
<tr><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td></tr>
</table>

3. 자본금 변동사항

당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로, 납입자본금 897,514백만원과는 이익소각으로 인하여 상이합니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제55기말
보통주	발행주식총수	5,969,782,550
	액면금액	100
	자본금	596,978,255,000
우선주	발행주식총수	822,886,700
	액면금액	100
	자본금	82,288,670,000
합계	자본금	679,266,925,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2023년말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2023년말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2023년말 현재 유통주식수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		20,000,000,000	5,000,000,000	25,000,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		7,780,466,850	1,194,671,350	8,975,138,200	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-

나. 자기주식

당사는 자기주식을 주주환원의 목적으로 2018년 중 모두 소각하였으며
공시대상기간 중 자기주식의 취득 및 처분거래는 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당가능 이익 범위이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(A)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(B)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(C)			보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(A+B+C)			보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보통주 외 비누적적 우선주를 발행하고 있습니다. 이 우선주는 보통주의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있으며, 2023년말 현재 우선주의 발행주식수는 822,886,700주입니다.

[우선주 발행 현황]

<table>
<tr><th colspan="3">구 분</th><th colspan="2">내 용</th></tr>
<tr><td colspan="3">발행일자</td><td colspan="2">1989년 08월 25일(최초 발행일)</td></tr>
<tr><td colspan="3">주당 액면가액</td><td colspan="2">100원</td></tr>
<tr><td colspan="3">발행총액(액면가기준) / 현재까지 발행한 주식수</td><td>119,467백만원</td><td>1,194,671,350주</td></tr>
<tr><td colspan="3">현재 잔액 / 현재 주식수</td><td>82,289백만원</td><td>822,886,700주</td></tr>
<tr><td rowspan="12">주식의 내용</td><td colspan="2">이익배당에 관한 사항</td><td colspan="2">액면금액 기준 보통주보다
1%의 금전배당을 추가로 받음</td></tr>
<tr><td colspan="2">잔여재산분배에 관한 사항</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">상환에 관한 사항</td><td>상환조건</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>상환방법</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>상환기간</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>주당 상환가액</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>1년 이내 상환 예정인 경우</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">전환에 관한 사항</td><td>전환조건(전환비율 변동여부 포함)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>전환청구기간</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>전환으로 발행할 주식의 종류</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>전환으로 발행할 주식수</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">의결권에 관한 사항</td><td colspan="2">의결권 없음</td></tr>
<tr><td colspan="3">기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

※ 이익소각으로 인해 발행주식의 액면 총액은 82,289백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다.
상기 발행주식수, 현재주식수 등은 2018년 주식분할로 인한 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.

[우선주 발행일자별 내역] (단위 : 주, 원)

일 자	변 동	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액	액면가액 합계	주 당 발행가액	발행가액 합계
1989.08.25	유상증자	우선주	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192
1991.04.08	전환권 행사	우선주	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883
1991.07.24	전환권 행사	우선주	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621
1991.07.30	전환권 행사	우선주	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주	△470,000	5,000	△2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주	△330,000	5,000	△1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주	△260,000	5,000	△1,300,000,000	-	-
2016.01.15	이익소각	우선주	△1,240,000	5,000	△6,200,000,000	-	-

2016.04.20	이익소각	우선주	△530,000	5,000	△2,650,000,000	-	-
2016.07.19	이익소각	우선주	△320,000	5,000	△1,600,000,000	-	-
2016.09.28	이익소각	우선주	△230,000	5,000	△1,150,000,000	-	-
2017.04.12	이익소각	우선주	△255,000	5,000	△1,275,000,000	-	-
2017.05.02	이익소각	우선주	△1,614,847	5,000	△8,074,235,000	-	-
2017.07.24	이익소각	우선주	△225,000	5,000	△1,125,000,000	-	-
2017.10.25	이익소각	우선주	△168,000	5,000	△840,000,000	-	-
2018.01.30	이익소각	우선주	△178,000	5,000	△890,000,000	-	-
2018.05.03	주식분할	우선주	885,556,420	100	-	-	-
2018.12.04	이익소각	우선주	△80,742,300	100	△8,074,230,000	-	-
우선주 계			822,886,700		82,288,670,000		642,261,376,652

[△는 부(-)의 값임]

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

당사의 최근 정관 개정일은 2018년 3월 23일이며, 공시대상기간 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없으나, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제55기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다.

☞ 제55기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2024년 2월 20일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

나. 사업 목적

[사업목적 현황]

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
2	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
3	의료기기의 제작 및 판매업	영위
4	광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업	영위
5	광섬유, 케이블 및 관련 기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위
6	전자계산조직 및 동 관련 제품의 제조, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
7	저작물, 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	영위
8	노우하우, 기술의 판매, 임대업	영위
9	정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공	영위
10	자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위
11	공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위
12	반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업	영위
13	반도체 제조 장치의 제조, 판매업	영위
14	반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업	영위
15	기타기계기구의 제작 및 판매업	영위
16	합성수지의 제조, 가공 및 판매업	영위
17	금을 제외한 금속의 제련가공 및 판매업	영위
18	수출입업 및 동 대행업	영위
19	경제성 식물의 재배 및 판매업	미영위
20	부동산업	영위
21	물품 매도 확약서 발행업	영위
22	계량기, 측정기 등의 교정 검사업 및 제작, 판매업	영위
23	전 각항의 기술용역, 정보통신 공사업 및 전기공사업	영위
24	주택사업 임대 및 분양	영위
25	운동, 경기 및 기타 관련사업	영위
26	전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업	영위
27	전기공급 및 제어장치 제조업	영위
28	교육 서비스업 및 사업 관련 서비스업	영위
29	각 항에 관련된 부대사업 및 투자	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산・판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 232개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산・판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산・판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산・판매하고 있습니다.

당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience) 사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 35개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽・CIS, 중동・아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 197개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체・디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 47개의 판매・생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽・CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia)등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 68개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동・아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG (Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV・SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체・디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2023년 당사의 매출은 258조 9,355억원으로 전년 대비 14.3% 감소하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산・판매하고 있습니다.

2023년 매출은 DX 부문이 169조 9,923억원(65.7%), DS 부문이 66조 5,945억원(25.7%)이며, SDC가 30조 9,754억원(12.0%), Harman은 14조 3,885억원(5.6%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	1,699,923	65.7%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	665,945	25.7%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	309,754	12.0%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	143,885	5.6%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△230,152	△9.0%
총 계		2,589,355	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2023년 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 3% 하락하였으며, 스마트폰은 전년 대비 약 6% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 45% 하락하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 2% 상승하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 대비 약 1% 상승하였습니다.

※ 주요 제품인 스마트폰 제품의 가격 변동 정보 제공을 위해, 2023년부터 기존 스마트폰 등에서 스마트폰 가격으로
주요 제품 가격 변동 현황을 작성하였습니다.

가격 변동 현황	2022년	2021년
스마트폰	전년 대비 4% 상승	전년 대비 3% 상승

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TV・모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SK실트론㈜ 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	모바일AP 솔루션	CPU	117,320	18.1%	Qualcomm, MediaTek 등
	디스플레이 패널	TV・모니터용 화면표시장치	58,624	9.0%	CSOT, AUO 등
	Camera Module	스마트폰 카메라	52,124	8.0%	삼성전기㈜, ㈜파워로직스 등
	기타	-	421,425	64.9%	
	소 계		649,493	100.0%	
DS 부문	Chemical	원판 가공	25,700	15.7%	솔브레인㈜, 동우화인켐㈜ 등
	Wafer	반도체 원판	22,393	13.7%	SK실트론㈜, SUMCO 등
	기타	-	115,283	70.6%	
	소 계		163,376	100.0%	
SDC	FPCA	구동회로	24,307	22.2%	㈜비에이치, 영풍전자㈜ 등
	Cover Glass	강화유리	16,856	15.4%	Apple, Biel 등
	기타	-	68,121	62.4%	
	소 계		109,284	100.0%	
Harman	SOC(System-On-Chip)	CPU	7,678	9.9%	NVIDIA, Intel 등
	통신 모듈	차량 통신	4,752	6.1%	WNC(Wistron NeWeb Corp.) 등
	기타	-	65,503	84.0%	
	소 계		77,933	100.0%	
기타	-	-	462	-	
총 계			1,000,548	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다.

※ AP와 그 주변부품의 높은 연관성을 감안하여, 2023년부터 기존 모바일AP에서 모바일AP 솔루션(AP와 AP전용 IC류 자재 포함)

가격으로, DX부문 주요 원재료 현황을 작성하였습니다.

매입액(억원)	2022년	2021년
모바일AP 솔루션	113,790	76,295

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 대비 약 30% 상승하였고, Camera Module 가격은 약 11% 상승하였으며, TV・모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 9% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 연간 평균 대비 약 1% 상승하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 5% 상승, 강화유리용
Cover Glass 가격은 약 4% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip)가격은 전년 대비 약 10% 상승하였으며, 통신 모듈은 약 7% 하락하였습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ AP와 그 주변부품의 높은 연관성을 감안하여, 2023년부터 기존 모바일AP에서 모바일AP 솔루션(AP와 AP전용 IC류 자재 포함) 가격으로, DX부문 주요 원재료 가격 변동 추이를 작성하였습니다.

가격 변동 추이	2022년	2021년
모바일AP 솔루션	전년 대비 46% 상승	전년과 유사한 수준

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제55기	제54기	제53기
DX 부문	TV, 모니터 등	53,552	55,747	54,235
	스마트폰 등	284,700	332,170	319,550
DS 부문	메모리	1,926,651,546	1,905,731,836	1,756,009,941
SDC	디스플레이 패널	2,320	2,700	3,604
Harman	디지털 콕핏	10,912	11,257	9,066

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처・제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2023년(제55기) DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 40,085천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 189,991천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 1,926,652백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 1,407천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 7,658천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고
있습니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제55기	제54기	제53기
DX 부문	TV, 모니터 등	40,085	41,802	44,133
	스마트폰 등	189,991	229,180	260,501
DS 부문	메모리	1,926,651,546	1,905,731,836	1,756,009,941
SDC	디스플레이 패널	1,407	2,008	2,849
Harman	디지털 콕핏	7,658	8,334	6,928

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2023년(제55기) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 74.9%, 스마트폰 등은 66.7%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제55기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	TV, 모니터 등	53,552	40,085	74.9%
	스마트폰 등	284,700	189,991	66.7%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2023년(제55기) 가동일은 휴일을 포함하여 총 365일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제55기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	87,600	87,600	100.0%
SDC	디스플레이 패널	43,800	43,800	100.0%

Harman의 2023년 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 70.2%입니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제55기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	10,912	7,658	70.2%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany
	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2023년 말 현재 장부금액은 187조 2,563억원으로 전년말 대비 19조 2,109억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기초	기초장부금액	98,922	407,069	797,146	336,076	41,241	1,680,454
	- 취득원가	100,246	677,138	3,030,006	336,076	132,485	4,275,951
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,324	△270,069	△2,232,860	-	△91,244	△2,595,497
증감	일반취득 및 자본적지출	1,723	64,986	336,417	131,418	14,620	549,164
	사업결합으로 인한 취득	-	181	201	347	2	731
	감가상각	△494	△38, 843	△300,316	-	△15,671	△355,324
	처분・폐기・손상	△259	△2,126	△847	△3	△380	△3,615
	매각예정분류	△66	△543	△371	△63	△141	△1,184
	기타	168	1,657	862	△572	222	2,337
기말	기말장부금액	99,994	432,381	833,092	467,203	39,893	1,872,563
	- 취득원가	101,580	736,900	3,285,615	467,203	140,586	4,731,884
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,586	△304,519	△2,452,523	-	△100,693	△2,859,321

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2023년 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설・전환과 인프라 투자를 중심으로 53.1조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2024년 글로벌 시황 개선에 대비하여
차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 점검할 것이며, 투자 효율성 제고를 통하여 내실을 다지는 활동도 병행할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신・증설, 보완 등	2023.01~2023.12	건물・설비 등	483,723
SDC	신・증설, 보완 등	2023.01~2023.12	건물・설비 등	23,856
기 타	신・증설, 보완 등	2023.01~2023.12	건물・설비 등	23,560
합 계				531,139

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2023년 매출은 258조 9,355억원으로 전년 대비 14.3% 감소하였습니다. 부문별로 보면 전년 대비 DX 부문이 6.8%, DS 부문이 32.4%, SDC는 9.9% 감소하였으며, Harman은 8.9% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제55기	제54기	제53기
DX 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	1,699,923	1,824,897	1,662,594
DS 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	665,945	984,553	953,872
SDC	제・상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	309,754	343,826	317,125
Harman	제・상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	143,885	132,137	100,399
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△230,152	△263,099	△237,942
합 계			2,589,355	3,022,314	2,796,048

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제55기	제54기	제53기
TV, 모니터 등	303,752	332,795	314,974
스마트폰 등	1,086,325	1,154,254	1,046,806
메모리	441,254	685,349	726,022
디스플레이 패널	309,754	343,826	317,125

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제55기	제54기	제53기
제・상품	2,461,380	2,903,461	2,658,785
용역 및 기타매출	127,975	118,853	137,263
계	2,589,355	3,022,314	2,796,048

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제55기	제54기	제53기
내수	국내	205,196	221,799	221,497
수출	미주	510,934	659,617	583,805
	유럽	239,342	265,147	258,227
	아시아・아프리카	326,262	425,114	336,671
	중국	422,007	546,998	597,247
계		1,703,741	2,118,675	1,997,447

※ 별도 기준의 내수・수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

<table>
<tr><th>판매자</th><th>판 매 경 로</th><th>소비자</th></tr>
<tr><td rowspan="4">생산 및
매입</td><td>전속 대리점</td><td rowspan="4">소비자</td></tr>
<tr><td>유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)</td></tr>
<tr><td>통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)</td></tr>
<tr><td>직접판매(B2B 및 온라인)</td></tr>
</table>

(2) 해외

<table>
<tr><th>판매자</th><th colspan="4">판 매 경 로</th><th>소비자</th></tr>
<tr><td rowspan="8">생산법인</td><td rowspan="5">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td><td rowspan="8">소비자</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td colspan="2">Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="3">통신사업자, Automotive OEM</td></tr>
<tr><td colspan="3">직접판매(B2B 및 온라인)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">물류법인</td><td rowspan="3">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
</table>

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	19%	30%	46%	5%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객・시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2023년 당사의 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 15% 수준입니다.

바. 수주상황

2023년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말		제54기말	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	418,776	△418,776	258,655	△258,655
EUR	151,740	△151,740	92,546	△92,546

[△는 부(-)의 값임]

(이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말		제54기말	
	이자율 상승시	이자율 하락시	이자율 상승시	이자율 하락시
금융자산	210,617	△210,617	72,750	△72,750
금융부채	△6,197	6,197	△8,427	8,427
순효과	204,420	△204,420	64,323	△64,323

[△는 부(-)의 값임]

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직・간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2023년말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 52,510백만원(전기: 92,073백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,472백만원(전기: 3,144백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정・관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를
하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 2023년말 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시
자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

1) 제55기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	43,302,421	589,743	1,529,785	7,811,246	2,337,792

2) 제54기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	42,990,570	733,984	1,925,448	5,402,672	1,562,274

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말	제54기말
부 채	92,228,115	93,674,903
자 본	363,677,865	354,749,604
부채비율	25.4%	26.4%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2023년말 현재 당사는 USD, EUR, JPY 등 총 35개 통화에 대하여 2,757건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산・부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	119,934	82,749	834,801	999,713

그리고 당사는 레인보우로보틱스㈜ 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스㈜ 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 2023년말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

삼성디스플레이㈜는 TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

2023년말 현재 상기 풋옵션들 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2023.12.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스・부제소를 통한 사업자유도 확보
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Nokia	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보

※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2023년(제55기) 당사의 연구개발비용은 28조 3,528억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 28조 3,397억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원, %)

과 목		제55기	제54기	제53기
연구개발비용 총계		28,352,769	24,929,171	22,596,487
(정부보조금)		△13,045	△9,973	△1,053
연구개발비용 계		28,339,724	24,919,198	22,595,434
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	△193,708
	연구개발비(비용)	28,339,724	24,919,198	22,401,726
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		10.9%	8.2%	8.1%

※ 연결 누계기준입니다.

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

다. 연구개발 조직 및 운영

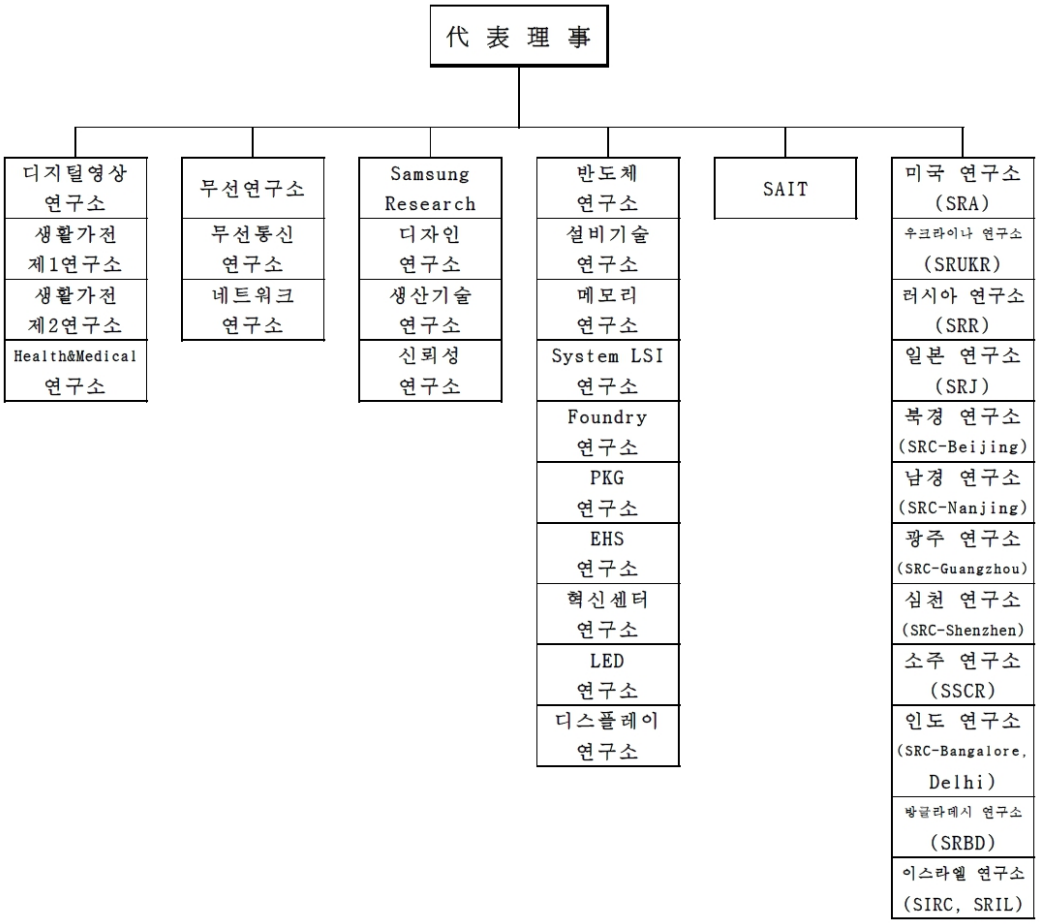
(국내)

당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2023년말 기준입니다.

☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'XII. 상세표'의
'1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'을 참고하시기 바랍니다.

라. 연구개발실적

2023년 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	갤럭시 폴더블	· Galaxy Z Fold5 출시 · Galaxy Z Flip5 출시
	갤럭시 S23	· Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra 출시
	갤럭시 탭	· Galaxy Tab S9 · S9+ · S9 Ultra출시
	갤럭시 A	· Galaxy A54 5G 출시 · Galaxy A34 5G 출시 · Galaxy A24 LTE 출시 · Galaxy A14 LTE · 5G 출시
	갤럭시북	· Galaxy Book3 Ultra 출시 · Galaxy Book3 Pro 360 출시 · Galaxy Book3 Pro 출시 · Galaxy Book3 360 출시
	웨어러블	· Galaxy Watch6/ Galaxy Watch6 Classic 출시
	Neo QLED 8K	· Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	· Mini LED 기반 3개 시리즈,6개 사이즈 출시
	냉장고	· 핵심 부품 고효율화로 에너지 1등급보다 더아끼는 초고효율 모델 출시
	세탁기	· 세탁/건조 일체형 BESPOKE 그랑데AI 원바디 Top-Fit 출시
	청소기	· 세계최고 성능(흡입력/사용시간) 스틱 청소기 BESPOKE 제트AI 280W 출시
	RAN S/W Package	· 업계 최초 4세대 CPU 기반 가상화 기지국 무선접속망(vRAN) 상용망 적용
DS 부문	모바일 DRAM	· 업계 최초 LPCAMM 개발
	서버용 DRAM	· 업계 최선단 12나노급 D램 양산 · 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발
	HBM	· 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개
	SSD	· 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 · 초고속 포터블 SSD 출시 · 업계 최대 용량 8Tb 포터블 SSD 출시
	엑시노스	· 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) · 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 출시
	이미지센서	· 초고화소 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp)
SDC	OLED	· 초고해상도 VR용 OLED 개발 · 노트북용 14/16" OLED 개발

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 244,731건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2023년말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	57,661	93,327	44,759	23,639	8,930	16,415	244,731

2023년 중 총 28.4조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 8,909건, 미국 특허 8,952건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

구 분	2023년	2022년	2021년
한 국	8,909	9,136	8,437
미 국	8,952	8,490	8,565

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술・특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2023년 중 미국에서 391건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직・간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수・재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기・전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.
1. 폐제품 회수・재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건 경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제:「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」
「소음・진동관리법」「환경영향평가법」등
2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
「기후위기대응을 위한 탄소중립・녹색성장기본법」등
3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」
「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장기본법」제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO_2-eq)	17,656,953	19,285,537	19,267,835
에너지(TJ)	300,615	290,111	274,298

※ 연결 기준입니다.
※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 2023년 배출량 및 에너지 사용량은 집계 및 검증 전으로 전망치로 반영하였습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 Color TV가 각각 등장한 이후 지금까지, 평면 TV(LCD/PDP), 스마트 TV, 초대형 TV(QLED/OLED/Neo QLED), 마이크로 LED 등 최고 화질을 추구하는 스크린 혁신활동이 지속적으로 일어나고 있습니다.

TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체계(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 최근들어 IoT 기술 발전으로 TV를 통해 제어할 수 있는 가정 내 전자기기들이 증가하고 있어서 스크린 허브 기능이 더욱 부각되고 있습니다.

TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하는 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 이제 75인치 이상 98인치까지 초대형 제품들이 성장을 주도합니다. 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.

TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)는 물론 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알림 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다.

한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치성, 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2023년 7.3억대로 판매가 확대되었고, 이러한 5G의 확산은 AI・XR・자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.02).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2023년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 85% 수준, 피처폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 15% 수준입니다(출처: TechInsights 2024.02). 또한 스마트폰 보급률은 2022년 52%에서 2023년 53%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.12).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터, 멀티카메라, 센서, 방수・방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 135만대 수준으로 소폭 감소하였습니다(출처: Omdia 2024.02).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2023년	2022년	2021년
TV	30.1%	29.7%	29.5%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 경기 회복에 따른 소비심리 상승과 폴더블폰 수요 증가 등으로 인해2023년 11.5억대에서 2024년 11.8억대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다(출처: TechInsights 2024.02). 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 교체 수요 감소 등으로 2023년 1.4억대 수준으로 역성장 하였으나 2024년에는 교체 주기 도래에 따라 수요가 점진적으로 회복될 전망입니다(출처: TechInsights 2024.02).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2023년	2022년	2021년
스마트폰	19.7%	21.7%	20.0%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.
※ TechInsights는 기존 외부조사기관인 Strategy Analytics를 인수하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2023년까지 18년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제위기 상황에서도 QLED 4K・8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다. 또한, 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED와 OLED를 출시해 프리미엄 제품군을 지속적으로 확대했으며, 라이프스타일
제품과 사운드바 제품 등 다양한 제품 판매를 통해 새로운 시장을 창출했습니다. 스마트 생태계 부분에서도 TV 플러스, OTT, 게임, 홈트레이닝 등 다양한 외부 업체들과의 협업을 확대해 새로운 성장 동력으로 자리매김 하고 있습니다.

전사적으로 중점을 두고 있는 지속가능성 관련해서도 제품 소재에서부터 패키징에 이르기까지 환경 친화적인 다양한 시도들을 지속해 오고 있으며 접근성 기능을 발전시켜서 시각, 청각이 불편한 분들도 제품을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

향후에도 당사의 주력 제품인 Neo QLED와 초대형, OLED 등 프리미엄 제품에 집중해 시장 점유율을 확대해 나가는 한편 라이프스타일 부문에서도 라인업 확대와 제품 성능 개선 등을 통해 소비자 맞춤형 제품들을 지속적으로 제공할 것입니다. 이 밖에도 AI를 활용한 다양한 기술을 TV 제품에 적용해 AI 스크린의 시대를 주도해나갈 것이며, 투명 마이크로 LED, AI 업스케일링 등 혁신적인 제품/기능 등의 연구/개발 활동을 통해 소비자들의 일상이 더욱 가치 있게 변화할 수 있도록 할 것입니다.

2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 13년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.02). 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 컨텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수・방진, 고속 유・무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영・8K 동영상 특화 카메라 기능, 생성형 AI를 적용한 검색・실시간 통번역・자동 내용 요약・사진 편집 등 고객의 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 Z 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'을 출시하였습니다. 갤럭시 Z 플립 시리즈는 아이코닉하고 젊은 감성의 디자인으로, 여성과 젊은 세대의 갤럭시 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 3세대, 4세대 갤럭시 Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 주도해 왔습니다.

또한, '갤럭시 Z 폴드5'와 '갤럭시 Z 플립5'는 사용자 관점에서 각 제품의 핵심 경험인 멀티태스킹과 Flex Mode 경험의 완성도를 더욱 높여 시장의 호응을 받고 있습니다. 당사는 새로운 폴더블 시리즈의 진정한 대중화로 기존 노트 시리즈 이상의 판매량을 달성할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을
통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, Bixby 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 SmartThings를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 자연스러운 연결 경험을 체감할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, SmartThings,
Bixby, Cloud를 활용하고 당사의 방대한 글로벌 Installed-base 기반 서비스 사업 강화를 통해 수익 구조를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 갤럭시 S22 시리즈 이후 많은 과제에 사용하고 있습니다. '갤럭시 Z 폴드5' 및 '갤럭시 Z 플립5'에는 플라스틱 이외에도 재활용 글라스와 알루미늄을 적용하였습니다.

추가로, 당사는 2023년 5월 '자가 수리 프로그램'을 도입하고 대상 모델과 국가를 확대해 가는 등, E-waste를 최소화하여 환경에도 도움이 되고자 하였습니다.

2024년에도 당사는 갤럭시 S24 시리즈를 통해 모바일 시장을 선도해 나갈 계획입니다. 갤럭시 S24는 사람들 간의 소통에 있어서 언어의 장벽을 낮추고, 생산성과 창의성을 높이는 새로운 모바일 AI 경험을 제공할 것이며, 향후 폴더블을 포함한 플래그십 모델로 지속 확대해 나갈 것입니다. 그리고 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용 프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지 센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 파운드리 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 PC 및 모바일 제품의 고객사 완제품 재고 정상화와 함께 탑재량이 증가가 이어졌으며, Generative AI 관련 투자 확대로 수요 환경이 개선되었습니다. 추가적으로 가격 상승에 대한 시장 인식 확산 영향으로 전 응용처에 걸쳐 재고 확대를 위한 수요가 나타나는 모습을 보였습니다. 당사는 사업 조기 정상화를 위해 고부가가치 제품 확판 기조 아래 HBM(High Bandwidth Memory), DDR5(Double Data Rate 5), LPDDR5x, UFS4.0 등 선단 인터페이스 제품 판매를 대폭 확대하였고, 서버 수요 회복세에 적극 대응하여 Bit Growth(비트 단위로 환산한 생산량 증가율)가 시장 전망치를 대폭 상회하며 DRAM/NAND 재고 소진을 가속화하였습니다. 특히, DRAM 재고 수준이 큰 폭으로 개선되었습니다.

Foundry 시장은 글로벌 시장 수요 회복 지연에 따른 부진 장기화 등으로 주요 업체 대부분 업계 전망 대비 하회한 실적을 보였습니다. 2024년은 플래그십 스마트폰 출시에 따른 수요 증가와 AI 관련 고성능 컴퓨팅 수요 확대 등이 예측됨에 따라 점진적 회복을 기대하고 있습니다. 한편, 중장기는 안정적인 모바일 수요 및 전장향/AI 등 고성능 SOC의 수요 증가로 성장세가 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2023년	2022년	2021년
DRAM	42.2%	43.1%	43.0%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

2023년 상반기 메모리는 고객사 재고 조정에 따른 메모리 수요 약세가 지속되어 모든 공급사들이 생산량 조절을 하였습니다. 하반기는 공급사들의 감산 영향과 고객사들의 가격 저점 인식으로 인하여 일부 응용에서 수요 개선 움직임이 확인 되었으며, 고용량 DDR5 및 HBM의 수요는 하반기에도 지속되었습니다. 2024년 1분기에는 계절적 비수기 영향에도 불구하고 HBM과 DDR5/LPDDR5x 및 UFS4.0 등 선단 제품의 수요가 지속해서 견조할 것으로 전망됩니다. 반면, 공급 측면에서 선단 제품의 생산 증가폭이 제한적인 상황에서 이에 대한 고객사의 공급 요청이 지속될 것으로 전망됩니다. 이에, 당사는 선단 제품 수요 대응에 주력하는 가운데 Generative AI향 HBM
및 서버향 SSD 수요에 적극 대응하여 수익성 개선에 집중할 계획이며, 공급 제약 상황에서 진성 수요 위주 대응에 주력할 예정입니다.

System LSI는 2023년에도 스마트폰 수요 회복 지연 및 모바일 업계 재고 조정 지속되었으나, 하반기는 MX사 갤럭시향 부품 공급 및 중국 OEM 수요 개선으로 시황이 다소 회복되었으며, On-Device AI 적용 신제품 적기 개발, 고객과 협력 강화 및 응용처 다변화 등을 통해 극복해나가고 있습니다. SOC는 On-Device AI 및 Game UX가 향상된 고성능 IP를 탑재한 모바일 SOC 신제품 출시, 3나노 적용 제품 개발, 자동차향 SOC 등 제품 라인업 및 고객 확대 지속하고, 표준 위성 통신 서비스 상용화, 커넥티비티 제품 신규 시장 진입 추진 등 차세대 기술 개발도 지속 추진하고 있습니다. 이미지 센서는 당사 우위의 미세 픽셀 성능 기반으로 2억 화소의 고부가 제품군 시장에서 카메라 줌 성능 차별화로 시장을 선도하고 있으며, 스마트폰에 탑재되는 초고화소 이미지 센서의 활용 범위를 확대하는 한편, 자율 주행, XR 가상 현실 기기, 로봇 등 신시장을 겨냥하여 제품 라인업 다각화를 준비하고 있습니다.

Foundry는 2022년 하반기부터 이어지고 있는 침체된 시장 상황을 극복하고, 회복에 대비하여 사업 전 영역에서 대책을 준비하여 실행하고 있습니다. Advanced 노드는 지속적인 기술 경쟁력 강화를 통해 중장기 수요 확보에 집중하고 있으며, 중장기 수요 대응을 위한 공급 능력 확대도 지속 검토 및 준비하고 있습니다. Mature 노드는 공정 경쟁력 강화를 통해 고객 및 고수익 응용처 확대에 집중하고 있습니다. 특히, 고객 중심의 디자인 인프라를 제공하고, 고성능 컴퓨팅/전장향/5G/IoT 등 신규 분야로
포트폴리오 다각화를 진행하고 있으며, 스페셜티 공정을 활용한 제품을 개발/공급하고자 고객들과 협력하고 있습니다. 시장 회복은 더딘 상황이나, 당사의 경쟁력을 강화하고 고객과 지속 협력하여 입지를 견고히 함과 동시에 사업 확대를 위한 기반을 마련하겠습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수
나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2022년 13.8억대에서 2023년 14.4억대로 시장이 다소 회복되었습니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2022년 5.7억대에서 2023년 6.1억대로 증가하였으며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2022년 41.6%에서 2023년 42.7%로 소폭 상승하였습니다(출처: Omdia 2023.12).

대형 디스플레이 패널 시장은 2022년 9억대였으며, 2023년은 8억대로 시장이 축소되었습니다(출처: Omdia 2023.12).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2023년	2022년	2021년
스마트폰 패널	50.7%	56.7%	51.4%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블,태블릿, 워치, 노트북, AUTO 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블・IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2023년 디스플레이 시장은 글로벌 경기 부진이 지속되어 전체적인 수요 회복은 지연되고 있습니다. 또한 스마트폰 시장은 로우-미드엔드 시장과 하이엔드 시장의 양극화 추세를 보이고 있습니다. 당사는 상대적으로 수요가 견조한 하이엔드 시장에서 프리미엄급 OLED에 집중함으로서 견조한 실적을 달성하였습니다.

또한, 8.6G IT OLED라인 투자를 본격화 하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, Gaming, AUTO 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.

한편, 대형 디스플레이 사업은 모니터 비중을 증가시키는 한편 수율 향상, Loss 절감 등 내실을 강화하여 사업 경쟁력을 향상하였습니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서경쟁하고 있습니다. 이중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 자동차 제조사들은 Harman의 전장부품(디지털 콕핏, 카 오디오 등)을 활용하여 보다 편리하고 개인화된 맞춤경험을 제공하여 차별화하는데 주력하고 있습니다.

특히, 차량의 IT 기기화에 따른 SDV(Software Defined Vehicle)로의 변화로 인해, 자동차 제조사들은 중앙집중형 아키텍쳐의 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 변화를 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 기술 변화에 따른 업체간 경쟁은 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거에 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술이 적용되고 AI(Artificial Intelligence)가 탑재되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 변화에 따라, 사운드 재생 기술을 보유한 전통적인 오디오 업체들로 구성된 소비자 오디오 시장에 IT 업체들이 진입하여 경쟁하고 있습니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Wifi Home 스피커 및 게이밍 스피커 분야에서 고성장이 예상되며, 특히 휴대폰 제조사가 높은 시장점유율을 차지하고 있는 TWS 분야는 가장 성장률이 높을 것으로 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용・대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 경쟁하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

미・중 원자재 공급망 불안 등으로 어려움이 지속되고 있고, 자동차 노조의 파업은 북미 자동차 공급시장에 추가적인 부담을 주었습니다. 또한, 세계 각국 중앙은행이 인플레이션에 대응하기 위해 추가적인 긴축 정책을 시행하는 등 거시경제의 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들을 감안하였을때 2024년 전세계 자동차 생산은 2023년 수준과 유사할것으로 예상됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2023.12).

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2023년	2022년	2021년
디지털 콕핏	16.5%	17.9%	15.0%

※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsignts의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
※ 2023년부터 디지털 콕핏의 고부가가치화를 반영하여 금액 기준으로 변경함에 따라 2022년과 2021년의 시장점유율도 재작성하였습니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 Harman으로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 강화하는데 지속적으로
도움이 될 것입니다.

또한 Harman은 Digital Transformation Solutions 사업을 지속적으로 발전시켜 왔습니다. DTS는 기업 고객을 대상으로 소프트웨어 솔루션 개발, 시스템 통합 및 유지보수 서비스를 제공하여 기업 고객의 경쟁력을 강화하는 사업을 진행하고 있습니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2023년(제55기) 매출은 DX 부문이 169조 9,923억원(65.7%), DS 부문이 66조 5,945억원(25.7%)이며, SDC가 30조 9,754억원(12.0%), Harman은 14조 3,885억원(5.6%)입니다.

2023년(제55기) 영업이익은 DX 부문이 14조 3,847억원, DS 부문이 △14조 8,795억원, SDC가 5조 5,665억원, 그리고 Harman은 1조 1,737억원입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제55기		제54기		제53기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	1,699,923	65.7%	1,824,897	60.4%	1,662,594	59.5%
	영업이익	143,847	219.0%	127,461	29.4%	173,866	33.7%
	총자산	2,342,534	37.2%	2,279,669	38.6%	2,479,832	42.0%
DS 부문	매출액	665,945	25.7%	984,553	32.6%	953,872	34.1%
	영업이익	△148,795	△226.6%	238,158	54.9%	291,920	56.5%
	총자산	2,871,411	45.6%	2,620,558	44.3%	2,258,223	38.3%
SDC	매출액	309,754	12.0%	343,826	11.4%	317,125	11.3%
	영업이익	55,665	84.8%	59,530	13.7%	44,574	8.6%
	총자산	792,752	12.6%	737,798	12.5%	668,836	11.3%
Harman	매출액	143,885	5.6%	132,137	4.4%	100,399	3.6%
	영업이익	11,737	17.9%	8,805	2.0%	5,991	1.2%
	총자산	179,566	2.9%	171,023	2.9%	158,874	2.7%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

・공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품・모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품・모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
・공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제55기	제54기	제53기
	2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	195,936,557	218,470,581	218,163,185
· 현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710	39,031,415
· 단기금융상품	22,690,924	65,102,886	81,708,986
· 기타유동금융자산	635,393	443,690	3,409,791
· 매출채권	36,647,393	35,721,563	40,713,415
· 재고자산	51,625,874	52,187,866	41,384,404
· 기타	15,256,080	15,333,866	11,915,174
[비유동자산]	259,969,423	229,953,926	208,457,973
· 기타비유동금융자산	8,912,691	12,802,480	15,491,183
· 관계기업 및 공동기업 투자	11,767,444	10,893,869	8,932,251
· 유형자산	187,256,262	168,045,388	149,928,539
· 무형자산	22,741,862	20,217,754	20,236,244
· 기타	29,291,164	17,994,435	13,869,756
자산총계	455,905,980	448,424,507	426,621,158
[유동부채]	75,719,452	78,344,852	88,117,133
[비유동부채]	16,508,663	15,330,051	33,604,094
부채총계	92,228,115	93,674,903	121,721,227
[지배기업 소유주지분]	353,233,775	345,186,142	296,237,697
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	346,652,238	337,946,407	293,064,763
· 기타	1,280,130	1,938,328	△2,128,473
[비지배지분]	10,444,090	9,563,462	8,662,234
자본총계	363,677,865	354,749,604	304,899,931
	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월
매출액	258,935,494	302,231,360	279,604,799
영업이익	6,566,976	43,376,630	51,633,856
연결총당기순이익	15,487,100	55,654,077	39,907,450
· 지배기업 소유주지분	14,473,401	54,730,018	39,243,791
· 비지배지분	1,013,699	924,059	663,659
기본주당순이익(단위 : 원)	2,131	8,057	5,777
희석주당순이익(단위 : 원)	2,131	8,057	5,777
연결에 포함된 회사수	233개	233개	229개

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제53기~제55기 연결감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제55기	제54기	제53기
	2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	68,548,442	59,062,658	73,553,416
・현금및현금성자산	6,061,451	3,921,593	3,918,872
・단기금융상품	50,071	137	15,000,576
・매출채권	27,363,016	20,503,223	33,088,247
・재고자산	29,338,151	27,990,007	15,973,053
・기타	5,735,753	6,647,698	5,572,668
[비유동자산]	228,308,847	201,021,092	177,558,768
・기타비유동금융자산	1,854,504	1,364,608	1,664,667
・종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,392,438	57,397,249	56,225,599
・유형자산	140,579,161	123,266,986	103,667,025
・무형자산	10,440,211	8,561,424	8,657,456
・기타	18,042,533	10,430,825	7,344,021
자산총계	296,857,289	260,083,750	251,112,184
[유동부채]	41,775,101	46,086,047	53,067,303
[비유동부채]	30,294,414	4,581,512	4,851,149
부채총계	72,069,515	50,667,559	57,918,452
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	219,963,351	204,388,016	188,774,335
[기타]	△476,984	△273,232	△882,010
자본총계	224,787,774	209,416,191	193,193,732
종속・관계・공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월
매출액	170,374,090	211,867,483	199,744,705
영업이익(손실)	△11,526,297	25,319,329	31,993,162
당기순이익	25,397,099	25,418,778	30,970,954
기본주당순이익(단위 : 원)	3,739	3,742	4,559
희석주당순이익(단위 : 원)	3,739	3,742	4,559

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제53기~제55기 감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 55 기 2023.12.31 현재

제 54 기 2022.12.31 현재

제 53 기 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
자산			
유동자산	195,936,557	218,470,581	218,163,185
현금및현금성자산 (주4,28)	69,080,893	49,680,710	39,031,415
단기금융상품 (주4,28)	22,690,924	65,102,886	81,708,986
단기상각후원가금융자산 (주4,28)	608,281	414,610	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	27,112	29,080	40,757
매출채권 (주4,5,7,28)	36,647,393	35,721,563	40,713,415
미수금 (주4,7,28)	6,633,248	6,149,209	4,497,257
선급비용	3,366,130	2,867,823	2,336,252
재고자산 (주8)	51,625,874	52,187,866	41,384,404
기타유동자산 (주4,28)	5,038,838	6,316,834	5,081,665
매각예정분류자산 (주33)	217,864	0	0
비유동자산	259,969,423	229,953,926	208,457,973
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,6,28)	7,481,297	11,397,012	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	1,431,394	1,405,468	1,525,344
관계종속기업투자자산-지분법 (주9)	11,767,444	10,893,869	8,932,251
유형자산 (주10)	187,256,262	168,045,388	149,928,539
무형자산 (주11)	22,741,862	20,217,754	20,236,244
순확정급여자산 (주14)	4,905,219	5,851,972	2,809,590
이연법인세자산 (주25)	10,211,797	5,101,318	4,261,214
기타비유동자산 (주4,7,28)	14,174,148	7,041,145	6,798,952
자산총계	455,905,980	448,424,507	426,621,158
부채			
유동부채	75,719,452	78,344,852	88,117,133
매입채무 (주4,28)	11,319,824	10,644,686	13,453,351
단기차입금 (주4,5,12,28)	7,114,601	5,147,315	13,687,793
미지급금 (주4,28)	15,324,119	17,592,366	15,584,866
선수금 (주17)	1,492,602	1,314,934	1,224,812
예수금 (주4,28)	892,441	1,298,244	1,294,052
미지급비용 (주4,17,28)	26,013,273	29,211,487	27,928,031
당기법인세부채	3,358,715	4,250,397	6,749,149
유동성장기부채 (주4,12,13,28)	1,308,875	1,089,162	1,329,968
충당부채 (주15)	6,524,876	5,844,907	5,372,872
기타 유동부채 (주4,17,28)	2,308,472	1,951,354	1,492,239
매각예정분류부채 (주33)	61,654	0	0
비유동부채	16,508,663	15,330,051	33,604,094
사채 (주4,13,28)	537,618	536,093	508,232

장기차입금 (주4,12,28)	3,724,850	3,560,672	2,866,156
장기미지급금 (주4,28)	5,488,283	2,753,305	2,991,440
순확정급여부채 (주14)	456,557	268,370	465,884
이연법인세부채 (주25)	620,549	5,111,332	23,198,205
장기충당부채 (주15)	2,878,450	1,928,518	2,306,994
기타 비유동 부채 (주4,17,28)	2,802,356	1,171,761	1,267,183
부채총계	92,228,115	93,674,903	121,721,227
자본			
지배기업 소유주지분	353,233,775	345,186,142	296,237,697
자본금 (주18)	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주19)	346,652,238	337,946,407	293,064,763
기타자본항목 (주20,33)	1,280,130	1,938,328	(2,128,473)
비지배지분 (주31)	10,444,090	9,563,462	8,662,234
자본총계	363,677,865	354,749,604	304,899,931
자본과부채총계	455,905,980	448,424,507	426,621,158

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
영업수익 (주29)	258,935,494	302,231,360	279,604,799
매출원가 (주21)	180,388,580	190,041,770	166,411,342
매출총이익	78,546,914	112,189,590	113,193,457
판매비와관리비 (주21,22)	71,979,938	68,812,960	61,559,601
영업이익 (주29)	6,566,976	43,376,630	51,633,856
기타이익 (주23)	1,180,448	1,962,071	2,205,695
기타손실 (주23)	1,083,327	1,790,176	2,055,971
지분법이익 (주9)	887,550	1,090,643	729,614
금융수익 (주24)	16,100,148	20,828,995	8,543,187
금융비용 (주24)	12,645,530	19,027,689	7,704,554
법인세비용차감전순이익(손실)	11,006,265	46,440,474	53,351,827
법인세비용(수익) (주25)	(4,480,835)	(9,213,603)	13,444,377
계속영업이익(손실)	15,487,100	55,654,077	39,907,450
당기순이익(손실)	15,487,100	55,654,077	39,907,450
당기순이익(손실)의 귀속			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,473,401	54,730,018	39,243,791
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,013,699	924,059	663,659
주당이익 (주26)			
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,131.0	8,057.0	5,777.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,131.0	8,057.0	5,777.0

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
당기순이익(손실)	15,487,100	55,654,077	39,907,450
기타포괄손익(*4)	3,350,311	4,005,664	10,002,299
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	665,943	(822,137)	2,508,106
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	1,481,091	(1,969,498)	2,980,896
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	13,150	(6,318)	51,816
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	(828,298)	1,153,679	(524,606)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,684,368	4,827,801	7,494,193
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	61,962	(44,192)	160,163
해외사업장환산외환차이 (주20)	2,621,479	4,884,886	7,283,620
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)	927	(12,893)	50,410
총포괄손익(*3)	18,837,411	59,659,741	49,909,749
포괄손익의 귀속			
지배기업 소유주지분	17,845,661	58,745,107	49,037,912
비지배지분	991,750	914,634	871,837

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계		
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	271,068,211	(8,687,155)	(12,132)	267,670,331	8,277,685	275,948,016
당기순이익(손실)			39,243,791			39,243,791	663,659	39,907,450
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)			3,232,934	(359,117)		2,873,817	107,079	2,980,896
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)				225,464		225,464	(13,485)	211,979
해외사업장환산외환차이 (주20)				7,164,982		7,164,982	118,638	7,283,620
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)				(520,552)		(520,552)	(4,054)	(524,606)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)				50,410		50,410		50,410
매각예정분류				(12,132)	12,132			
배당 (주19)			(20,480,721)			(20,480,721)	(32,005)	(20,512,726)
연결실체내 자본거래 등							12,553	12,553
연결실체의 변동							(477,617)	(477,617)
기타			548	9,627		10,175	9,781	19,956
2021.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)		296,237,697	8,662,234	304,899,931
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)		296,237,697	8,662,234	304,899,931
당기순이익(손실)			54,730,018			54,730,018	924,059	55,654,077
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)			(38,937)	(1,867,530)		(1,906,467)	(63,031)	(1,969,498)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)				(51,848)		(51,848)	1,338	(50,510)
해외사업장환산외환차이 (주20)				4,863,930		4,863,930	20,956	4,884,886
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)				1,122,367		1,122,367	31,312	1,153,679
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)				(12,893)		(12,893)		(12,893)
매각예정분류								
배당 (주19)			(9,809,437)			(9,809,437)	(5,523)	(9,814,960)
연결실체내 자본거래 등							(176)	(176)
연결실체의 변동							124	124
기타				12,775		12,775	(7,831)	4,944
2022.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328		345,186,142	9,563,462	354,749,604
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328		345,186,142	9,563,462	354,749,604
당기순이익(손실)			14,473,401			14,473,401	1,013,699	15,487,100
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)			4,041,867	(2,554,690)		1,487,177	(6,086)	1,481,091
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)				70,157		70,157	4,955	75,112
해외사업장환산외환차이 (주20)				2,611,915		2,611,915	9,564	2,621,479
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)				(797,916)		(797,916)	(30,382)	(828,298)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)				927		927		927
매각예정분류								
배당 (주19)			(9,809,437)			(9,809,437)	(101,984)	(9,911,421)
연결실체내 자본거래 등							(9,368)	(9,368)
연결실체의 변동							230	230
기타				11,409		11,409		11,409
2023.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130		353,233,775	10,444,090	363,677,865

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
영업활동현금흐름	44,137,427	62,181,346	65,105,448
영업에서 창출된 현금흐름	46,547,889	71,728,568	72,676,199
당기순이익	15,487,100	55,654,077	39,907,450
조정 (주27)	36,519,534	33,073,439	49,055,633
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)	(5,458,745)	(16,998,948)	(16,286,884)
이자의 수취	4,786,010	2,136,795	1,406,706
이자의 지급	(844,691)	(714,543)	(434,441)
배당금 수입	269,169	529,421	299,033
법인세 납부액	(6,620,950)	(11,498,895)	(8,842,049)
투자활동현금흐름	(16,922,817)	(31,602,804)	(33,047,763)
단기금융상품의 순감소(증가)	39,421,565	15,214,321	10,917,128
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	(195,616)	3,050,104	(336,959)
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	2,718	11,677	30,694
장기금융상품의 처분	4,565,426	8,272,909	10,216,082
장기금융상품의 취득	(5,307,770)	(4,393,754)	(6,981,810)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	6,521,568	496,090	2,919,888
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(124,488)	(37,687)	(1,121,201)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	63,962	166,315	350,212
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(130,459)	(158,244)	(208,262)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	33,457	13,233	19,169
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(78,690)	(907,958)	(47,090)
유형자산의 처분	98,341	217,878	358,284
유형자산의 취득	(57,611,292)	(49,430,428)	(47,122,106)
무형자산의 처분	11,744	23,462	1,752
무형자산의 취득	(2,922,875)	(3,696,304)	(2,706,915)
사업결합으로 인한 현금유출액	(356,511)	(31,383)	(5,926)
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	661,168
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(913,897)	(413,035)	8,129
재무활동현금흐름	(8,593,059)	(19,390,049)	(23,991,033)
단기차입금의 순증가(감소) (주27)	2,145,400	(8,339,149)	(2,616,943)
장기차입금의 차입 (주27)	354,712	271,997	58,279
사채 및 장기차입금의 상환 (주27)	(1,219,579)	(1,508,465)	(894,749)
배당금의 지급	(9,864,474)	(9,814,426)	(20,510,350)
비지배지분의 증감	(9,118)	(6)	(27,270)
매각예정분류 (주33)	(14,153)	0	139
외화환산으로 인한 현금의 변동	792,785	(539,198)	1,582,046
현금및현금성자산의순증감	19,400,183	10,649,295	9,648,837
기초현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415	29,382,578
기말현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710	39,031,415

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

보고기업의 명칭 또는 그 밖의 식별 수단

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 통신시스템등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 232개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 37개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

전체 종속기업
종속기업

당기 (단위 : 백만원)

	전체 종속기업																										
	종속기업																										
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Harman 과 그 종속기업	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	세메스㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics GmbH (SEG)	Samsung International, Inc. (SII)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)
자산	65,328,568	41,926,899	22,234,942	17,956,557	16,714,945	15,808,283	12,796,440	12,554,481	10,222,557	9,660,481	7,738,259	7,383,485	7,301,860	5,542,627	5,262,086	4,043,677	3,039,379	2,902,722	2,187,919	2,153,032	2,097,706	1,879,442	1,797,627	1,794,552	1,639,004		
부채	7,266,213	15,322,780	282,614	6,009,675	7,791,914	870,453	6,276,293	3,593,527	8,797,991	4,585,806	3,373,730	1,570,459	2,215,062	1,587,911	4,552,030	843,736	640,512	1,976,067	659,607	1,038,115	2,033,152	383,763	1,139,056	639,120	1,443,005		
영업수익	27,083,336	39,551,809	0	14,367,766	4,109,744	8,693,788	23,465,031	30,639,349	3,148,858	0	15,216,331	24,200,246	20,154,119	7,222,304	15,649,307	6,152,983	4,213,492	5,859,133	2,502,143	3,638,080	6,374,670	6,553,383	4,108,479	2,833,717	15,462,852		
당기순이익(손실)	8,268,314	477,338	14,140,195	896,384	301,778	877,892	136,458	2,240,480	189,887	103,387	1,153,256	1,143,824	1,476,382	333,812	244,210	402,418	150,510	185,113	58,754	148,873	(3,157)	141,226	56,467	140,313	4,984		

종속기업의 요약재무정보 작성기준에 대한 기술				(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.																						

전기

(단위 : 백만원)

	전체 종속기업																										
	종속기업																										
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Harman 과 그 종속기업	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	세메스㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics GmbH (SEG)	Samsung International, Inc. (SII)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)
자산	57,302,567	37,883,156	26,894,611	17,102,324	9,301,017	17,095,000	12,199,102	15,718,299	13,830,988	10,841,515	6,772,537	7,471,680	10,931,037	4,600,508	5,067,891	3,732,057	3,263,473	2,819,792	2,065,558	1,816,895	1,968,273			2,377,730	2,194,975	2,374,317	2,135,132
부채	7,282,718	12,258,315	2,678,285	6,380,456	828,494	2,970,835	5,930,369	2,358,140	9,764,636	6,272,800	3,571,863	1,608,448	1,408,387	1,342,517	2,858,382	980,448	486,820	1,708,064	602,323	996,002	1,907,132			597,044	2,021,491	452,628	265,835
영업수익	30,779,405	46,738,920	0	13,211,151	3,663,909	9,679,757	43,009,331	36,336,963	2,865,831	0	16,180,492	25,773,970	23,667,565	7,485,104	21,370,622	6,253,401	4,824,734	5,929,357	2,889,238	3,270,016	6,567,011			2,834,008	15,409,984	3,935,745	2,556,608
당기순이익(손실)	4,365,588	219,670	8,699,679	631,019	208,879	638,385	88,467	2,721,701	257,878	57,997	508,510	1,301,926	1,646,165	(38,490)	318,578	386,119	168,524	243,396	185,762	110,386	3,695			25,411	20,347	199,742	111,643
종속기업의 요약재무정보 작성기준에 대한 기술				(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.																						

종속기업의 요약재무정보 작성기준에 대한 추가 설명

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

2. 중요한 회계처리방침 (연결)

유의적인 회계정책 공시

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

재무제표 작성기준에 대한 공시

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회(""IASB"")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

	기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시	기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의	기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세	기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙'	최초 적용하는 IFRS 합계
최초 적용하는 IFRS 명칭	- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정	- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정	- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정	
최초 적용하는 IFRS의 경과규정에 대한 기술	공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 또한 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다.	회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다.	자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래 당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다.	경제협력개발기구(OECD)가 발표한 필라2 모범규칙을 시행하기 위하여 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법 등에서 생기는 법인세에 기업회계기준서 제1012호 '법인세'를 적용한다는 점을 명확히 합니다.	

최초 적용하는 IFRS의 경과규정에 따른 회계정책의 변경 여부에 대한 기술	이 개정사항은 회계정책의 변경을 수반하는 것은 아니지만, 연결재무제표에 공시되는 회계정책 정보에 영향을 미칩니다. 연결회사는 해당 기준서 개정내용에 따라 주석2에서 연결회사의 중요한 회계정책 정보를 설명하고 있습니다.	해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.	해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.	다만 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 이연법인세 회계처리 요구사항에 한시적 예외 규정을 도입하여 필라2 법인세와 관련되는 이연법인세자산 및 부채를 인식하지 아니하고 이에 대한 정보도 공시하지 아니합니다.	가. 연결회사가 채택한 제・개정 기준서 연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정	기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정	새로운 IFRSs 합계
새로운 한국채택국제회계기준의 명칭	- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정	- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정	

예정된 회계정책의 변경의 성격에 대한 기술	보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사 가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.	기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정리스료'를 산정하도록 요구합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.	동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 동 개정사항에는 최초로 적용하는 회계연도에 대한 구체적인 경과 규정을 포함합니다. 또한 조기적용이 허용됩니다.	나. 연결회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서 제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 연결회사가 조기적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.
새로운 한국채택국제회계기준의 의무적용일	2024-01-01	2024-01-01	2024-01-01	

전기 (단위 : 백만원)

	기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정	기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정	새로운 IFRSs 합계

새로운 한국채택국제회계기준의 명칭				
예정된 회계정책의 변경의 성격에 대한 기술				
새로운 한국채택국제회계기준의 의무적용일				

연결기준에 대한 공시

2.3 연결

연결회사는 기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

가. 비지배지분

당기순손익과 기타포괄손익의 각 구성요소는 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속되며, 비지배지분이 부(-)의 잔액이 되더라도 총포괄손익은 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속시키고 있습니다.

나. 내부거래 제거

연결회사 내의 거래, 이와 관련된 잔액, 수익과 비용, 미실현손익(외환차손익제외)은 연결재무제표 작성시 모두 제거하고 있습니다. 한편, 연결회사는 지분법피투자기업과의 거래에서 발생한 미실현이익 중 연결실체의 몫을 제거하고 있으며, 미실현손실은 자산손상의 증거가 없다면 미실현이익과 동일한 방식으로 제거하고 있습니다.

외화거래의 회계정책에 대한 기술

2.4 외화환산

가. 기능통화와 표시통화

연결회사는 연결회사 내 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 지배회사의 기능통화는 대한민국 원화(KRW)이며 연결재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

나. 표시통화로의 환산

연결회사의 표시통화와 다른 기능통화를 가진 모든 연결회사 내 개별기업의 경영성과와 재무상태는 다음과 같은 방법으로 연결회사의 표시통화로 환산되고 있습니다.

(1) 자산과 부채는 보고기간종료일의 마감환율로 환산되고 있습니다.
(2) 손익계산서의 수익과 비용은 해당 기간의 평균환율로 환산되고 있습니다.
다만, 이러한 평균환율이 거래일의 전반적인 누적환율효과에 대한 합리적인 근사치가 아닐 경우에는 해당 거래일의 환율로 환산되고 있습니다.
(3) 위 (1), (2)의 환산에서 발생하는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식됩니다.

현금 및 현금성자산 구성요소 결정의 회계정책에 대한 기술

2.5 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기투자자산으로 구성되어 있습니다.

금융자산의 회계정책에 대한 기술

2.6 금융자산

가. 분류

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다. 계약상 현금흐름이 원금과 이자에 대한 지급만으로 이루어져 있는지를 평가할 때, 연결회사는 해당 상품의 계약조건을 고려합니다.

나. 손상
연결회사는 미래 전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을
적용합니다.

매출채권 및 기타채권의 회계정책에 대한 기술

2.7 매출채권

매출채권은 유의적인 금융요소를 포함하는 경우를 제외하고는 최초에 거래가격으로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 손실충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

재고자산 측정의 회계정책에 대한 기술

2.8 재고자산

연결회사는 미착품을 제외하고는 재고자산의 단위원가를 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유휴 생산설비 원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다.

연결회사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액으로, 판가의 하락 또는 완성시까지의 원가 상승을 반영하는 저가법 평가와 재고의 과잉 또는 진부화로 인한 가치의 하락을 반영하는 과잉/진부화평가의 2가지 평가방법을 적용합니다.

유형자산의 회계정책에 대한 기술

2.9 유형자산

연결회사는 제품의 생산 등 자산을 경영진이 의도한 목적으로 사용할 수 있게 되었다고 판단된 시점을 기준으로 감가상각을 개시하고 있습니다

연결회사의 유형자산은 취득원가에서 잔존가액을 차감한 금액이 연결회사가 추정한 추정내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련 자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

자산별로 연결회사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

	유형자산								
	건물 및 구축물			기계장치			기타		
	범위		범위 합계	범위 합계		범위 합계	범위 합계		범위 합계
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		하위범위	상위범위	
추정내용연수	15년	30년				5년			5년
감가상각방법, 유형자산			정액법			정액법			정액법

무형자산 및 영업권의 회계정책에 대한 기술

2.10 무형자산

영업권은 취득 시점에 취득하는 종속기업, 관계기업 및 공동기업, 사업 등의 식별가능한 순자산 중 연결회사의 지분에 해당하는 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며 종속기업의 사업취득과 관련된 건은 무형자산으로, 관계기업 및 공동기업의 지분 취득과 관련한 건은 관계기업 및 공동기업 투자에 포함하여 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

회원권 및 특정 상표권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 하지만 회원권의 시장가치 하락 등 손상 징후 발견 시 합리적으로 추정하여 손상을 반영합니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

	영업권 이외의 무형자산		
	특허권, 상표권 및 기타무형자산		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
추정내용연수	3년	25년	
상각방법, 영업권 이외의 무형자산			정액법

금융부채의 회계정책에 대한 기술

2.11 금융부채

연결회사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 연결재무상태표에 인식하고 있습니다.

종업원급여의 회계정책에 대한 기술

2.12 종업원급여

연결회사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 연결재무상태표에 계상된 부채(자산)는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 과소적립액(자산인식상한을 한도로 하는 초과적립액)이며, 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다.

법인세의 회계정책에 대한 기술

2.13 법인세비용

연결회사는 필라2 규칙과 관련되는 이연법인세의 인식 및 공시에 대한 예외 규정을 적용하고 있습니다. 또한, 관련 법률이 2024년 1월 1일부터 시행될 예정이므로 보고기간 중 연결회사가 인식한 필라2 관련 당기법인세비용은 없습니다.

연결회사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

파생금융상품의 회계정책에 대한 기술

2.14 파생상품

연결회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피 금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

수익인식 회계정책에 대한 기술

2.15 수익인식

연결회사의 수익은 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액에서 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액 등을 차감한 순액으로 표시하고 있습니다.

(1) 수행의무의 식별

연결회사는 고객과의 계약에 따라 재화 및 용역에 대한 통제를 이전할 의무가 있습니다. 연결회사가 Incoterms Group C 조건(무역조건 CIF 등)에 따라 제품 및 상품을 수출하는 경우, 고객에게 재화의 통제가 이전된 이후 제공하는 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 한시점에 이행하는 수행의무

연결회사의 수익은 주로 재화의 판매에서 발생하고 있으며, 재화의 통제가 고객에게 이전되는 시점에 수익을 인식하고 있습니다.

(3) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하게 되는 S/W판매, 운송용역, 설치용역 등의 경우, 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 변동대가

연결회사는 인센티브, 판매장려금, 매출에누리 등 다양한 판매촉진 정책을 운영하고 있습니다. 이러한 판매촉진 정책으로 인해 고객과 약속한 대가에 변동가능성이 있는 경우, 고객으로부터 이미 받았거나 받을 대가 중 권리를 갖지 않을 것으로 예상하는 금액(변동대가)을 기대값 또는 가능성이 가장 높은 금액 중 보다 신뢰성 있는 방법으로 추정하고 있습니다. 변동대가의 추정치는 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하며, 관련 매출이 발생한 시점과 고객에게 변동대가를 지급하기로 결정한 시점 중 늦은 시점에 수익 및 계약부채를 인식합니다.

연결회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대해 경험률에 기초한 기대값 방법으로 반품율을 예측하여 계약부채(환불부채)를 인식하고 있습니다. 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

리스의 회계정책에 대한 기술

2.16 리스

(1) 리스이용자

연결회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 실무적 간편법을 적용하여, 계약에서리스요소와 리스가 아닌 요소(이하 "비리스요소")를 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련된 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

연결회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 연결재무상태표에 '유형자산'으로 분류하며, 리스부채는 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하며, 연결회사는 현재가치 측정시 연결회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하)와 소액자산 리스(기초자산 US$ 5,000 이하)의 경우 실무적 간편법을 적용하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자

리스제공자로서 연결회사는 리스약정일에 리스가 금융리스인지 운용리스인지 판단합니다.

연결회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는
리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약 단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

정부보조금에 대한 회계정책에 대한 기술

2.17 정부보조금

수익과 관련된 정부보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 수익 또는 비용과 대응될 수 있는 기간에 연결손익계산서에 인식하고 있습니다. 한편, 특정 자산의 취득과 관련된 정부보조금은 이연수익으로 처리하고, 관련 자산의 내용연수 동안 상각하여 손익으로 반영하고 있습니다.

재무제표의 승인에 대한 공시

2.18 연결재무제표의 승인

연결회사의 연결재무제표는 2024년 1월 31일 이사회에서 승인되었으며, 향후 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

	중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 자산과 부채에 관한 설명
다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험에 대한 기술	연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.
다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 자산의 성격에 대한 기술	다. 금융상품의 공정가치 연결회사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다. 라. 금융자산의 손상 연결회사는 금융자산의 손실충당금을 측정할 때에 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 연결회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간종료일의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다. 사. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 연결회사는 매년 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위 또는 자산의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 부채의 성격에 대한 기술	나. 판매보증충당부채 연결회사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 매 보고기간종료일 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는 과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다. 바. 순확정급여부채(자산) 순확정급여부채(자산)는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채(자산)의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 연결회사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채(자산)의 정산 시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용되어야 하는 이자율을 나타냅니다. 순확정급여부채(자산)와 관련된 주요한 가정들 중 일부는 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 기타 항목의 성격에 대한 기술	가. 수익인식 연결회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기대값 방법으로 반품률을 예측하고 있으며, 연결회사의 수익은 예측된 반품률의 변동에 영향을 받습니다. 연결회사는 재화의 판매로 인한 수익을 통제가 이전되는 시점에 계약에 따른 대가에서 특정 매출장려활동을 차감한 금액으로 인식하고 있습니다. 과거의 경험 및 계약에 기초하여 매출차감액을 합리적으로 추정하고 있으며, 연결회사의 수익은 추정된 매출차감에 영향을 받습니다. 마. 리스 연결회사는 리스기간을 산정할 때에 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다. 선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연결회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다. 아. 법인세 연결회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 연결회사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산・부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산・부채에 영향을 줄 수 있습니

	다. 연결회사는 특정 기간 동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 연결회사는 법인세 처리의 불확실성 여부를 검토하고 있으며, 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높지 않다고 결론 내리는 경우에는 불확실한 법인세 처리 각각에 다음 방법 가운데 불확실성의 해소를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 불확실성의 영향을 연결재무제표에 반영하고 있습니다. (1) 가능성이 가장 높은 금액: 가능한 결과치 범위에서 가능성이 가장 높은 단일금액 (2) 기대값: 가능한 결과치의 범위에 있는 모든 금액에 각 확률을 곱한 금액의 합

4. 범주별 금융상품 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

			금융자산, 범주				
			상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타금융자산	계
금융자산			143,321,745	7,481,297	1,933,750	70,777	152,807,569
금융자산	금융자산, 분류	현금및현금성자산	69,080,893	0	0	0	69,080,893
		단기금융상품	22,690,924	0	0	0	22,690,924
		단기상각후원가금융자산	608,281	0	0	0	608,281
		단기당기손익-공정가치금융자산	0	0	27,112	0	27,112
		매출채권	36,647,393	0	0	0	36,647,393
		기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	0	7,481,297	0	0	7,481,297
		당기손익-공정가치금융자산	0	0	1,431,394	0	1,431,394
		기타	14,294,254	0	475,244	70,777	14,840,275

전기 (단위 : 백만원)

			금융자산, 범주				
			상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타금융자산	계
금융자산			160,864,978	11,397,012	1,768,811	61,404	174,092,205

금융자산	금융자산, 분류	현금및현금성자산	49,680,710	0	0	0	49,680,710
		단기금융상품	65,102,886	0	0	0	65,102,886
		단기상각후원가금융자산	414,610	0	0	0	414,610
		단기당기손익-공정가치금융자산	0	0	29,080	0	29,080
		매출채권	35,721,563	0	0	0	35,721,563
		기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	0	11,397,012	0	0	11,397,012
		당기손익-공정가치금융자산	0	0	1,405,468	0	1,405,468
		기타	9,945,209	0	334,263	61,404	10,340,876

당기 및 전기 기타금융자산에 대한 각주

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

			금융부채, 범주			
			상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채	계
금융부채			42,907,245	49,904	11,366,897	54,324,046
금융부채	금융부채, 분류	매입채무	11,319,824	0	0	11,319,824
		단기차입금	504,552	0	6,610,049	7,114,601
		단기미지급금	13,996,395	0	0	13,996,395
		유동성장기부채	310,436	0	998,439	1,308,875
		사채	537,618	0	0	537,618
		장기차입금	0	0	3,724,850	3,724,850
		장기미지급금	4,907,875	0	0	4,907,875
		기타	11,330,545	49,904	33,559	11,414,008

전기 (단위 : 백만원)

			금융부채, 범주			
			상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채	계
금융부채			43,672,960	334,415	7,997,555	52,004,930
금융부채	금융부채, 분류	매입채무	10,644,686	0	0	10,644,686
		단기차입금	1,577,958	0	3,569,357	5,147,315
		단기미지급금	16,328,237	0	0	16,328,237
		유동성장기부채	215,143	0	874,019	1,089,162
		사채	536,093	0	0	536,093
		장기차입금	33,846	0	3,526,826	3,560,672
		장기미지급금	2,289,236	0	0	2,289,236
		기타	12,047,761	334,415	27,353	12,409,529

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을
포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타금융자산	금융자산, 범주 합계
평가손익(기타포괄손익)	0	1,481,091	0	58,290	1,539,381
평가・처분손익(당기손익)	(64,758)	0	213,308	436	148,986
평가손익(손익대체)	0	0	0	1,169	1,169
이자수익	4,357,792	0	230	0	4,358,022
외환차이(당기손익)	(98,522)	0	0	0	(98,522)
배당금수익	0	161,509	2,694	0	164,203
손상(환입)	(74,594)	0	0	0	(74,594)

전기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타금융자산	금융자산, 범주 합계
평가손익(기타포괄손익)	0	(1,969,498)	0	53,180	(1,916,318)
평가・처분손익(당기손익)	(36,550)	0	83,332	474	47,256
평가손익(손익대체)	0	0	0	310	310
이자수익	2,720,213	0	266	0	2,720,479
외환차이(당기손익)	(822,011)	0	0	0	(822,011)
배당금수익	0	413,467	1,134	0	414,601
손상(환입)	(19,124)	0	0	0	(19,124)

당기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
평가손익(기타포괄손익)	0	0	(16,809)	(16,809)
평가・처분손익(당기손익)	0	(116,167)	(126)	(116,293)
평가손익(손익대체)	0	0	(337)	(337)
이자비용	(510,865)	0	(419,388)	(930,253)

외환차이(당기손익)	162,844	0	61,920	224,764

전기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
평가손익(기타포괄손익)	0	0	(10,621)	(10,621)
평가・처분손익(당기손익)	0	(91,056)	(45)	(91,101)
평가손익(손익대체)	0	0	59	59
이자비용	(322,529)	0	(440,486)	(763,015)
외환차이(당기손익)	574,771	0	155,952	730,723

5. 금융자산의 양도 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	매출채권
할인된 매출채권의 장부금액	6,610,049
관련 차입금의 장부금액	6,610,049
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채과의 관계의 성격에 대한 기술	연결회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 연결재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술	(*) 할인된 매출채권에는 연결회사 간의 매출채권이 포함되어 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	매출채권
할인된 매출채권의 장부금액	3,569,357
관련 차입금의 장부금액	3,569,357

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채과의 관계의 성격에 대한 기술	연결회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 연결재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술	(*) 할인된 매출채권에는 연결회사 간의 매출채권이 포함되어 있습니다.

6. 공정가치금융자산 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	7,481,297

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	11,397,012

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주		금융자산, 범주 합계
	당기손익인식금융자산		
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익인식금융자산	27,112		27,112
비유동 당기손익인식금융자산	619,036	812,358	1,431,394
당기손익인식금융자산 합계			1,458,506

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주		금융자산, 범주 합계
	당기손익인식금융자산		
	채무상품	지분상품	

유동 당기손익인식금융자산	29,080		29,080
비유동 당기손익인식금융자산	632,405	773,063	1,405,468
당기손익인식금융자산 합계			1,434,548

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산
	장부금액	
	공시금액	
기초	11,397,012	1,405,468
취득	124,897	146,392
처분	(5,918,616)	(81,113)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,548,022	
당기손익-공정가치금융자산평가손익		(38,110)
기타	329,982	(1,243)
기말	7,481,297	1,431,394

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산
	장부금액	
	공시금액	
기초	13,965,839	1,525,344
취득	35,013	158,244
처분	(20,913)	(80,718)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,636,448)	
당기손익-공정가치금융자산평가손익		(198,594)
기타	53,521	1,192
기말	11,397,012	1,405,468

당기 (단위 : 백만원)

	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
기초	3,636,478
공정가치평가	1,548,022
처분으로 인한 이익잉여금 대체	(4,935,379)
기말	249,121
차감: 자본에 가감되는 법인세효과 및 비지배지분	(54,702)
계	194,419

전기 (단위 : 백만원)

	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
기초	6,222,980
공정가치평가	(2,636,448)
처분으로 인한 이익잉여금 대체	49,946
기말	3,636,478
차감: 자본에 가감되는 법인세효과 및 비지배지분	(887,369)
계	2,749,109

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																			
	공정가치로 측정하는 금융자산																			
	상장주식																			
	삼성중공업㈜		㈜호텔신라		㈜아이마켓코리아		㈜에스에프에이		㈜면역치료당스		㈜면역아이피에스		Wacom Co., Ltd.		Corning Incorporated		기타		합계	
	장부금액	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계
	취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가	
장부금액(시장가치)	932,158	1,038,711	13,957	131,108	324	5,560	22,050	63,840	30,821	11,857	32,428	125,679	62,013	50,358	3,980,636	3,140,978	561,530	1,030,123	5,635,917	5,598,214
보유주식수(주)		134,027,281주		2,004,717주		647,320주		2,100,000주		3,518,342주		3,701,872주		8,398,400주		80,000,000주				
지분율		15.20%		5.10%		1.90%		5.80%		4.60%		7.50%		5.30%		9.40%				
지분율에 대한 설명																				(*) 총발행보통주식수 기준 지분율임니다.

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																			
	공정가치로 측정하는 금융자산																			
	상장주식																			
	삼성중공업㈜		㈜호텔신라		㈜아이마켓코리아		㈜에스에프에이		㈜면역치료당스		㈜면역아이피에스		Wacom Co., Ltd.		Corning Incorporated		기타		합계	
	장부금액	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계	장부금액 합계
	취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가	
장부금액(시장가치)	932,158	684,879	13,957	166,592	324	6,538	38,262	132,642	30,821	11,945	32,428	91,621	62,013	46,750	3,980,636	3,238,205	563,635	5,142,573		9,521,745
보유주식수(주)		134,027,281주		2,004,717주		647,320주		2,100,000주		3,518,342주		3,701,872주		8,398,400주		80,000,000주				

지분율		15.20%		5.10%		1.90%		5.80%		4.60%		7.50%		5.30%		9.40%				
지분율에 대한 설명																				(*) 총발행보통주식수 기준 지분율임니다.

7. 매출채권 및 미수금 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	손상차손누계	장부금액 합계
매출채권	37,026,738	(355,456)	36,671,282
미수금	7,474,967	(82,224)	7,392,743

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	손상차손누계	장부금액 합계
매출채권	36,238,032	(312,221)	35,925,811
미수금	7,051,536	(78,101)	6,973,435

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
비유동매출채권	(23,889)
유동매출채권	36,647,393
장기미수금	(759,495)
단기미수금	6,633,248

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
비유동매출채권	(204,248)
유동매출채권	35,721,563
장기미수금	(824,226)
단기미수금	6,149,209

당기 (단위 : 백만원)

	매출채권	미수금
기초	312,221	78,101
대손상각(환입)	62,964	(297)
제각	(18,875)	(124)
기타	(854)	4,544
기말	355,456	82,224

전기 (단위 : 백만원)

	매출채권	미수금
기초	310,880	72,805

대손상각(환입)	8,784	7,312
제각	(3,557)	(6,154)
기타	(3,886)	4,138
기말	312,221	78,101

당기

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																																			
	상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류																																			
	매출채권																				미수금															
	금융자산의 손상차손 전체금액																																			
	기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				총장부금액				기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				총장부금액			
	연체상태			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계
	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	
금융자산				33,633,006	2,262,296					478,371	653,065					3,393,732				37,026,738				7,077,413	269,390					15,369	112,795					397,554				7,474,967
기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보					연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용이 손상된 것으로 간주하지 않습니다.																				연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용이 손상된 것으로 간주하지 않습니다.															

전기

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																																			
	상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류																																			
	매출채권																				미수금															
	금융자산의 손상차손 전체금액																																			
	기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				총장부금액				기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				총장부금액			
	연체상태			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계	연체상태 합계			연체상태 합계
	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	

금융자산				33,177,298	2,206,622					642,859	211,253					3,060,734				36,238,032				5,890,018	981,889					52,972	126,657					1,161,518				7,051,536
기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보					연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용이 손상된 것으로 간주하지 않습니다.																				연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용이 손상된 것으로 간주하지 않습니다.															

채권의 신용위험 금액에 대한 설명

보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액입니다. 연결회사의 주요 채권과 관련하여 보험사와 보험계약을 체결하고 있습니다.

8. 재고자산 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	16,120,367	(1,567,353)	14,553,014
반제품 및 재공품	26,501,664	(4,303,216)	22,198,448
원재료 및 저장품	15,222,937	(1,525,583)	13,697,354
미착품	1,177,058	0	1,177,058
재고자산 계	59,022,026	(7,396,152)	51,625,874
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가			177,539,372

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	17,526,178	(1,493,952)	16,032,226
반제품 및 재공품	21,612,965	(1,535,446)	20,077,519
원재료 및 저장품	16,268,974	(1,289,694)	14,979,280
미착품	1,098,841	0	1,098,841

재고자산 계	56,506,958	(4,319,092)	52,187,866
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가			186,396,549

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가에 대한 기술

동 비용에는 재고자산평가손실 금액이 포함되어 있습니다.

9. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	10,893,869
취득	78,690
처분	(33,464)
이익 중 지분해당액	887,550
기타(*)	(59,201)
기말	11,767,444

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	8,932,251
취득	1,006,998
처분	(20,894)
이익 중 지분해당액	1,090,643
기타(*)	(115,129)
기말	10,893,869

관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역에 대한 설명

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	전체 관계기업 투자금액																							
	관계기업																							
	삼성전기㈜			삼성에스디에스㈜			삼성바이오로직스㈜			삼성SDI㈜(*2)			㈜제일기획			기타			전체 관계기업			개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액		
	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체	측정 전체		측정 전체
	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계	취득원가	장부금액	합계
기업명		삼성전기㈜	삼성전기㈜		삼성에스디에스㈜	삼성에스디에스㈜		삼성바이오로직스㈜	삼성바이오로직스㈜		삼성SDI㈜(*2)	삼성SDI㈜(*2)		㈜제일기획	㈜제일기획									

관계의 성격		수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급		컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 불류서비스 제공	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 불류서비스 제공		신사업 투자	신사업 투자		2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급		광고 대행업	광고 대행업								
지분율(%)(*1)		23.7%	23.7%		22.6%	22.6%		31.2%	31.2%		19.6%	19.6%		25.2%	25.2%									
유통보통주식수 기준 관계기업에 대한 소유지분율											20.6%	20.6%												
주사업장		한국	한국		한국	한국		한국	한국		한국	한국		한국	한국									
결산월		2023-12-31	2023-12-31		2023-12-31	2023-12-31		2023-12-31	2023-12-31		2023-12-31	2023-12-31		2023-12-31	2023-12-31									
지분법적용 투자지분	359,237			147,963			1,424,358			1,242,605			506,162			690,481			4,370,806					
유동자산		5,208,418	5,208,418		8,160,300	8,160,300		5,521,988	5,521,988		9,187,029	9,187,029		2,372,420	2,372,420									
비유동자산		6,449,453	6,449,453		4,160,724	4,160,724		10,524,209	10,524,209		24,851,831	24,851,831		517,085	517,085									
유동부채		2,900,460	2,900,460		2,391,861	2,391,861		4,157,861	4,157,861		8,518,933	8,518,933		1,375,034	1,375,034									
비유동부채		727,087	727,087		953,592	953,592		2,057,844	2,057,844		5,612,677	5,612,677		216,707	216,707									
비지배지분		182,613	182,613		317,562	317,562		0	0		1,395,877	1,395,877		11,206	11,206									
영업수익		8,909,348	8,909,348		13,276,844	13,276,844		3,694,589	3,694,589		22,708,300	22,708,300		4,138,275	4,138,275									
계속영업손익(*4)		430,839	430,839		693,422	693,422		857,691	857,691		2,009,207	2,009,207		187,302	187,302									
세후중단영업손익(*3)		(7,883)	(7,883)		0	0		0	0		0	0		0	0									
기타포괄손익(*4)		45,054	45,054		(11,085)	(11,085)		(11,673)	(11,673)		85,394	85,394		3,685	3,685									
총포괄손익(*4)		468,010	468,010		682,337	682,337		846,018	846,018		2,094,601	2,094,601		190,987	190,987									
순자산 (a)		7,847,711	7,847,711		8,658,009	8,658,009		9,830,492	9,830,492		18,511,373	18,511,373		1,286,558	1,286,558									
연결실체지분율(b)(*5)		0.234	0.234		0.226	0.226		0.312	0.312		0.201	0.201		0.287	0.287									
순자산가액(axb)(*3)		1,837,925	1,837,925		1,955,699	1,955,699		3,068,636	3,068,636		3,726,675	3,726,675		368,875	368,875		844,645	844,645		11,802,455	11,802,455			
영업권		7,081	7,081		26,801	26,801		3,645	3,645		0	0		298,779	298,779									
내부거래 등(*6)		(3,613)	(3,613)		(16,294)	(16,294)		1,314	1,314		(814,111)	(814,111)		1,709	1,709									
배당		37,155	37,155		55,911	55,911		0	0		13,867	13,867		33,394	33,394									
당기순손익																							87,072	87,072
기타포괄손익																							50,260	50,260
총포괄손익																							137,332	137,332
주식수(주)		17,693,084	17,693,084		17,472,110	17,472,110		22,217,309	22,217,309		13,462,673	13,462,673		29,038,075	29,038,075									
시장가치		2,710,580	2,710,580		2,970,259	2,970,259		16,885,155	16,885,155		6,354,382	6,354,382		552,595	552,595									

전기

(단위 : 백만원)

	전체 관계기업 투자금액																							
	관계기업																							
	삼성전기㈜			삼성에스디에스㈜			삼성바이오로직스㈜			삼성SDI㈜(*2)			㈜제일기획			기타			전체 관계기업			개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액		
	측정 전체		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체	측정 전체 함계		측정 전체
	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계	취득원가	장부금액	함계

기업명																								
관계의 성격																								
지분율(%)(*1)																								
유통보통주식수 기준 관계기업에 대한 소유지분율																								
주사업장																								
결산월																								
지분법적용투자지분	359,237			147,963			1,424,358			1,242,605			506,162			645,255			4,325,580					
유동자산		4,888,319	4,888,319		8,005,764	8,005,764		6,457,657	6,457,657		9,651,702	9,651,702		2,193,979	2,193,979									
비유동자산		6,108,852	6,108,852		3,946,660	3,946,660		10,124,394	10,124,394		20,605,823	20,605,823		557,466	557,466									
유동부채		2,525,123	2,525,123		2,493,323	2,493,323		4,181,542	4,181,542		8,006,939	8,006,939		1,335,643	1,335,643									
비유동부채		778,563	778,563		992,132	992,132		3,416,034	3,416,034		5,033,084	5,033,084		194,373	194,373									
비지배지분		154,991	154,991		243,777	243,777		0	0		731,779	731,779		9,388	9,388									
영업수익		9,441,276	9,441,276		17,234,750	17,234,750		3,001,295	3,001,295		20,124,070	20,124,070		4,253,367	4,253,367									
계속영업손익(*4)		1,009,739	1,009,739		1,099,745	1,099,745		798,056	798,056		1,952,149	1,952,149		193,732	193,732									
세후중단영업손익(*3)		(29,187)	(29,187)		0	0		0	0		0	0		0	0									
기타포괄손익(*4)		(2,215)	(2,215)		80,368	80,368		6,995	6,995		(139,877)	(139,877)		(1,122)	(1,122)									
총포괄손익(*4)		978,337	978,337		1,180,113	1,180,113		805,051	805,051		1,812,272	1,812,272		192,610	192,610									
순자산 (a)		7,538,494	7,538,494		8,223,192	8,223,192		8,984,475	8,984,475		16,485,723	16,485,723		1,212,041	1,212,041									
연결실체지분율(b)(*5)		0.234	0.234		0.226	0.226		0.312	0.312		0.201	0.201		0.287	0.287									
순자산가액(axb)(*3)		1,765,507	1,765,507		1,857,481	1,857,481		2,804,547	2,804,547		3,318,875	3,318,875		347,510	347,510		718,801	718,801		10,812,721	10,812,721			
영업권		7,081	7,081		26,801	26,801		3,645	3,645		0	0		298,779	298,779									
내부거래 등(*6)		(8,339)	(8,339)		(13,944)	(13,944)		481	481		(627,652)	(627,652)		2,872	2,872									
배당		37,155	37,155		41,933	41,933		0	0		13,463	13,463		28,748	28,748									
당기순손익																							102,930	102,930
기타포괄손익																							(50,761)	(50,761)
총포괄손익																							52,169	52,169
주식수(주)																								
시장가치		2,308,947	2,308,947		2,149,070	2,149,070		18,240,411	18,240,411		7,956,440	7,956,440		669,328	669,328									

관계기업에 대한 공시에 관한 추가 설명

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(*4) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*5) 보통주와 우선주 포함 지분율입니다.

(*6) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

당기

(단위 : 백만원)

	전체 공동기업
	공동기업

	삼성코닝어드밴스드글라스(유)			기타 공동기업			전체 공동기업			개별적으로 중요하지 않은 공동기업들의 합계		
	측정 전체		측정 전체 합계	측정 전체 합계		측정 전체 합계	측정 전체 합계		측정 전체 합계	측정 전체 합계		측정 전체 합계
	취득원가	장부금액		취득원가	장부금액		취득원가	장부금액		취득원가	장부금액	
기업명		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	삼성코닝어드밴스드글라스(유)									
관계의 성격		기타 산업용 유리 제품 생산 및 공급	기타 산업용 유리 제품 생산 및 공급									
지분율(%)(*1)		50%	50%									
주사업장		한국	한국									
결산월		2023-12-31	2023-12-31									
지분법적용 투자지분	215,000			259,994			474,994					
유동자산		116,372	116,372									
비유동자산		185,100	185,100									
유동부채		22,684	22,684									
비유동부채		911	911									
매출		122,446	122,446									
계속영업손익(*3)		2,672	2,672									
세후중단영업손익(*3)		0	0									
기타포괄손익(*3)		0	0									
총포괄손익(*3)		2,672	2,672									
순자산 (a)		277,877	277,877									
연결실체지분율(b)(*4)		0.5	0.5									
순자산지분금액(a×b)(*2)		138,939	138,939		72,215	72,215		211,154	211,154			
내부거래 등(*5)		(1)	(1)									
배당		0	0									
당기순손익											2,399	2,399
기타포괄손익											1,915	1,915
총포괄손익											4,314	4,314

전기

(단위 : 백만원)

	전체 공동기업											
	공동기업											
	삼성코닝어드밴스드글라스(유)			기타 공동기업			전체 공동기업			개별적으로 중요하지 않은 공동기업들의 합계		
	측정 전체		측정 전체 합계	측정 전체 합계		측정 전체 합계	측정 전체 합계		측정 전체 합계	측정 전체 합계		측정 전체 합계
	취득원가	장부금액		취득원가	장부금액		취득원가	장부금액		취득원가	장부금액	
기업명												
관계의 성격												
지분율(%)(*1)												
주사업장												
결산월												
지분법적용 투자지분	215,000			259,994			474,994					
유동자산		170,103	170,103									
비유동자산		125,507	125,507									
유동부채		19,794	19,794									
비유동부채		363	363									
매출		133,634	133,634									
계속영업손익(*3)		3,998	3,998									
세후중단영업손익(*3)		0	0									
기타포괄손익(*3)		288	288									
총포괄손익(*3)		4,286	4,286									
순자산 (a)		275,453	275,453									
연결실체지분율(b)(*4)		0.5	0.5									

순자산지분금액 (a×b)(*2)		137,727	137,727		67,632	67,632		205,359	205,359			
내부거래 등(*5)		18	18									
배당		0	0									
당기순손익											1,867	1,867
기타포괄손익											(2,677)	(2,677)
총포괄손익											(810)	(810)

공동기업에 대한 공시에 관한 추가 설명

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(*3) 공동기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*5) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타	관계기업 및 공동기업 합계
기초	1,764,249	1,870,338	2,808,673	2,691,223	649,161	137,745	972,480	10,893,869
지분법손익	106,455	154,282	267,614	214,702	53,690	1,336	89,471	887,550
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	7,844	(2,503)	(2,692)	20,506	(94)	(124)	52,175	75,112
기타증감액(*)	(37,155)	(55,911)	0	(13,867)	(33,394)	(19)	51,259	(89,087)
기말	1,841,393	1,966,206	3,073,595	2,912,564	669,363	138,938	1,165,385	11,767,444
기타증감액에 대한 설명								(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타	관계기업 및 공동기업 합계
기초	1,556,386	1,652,155	1,577,664	2,529,650	621,292	135,580	859,524	8,932,251
지분법손익	242,139	241,962	250,028	194,242	55,476	1,999	104,797	1,090,643
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	2,880	18,154	(183)	(19,207)	1,140	144	(53,438)	(50,510)
기타증감액(*)	(37,156)	(41,933)	981,164	(13,462)	(28,747)	22	61,597	921,485
기말	1,764,249	1,870,338	2,808,673	2,691,223	649,161	137,745	972,480	10,893,869
기타증감액에 대한 설명								(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

	전체 관계기업 투자금액
	관계기업
	삼성바이오로직스㈜

	우발부채
	법적소송우발부채

중요한 조정을 유발할 수 있는 유의한 위험이 내포된 추정 불확실성의 원천에 대한 설명	증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일에의결하였습니다. 이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스㈜는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다. 향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가 삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시

	기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

10. 유형자산 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타	유형자산 합계
기초 유형자산	9,892,167	40,706,918	79,714,631	33,607,564	4,124,108	168,045,388
일반취득 및 자본적 지출	172,262	6,498,611	33,641,691	13,141,766	1,462,032	54,916,362
사업결합을 통한 취득, 유형자산	0	18,125	20,140	34,698	165	73,128
감가상각비, 유형자산	(49,367)	(3,884,333)	(30,031,617)	0	(1,567,094)	(35,532,411)
처분・폐기	(25,934)	(181,700)	(37,681)	(256)	(30,547)	(276,118)
손상(환입)	0	(30,864)	(47,044)	0	(7,449)	(85,357)
매각예정분류	(6,615)	(54,318)	(37,101)	(6,255)	(14,100)	(118,389)
기타	16,864	165,676	86,149	(57,189)	22,159	233,659
기말 유형자산	9,999,377	43,238,115	83,309,168	46,720,328	3,989,274	187,256,262

전기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타	유형자산 합계
기초 유형자산	9,830,154	38,869,440	79,526,297	18,009,324	3,693,324	149,928,539
일반취득 및 자본적 지출	138,925	5,302,095	31,010,080	16,675,741	2,100,119	55,226,960
사업결합을 통한 취득, 유형자산						
감가상각비, 유형자산	(49,516)	(3,533,917)	(30,761,685)	0	(1,606,980)	(35,952,098)
처분・폐기	(57,596)	(127,935)	(35,098)	(193)	(34,208)	(255,030)
손상(환입)	0	(2,255)	(11,815)	0	(12,323)	(26,393)
매각예정분류						
기타	30,200	199,490	(13,148)	(1,077,308)	(15,824)	(876,590)
기말 유형자산	9,892,167	40,706,918	79,714,631	33,607,564	4,124,108	168,045,388

당기 (단위 : 백만원)

	유형자산																	
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타			계		
	장부금액			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계		
	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계
기초 유형자산	10,024,569	(132,402)	9,892,167	67,713,808	(27,006,890)	40,706,918	303,000,627	(223,285,996)	79,714,631	33,607,564	0	33,607,564	13,248,490	(9,124,382)	4,124,108	427,595,058	(259,549,670)	168,045,388
기말 유형자산	10,157,963	(158,586)	9,999,377	73,689,951	(30,451,836)	43,238,115	328,561,492	(245,252,324)	83,309,168	46,720,328	0	46,720,328	14,058,654	(10,069,380)	3,989,274	473,188,388	(285,932,126)	187,256,262

전기 (단위 : 백만원)

	유형자산																	
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타			계		
	장부금액			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계		
	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계

기초 유형자산	9,943,570	(113,416)	9,830,154	62,651,459	(23,782,019)	38,869,440	274,909,571	(195,383,274)	79,526,297	18,009,324	0	18,009,324	11,958,070	(8,264,746)	3,693,324	377,471,994	(227,543,455)	149,928,539
기말 유형자산	10,024,569	(132,402)	9,892,167	67,713,808	(27,006,890)	40,706,918	303,000,627	(223,285,996)	79,714,631	33,607,564	0	33,607,564	13,248,490	(9,124,382)	4,124,108	427,595,058	(259,549,670)	168,045,388

일반취득 및 자본적지출에 대한 각주, 유형자산

(*1) 일반취득 및 자본적지출은 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
자본화된 차입원가			204,814
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.039	0.058	

전기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
자본화된 차입원가			41,634
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.021	0.041	

기타 변동에 대한 각주, 유형자산

(*2) 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타	자산 합계
기초	503,203	3,451,596	175,151	787,659	4,917,609
일반취득	38,677	1,594,886	10,058	158,842	1,802,463
감가상각	(49,367)	(871,275)	(47,174)	(147,178)	(1,114,994)
계약의 해지	(12,461)	(174,426)	(279)	(6,904)	(194,070)
매각예정분류	(4,305)	(17)	0	(414)	(4,736)
기타	5,863	33,288	(182)	3,791	42,760
기말	481,610	4,034,052	137,574	795,796	5,449,032

전기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타	자산 합계

기초	525,954	2,841,970	191,059	391,584	3,950,567
일반취득	32,632	1,542,889	29,098	507,041	2,111,660
감가상각	(49,516)	(823,543)	(58,000)	(116,287)	(1,047,346)
계약의 해지	(13,741)	(111,145)	(263)	(4,220)	(129,369)
매각예정분류					
기타	7,874	1,425	13,257	9,541	32,097
기말	503,203	3,451,596	175,151	787,659	4,917,609

기타 변동에 대한 각주, 사용권자산

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	31,647,926	3,884,485	35,532,411

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	32,285,800	3,666,298	35,952,098

11. 무형자산 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	산업재산권	개발비	회원권	영업권	기타	무형자산 및 영업권 합계
기초의 무형자산 및 영업권	4,278,750	85,018	253,554	6,014,422	9,586,010	20,217,754
개별취득	401,561	0	6,251	0	4,608,488	5,016,300
사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	3,944	0	0	315,136	37,758	356,838
상각	(276,781)	(85,018)	0	0	(2,772,349)	(3,134,148)
처분・폐기	(41,492)	0	(8,656)	0	(44)	(50,192)
손상(환입)	(6,265)	0	3,738	0	(2,900)	(5,427)
매각예정분류	(2)	0	0	(58,455)	(4,405)	(62,862)
기타	64,851	0	1,972	186,516	150,260	403,599
기말 무형자산 및 영업권	4,424,566	0	256,859	6,457,619	11,602,818	22,741,862

전기 (단위 : 백만원)

	산업재산권	개발비	회원권	영업권	기타	무형자산 및 영업권 합계
기초의 무형자산 및 영업권	4,153,236	236,910	241,219	5,844,259	9,760,620	20,236,244
개별취득	299,484	0	8,905	0	2,375,986	2,684,375

사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	0	0	0	0	0	0
상각	(268,070)	(151,892)	0	0	(2,735,599)	(3,155,561)
처분・폐기	(50,979)	0	(417)	0	(402)	(51,798)
손상(환입)	0	0	(509)	0	(5,753)	(6,262)
매각예정분류	0	0	0	0	0	0
기타	145,079	0	4,356	170,163	191,158	510,756
기말 무형자산 및 영업권	4,278,750	85,018	253,554	6,014,422	9,586,010	20,217,754

기타 변동에 대한 각주, 무형자산

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	기 타	현금창출단위 합계 합계
영업권	1,256,815	164,607	343,967	4,691,440	790	6,457,619

전기 (단위 : 백만원)

	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	기 타	현금창출단위 합계 합계
영업권	1,249,290	159,359	138,754	4,466,339	680	6,014,422

영업권 손상검토에 대한 설명

연결회사는 매년 영업권의 손상 여부를 검토하고 있으며, 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거한 세전현금흐름 추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정 성장률의 가정(단, 산업평균 성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,197,662	936,486	3,134,148

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,211,481	944,080	3,155,561

12. 차입금 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	차입금명칭																					
	단기차입금								유동성장기차입금								장기 차입금					
	당보부차입금-우리은행 등		무담보차입금-씨티은행 등		단기차입금 합계				은행차입금-BNP 등		리스부채-CSSD 등_1		유동성차입금 합계				은행차입금		리스부채-CSSD 등_2		장기차입금 합계	
	범위	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위			범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위			범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위

	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계	하위법위	가중법위	상위법위	합계
연이자율	0.000		0.173		0.000		0.622						0.361		0.615			0.043										0.000		0.043						
단기차입금 및 유동성장기차입금				6,610,049				504,552				7,114,601				304,082				998,439				1,302,521												
장기차입금																												0				3,724,850				3,724,850

차입금에 대한 기술				담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.																리스부채와 관련하여 연 이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 197,202백만원(전기: 140,111백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다. 한편, 당기 중 리스부채 측												리스부채와 관련하여 연 이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 197,202백만원(전기: 140,111백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다. 한편, 당기 중 리스부채 측				

																			정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 158,395백만원(전기: 211,283백만원)입니다.												정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 158,395백만원(전기: 211,283백만원)입니다.				
인식면제 규정이 적용된 소액자산 리스 및 단기리스를 포함한 리스료에 관련되는 비용																			158,395												158,395				

전기

(단위 : 백만원)

	차입금명칭																																			
	단기차입금												유동성장기차입금												장기 차입금											
	당보부차입금-우리은행 등				무담보차입금-씨티은행 등				단기차입금 합계				은행차입금-BNP 등				리스부채-CSSD 등_1				유동성차입금 합계				은행차입금				리스부채-CSSD 등_2				장기차입금 합계			
	범위				범위 합계				범위 합계				범위 합계				범위 합계				범위 합계				범위 합계				범위 합계				범위 합계			
	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계
연이자율	0.000	0.000	0.173	0.000	0.000	0.000	0.622						0.361		0.615			0.043										0.000		0.043						
단기차입금 및 유동성장기차입금	0	0	0	3,569,357	0	0		1,577,958				5,147,315				208,915				874,019				1,082,934												

장기차입금	0	0	0	0	0	0																					33,846				3,526,826				3,560,672

차입금에 대한 기술				담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.																리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 197,202백만원(전기: 140,111백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다. 한편, 당기 중 리스부채 측												리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 197,202백만원(전기: 140,111백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다. 한편, 당기 중 리스부채 측				

																			정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 158,395백만원(전기: 211,283백만원)입니다.											정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 158,395백만원(전기: 211,283백만원)입니다.				
인식면제 규정이 적용된 소액자산 리스 및 단기리스를 포함한 리스료에 관련되는 비용	0	0	0	0	0	0													211,283												211,283				

(단위 : 백만원)

	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년 이후	합계 구간 합계
리스부채	1,171,751	965,266	821,551	625,811	1,822,019	5,406,398

13. 사채 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bond	US$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율(%)	7.700	4.200	
명목금액	25,788	515,760	541,548

명목금액, 외화금액	US$ 20,000천	US$ 400,000천	
사채할인발행차금			(370)
사채할증발행차금			2,794
계			543,972
차감: 유동성사채			(6,354)
비유동성사채			537,618
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bond	US$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율(%)	7.700	4.200	
명목금액	31,683	506,920	538,603
명목금액, 외화금액	US$ 25,000천	US$ 400,000천	
사채할인발행차금			(543)
사채할증발행차금			4,261
계			542,321
차감: 유동성사채			(6,228)
비유동성사채			536,093
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

(단위 : 백만원)

	2024년	2025년	2026년	2027년	합계 구간 합계
사채, 미할인현금흐름	6,447	522,207	6,447	6,447	541,548

14. 순확정급여부채(자산) (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계

	여제도		
확정급여채무, 현재가치	15,403,976	319,689	15,723,665
사외적립자산의 공정가치			(20,172,327)
순확정급여부채(자산) 계			(4,448,662)

전기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	13,639,460	370,848	14,010,308
사외적립자산의 공정가치			(19,593,910)
순확정급여부채(자산) 계			(5,583,602)

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,294,308
순이자비용(수익), 확정급여제도			(354,220)
과거근무원가, 확정급여제도			4,839
기타 비용, 확정급여제도			9,491
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	378,104	576,314	954,418

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,365,600
순이자비용(수익), 확정급여제도			(99,356)
과거근무원가, 확정급여제도			(253)
기타 비용, 확정급여제도			28,713

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	514,589	780,115	1,294,704

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	203,004

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	145,395

당기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초	14,010,308	19,593,910
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,294,308	
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	805,084	1,159,304
과거근무원가, 순확정급여부채(자산)	4,839	
재측정요소		(654,005)
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	62,291	
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	266,505	
- 기타사항에 의한 효과	123,165	
사용자의 기여금		746,068
급여지급액	(846,457)	(687,125)
기타(*)	3,622	14,175
기말	15,723,665	20,172,327
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치		1,757,413

전기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초	14,658,185	17,001,891
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,365,600	

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	528,884	628,240
과거근무원가, 순확정급여부채(자산)	(253)	
재측정요소		(312,565)
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	34,917	
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	(2,496,879)	
- 기타사항에 의한 효과	521,452	
사용자의 기여금		2,741,417
급여지급액	(630,019)	(498,246)
기타(*)	28,421	33,173
기말	14,010,308	19,593,910
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치		

기타 변동에 의한 증가(감소), 순확정급여부채(자산)에 대한 기술

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 매각예정 재분류를 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
원금보장형 고정수익 상품 등	18,178,623
그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액	1,993,704
사외적립자산, 공정가치	20,172,327
사외적립자산의 공정가치에 대한 설명	사외적립자산은 대부분 활성시장에서 공시되는 가격이 있는 자산에 투자되어 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
원금보장형 고정수익 상품 등	18,766,006
그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액	827,904
사외적립자산, 공정가치	19,593,910
사외적립자산의 공정가치에 대한 설명	사외적립자산은 대부분 활성시장에서 공시되는 가격이 있는 자산에 투자되어 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	보험수리적 가정					
	할인율에 대한 보험수리적 가정			미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		
	범위		범위 합계	범위 합계		범위 합계
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위	
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.039	0.059				
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정				0.030	0.063	
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)			14,291,442			17,365,127
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)			17,385,125			14,280,988

전기 (단위 : 백만원)

	보험수리적 가정					
	할인율에 대한 보험수리적 가정			미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		
	범위		범위 합계	범위 합계		범위 합계
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위	
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.043	0.064				
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정				0.020	0.064	
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)			12,920,156			15,261,609

보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)			15,268,164			12,900,865

	가중범위
확정급여채무의 가중평균만기	9년11개월3일

15. 충당부채 (연결)

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
기초	2,309,726	1,546,606	783,263	3,133,830	7,773,425
순전입(환입)	2,456,609	595,307	468,745	2,012,062	5,532,723
사용	(2,279,281)	(299,250)	(261,622)	(1,125,666)	(3,965,819)
기타	53,158	(4,611)	3,365	11,085	62,997
기말	2,540,212	1,838,052	993,751	4,031,311	9,403,326
충당부채의 성격에 대한 기술	연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.	연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.	연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.	

그 밖의 기타충당부채에 대한 기술

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	1,272
사용	(17,702)
기말	3,137

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	46,073
증가	1,872
사용	(28,378)
기말	19,567

	연도			
	당기 이행연도	잔여 계획기간		
		2024년	2025년	잔여 계획기간 합계
무상할당 배출권	1806만톤(tCO2-eq)	1630만톤(tCO2-eq)	1630만톤(tCO2-eq)	3260만톤(tCO2-eq)
배출량 추정치	1766만톤(tCO2-eq)			

	공시금액
무상할당배출권 수량	5,625만톤
담보로 제공된 배출권 수량	-

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	32,838
순전입	(15,210)
사용	(17,491)
기말	137

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	45,049
순전입	16,167
사용	(28,378)
기말	32,838

16. 우발부채와 약정사항 (연결)

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	보고기간종료일 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

	무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정	무역금융 약정	외상매출채권담보대출, 일반대출 등의 약정	발생하지 않은 유・무형자산의 취득을 위한 약정
총 약정금액	21,762,600	15,958,875	2,149,320	9,783,549
약정에 대한 설명	(1) 보고기간종료일 현재 연결회사는 우리은행 등 28개 은행과 무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 21,762,600백만원입니다.	이외에도 연결회사는 신한은행 등 23개 은행과 한도액 15,958,875백만원의 무역금융 약정을 체결하고 있으며,	우리은행 등 13개 은행과 한도액 2,149,320백만원의 외상매출채권담보대출, 일반대출 등의 약정을 맺고 있습니다.	(2) 보고기간종료일 현재 발생하지 않은 유・무형자산의 취득을 위한 약정액은 9,783,549백만원입니다.

17. 계약부채 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액

계약부채	13,327,724
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	1,156,619

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,255,682
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

18. 자본금 (연결)

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514

자본에 대한 설명			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다

19. 연결이익잉여금 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
임의적립금 등	208,198,003
연결미처분이익잉여금	138,454,235
계	346,652,238

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
임의적립금 등	192,294,496
연결미처분이익잉여금	145,651,911
계	337,946,407

당기 (단위 : 백만원)

	범위											
	1분기			2분기			3분기			기말		
	주식		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30			2023-09-30			2023-12-31
배당받을 주식	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률	3.61			3.61			3.61			3.61		
우선주 주당 배당률		3.61			3.61			3.61			3.62	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,884	2,452,976

전기 (단위 : 백만원)

	범위											
	1분기			2분기			3분기			기말		
	주식		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2022-03-31			2022-06-30			2022-09-30			2022-12-31
배당받을 주식	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률	3.61			3.61			3.61			3.61		
우선주 주당 배당률		3.61			3.61			3.61			3.62	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,884	2,452,976

20. 기타자본항목 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본항목		1,280,130
기타자본항목	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	194,419
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	185,144
	해외사업장환산외환차이	3,651,112
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,849,526)
	기타	98,981

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본항목		1,938,328
기타자본항목	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	2,749,109
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	114,987
	해외사업장환산외환차이	1,039,197

	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,051,610)
	기타	86,645

21. 비용의 성격별 분류 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(644,905)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	96,219,181
급여	30,405,245
퇴직급여	1,157,422
감가상각비	35,532,411
무형자산상각비	3,134,148
복리후생비	6,472,979
유틸리티비	7,502,408
외주용역비	7,058,833
광고선전비	5,213,896
판매촉진비	6,894,395
기타 비용	53,422,505
성격별 비용 합계	252,368,518

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(10,355,548)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	112,591,917
급여	30,078,623
퇴직급여	1,440,099
감가상각비	35,952,098
무형자산상각비	3,155,561
복리후생비	6,091,626
유틸리티비	6,142,317
외주용역비	6,597,467
광고선전비	6,112,951
판매촉진비	7,110,649
기타 비용	53,936,970
성격별 비용 합계	258,854,730

성격별 비용에 대한 공시

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

22. 판매비와관리비 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
급여, 판관비		8,324,562
퇴직급여, 판관비		299,369
지급수수료, 판관비		8,753,442
감가상각비, 판관비		1,649,335
무형자산상각비, 판관비		688,786
광고선전비, 판관비		5,213,896
판매촉진비, 판관비		6,894,395
운반비, 판관비		1,721,614
서비스비, 판관비		3,968,816
기타판매비와관리비		6,125,999
소계		43,640,214
경상개발비, 판관비		
경상개발비, 판관비	연구개발 총지출액	28,339,724
판매비와관리비		71,979,938

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
급여, 판관비		7,763,588
퇴직급여, 판관비		330,115
지급수수료, 판관비		7,457,896
감가상각비, 판관비		1,574,757
무형자산상각비, 판관비		664,346
광고선전비, 판관비		6,112,951
판매촉진비, 판관비		7,110,649
운반비, 판관비		3,214,301
서비스비, 판관비		3,671,913
기타판매비와관리비		5,993,246
소계		43,893,762
경상개발비, 판관비		
경상개발비, 판관비	연구개발 총지출액	24,919,198
판매비와관리비		68,812,960

23. 기타수익 및 기타비용 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
배당금수익	164,203

임대료수익	150,273
유형자산처분이익	104,663
기타	761,309
기타이익	1,180,448
유형자산처분손실	85,799
기부금	243,377
기타	754,151
기타손실	1,083,327

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
배당금수익	414,601
임대료수익	140,908
유형자산처분이익	159,123
기타	1,247,439
기타이익	1,962,071
유형자산처분손실	61,256
기부금	305,941
기타	1,422,979
기타손실	1,790,176

24. 금융수익 및 금융비용 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		4,358,022
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	4,357,792
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	230
외환차이		10,608,661
파생상품관련이익		1,133,465
금융수익 합계		16,100,148
이자비용		930,253
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	510,865
	기타 금융부채 이자비용	419,388
외환차이		10,711,058
파생상품관련손실		1,004,219
금융비용 합계		12,645,530

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		2,720,479
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	2,720,213
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	266
외환차이		16,537,855
파생상품관련이익		1,570,661
금융수익 합계		20,828,995
이자비용		763,015
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	322,529
	기타 금융부채 이자비용	440,486
외환차이		16,809,703
파생상품관련손실		1,454,971
금융비용 합계		19,027,689

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

25. 법인세비용 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		4,934,981
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	5,660,505
	당기에 인식한 조정사항	(725,524)
이연법인세 소계		(9,415,816)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(5,346,657)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(3,061,001)
	이월결손금으로 인한 이연법인세변동액	(1,041,996)
	기타변동액	33,838
법인세비용 계		(4,480,835)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		6,889,416
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	7,391,099
	당기에 인식한 조정사항	(501,683)
이연법인세 소계		(16,103,019)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(1,080,068)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(15,407,692)
	이월결손금으로 인한 이연법인세변동액	160,123
	기타변동액	224,618
법인세비용 계		(9,213,603)

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
법인세비용차감전순이익		11,006,265
가중평균 적용세율(*)에 따른 법인세비용		1,901,195
조정사항 합계		(6,382,030)
조정사항 합계	영구적차이	219,374
	실현가능성이 없는 이연법인세자산의 변동	(12,588)
	세액공제 및 감면에 대한 법인세효과	(6,706,820)
	종속기업 손익 등에 대한 법인세효과	(389,305)
	세율변동효과	(3,926)
	기타	511,235
법인세비용 계		(4,480,835)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
법인세비용차감전순이익		46,440,474
가중평균 적용세율(*)에 따른 법인세비용		13,652,900
조정사항 합계		(22,866,503)
조정사항 합계	영구적차이	(2,090,031)
	실현가능성이 없는 이연법인세자산의 변동	769,211
	세액공제 및 감면에 대한 법인세효과	(5,185,576)

	종속기업 손익 등에 대한 법인세 효과	(16,186,745)
	세율변동효과	(376)
	기타	(172,986)
법인세비용 계		(9,213,603)

적용세율에 대한 기술

보고기간종료일 현재 연결회사의 이익에 대해서 과세관청별로 다르게 적용되는 법정세율을 가중평균하여 산정하였습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제																
	일시적차이로 인한 이연법인세								일시적차이 소계	미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		자본에 직접 가감하는 이연법인세 소계	이연법인세부채 (자산) 순액	이연법인세자산	이연법인세부채
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	자산손상	기타				기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 등	순확정급여부채 (자산) 재측정요소				
기초 이연법인세 부채(자산)	(898,505)	(4,960,247)	(2,566,535)	39,680	5,219,130	185,900	234,734	(969,702)	(3,715,545)	276,358	2,746,430	(50,392)	733,135	682,743	(10,014)	5,101,318	(5,111,332)
이연법인세부채 (자산)의 증가(감소)	(182)	57,640	682,845	28,042	1,923,486	(12,997)	1,011	381,157	3,061,002	1,041,996	5,346,657	(156,443)	308,050	151,607	9,601,262	5,110,479	4,490,783
기말 이연법인세 부채(자산)	(898,687)	(4,902,607)	(1,883,690)	67,722	7,142,616	172,903	235,745	(588,545)	(654,543)	1,318,354	8,093,087	(206,835)	1,041,185	834,350	9,591,248	10,211,797	(620,549)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이에 대한 설명		(*) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세 자산을 인식하지 않았습니다.															

전기 (단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제																
	일시적차이로 인한 이연법인세								일시적차이 소계	미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		자본에 직접 가감하는 이연법인세 소계	이연법인세부채 (자산) 순액	이연법인세자산	이연법인세부채
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	자산손상	기타				기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 등	순확정급여부채 (자산) 재측정요소				
기초 이연법인세 부채(자산)	(936,822)	(20,614,554)	(1,771,793)	6,853	4,560,874	12,076	258,886	(638,757)	(19,123,237)	436,481	1,666,362	(3,155,310)	1,238,713	(1,916,597)	(18,936,991)	4,261,214	(23,198,205)
이연법인세부채 (자산)의 증가(감소)	38,317	15,654,307	(794,742)	32,827	658,256	173,824	(24,152)	(330,945)	15,407,692	(160,123)	1,080,068	3,104,918	(505,578)	2,599,340	18,926,977	840,104	18,086,873
기말 이연법인세 부채(자산)	(898,505)	(4,960,247)	(2,566,535)	39,680	5,219,130	185,900	234,734	(969,702)	(3,715,545)	276,358	2,746,430	(50,392)	733,135	682,743	(10,014)	5,101,318	(5,111,332)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이에 대한 설명		(+) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.															

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
이월결손금이월액	597,176
세액공제이월액	118,694

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
이월결손금이월액	594,798
세액공제이월액	46,550

(단위 : 백만원)

	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년초과
이월결손금이월액	37,899	741	0	558,536
세액공제이월액	7,163	0	110,450	1,081

당기 (단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	합계 구간 합계
이연법인세자산	9,392,311	819,486	10,211,797
이연법인세부채		(620,549)	(620,549)
이연법인세부채(자산) 순액			9,591,248

전기 (단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	합계 구간 합계
이연법인세자산	3,249,661	1,851,657	5,101,318

이연법인세부채		(5,111,332)	(5,111,332)
이연법인세부채(자산) 순액			(10,014)

글로벌 최저한세 도입 영향에 대한 기술

마. 글로벌 최저한세

글로벌 최저한세는 직전 4개연도 중 2개이상 연결재무제표상 매출액이 7.5억 유로 이상인 다국적 기업이 소재한 국가에서 실효세율이 15%에 미치지 못하는 경우, 그 상당액을 특정 요건을 충족하는 지배기업이 속해있는 국가의 과세관청에 납부하는 제도입니다.

연결회사의 지배기업이 소재하고 있는 대한민국은 2023년에 글로벌 최저한세 관련 세법을 제정하였으며, 2024년 1월 1일 이후 개시하는 사업연도분부터 글로벌 최저한세를 적용하여야 합니다.

연결회사는 글로벌 최저한세 법률의 적용대상에 해당될 것으로 판단하고 있으나, 대한민국의 글로벌최저한세 관련 세법이 2024년 1월 1일부터 시행되기 때문에 당기 중
당기법인세비용에 영향은 없습니다. 또한, 연결회사는 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 글로벌 최저한세 법률과 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다.

글로벌 최저한세 법률의 주된 영향을 받는 종속회사 소재 국가의 법률이 제정 전이거나 구체적인 법령의 제정이 진행중이기 때문에, 보고기간종료일 현재 연결회사에 미칠 영향을 합리적으로 추정하기 어렵습니다. 연결회사의 각 종속회사는 각 국의 세무전문가들과 함께 연결재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있습니다.

26. 주당이익 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 당기순이익	14,473,401	14,473,401
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	12,719,321	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783천주	
기본 보통주 주당이익(원)	2,131	
지배기업의 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		1,754,080
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887천주
기본 우선주 주당이익(원)		2,132

전기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 당기순이익	54,730,018	54,730,018

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	48,099,117	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783천주	
기본 보통주 주당이익(원)	8,057	
지배기업의 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		6,630,901
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887천주
기본 우선주 주당이익(원)		8,058

희석주당이익에 대한 기술

나. 희석주당순이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

27. 현금흐름표 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		36,519,534
조정내역 계	법인세비용(수익)	(4,480,835)
	금융수익	(6,156,093)
	금융비용	3,076,837
	퇴직급여	1,157,422
	감가상각비	35,532,411
	무형자산상각비	3,134,148
	대손상각비(환입)	62,964
	배당금수익	(164,203)
	지분법이익	(887,550)
	유형자산처분이익	(104,663)
	유형자산처분손실	85,799
	재고자산평가손실(환입) 등	5,037,579
	기타	225,718
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 계		(5,458,745)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 계	매출채권의 감소(증가)	(90,243)
	미수금의 감소(증가)	325,894
	장단기선급비용의 감소(증가)	(390,636)
	재고자산의 감소(증가)	(3,206,615)
	매입채무의 증가(감소)	318,432
	장단기미지급금의 증가(감소)	785,534

	선수금의 증가(감소)	138,188
	예수금의 증가(감소)	(411,028)
	미지급비용의 증가(감소)	(3,704,020)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,566,904
	퇴직금의 지급	(938,691)
	사외적립자산의 감소(증가)	100,384
	기타	47,152

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		33,073,439
조정내역 계	법인세비용(수익)	(9,213,603)
	금융수익	(5,778,279)
	금융비용	4,336,254
	퇴직급여	1,440,099
	감가상각비	35,952,098
	무형자산상각비	3,155,561
	대손상각비(환입)	8,784
	배당금수익	(414,601)
	지분법이익	(1,090,643)
	유형자산처분이익	(159,123)
	유형자산처분손실	61,256
	재고자산평가손실(환입) 등	4,408,767
	기타	366,869
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 계		(16,998,948)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 계	매출채권의 감소(증가)	7,856,258
	미수금의 감소(증가)	(1,524,173)
	장단기선급비용의 감소(증가)	3,506
	재고자산의 감소(증가)	(13,311,072)
	매입채무의 증가(감소)	(5,298,547)
	장단기미지급금의 증가(감소)	(1,443,409)
	선수금의 증가(감소)	106,977
	예수금의 증가(감소)	25,392
	미지급비용의 증가(감소)	919,271
	장단기충당부채의 증가(감소)	(34,298)
	퇴직금의 지급	(707,887)
	사외적립자산의 감소(증가)	(2,243,171)
	기타	(1,347,795)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	1,548,022
관계기업 및 공동기업 투자의 평가	75,112
유형자산의 본계정 대체	39,749,735
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	1,802,463
사채의 유동성 대체	1,308,875

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	(2,636,448)
관계기업 및 공동기업 투자의 평가	(50,510)
유형자산의 본계정 대체	36,047,916
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	2,111,660
사채의 유동성 대체	1,089,162

당기 (단위 : 백만원)

		단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초		5,147,315	5,185,927	10,333,242
재무현금흐름		2,145,400	(864,867)	1,280,533
비현금흐름, 재무활동				
비현금흐름, 재무활동	리스신규계약	0	1,497,058	1,497,058
	기타	(178,114)	(246,775)	(424,889)
기말		7,114,601	5,571,343	12,685,944

전기 (단위 : 백만원)

		단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초		13,687,793	4,704,356	18,392,149
재무현금흐름		(8,339,149)	(1,236,468)	(9,575,617)
비현금흐름, 재무활동				
비현금흐름, 재무활동	리스신규계약	0	2,111,660	2,111,660
	기타	(201,329)	(393,621)	(594,950)
기말		5,147,315	5,185,927	10,333,242

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)에 대한 기술

상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	1,098,944
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	197,202

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	998,531
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	140,111

기업이 보유한 현금및현금성자산에 대한 경영진의 설명

연결회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품, 단기차입금등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결회사의 현금및현금성자산은 대부분 예금 등으로 구성되어 있습니다.

28. 재무위험관리 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	위험																					위험 합계
	시장위험																					
	환위험							이자율위험							지분가격위험							
	기능통화 또는 표시통화						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	
	USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			
	범위							범위							범위							
	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		
시장변수의 증감	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시								이자율 1%p 상승 시	이자율 1%p 하락 시								주가 1% 변동 시	
시장변수 상승 시 당기손익 증가	418,776		151,740									204,420										
시장변수 하락 시 당기손익 감소		(418,776)		(151,740)									(204,420)									
세전 당기손익 위험노출 금액, 변동금리부 금융자산												210,617	(210,617)									

세전 당기손익 위험노출금액, 변동금리부 금융부채												(6,197)	6,197									
시장변수 변동에 따른 세전 당기손익 변동																					52,510	
시장변수 변동에 따른 세전 기타포괄손익 변동																					3,472	
위험에 대한 노출정도에 대한 기술							연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.							이자율변동 위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.								

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술							연결회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 가능통화로 거래하거나 임금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 연결회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가							연결회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.									연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	연결회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통

							하고 있으며 투기적 외환 거래는 엄격히 금지하고 있습니다.															활용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

전기

(단위 : 백만원)

	위험																					위험 합계
	시장위험																					
	환위험							이자율위험							지분가격위험							
	기능통화 또는 표시통화						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	
	USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			
	범위							범위							범위							
	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		
시장변수의 증감	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시								이자율 1%p 상승 시	이자율 1%p 하락 시								주가 1% 변동 시	
시장변수 상승 시 당기손익 증가	258,655		92,546									64,323										
시장변수 하락 시 당기손익 감소		(258,655)		(92,546)									(64,323)									
세전 당기손익 위험노출금액, 변동금리부 금융자산												72,750	(72,750)									
세전 당기손익 위험노출금액, 변동금리부 금융부채												(8,427)	8,427									

시장변수 변동에 따른 세전 당기손익 변동																					92,073	
시장변수 변동에 따른 세전 기타포괄손익 변동																					3,144	
위험에 대한 노출정도에 대한 기술																						
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술																						

신용위험에 대한 공시

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정・관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금
및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 연결회사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

연결회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

당기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	43,302,421	589,743	1,529,785	7,811,246	2,337,792	
파생금융부채	44,252					
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

파생금융부채의 만기분석에 대한 설명						매매목적 파생상품 중 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는 데 필수적이지 않은 순액 결제 요건의 파생금융부채 44,252백만원(전기말: 119,061백만원)은 3개월 이내 구간에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 순액으로 결제되는 파생상품은 연결회사의 환율변동을 관리할 목적으로 계약한 통화선도로 구성되어 있습니다. 위험회피목적 파생상품을 포함한 총액 결제 요건의 파생상품은 보고기간종료일로부터 최대 48개월 이내에 결제될 예정입니다. 이러한 파생상품은 위의 표에 포함되지 않았습니다.
유동성위험에 노출된 금융부채에 대한 설명						보고기간종료일 현재 상기 금융부채 외 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험은 없습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	42,990,570	733,984	1,925,448	5,402,672	1,562,274	
파생금융부채	119,061					
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						
파생금융부채의 만기분석에 대한 설명						

유동성위험에 노출된 금융부채에 대한 설명						

당기 (단위 : 백만원)

	위험회피
	현금흐름위험회피
	파생상품 계약 유형
	통화 관련
	파생상품 유형
	선도계약
	장부금액
	총장부금액
통화선도 자산, 유동	50,018
통화선도 자산, 비유동	19,853
자산 계	69,871
통화선도 부채, 유동	15,031
통화선도 부채, 비유동	18,099
부채 계	33,130
위험회피대상항목이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 현금흐름 위험회피 목적 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	위험회피
	현금흐름위험회피
	파생상품 계약 유형
	통화 관련
	파생상품 유형
	선도계약
	장부금액
	총장부금액
통화선도 자산, 유동	44,567
통화선도 자산, 비유동	15,703
자산 계	60,270
통화선도 부채, 유동	11,035
통화선도 부채, 비유동	15,813
부채 계	26,848

위험회피대상항목이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
현금흐름위험회피에 효과적인 부분에 대한 세후 평가손익, 기타포괄손익	927
현금흐름위험회피에 비효과적인 부분에 대한 세전 평가손익, 당기손익	1,304
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,692
재고자산으로 재분류되는 세후기타포괄손익	51,614

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
현금흐름위험회피에 효과적인 부분에 대한 세후 평가손익, 기타포괄손익	(12,893)
현금흐름위험회피에 비효과적인 부분에 대한 세전 평가손익, 당기손익	611
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,602)
재고자산으로 재분류되는 세후기타포괄손익	55,856

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
부채	92,228,115
자본	363,677,865
부채비율	25.40%
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
부채	93,674,903
자본	354,749,604
부채비율	26.40%
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	

당기 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융자산	단기당기손익-공정가치금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	69,080,893	22,690,924	608,281	27,112	36,647,393	7,481,297	1,431,394	14,840,275	152,807,569
공정가치				27,112		7,481,297	1,431,394	546,021	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산									14,294,254
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.				

전기 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융자산	단기당기손익-공정가치금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	49,680,710	65,102,886	414,610	29,080	35,721,563	11,397,012	1,405,468	10,340,876	174,092,205
공정가치				29,080		11,397,012	1,405,468	395,667	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산									9,945,209
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.				

당기 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
장부금액	11,319,824	7,114,601	13,996,395	1,308,875	1,302,521	6,354	537,618	3,724,850	4,907,875	11,414,008	54,324,046
공정가치				6,757		6,757	529,254			83,463	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융부채											11,330,545

공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		

전기

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
장부금액	10,644,686	5,147,315	16,328,237	1,089,162	1,082,934	6,228	536,093	3,560,672	2,289,236	12,409,529	52,004,930
공정가치				6,580		6,580	521,129			361,768	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융부채											12,047,761
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		

당기

(단위 : 백만원)

	측정 전체																											
	공정가치																											
	금융상품																											금융상품 합계
	단기당기손익-공정가치금융자산				기타포괄손익-공정가치금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타				유동성사채				사채				기타			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		
금융자산	0	27,112	0	27,112	5,250,993	0	2,230,304	7,481,297	347,221	0	1,084,173	1,431,394	0	130,364	415,657	546,021												
금융부채																	0	6,757	0	6,757	0	529,254	0	529,254	0	83,463	0	83,463	

공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술																													공정가치 측정의 투입변수 특정에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. - '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 - '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외) - '수준 3': 관측 가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입 변수에 대한 기술																														활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에

포함됩니다. '수준1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측 가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의

적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정를 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다.

재무보고 원칙에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간중 료원에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장 가격 또는 딜러 가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간

종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다.

유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타 채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사

																												는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

전기

(단위 : 백만원)

	측정 전체																											
	공정가치																											
	금융상품																											금융상품 합계
	단기당기손익-공정가치금융자산				기타포괄손익-공정가치금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타				유동성사채				사채				기타				
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계				공정가치 서열체계의 모든 수준 합계				공정가치 서열체계의 모든 수준 합계				공정가치 서열체계의 모든 수준 합계				공정가치 서열체계의 모든 수준 합계				공정가치 서열체계의 모든 수준 합계				공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	
	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	
금융자산	0	29,080	0	29,080	9,207,295	0	2,189,717	11,397,012	314,449	0	1,091,019	1,405,468	0	373,176	22,491	395,667													
금융부채																	0	6,580	0	6,580	0	521,129	0	521,129	0	354,364	7,404	361,768	
공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술																													
평가기법 및 투입변수에 대한 기술																													

(단위 : 백만원)

	금융상품					
	기타포괄손익-공정가치금융자산				기타	
	삼성벤처투자㈜	㈜미코세라믹스	TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	지분 콜옵션	지분 풋옵션
	관측할 수 없는 투입변수	관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수 합계

가치평가기법	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율 1, 측정투입변수	무위험이자율 2, 측정투입변수	가격변동성 1, 측정투입변수	가격변동성 2, 측정투입변수
현금흐름할인법	0.010	0.171				
현금흐름할인법	0.000	0.158				
현금흐름할인법	0.000	0.106				
현금흐름할인법	0.000	0.106				
이항모형			0.032		0.695	
이항모형			0.039 / 0.052	0.022	0.270	0.240

(범위: 하위범위, 상위범위, 합계 / 유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산)

금융자산, 공정가치	32,286	33,973	1,286,007	226,531	393,235	22,422

당기 (단위 : 백만원)

	수준 3
기초금융자산	3,303,227
취득	207,023
처분	(124,477)
당기손익으로 인식된 손익	297,680
기타포괄손익으로 인식된 손익	46,725
기타	(44)
기말금융자산	3,730,134

전기 (단위 : 백만원)

	수준 3
기초금융자산	3,430,214
취득	207,730
처분	(207,252)
당기손익으로 인식된 손익	73,782
기타포괄손익으로 인식된 손익	(197,830)
기타	(3,417)
기말금융자산	3,303,227

당기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	7,404
당기손익으로 인식된 손익	619
기타	(8,023)
기말금융부채	0

전기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	5,438

당기손익으로 인식된 손익	1,966
기타	0
기말금융부채	7,404

(단위 : 백만원)

	측정 전체										
	공정가치										
	반복적인 공정가치측정치										
	자산										자산 합계
	기타포괄손익-공정가치금융자산					기타					
	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수 합계				관측할 수 없는 투입변수 합계	
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성		영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성		
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					0					101,749	
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					0					(101,696)	
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					161,758					0	

기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					(111,678)					0	
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 기술, 자산	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.						주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.		금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10		
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10		

29. 부문별 보고 (연결)

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당기와 전기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계					기업 전체 총계 합계
	영업부문				중요한 조정사항	
	DX 부문	DS부문	SDC	Harman		
영업수익	169,992,337	66,594,471	30,975,373	14,388,454	(23,015,141)	258,935,494
감가상각비	2,524,199	29,371,056	3,108,935	327,572	0	35,532,411
무형자산상각비	1,721,938	754,901	222,045	200,896	0	3,134,148
영업이익	14,384,705	(14,879,458)	5,566,478	1,173,702	0	6,566,976
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계					기업 전체 총계 합계
	영업부문				중요한 조정사항	
	DX 부문	DS부문	SDC	Harman		
영업수익	182,489,720	98,455,270	34,382,619	13,213,694	(26,309,943)	302,231,360
감가상각비	2,520,708	28,196,959	4,768,498	331,342	0	35,952,098
무형자산상각비	1,678,572	809,270	237,182	211,549	0	3,155,561
영업이익	12,746,074	23,815,810	5,952,973	880,548	0	43,376,630
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
영업수익	30,375,193	108,632,515	44,125,386	30,975,373	258,935,494
주요 제품별 매출액에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
영업수익	33,279,488	115,425,375	68,534,930	34,382,619	302,231,360

주요 제품별 매출액에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	지역						지역 합계
	국내	외국				연결실체 내 내부거래조정	
		미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국		
영업수익	45,599,419	92,136,669	48,108,965	44,814,355	28,276,086	0	258,935,494
비유동자산	163,312,301	20,346,775	6,288,864	8,737,541	12,191,879	(879,236)	209,998,124
비유동자산에 대한 기술							금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	지역						지역 합계
	국내	외국				연결실체 내 내부거래조정	
		미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국		
영업수익	48,654,656	118,974,561	50,283,975	48,692,399	35,625,769	0	302,231,360
비유동자산	144,936,912	14,022,225	5,839,813	9,056,272	15,338,153	(930,233)	188,263,142
비유동자산에 대한 기술							금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

30. 특수관계자와의 거래 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

	기업명(*1)														
	특수관계자											기타(*2)			
	관계기업 및 공동기업						그 밖의 특수관계자			당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진	특수관계자 합계				
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	관계기업 및 공동기업 합계	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	그 밖의 특수관계자 합계			삼성엔지니어링㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	대규모기업집단 소속회사 합계
매출 등	202,810	69,782	110,025	38,930	1,023,702	1,445,249	49,366	582,978	632,344			1,358	9,720	239,223	250,301
비유동자산 처분	0	0	0	0	0	0	70	0	70			0	0	0	0
매입 등	1,984,263	1,113,058	754,792	948,677	12,540,601	17,341,391	270,079	1,675,564	1,945,643			35,482	527,232	1,251,775	1,814,489
비유동자산 매입	291,120	60	31,750	4,900	168,977	496,807	6,149,229	4,686,787	10,836,016			2,837,309	40,327	612,481	3,490,117
채권 등	84,747	1,894	117,690	137	310,708	515,176	213,538	23,155	236,693			305	1,289	16,096	17,690
채무 등(*3)	458,723	138,405	92,854	440,414	1,268,131	2,398,527	1,955,976	318,355	2,274,331			807,098	49,955	390,073	1,247,126
출자, 특수관계자거래						78,690									
출자금 회수, 특수관계자거래						33,457									
지급결의한 배당금, 특수관계자거래											1,650,995				128,232
리스 이용 계약, 특수관계자거래											3,791				
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래											25,443				
단기금여										14,073					
퇴직금여										557					
기타 장기금여										7,834					

특수관계자거래에 대한 기술											(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다. (*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.				(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다. (*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술															(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기

(단위 : 백만원)

	기업명(*1)														
	특수관계자											기타(*2)			
	관계기업 및 공동기업						그 밖의 특수관계자			당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진	특수관계자 합계				
	삼성메스디메스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	관계기업 및 공동기업 합계	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	그 밖의 특수관계자 합계			삼성엔지니어링㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	대규모기업집단 소속회사 합계
매출 등	214,105	62,274	82,062	31,782	1,353,769	1,743,992	51,447	345,901	397,348			1,666	13,634	166,052	181,352
비유동자산 처분	0	767	0	0	0	767	0	188	188			0	0	0	0
매입 등	1,865,588	1,401,483	803,556	964,096	15,158,969	20,193,692	433,100	1,595,487	2,028,587			53,793	510,311	550,757	1,114,861
비유동자산 매입	378,770	120	24,926	361	125,053	529,230	7,423,404	1,910,813	9,334,217			3,249,254	54,069	746,749	4,050,072
채권 등	49,792	385	121,605	223	371,575	543,580	217,818	20,830	238,648			331	3,839	15,647	19,817
채무 등(*3)	512,022	133,952	92,452	453,545	1,236,017	2,427,987	2,783,240	250,103	3,033,343			1,251,039	73,102	545,684	1,869,825
출자, 특수관계자거래						907,958									
출자금 회수, 특수관계자거래						13,087									
지급결의한 배당금, 특수관계자거래											1,663,149				128,232
리스 이용 계약, 특수관계자거래											25,243				
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래											22,607				
단기금여										14,768					
퇴직급여										612					
기타 장기급여										5,434					

특수관계자거래에 대한 기술											(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다. (*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.				(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다. (*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술															(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

31. 비지배지분 (연결)

당기 (단위 : 백만원)

		전체 종속기업
		종속기업
		비지배지분이 중요한 종속기업
		삼성디스플레이㈜와 그 종속기업
비지배지분율		0.152
기초		8,853,712
당기순이익		941,786
배당금		(43,646)
기타		(24,178)
기말		9,727,674
유동자산		24,721,411
비유동자산		46,413,723
유동부채		5,821,885
비유동부채		1,485,250
자본		63,827,999
자본	자본 - 지배기업 소유주지분	63,769,776
	자본 - 비지배지분	58,223
영업수익		30,950,579

당기순이익		6,331,238
기타포괄손익(*4)		(108,689)
총포괄손익(*3)		6,222,549
총포괄손익(*3)	총포괄손익 - 지배기업 소유주지분	6,217,248
	총포괄손익 - 비지배지분	5,301
영업활동현금흐름		9,244,331
투자활동현금흐름		(3,931,091)
재무활동현금흐름		(277,515)
매각예정분류		(14,153)
외화환산으로 인한 현금의 변동		(1,534)
현금및현금성자산의 증가(감소)		5,020,038
기초의 현금및현금성자산		2,309,210
기말의 현금및현금성자산		7,329,248

전기 (단위 : 백만원)

		전체 종속기업
		종속기업
		비지배지분이 중요한 종속기업
		삼성디스플레이㈜와 그 종속기업
비지배지분율		0.152
기초		8,028,555
당기순이익		853,290
배당금		(3,947)
기타		(24,186)
기말		8,853,712
유동자산		42,082,412
비유동자산		23,070,658
유동부채		6,294,310
비유동부채		1,220,097
자본		57,638,663
자본	자본 - 지배기업 소유주지분	57,552,528
	자본 - 비지배지분	86,135
영업수익		34,298,283
당기순이익		6,614,496
기타포괄손익(*4)		(67,942)
총포괄손익(*3)		6,546,554
총포괄손익(*3)	총포괄손익 - 지배기업 소유주지분	6,539,633

	총포괄손익 - 비지배지분	6,921
영업활동현금흐름		11,395,827
투자활동현금흐름		(8,654,933)
재무활동현금흐름		(1,146,117)
매각예정분류		0
외화환산으로 인한 현금의 변동		(44,426)
현금및현금성자산의 증가(감소)		1,550,351
기초의 현금및현금성자산		758,859
기말의 현금및현금성자산		2,309,210

32. 사업결합 (연결)

(단위 : 백만원)

			사업결합
피인수회사명			eMagin Corporation
피취득자에 대한 설명			New York, USA Andrew G. Sculley Jr. 디스플레이 개발 및 생산
취득일			2023-10-18
취득한 의결권이 있는 지분율			1
사업결합의 주된 이유에 대한 기술			연결회사의 종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 OLEDoS 기술 경쟁력을 확보를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation의 지분 100%를 인수하였습니다.
사업결합의 주된 이유에 대한 기술	이전된 현금및현금성자산		295,291
	추가 이전 대가의 공정가치		15,164
	추가 이전 대가의 공정가치	총 이전대가	310,455
	현금및현금성자산		4,473
	매출채권 및 기타채권		13,033
	재고자산		13,753
	유형자산		77,500
	무형자산		15,580
	기타자산		1,691

	매입채무 및 기타채무	(22,370)
	기타부채	(69,653)
	총 식별가능한 순자산	34,007
Ⅲ. 영업권 (Ⅰ- Ⅱ)		276,448
사업결합이 기초에 발생하였다고 가정할 경우 결합기업의 수익		27,781
사업결합이 기초에 발생하였다고 가정할 경우 결합기업의 당기손익		(36,021)
취득일 이후 피취득자의 수익(손실)		4,684
취득일 이후 피취득자의 이익(손실)		(6,847)

33. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)

(단위 : 백만원)

	매각예정 비유동자산
현금및현금성자산	14,153
매출채권	1,316
유동재고자산	4,697
기타유동자산	13,134
유형자산 및 무형자산	181,251
기타비유동자산	3,313
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	217,864
유동부채	27,608
비유동부채	34,046
매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	61,654
외화환산외환차이의 세후차익(차손)	(217)
매각예정 지분율	56.80%
계약체결일자	2023-12-07
처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단에 대한 기술	당기 중 연결회사의 경영진은 ㈜도우인시스 지분 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에게 매각하기로 결정하였습니다. 2023년 12월 7일 계약이 체결되었으며, 2024년 1월 31일 매각이 완료되었습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 55 기 2023.12.31 현재

제 54 기 2022.12.31 현재

제 53 기 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
자산			
유동자산	68,548,442	59,062,658	73,553,416
현금및현금성자산 (주4,28)	6,061,451	3,921,593	3,918,872
단기금융상품 (주4,28)	50,071	137	15,000,576
매출채권 (주4,5,7,28)	27,363,016	20,503,223	33,088,247
미수금 (주4,7,28)	1,910,054	2,925,006	1,832,488
선급비용	1,349,755	1,047,900	817,689
재고자산 (주8)	29,338,151	27,990,007	15,973,053
기타유동자산 (주4,28)	2,475,944	2,674,792	2,922,491
비유동자산	228,308,847	201,021,092	177,558,768
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,6,28)	1,854,503	1,364,325	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	1	283	2,135
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주9)	57,392,438	57,397,249	56,225,599
유형자산 (주10)	140,579,161	123,266,986	103,667,025
무형자산 (주11)	10,440,211	8,561,424	8,657,456
순확정급여자산 (주14)	3,745,697	4,410,223	2,324,291
이연법인세자산 (주25)	9,931,358	2,142,512	1,211,100
기타비유동자산 (주4,7,28)	4,365,478	3,878,090	3,808,630
자산총계	296,857,289	260,083,750	251,112,184
부채			
유동부채	41,775,101	46,086,047	53,067,303
매입채무 (주4,28)	7,943,834	8,729,315	11,557,441
단기차입금 (주4,5,12,28)	5,625,163	2,381,512	9,204,268
미지급금 (주4,28)	15,256,046	18,554,543	13,206,753
선수금 (주17)	302,589	320,689	474,731
예수금 (주4,28)	445,470	523,354	624,585
미지급비용 (주4,17,28)	6,931,991	8,359,296	8,275,410
당기법인세부채	0	2,533,481	5,599,896
유동성장기부채 (주4,12,13,28)	228,491	135,753	139,328
충당부채 (주15)	4,540,702	4,059,491	3,643,853
기타 유동부채 (주17)	500,815	488,613	341,038
비유동부채	30,294,414	4,581,512	4,851,149
사채 (주4,13,28)	19,064	24,912	29,048
장기차입금 (주4,12,28)	22,902,035	654,979	431,915

장기미지급금 (주4,28)	4,942,826	2,439,232	2,653,715
장기충당부채 (주15)	2,413,133	1,423,165	1,659,774
기타 비유동 부채	17,356	39,224	76,697
부채총계	72,069,515	50,667,559	57,918,452
자본			
자본금 (주18)	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주19)	219,963,351	204,388,016	188,774,335
기타자본항목 (주20)	(476,984)	(273,232)	(882,010)
자본총계	224,787,774	209,416,191	193,193,732
자본과부채총계	296,857,289	260,083,750	251,112,184

4-2. 손익계산서

손익계산서

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
영업수익 (주29)	170,374,090	211,867,483	199,744,705
매출원가 (주21)	144,023,552	152,589,393	135,823,433
매출총이익	26,350,538	59,278,090	63,921,272
판매비와관리비 (주21,22)	37,876,835	33,958,761	31,928,110
영업이익 (주29)	(11,526,297)	25,319,329	31,993,162
기타이익 (주23)	29,643,315	4,576,378	7,359,004
기타손실 (주23)	375,723	296,344	745,978
금융수익 (주24)	7,388,664	9,734,299	3,796,979
금융비용 (주24)	7,598,459	9,641,742	3,698,675
법인세비용차감전순이익(손실)	17,531,500	29,691,920	38,704,492
법인세비용(수익) (주25)	(7,865,599)	4,273,142	7,733,538
계속영업이익(손실)	25,397,099	25,418,778	30,970,954
당기순이익(손실)	25,397,099	25,418,778	30,970,954
주당이익 (주26)			
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,739.0	3,742.0	4,559.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,739.0	3,742.0	4,559.0

4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
당기순이익(손실)	25,397,099	25,418,778	30,970,954
기타포괄손익(*4)	(216,079)	613,118	(613,225)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(216,079)	613,118	(613,225)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	356,472	(208,883)	(99,916)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	(572,551)	822,001	(513,309)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0
총포괄손익(*3)	25,181,020	26,031,896	30,357,729

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	178,284,102	(268,785)	183,316,724
당기순이익(손실)			30,970,954		30,970,954
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)				(99,916)	(99,916)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)				(513,309)	(513,309)
배당 (주19)			(20,480,721)		(20,480,721)
2021.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
당기순이익(손실)			25,418,778		25,418,778
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)			4,340	(213,223)	(208,883)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)				822,001	822,001
배당 (주19)			(9,809,437)		(9,809,437)
2022.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191
당기순이익(손실)			25,397,099		25,397,099
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)			(12,327)	368,799	356,472
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)				(572,551)	(572,551)
배당 (주19)			(9,809,437)		(9,809,437)
2023.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기	제 54 기	제 53 기
영업활동현금흐름	34,455,084	44,788,749	51,250,069
영업에서 창출된 현금흐름	8,088,628	49,589,897	50,357,361
당기순이익	25,397,099	25,418,778	30,970,954
조정 (주27)	(4,092,924)	31,039,388	25,168,062
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주27)	(13,215,547)	(6,868,269)	(5,781,655)
이자의 수취	332,111	339,560	282,918
이자의 지급	(798,649)	(287,488)	(125,036)
배당금 수입	29,497,803	3,551,435	6,560,011
법인세 납부액	(2,664,809)	(8,404,655)	(5,825,185)
투자활동현금흐름	(47,571,537)	(28,123,886)	(24,435,207)
단기금융상품의 순감소(증가)	(49,934)	15,000,439	13,600,708
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	15,538	10,976	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(15,515)	0	(234,975)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	243	1,744	912
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	144,292	165,089	605,607
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(108,300)	(1,001,723)	(138,858)
유형자산의 처분	164,415	288,684	408,560
유형자산의 취득	(45,026,206)	(39,160,176)	(36,021,504)
무형자산의 처분	12,002	6,242	5,809
무형자산의 취득	(2,639,614)	(3,298,378)	(2,459,929)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(68,458)	(136,783)	(201,537)
재무활동현금흐름	15,268,902	(16,665,064)	(23,885,054)
단기차입금의 순증가(감소) (주27)	3,274,337	(6,700,826)	(3,288,858)
사채 및 장기차입금의 상환 (주27)	(185,316)	(155,264)	(117,963)
사채 및 장기차입금의 차입 (주27)	21,990,000	0	0
배당금의 지급	(9,810,119)	(9,808,974)	(20,478,233)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(12,591)	2,922	19
현금및현금성자산의순증감	2,139,858	2,721	2,929,827
기초현금및현금성자산	3,921,593	3,918,872	989,045
기말현금및현금성자산	6,061,451	3,921,593	3,918,872

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

보고기업의 명칭 또는 그 밖의 식별 수단

삼성전자주식회사(이하 ""회사"")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

유의적인 회계정책 공시

다음은 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

재무제표 작성기준에 대한 공시

2.1 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

	기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'	기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의	기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세	기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라 2 모범규칙'	최초 적용하는 IFRS 합계
최초 적용하는 IFRS 명칭	- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정	- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정	- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정	

최초 적용하는 IFRS의 경과규정에 대한 기술	공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 또한, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서2 중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다.	회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다.	자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래 당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다.	경제협력개발기구(OECD)가 발표한 필라2 모범규칙을 시행하기 위하여 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법 등에서 생기는 법인세에 기업회계기준서 제1012호 '법인세'를 적용한다는 점을 명확히 합니다.	
최초 적용하는 IFRS의 경과규정에 따른 회계정책의 변경 여부에 대한 기술	이 개정사항은 회계정책의 변경을 수반하는 것은 아니지만, 재무제표에 공시되는 회계정책 정보에 영향을 미칩니다. 회사는 해당 기준서 개정내용에 따라 주석2에서 회사의 중요한 회계정책 정보를 설명하고 있습니다.	해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.	해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.	다만 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 이연법인세 회계처리 요구사항에 한시적 예외 규정을 도입하여 필라2 법인세와 관련되는 이연법인세자산 및 부채를 인식하지아니하고 이에 대한 정보도 공시하지 아니합니다.	가. 회사가 채택한 제・개정 기준서 회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

적용하지 않은 새로운 기준 또는 해석에 대한 설명

(단위 : 백만원)

	기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정	기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정	새로운 IFRSs 합계
새로운 한국채택국제회계기준의 명칭	- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정	- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정	- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정	

예정된 회계정책의 변경의 성격에 대한 기술	보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.	기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정리스료'를 산정하도록 요구합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.	동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 동 개정사항에는 최초로 적용하는 회계연도에 대한 구체적인 경과 규정을 포함합니다. 또한, 조기적용이 허용됩니다.	나. 회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서 제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.
새로운 한국채택국제회계기준의 의무적용일	2024-01-01	2024-01-01	2024-01-01	

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 회계정책에 대한 기술

2.3 종속기업, 관계기업 및 공동기업

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자를 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따라 원가법으로 처리하고 있습니다. 또한, 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우, 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다.

외화거래의 회계정책에 대한 기술

2.4 외화환산

가. 기능통화와 표시통화

회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 회사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")인 대한민국 원화(KRW)를 적용하여 측정하고 있으며, 재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

현금 및 현금성자산 구성요소 결정의 회계정책에 대한 기술

2.5 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기투자자산으로 구성되어 있습니다.

금융자산의 회계정책에 대한 기술

2.6 금융자산

가. 분류

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다. 계약상 현금흐름이 원금과 이자에 대한 지급만으로 이루어져 있는지를 평가할 때, 회사는 해당 상품의 계약조건을 고려합니다.

나. 손상

회사는 미래 전망 정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

매출채권 및 기타채권의 회계정책에 대한 기술

2.7 매출채권

매출채권은 유의적인 금융요소를 포함하는 경우를 제외하고는 최초에 거래가격으로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 손실충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

재고자산 측정의 회계정책에 대한 기술

2.8 재고자산

회사는 미착품을 제외하고는 재고자산의 단위원가를 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에
근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유휴 생산설비 원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다.

회사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액으로, 판가의 하락 또는 완성시까지의 원가 상승을 반영하는 저가법 평가와 재고의 과잉 또는 진부화로 인한 가치의 하락을 반영하는 과잉/진부화평가의 2가지 평가방법을 적용합니다.

유형자산의 회계정책에 대한 기술

2.9 유형자산

회사는 제품의 생산 등 자산을 경영진이 의도한 목적으로 사용할 수 있게 되었다고 판단된 시점을 기준으로 감가상각을 개시하고 있습니다.

회사의 유형자산은 취득원가에서 잔존가액을 차감한 가액이 회사가 추정한 추정내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련 자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

자산별로 회사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

	유형자산								
	건물 및 구축물			기계장치			기타		
	범위		범위 합계	범위 합계		범위 합계	범위 합계		범위 합계
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		하위범위	상위범위	
추정내용연수	15년	30년				5년			5년
감가상각방법, 유형자산			정액법			정액법			정액법

무형자산 및 영업권의 회계정책에 대한 기술

2.10 무형자산

영업권은 사업의 취득시점에 회사가 식별가능 순자산에 대해 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며, 무형자산으로 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

회원권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정 되지 않아 상각되지 않습니다. 하지만 회원권의 시장가치 하락 등 손상 징후 발견 시
합리적으로 추정하여 손상을 반영합니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정 된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수 동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

	영업권 이외의 무형자산		
	특허권, 상표권 및 기타무형자산		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
추정내용연수	5년	10년	
상각방법, 영업권 이외의 무형자산			정액법

금융부채의 회계정책에 대한 기술

2.11 금융부채

회사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고
있습니다.

종업원급여의 회계정책에 대한 기술

2.12 종업원급여

회사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채(자산)는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 과소적립액(자산인식상한을 한도로 하는 초과적립액)이며, 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다
.

법인세의 회계정책에 대한 기술

2.13 법인세비용

회사는 필라2 규칙과 관련되는 이연법인세의 인식 및 공시에 대한 예외 규정을 적용하고 있습니다. 또한, 관련 법률이 2024년 1월 1일부터 시행될 예정이므로 보고기간 중 회사가 인식한 필라2 관련 당기법인세비용은 없습니다.

회사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸 시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

파생금융상품의 회계정책에 대한 기술

2.14 파생상품

회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피 금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

수익인식 회계정책에 대한 기술

2.15 수익인식

회사의 수익은 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액에서 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액 등을 차감한 순액으로 표시하고 있습니다.

(1) 수행의무의 식별

회사는 고객과의 계약에 따라 재화 및 용역에 대한 통제를 이전할 의무가 있습니다. 회사가 Incoterms Group C 조건(무역조건 CIF 등)에 따라 제품 및 상품을 수출하는 경우, 고객에게 재화의 통제가 이전된 이후 제공하는 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 한시점에 이행하는 수행의무

회사의 수익은 주로 재화의 판매에서 발생하고 있으며, 재화의 통제가 고객에게 이전되는 시점에 수익을 인식하고 있습니다.

(3) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하게 되는 S/W판매, 운송용역, 설치용역 등의 경우, 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 변동대가

회사는 인센티브, 판매장려금, 매출에누리 등 다양한 판매촉진 정책을 운영하고 있습니다. 이러한 판매촉진 정책으로 인해 고객과 약속한 대가에 변동가능성이 있는 경우, 고객으로부터 이미 받았거나 받을 대가 중 권리를 갖지 않을 것으로 예상하는 금액(변동대가)을 기대값 또는 가능성이 가장 높은 금액 중 보다 신뢰성 있는 방법으로 추정하고 있습니다. 변동대가의 추정치는 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하며, 관련 매출이 발생한 시점과 고객에게 변동대가를 지급하기로 결정한 시점 중 늦은 시점에 수익 및 계약부채를 인식합니다.

회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대해 경험률에 기초한 기대값 방법으로 반품율을 예측하여 계약부채(환불부채)를 인식하고 있습니다. 고객이 반품권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

리스의 회계정책에 대한 기술

2.16 리스

(1) 리스이용자

회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 실무적 간편법을 적용하여, 계약에서 리스요소와 리스가 아닌 요소(이하 "비리스요소")를 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련된 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류하며, 리스부채는 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하며, 회사는 현재가치 측정 시 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하)와 소액자산 리스(기초자산 US$ 5,000 이하)의 경우 실무적 간편법을 적용하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자

리스제공자로서 회사는 리스약정일에 리스가 금융리스인지 운용리스인지 판단합니다.

회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약 단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

정부보조금에 대한 회계정책에 대한 기술

2.17 정부보조금

수익과 관련된 정부보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 수익 또는 비용과 대응될 수 있는 기간에 손익계산서에 인식하고 있습니다. 한편, 특정 자산의 취득과 관련된 정부보조금은 이연수익으로 처리하고, 관련 자산의 내용연수 동안 상각하여 손익으로 반영하고 있습니다.

재무제표의 승인에 대한 공시

2.18 재무제표의 승인

회사의 재무제표는 2024년 1월 31일 이사회에서 승인되었으며, 향후 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

	중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 자산과 부채에 관한 설명
다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험에 대한 기술	회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.
다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 자산의 성격에 대한 기술	다. 금융상품의 공정가치 회사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다. 라. 금융자산의 손상 회사는 금융자산의 손실충당금을 측정할 때에 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 회사는 이러한 가정을 세우고 손상계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간종료일의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다. 사. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 회사는 매년 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위 또는 자산의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 부채의 성격에 대한 기술	나. 판매보증충당부채 회사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간종료일 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다. 바. 순확정급여부채(자산) 순확정급여부채(자산)는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채(자산)의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 회사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채(자산)의 정산시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용되어야 하는 이자율을 나타냅니다. 순확정급여부채(자산)와 관련된 주요한 가정들 중 일부는 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

다음 회계연도에 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 가진 기타 항목의 성격에 대한 기술	가. 수익인식 회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매 시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기대값 방법으로 반품률을 예측하고 있으며, 회사의 수익은 예측된 반품률의 변동에 영향을 받습니다. 회사는 재화의 판매로 인한 수익을 통제가 이전되는 시점에 계약에 따른 대가에서 특정 매출장려활동을 차감한 금액으로 인식하고 있습니다. 과거의 경험 및 계약에 기초하여 매출차감액을 합리적으로 추정하고 있으며, 회사의 수익은 추정된 매출차감에 영향을 받습니다. 마. 리스 회사는 리스기간을 산정할 때에 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다. 선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다. 아. 법인세 회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 회사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산・부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산・부채에 영향을 줄 수 있습니다. 회사는 특정 기간 동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서 해당 기간의 당기법인세와

	이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 회사는 법인세 처리의 불확실성 여부를 검토하고 있으며, 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높지 않다고 결론을 내리는 경우에는 불확실한 법인세 처리 각각에 다음 방법 가운데 불확실성의 해소를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 불확실성의 영향을 재무제표에 반영하고 있습니다. (1) 가능성이 가장 높은 금액: 가능한 결과치 범위에서 가능성이 가장 높은 단일금액 (2) 기대값: 가능한 결과치의 범위에 있는 모든 금액에 각 확률을 곱한 금액의 합

4. 범주별 금융상품

당기 (단위 : 백만원)

			금융자산, 범주			
			상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
금융자산			38,446,822	1,854,503	393,236	40,694,561
금융자산	금융자산, 분류	현금및현금성자산	6,061,451	0	0	6,061,451
		단기금융상품	50,071	0	0	50,071
		매출채권	27,363,016	0	0	27,363,016
		기타포괄손익-공정가치금융자산	0	1,854,503	0	1,854,503
		당기손익-공정가치금융자산	0	0	1	1
		기타	4,972,284	0	393,235	5,365,519

전기 (단위 : 백만원)

			금융자산, 범주			
			상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
금융자산			29,895,308	1,364,325	283	31,259,916
금융자산	금융자산, 분류	현금및현금성자산	3,921,593	0	0	3,921,593
		단기금융상품	137	0	0	137
		매출채권	20,503,223	0	0	20,503,223
		기타포괄손익-공정가치금융자산	0	1,364,325	0	1,364,325
		당기손익-공정가치금융자산	0	0	283	283
		기타	5,470,355	0	0	5,470,355

당기 (단위 : 백만원)

			금융부채, 범주		
			상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	계
금융부채			53,114,189	6,759,335	59,873,524
금융부채	금융부채, 분류	매입채무	7,943,834	0	7,943,834
		단기차입금	0	5,625,163	5,625,163
		단기미지급금	15,015,578	0	15,015,578
		유동성장기부채	6,354	222,137	228,491
		사채	19,064	0	19,064
		장기차입금	21,990,000	912,035	22,902,035
		장기미지급금	4,486,390	0	4,486,390
		기타	3,652,969	0	3,652,969

전기 (단위 : 백만원)

			금융부채, 범주		
			상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	계
금융부채			32,314,322	3,166,016	35,480,338
금융부채	금융부채, 분류	매입채무	8,729,315	0	8,729,315
		단기차입금	0	2,381,512	2,381,512
		단기미지급금	18,324,604	0	18,324,604
		유동성장기부채	6,228	129,525	135,753
		사채	24,912	0	24,912
		장기차입금	0	654,979	654,979
		장기미지급금	2,083,790	0	2,083,790
		기타	3,145,473	0	3,145,473

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을
포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	금융자산, 범주 합계
평가손익(기타포괄손익)	0	356,472	0	356,472

평가・처분손익(당기손익)	0	0	365,387	365,387
이자수익(금융수익)	371,106	0	0	371,106
외환차이(당기손익)	(216,145)	0	0	(216,145)
배당금수익	0	4,081	637	4,718
손상(환입)	(2,113)			(2,113)

전기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	금융자산, 범주 합계
평가손익(기타포괄손익)	0	(208,883)	0	(208,883)
평가・처분손익(당기손익)	0	0	271,057	271,057
이자수익(금융수익)	339,242	0	0	339,242
외환차이(당기손익)	(668,955)	0	0	(668,955)
배당금수익	0	3,594	0	3,594
손상(환입)	(2,130)			(2,130)

당기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
이자비용	(310,267)	(285,498)	(595,765)
외환차이(당기손익)	5,103	31,557	36,660

전기 (단위 : 백만원)

	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
이자비용	(45,883)	(244,200)	(290,083)
외환차이(당기손익)	477,397	132,902	610,299

5. 금융자산의 양도

당기 (단위 : 백만원)

	매출채권
할인된 매출채권의 장부금액	5,625,163
관련 차입금의 장부금액	5,625,163
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채과의 관계의 성격에 대한 기술	회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).

전기 (단위 : 백만원)

	매출채권
할인된 매출채권의 장부금액	2,381,512
관련 차입금의 장부금액	2,381,512
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채과의 관계의 성격에 대한 기술	회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).

6. 공정가치금융자산

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,854,503

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,364,325

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
비유동 당기손익인식금융자산	1

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
비유동 당기손익인식금융자산	283

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산
	장부금액	
	공시금액	
기초	1,364,325	283
취득	15,515	
처분	(15,577)	(282)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	490,240	
기타	0	0
기말	1,854,503	1

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산
	장부금액	
	공시금액	
기초	1,662,532	2,135
취득	0	
처분	(10,976)	(1,744)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(285,585)	
기타	(1,646)	(108)
기말	1,364,325	283

당기 (단위 : 백만원)

	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
기초	(166,635)
공정가치평가	490,240
처분으로 인한 이익잉여금 대체	16,627
기말	340,232
차감: 자본에 가감되는 법인세효과 및 비지배지분	(94,077)
계	246,155

전기 (단위 : 백만원)

	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
기초	124,937
공정가치평가	(285,585)
처분으로 인한 이익잉여금 대체	(5,987)
기말	(166,635)
차감: 자본에 가감되는 법인세효과 및 비지배지분	43,991
계	(122,644)

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																																									
	공정가치측정 금융자산																																									
	상장주식																																									
	삼성중공업㈜		㈜호텔신라		㈜아이마켓코리아		㈜케이티스카이라이프		㈜용평리조트		㈜에이테크솔루션		㈜판막출당스		㈜판막아이피에스		㈜동진쎄미켐		솔브레인홀딩스㈜		솔브레인㈜		㈜에스앤에스텍		와이아이케이㈜		㈜케이씨텍		㈜원오티비용		㈜뉴파워프라즈마		㈜에프에스티		㈜디엔에프		Marvell Technology, Inc.		SoundHound AI, Inc.		합계	
	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액	장부금액
	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계	취득원가	합계
장부금액(시장가치)	932,158	1,038,712	13,957	131,108	324	5,560	3,344	1,421	1,869	1,220	26,348	17,241	15,410	5,928	16,214	62,839	48,277	95,508	0	0	40,382	132,952	65,933	77,740	47,336	47,864	20,720	27,395	18,990	25,544	12,739	11,240	43,009	37,541	20,964	19,400	11,705	13,468	13,719	4,655	1,353,398	1,757,336
보유주식수(주)		134,027,281주		2,004,717주		647,320주		240,000주		400,000주		1,592,000주		1,759,171주		1,856,936주		2,467,894주		0주		437,339주		1,716,116주		9,601,617주		1,022,216주		1,267,688주		2,140,939주		1,522,975주		810,030주		173,187주		1,702,957주		
지분율		15.20%		5.10%		1.90%		0.50%		0.80%		15.90%		2.30%		3.80%		4.80%		0		5.60%		8.00%		11.70%		4.90%		7.10%		4.90%		7.00%		7.00%		0.00%		0.70%		

지분율에 대한 설명																																														(+) 증빙 행보 통주 식수 기준 지분율임니다.

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																																													
	공정가치측정 금융자산																																													
	상장주식																																													
	삼성중공업㈜		㈜호텔신라		㈜아이마켓코리아		㈜케이티스카이라이프		㈜용평리조트		㈜에이테크솔루션		㈜판막홀딩스		㈜판막아이피메스		㈜동진쎄미켐		솔브레인홀딩스㈜		솔브레인㈜		㈜에스엔에스텍		와이아이케이㈜		㈜케이씨텍		㈜원오티비큐		㈜뉴파워프라즈마		㈜에프에스티		㈜디엔에프		Marvell Technology, Inc.		SoundHound AI, Inc.		합계	
	장부금액	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계
	취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가		취득원가	
장부금액(시장가치)	932,158	684,879	13,957	166,592	324	6,538	3,344	1,954	1,869	1,412	26,348	12,879	15,410	5,972	16,214	45,811	48,277	73,913	30,752	10,989	24,866	81,357	65,933	45,220	47,336	26,933	20,720	15,129	18,990	14,326	12,739	7,579	43,009	23,758	20,964	10,692	11,705	8,129	13,719	3,820	13,719	1,247,862
보유주식수(주)																																														
지분율																																														
지분율에 대한 설명																																														

7. 매출채권 및 미수금

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	손상차손누계	장부금액 합계
매출채권	27,421,756	(58,740)	27,363,016
미수금	1,927,564	(6,230)	1,921,334

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	손상차손누계	장부금액 합계
매출채권	20,720,707	(56,432)	20,664,275
미수금	2,945,898	(6,387)	2,939,511

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
비유동매출채권	0
유동매출채권	27,363,016
장기미수금	11,280
단기미수금	1,910,054

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
비유동매출채권	161,052
유동매출채권	20,503,223
장기미수금	14,505
단기미수금	2,925,006

당기 (단위 : 백만원)

	매출채권	미수금
기초	56,432	6,387
대손상각(환입)	2,308	(145)
제각	0	(12)
기말	58,740	6,230

전기 (단위 : 백만원)

	매출채권	미수금
기초	56,610	4,397
대손상각(환입)	(178)	1,994
제각	0	(4)
기말	56,432	6,387

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																																							
	상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류																																							
	매출채권																												미수금											
	금융자산의 손상차손 전체금액																																							
	기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				총장부금액				기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				총장부금액			
	연체상태				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계			
	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계
금융자산				26,584,115	430,299					252,998	154,344					837,641				27,421,756				1,747,904	142,166			0	0	7,893	29,601			0	0	179,660				1,927,564

기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보					회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.																			회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.														

전기

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류																																					
	상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류																																					
	매출채권																				미수금																	
	금융자산의 손상차손 전체금액																																					
	기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				충당부금액				기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산				기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산				손상된 금융자산				기간이 경과된 금융자산				충당부금액			
	연체상태				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계				연체상태 합계			
	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	연체상태 합계
금융자산				19,948,076	581,231					89,722	101,678					772,631				20,720,707				2,237,287	651,489					30,611	26,511					706,611				2,945,898

기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보					회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.																				회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.															

채권의 신용위험 금액에 대한 설명

보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액입니다. 회사의 주요 채권과 관련하여 보험사와 보험계약을 체결하고 있습니다.

8. 재고자산

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	7,914,117	(1,203,662)	6,710,455
반제품 및 재공품	21,866,523	(3,863,881)	18,002,642
원재료 및 저장품	4,910,170	(861,821)	4,048,349
미착품	576,705	0	576,705
재고자산 계	35,267,515	(5,929,364)	29,338,151
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가			142,735,272

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	8,589,879	(956,427)	7,633,452
반제품 및 재공품	16,738,121	(1,216,059)	15,522,062
원재료 및 저장품	4,891,951	(492,006)	4,399,945

미착품	434,548	0	434,548
재고자산 계	30,654,499	(2,664,492)	27,990,007
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가			151,436,315

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가에 대한 기술

동 비용에는 재고자산평가손실 금액이 포함되어 있습니다.

9. 관계기업 및 공동기업 투자

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	57,397,249
취득	108,300
처분	(144,317)
손상환입	31,206
기말	57,392,438

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	56,225,599
취득	1,272,296
처분	(164,503)
손상환입	63,857
기말	57,397,249

당기 (단위 : 백만원)

	전체 관계기업 투자금액				
	관계기업				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜(*2)	㈜제일기획
기업명	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
관계의 성격	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	신사업 투자	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	광고 대행업
지분율(%)(*1)	23.70%	22.60%	31.20%	19.60%	25.20%

유통보통주식수 기준 관계기업에 대한 소유지분율				20.60%	
주사업장	한국	한국	한국	한국	한국
결산월	2023-12-31	2023-12-31	2023-12-31	2023-12-31	2023-12-31
유동자산	5,208,418	8,160,300	5,521,988	9,187,029	2,372,420
비유동자산	6,449,453	4,160,724	10,524,209	24,851,831	517,085
유동부채	2,900,460	2,391,861	4,157,861	8,518,933	1,375,034
비유동부채	727,087	953,592	2,057,844	5,612,677	216,707
매출	8,909,348	13,276,844	3,694,589	22,708,300	4,138,275
계속영업손익(*3)	430,839	693,422	857,691	2,009,207	187,302
세후중단영업손익(*3)	(7,883)	0	0	0	0
기타포괄손익(*4)	45,054	(11,085)	(11,673)	85,394	3,685
총포괄손익(*4)	468,010	682,337	846,018	2,094,601	190,987
주식수(주)	17,693,084주	17,472,110주	22,217,309주	13,462,673주	29,038,075주
시장가치	2,710,580	2,970,259	16,885,155	6,354,382	552,595
장부금액	445,244	560,827	1,595,892	1,242,605	491,599

전기 (단위 : 백만원)

	전체 관계기업 투자금액				
	관계기업				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜(*2)	㈜제일기획
기업명					
관계의 성격					
지분율(%)(*1)					
유통보통주식수 기준 관계기업에 대한 소유지분율					
주사업장					
결산월					
유동자산	4,888,319	8,005,764	6,457,657	9,651,702	2,193,979
비유동자산	6,108,852	3,946,660	10,124,394	20,605,823	557,466
유동부채	2,525,123	2,493,323	4,181,542	8,006,939	1,335,643
비유동부채	778,563	992,132	3,416,034	5,033,084	194,373
매출	9,441,276	17,234,750	3,001,295	20,124,070	4,253,367
계속영업손익(*3)	1,009,739	1,099,745	798,056	1,952,149	193,732
세후중단영업손익(*3)	(29,187)	0	0	0	0
기타포괄손익(*4)	(2,215)	80,368	6,995	(139,877)	(1,122)
총포괄손익(*4)	978,337	1,180,113	805,051	1,812,272	192,610
주식수(주)					
시장가치	2,308,947	2,149,070	18,240,411	7,956,440	669,328
장부금액	445,244	560,827	1,595,892	1,242,605	491,599

관계기업의 요약재무정보 작성기준에 대한 기술

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.
(*) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

당기 (단위 : 백만원)

	전체 종속기업																
	기업명(*)																
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	세메스㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)
자산	65,328,568	41,926,899	22,234,942	15,808,283	10,222,557	9,660,481	7,738,259	5,542,627	5,262,086	3,039,379	2,902,722	2,187,919	2,153,032	1,797,627	1,794,552		
부채	7,266,213	15,322,780	282,614	870,453	8,797,991	4,585,806	3,373,730	1,587,911	4,552,030	640,512	1,976,067	659,607	1,038,115	1,139,056	639,120		
매출	27,083,336	39,551,809	0	8,693,788	3,148,858	0	15,216,331	7,222,304	15,649,307	4,213,492	5,859,133	2,502,143	3,638,080	4,108,479	2,833,717		
당기순이익(손실)	8,268,314	477,338	14,140,195	877,892	189,887	103,387	1,153,256	333,812	244,210	150,510	185,113	58,754	148,873	56,467	140,313		

전기 (단위 : 백만원)

	전체 종속기업																
	기업명(*)																
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	세메스㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)
자산	57,302,567	37,883,156	26,894,611	17,095,000	13,830,988	10,841,515	6,772,537	4,600,508	5,067,891	3,263,473	2,819,792	2,065,558			2,377,730	2,374,317	2,194,975
부채	7,282,718	12,258,315	2,678,285	2,970,835	9,764,636	6,272,800	3,571,863	1,342,517	2,858,382	486,820	1,708,064	602,323			597,044	452,628	2,021,491
매출	30,779,405	46,738,920	0	9,679,757	2,865,831	0	16,180,492	7,485,104	21,370,622	4,824,734	5,929,357	2,889,238			2,834,008	3,935,745	15,409,984
당기순이익(손실)	4,365,588	219,670	8,699,679	638,385	257,878	57,997	508,510	(38,490)	318,578	168,524	243,396	185,762			25,411	199,742	20,347

종속기업의 요약재무정보 작성기준에 대한 기술

(*) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

10. 유형자산

당기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타	유형자산 합계
기초 유형자산	7,752,989	23,246,622	61,426,540	28,768,364	2,072,471	123,266,986
일반취득 및 자본적 지출	131,535	5,509,158	31,107,219	5,907,608	461,345	43,116,865
감가상각비, 유형자산	(1,003)	(2,135,709)	(22,908,637)	0	(574,245)	(25,619,594)
유형자산의 처분 및 폐기 합계	(2,277)	(25,652)	(95,125)	0	(5,330)	(128,384)
손상	0	(27,715)	(24,920)	0	(1,547)	(54,182)
기타	(22)	(2,408)	(12,290)	(641)	12,831	(2,530)
기말 유형자산	7,881,222	26,564,296	69,492,787	34,675,331	1,965,525	140,579,161

전기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타	유형자산 합계
기초 유형자산	7,780,994	21,841,816	57,135,313	15,307,502	1,601,400	103,667,025
일반취득 및 자본적지출	154	3,246,081	26,182,600	13,481,591	1,085,750	43,996,176
감가상각비, 유형자산	(439)	(1,827,588)	(21,889,623)	0	(594,290)	(24,311,940)
유형자산의 처분 및 폐기 합계	(27,720)	(20,264)	(137,496)	0	(8,247)	(193,727)
손상						
기타	0	6,577	135,746	(20,729)	(12,142)	109,452
기말 유형자산	7,752,989	23,246,622	61,426,540	28,768,364	2,072,471	123,266,986

당기 (단위 : 백만원)

	유형자산																	
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타			계		
	장부금액			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계		
	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계
기초 유형자산	7,754,559	(1,570)	7,752,989	36,449,026	(13,202,404)	23,246,622	199,823,339	(138,396,799)	61,426,540	28,768,364	0	28,768,364	4,886,059	(2,813,588)	2,072,471	277,681,347	(154,414,361)	123,266,986
기말 유형자산	7,883,620	(2,398)	7,881,222	41,814,348	(15,250,052)	26,564,296	228,287,817	(158,795,030)	69,492,787	34,675,331	0	34,675,331	5,182,709	(3,217,184)	1,965,525	317,843,825	(177,264,664)	140,579,161

전기 (단위 : 백만원)

	유형자산																	
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타			계		
	장부금액			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계			장부금액 합계		
	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계	취득원가	감가상각누계액 (손상 포함)	장부금액 합계
기초 유형자산	7,782,125	(1,131)	7,780,994	33,244,532	(11,402,716)	21,841,816	175,487,461	(118,352,148)	57,135,313	15,307,502	0	15,307,502	4,022,759	(2,421,359)	1,601,400	235,844,379	(132,177,354)	103,667,025
기말 유형자산	7,754,559	(1,570)	7,752,989	36,449,026	(13,202,404)	23,246,622	199,823,339	(138,396,799)	61,426,540	28,768,364	0	28,768,364	4,886,059	(2,813,588)	2,072,471	277,681,347	(154,414,361)	123,266,986

일반취득 및 자본적지출에 대한 각주, 유형자산

(*) 일반취득 및 자본적지출은 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	유형자산	자산 합계
자본화된 차입원가	646,471	646,471
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.046	0.046

전기 (단위 : 백만원)

	유형자산	자산 합계
자본화된 차입원가	40,577	40,577
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율		

당기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타	자산 합계
기초	1,866	642,700	22,135	569,312	1,236,013
일반취득	3,712	863,062	1,728	4,554	873,056
감가상각	(1,003)	(189,855)	(16,057)	(40,749)	(247,664)
계약의 해지	0	(20,500)	0	(234)	(20,734)
기타	0	(114)	336	20	242
기말	4,575	1,295,293	8,142	532,903	1,840,913

전기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타	자산 합계
기초	2,279	510,528	39,038	178,480	730,325
일반취득	26	261,999	1,380	410,088	673,493
감가상각	(439)	(128,754)	(23,276)	(19,120)	(171,589)
계약의 해지	0	(1,070)	0	(737)	(1,807)
기타	0	(3)	4,993	601	5,591
기말	1,866	642,700	22,135	569,312	1,236,013

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	23,618,150	2,001,444	25,619,594

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	22,486,452	1,825,488	24,311,940

11. 무형자산

당기 (단위 : 백만원)

	산업재산권	개발비	회원권	기타	영업권 이외의 무형자산 합계
기초의 무형자산 및 영업권	1,193,286	85,018	199,870	7,083,250	8,561,424
개별취득	371,570	0	1,069	4,174,044	4,546,683
상각	(229,849)	(85,018)	0	(2,299,322)	(2,614,189)
처분・폐기	(40,944)	0	(7,850)	(560)	(49,354)
손상(환입)	(6,265)	0	3,738	(3,114)	(5,641)
기타	0	0	0	1,288	1,288
기말 무형자산 및 영업권	1,287,798	0	196,827	8,955,586	10,440,211

전기 (단위 : 백만원)

	산업재산권	개발비	회원권	기타	영업권 이외의 무형자산 합계

기초의 무형자산 및 영업권	1,226,241	236,910	195,135	6,999,170	8,657,456
개별취득	232,768	0	5,795	2,315,598	2,554,161
상각	(217,808)	(151,892)	0	(2,235,367)	(2,605,067)
처분・폐기	(47,915)	0	(197)	0	(48,112)
손상(환입)	0	0	(863)	0	(863)
기타	0	0	0	3,849	3,849
기말 무형자산 및 영업권	1,193,286	85,018	199,870	7,083,250	8,561,424

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,016,938	597,251	2,614,189

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,006,928	598,139	2,605,067

12. 차입금

당기 (단위 : 백만원)

	차입금명칭																							
	단기차입금				유동성장기차입금				장기 차입금												리스 부채	리스 부채	리스 부채	리스 부채
	담보부차입금-우리은행 등				리스 부채_1				리스 부채_2				무담보차입금-삼성디스플레이㈜				장기차입금 합계				합계	합계 합계	합계 합계	합계 합계
	범위			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계
	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위	
차입금, 만기				0				0				0				2025-08-16								
연이자율	0.000		0.173			0.029				0.029						0.046								
단기차입금 및 유동성 장기차입금				5,625,163				222,137																
장기차입금												912,035				21,990,000				22,902,035				

차입금에 대한 기술				담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.																				리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당기 중 발생한 이자비용은 28,282백만원(전기: 10,876백만원)입니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 51,569백만원(전기: 63,103백만원)입니다.
인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스 및 단기리스를 포함한 리스료에 관련되는 비용																								51,569
리스부채에 대한 이자비용																								28,282

전기

(단위 : 백만원)

	차입금명칭																							
	단기차입금				유동성장기차입금				장기 차입금												리스 부채	리스 부채	리스 부채	리스 부채
	담보부차입금-우리은행 등				리스 부채_1				리스 부채_2				무담보차입금-삼성디스플레이㈜				장기차입금 합계				합계	합계 합계	합계 합계	합계 합계
	범위			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계	범위 합계			범위 합계
	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위	
차입금, 만기																2025-08-16								
연이자율	0.000		0.173			0.029				0.029						0.046								

단기차입금 및 유동성 장기차입금				2,381,512				129,525															
장기차입금												654,979				0				654,979				
차입금에 대한 기술				담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.																				리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당기 중 발생한 이자비용은 28,282백만원(전기: 10,876백만원)입니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 51,569백만원(전기: 63,103백만원)입니다.
인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스 및 단기리스를 포함한 리스료에 관련되는 비용																								63,103
리스부채에 대한 이자비용																								10,876

(단위 : 백만원)

	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년 이후	합계 구간 합계
장기차입금	1,012,236	22,873,362	0	0	0	23,885,598
리스부채	257,823	178,055	198,744	149,858	481,592	1,266,072

13. 사채

당기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bond	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	
만기상환일	2027-10-01	
연이자율(%)	0.077	
명목금액	25,788	
명목금액, 외화금액	US$ 20,000천	
사채할인발행차금		(370)
계		25,418
차감: 유동성사채		(6,354)
비유동성사채		19,064
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bond	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	
만기상환일	2027-10-01	
연이자율(%)		
명목금액	31,683	
명목금액, 외화금액	US$ 25,000천	
사채할인발행차금		(543)
계		31,140
차감: 유동성사채		(6,228)
비유동성사채		24,912
사채에 대한 기술		

(단위 : 백만원)

	2024년	2025년	2026년	2027년	합계 구간 합계
사채, 미할인현금흐름	6,447	6,447	6,447	6,447	25,788

14. 순확정급여부채(자산)

당기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계

확정급여채무, 현재가치	11,959,655	22,672	11,982,327
사외적립자산의 공정가치			(15,728,024)
순확정급여부채(자산) 계			(3,745,697)

전기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	10,729,126	29,546	10,758,672
사외적립자산의 공정가치			(15,168,895)
순확정급여부채(자산) 계			(4,410,223)

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			962,366
순이자비용(수익), 확정급여제도			(275,246)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	271,113	416,007	687,120
퇴직급여비용, 확정기여제도			48,884

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,030,033
순이자비용(수익), 확정급여제도			(91,902)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	373,835	564,296	938,131
퇴직급여비용, 확정기여제도			36,580

당기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

기초	10,758,672	15,168,895
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	962,366	
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	613,363	888,609
재측정요소		(494,687)
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	(61,559)	
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	226,995	
- 기타사항에 의한 효과	117,800	
사용자의 기여금		694,100
급여지급액	(653,343)	(537,855)
기타	18,033	8,962
기말	11,982,327	15,728,024
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치		1,347,628

전기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초	11,173,636	13,497,927
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,030,033	
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	401,973	493,875
재측정요소		(249,943)
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	0	
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	(1,779,803)	
- 기타사항에 의한 효과	356,672	
사용자의 기여금		1,757,800
급여지급액	(455,787)	(355,311)

기타	31,948	24,547
기말	10,758,672	15,168,895
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치		

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시

바. 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 원금보장형 고정수익 상품 등에 투자되어 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	할인율에 대한 보험수리적 가정	미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.056	
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		0.056
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)	(10,888,509)	13,242,324
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	13,258,187	(10,880,916)

전기 (단위 : 백만원)

	할인율에 대한 보험수리적 가정	미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.061	
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		0.058
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)	(9,947,680)	11,703,469
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율	0.01	0.01

보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	11,689,622	(9,922,271)

	가중범위
확정급여채무의 가중평균만기	9년11개월21일

15. 충당부채

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
기초	587,665	1,546,606	549,181	2,799,204	5,482,656
순전입(환입)	815,216	573,194	348,381	2,052,943	3,789,734
사용	(728,930)	(299,250)	(183,843)	(1,111,233)	(2,323,256)
기타	0	(4,612)	0	9,313	4,701
기말	673,951	1,815,938	713,719	3,750,227	6,953,835
충당부채의 성격에 대한 기술	회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.	회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.	회사는 생산 및 판매를 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.	

	연도			
	당기 이행연도	잔여 계획기간		
		2024년	2025년	잔여 계획기간 합계
무상할당 배출권	1176만톤(tCO2-eq)	1117만톤(tCO2-eq)	1117만톤(tCO2-eq)	2234만톤(tCO2-eq)

배출량 추정치	1362만톤(tCO2-eq)			

	공시금액
무상할당배출권 수량	3,964만톤
담보로 제공된 배출권 수량	-

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	1,265
사용	(17,695)
기말	3,137

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	46,073
증가	1,872
사용	(28,378)
기말	19,567

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	32,825
순전입	(15,348)
사용	(17,477)
기말	0

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	45,049
순전입	16,154
사용	(28,378)
기말	32,825

16. 우발부채와 약정사항

(단위 : 백만원)

	채무지급보증 - SETK	채무지급보증 - SEMAG	채무지급보증 - 기타	채무지급보증 - 계	계약이행지급보증	제공받는 담보 및 지급보증	분할 전 채무에 대한 연대채무	무역금융, 상업어음 할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정	무역금융 약정	외상매출채권담보대출 약정	발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정
해외종속기업, 차입기업	SETK	SEMAG	기타								
보증처	BNP 외	SocGen 외	기타								
보증종료일	2024-12-16	2024-12-16									
관련 차입금	413,744	10,399	0	424,143							
관련 차입금, 외화				US$ 328,958천							
총 약정금액	1,182,380	123,782	9,176,026	10,482,188	478,560			10,440,914		470,602	6,962,653
총 약정금액, 외화				US$ 8,129,508천					US$ 8,908백만		
약정에 대한 설명				(1) 보고기간종료일 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 채무보증 내역은 다음과 같습니다.	(2) 보고기간종료일 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 478,560백만원입니다.	(3) 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.	다. 분할과 관련된 연대채무 회사와 삼성디스플레이㈜ 등은 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.	(1) 보고기간종료일 현재 회사는 우리은행 외 4개 은행과 무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 10,440,914백만원입니다.	이외에도 회사는 신한은행 외 18개 은행과 한도액 US$ 8,908백만의 무역금융 약정을 체결하고 있으며,	외상매출채권담보대출 등과 관련하여 기업은행 외 4개 은행과 한도액 470,602백만원의 외상매출채권담보대출 약정 등을 맺고 있습니다.	(2) 보고기간종료일 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 6,962,653백만원입니다.

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	나. 소송 등 보고기간종료일 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

17. 계약부채

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	1,491,085
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	262,592

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액

계약부채	1,133,426
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	

계약부채에 대한 기술

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.
회사가 당기초 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 262,592백만원입니다.

18. 자본금

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수			25,000,000,000
주당 액면가액			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514

자본에 대한 설명			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

19. 별도이익잉여금

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
법정적립금		
법정적립금	이익준비금	450,789
임의적립금		201,484,221
미처분이익잉여금		18,028,341
계		219,963,351

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술	회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나, 보고기간종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
법정적립금		
법정적립금	이익준비금	450,789
임의적립금		185,870,540
미처분이익잉여금		18,066,687
계		204,388,016
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술		회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나, 보고기간종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
미처분이익잉여금			18,028,341
미처분이익잉여금	전기이월이익잉여금		30
	분기배당		(7,356,461)
	분기배당	주당 배당금, 분기배당	1,083원
		배당률, 분기배당	1083.00%
	당기순이익		25,397,099
	기타포괄손익-공정가치금융자산 처분		(12,327)
임의적립금 등의 이입액			0
이익잉여금처분액			18,028,311
이익잉여금처분액	배당금		2,452,976
	배당금	보통주에 지급될 주당배당금	361
		우선주에 지급될 주당배당금	362

		보통주에 지급된 주당배당금	
		우선주에 지급된 주당배당금	
		보통주 주당 배당률	3.61
		우선주 주당 배당률	3.62
	연구및인력개발준비금		15,575,335
차기이월 미처분이익잉여금			30
이익잉여금 처분예정일			2024-03-20
이익잉여금 처분확정일			

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
미처분이익잉여금			18,066,687
미처분이익잉여금	전기이월이익잉여금		30
	분기배당		(7,356,461)
	분기배당	주당 배당금, 분기배당	1,083원
		배당률, 분기배당	1083.00%
	당기순이익		25,418,778
	기타포괄손익-공정가치금융자산 처분		4,340
임의적립금 등의 이입액			0
이익잉여금처분액			18,066,657
이익잉여금처분액	배당금		2,452,976
	배당금	보통주에 지급될 주당배당금	
		우선주에 지급될 주당배당금	
		보통주에 지급된 주당배당금	361
		우선주에 지급된 주당배당금	362
		보통주 주당 배당률	3.61
		우선주 주당 배당률	3.62
	연구및인력개발준비금		15,613,681
차기이월 미처분이익잉여금			30
이익잉여금 처분예정일			
이익잉여금 처분확정일			2023-03-15

당기 (단위 : 백만원)

	범위			
	1분기	2분기	3분기	기말

	주식		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30			2023-09-30			2023-12-31
배당받을 주식	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률										3.61		
우선주 주당 배당률											3.62	
보통주, 우선주 배당률(액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,884	2,452,976

전기 (단위 : 백만원)

	범위											
	1분기			2분기			3분기			기말		
	주식		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계	주식 합계		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2022-03-31			2022-06-30			2022-09-30			2022-12-31
배당받을 주식	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률										3.61		
우선주 주당 배당률											3.62	
보통주, 우선주 배당률(액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,884	2,452,976

20. 기타자본항목

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		246,155
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,483,547)
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	1,760,408
	기타	(476,984)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(122,644)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,910,996)
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	1,760,408
	기타	(273,232)

21. 비용의 성격별 분류

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(1,557,583)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	89,350,845
급여	13,941,832
퇴직급여	736,004
감가상각비	25,619,594
무형자산상각비	2,614,189
복리후생비	3,307,047
유틸리티비	5,051,847
외주용역비	3,791,485
광고선전비	1,747,480
판매촉진비	1,298,806
기타 비용	35,998,841
성격별 비용 합계	181,900,387

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(10,475,794)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	107,383,581
급여	14,861,811
퇴직급여	974,711
감가상각비	24,311,940
무형자산상각비	2,605,067
복리후생비	3,220,421
유틸리티비	3,779,467
외주용역비	3,623,225
광고선전비	1,662,135
판매촉진비	1,385,835
기타 비용	33,215,755
성격별 비용 합계	186,548,154

성격별 비용에 대한 공시

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

22. 판매비와관리비

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
급여, 판관비		2,541,935
퇴직급여, 판관비		133,881

지급수수료, 판관비		3,566,826
감가상각비, 판관비		468,454
무형자산상각비, 판관비		390,581
광고선전비, 판관비		1,747,480
판매촉진비, 판관비		1,298,806
운반비, 판관비		541,902
서비스비, 판관비		981,945
기타판매비와관리비		2,352,176
소계		14,023,986
경상개발비, 판관비		
경상개발비, 판관비	연구개발 총지출액	23,852,849
계		37,876,835

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
급여, 판관비		2,308,767
퇴직급여, 판관비		171,358
지급수수료, 판관비		2,652,491
감가상각비, 판관비		412,787
무형자산상각비, 판관비		361,653
광고선전비, 판관비		1,662,135
판매촉진비, 판관비		1,385,835
운반비, 판관비		790,774
서비스비, 판관비		935,838
기타판매비와관리비		2,333,072
소계		13,014,710
경상개발비, 판관비		
경상개발비, 판관비	연구개발 총지출액	20,944,051
계		33,958,761

23. 기타수익 및 기타비용

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
배당금수익	29,096,899
수입임대료	183,234
유형자산처분이익	105,553
기타	257,629
기타이익	29,643,315
유형자산처분손실	49,044

기부금	176,171
기타	150,508
기타손실	375,723

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
배당금수익	3,952,338
수입임대료	173,719
유형자산처분이익	115,861
기타	334,460
기타이익	4,576,378
유형자산처분손실	18,842
기부금	220,309
기타	57,193
기타손실	296,344

24. 금융수익 및 금융비용

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		371,106
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	371,106
외환차이		6,652,107
파생상품관련이익		365,451
금융수익 합계		7,388,664
이자비용		595,765
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	310,267
	기타 금융부채 이자비용	285,498
외환차이		7,002,694
금융비용 합계		7,598,459

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		339,242
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	339,242
외환차이		9,124,484
파생상품관련이익		270,573
금융수익 합계		9,734,299

이자비용		290,083
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	45,883
	기타 금융부채 이자비용	244,200
외환차이		9,351,659
금융비용 합계		9,641,742

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

25. 법인세비용

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		(149,839)
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	337,983
	당기에 인식한 조정사항	(487,822)
이연법인세 소계		(7,715,760)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(4,713,725)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(2,073,330)
	이월결손금으로 인한 이연법인세변동액	(928,705)
법인세비용 계		(7,865,599)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		5,477,392
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	5,926,928
	당기에 인식한 조정사항	(449,536)
이연법인세 소계		(1,204,250)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(1,010,632)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(193,618)
	이월결손금으로 인한 이연법인세변동액	0
법인세비용 계		4,273,142

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
법인세비용차감전순이익		17,531,500
적용세율에 따른 법인세비용(*)		4,628,316
조정사항 합계		(12,493,915)
조정사항 합계	세무상 과세되지 않는 수익	(7,340,802)
	세무상 차감되지 않는 비용	6,256
	세액공제 및 감면에 대한 법인세 효과	(5,082,791)
	기타	(76,578)
법인세비용 계		(7,865,599)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
법인세비용차감전순이익		29,691,920
적용세율에 따른 법인세비용(*)		8,165,278
조정사항 합계		(3,892,136)
조정사항 합계	세무상 과세되지 않는 수익	(47,446)
	세무상 차감되지 않는 비용	507,992
	세액공제 및 감면에 대한 법인세 효과	(4,133,747)
	기타	(218,935)
법인세비용 계		4,273,142

적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 설명

(*) 보고기간종료일 현재 제정된 세법에서 규정한 법정세율을 적용하여 산정하였습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제															
	일시적차이로 인한 이연법인세									일시적차이 소계	미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		자본에 직접 가감하는 이연법인세 소계	이연법인세부채(자산) 순액
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	자산손상	퇴직급여	기타				기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	순확정급여부채(자산) 재측정요소		
기초 이연법인세부채(자산)	(898,505)	(819,038)	(1,634,038)	(2,487)	3,613,572	147,194	184,282	(1,427,630)	624,180	(212,470)	0	1,625,525	43,991	685,466	729,457	2,142,512
이연법인세부채(자산)의 증가(감소)	(182)	590,734	225,356	(1,077)	1,819,455	(22,342)	(2,641)	(451,597)	(84,376)	2,073,330	928,705	4,713,725	(132,286)	205,372	73,086	7,788,846
기말 이연법인세부채(자산)	(898,687)	(228,304)	(1,408,682)	(3,564)	5,433,027	124,852	181,641	(1,879,227)	539,804	1,860,860	928,705	6,339,250	(88,295)	890,838	802,543	9,931,358

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이에 대한 설명		(*) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.														

전기 (단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제															
	일시적차이로 인한 이연법인세									일시적차이 소계	미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		자본에 직접 가감하는 이연법인세 소계	이연법인세부채(자산) 순액
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	자산손상	퇴직급여	기타				기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	순확정급여부채(자산) 재측정요소		
기초 이연법인세부채(자산)	(936,822)	(853,165)	(675,483)	(14,879)	3,052,034	(1,461)	220,916	(1,675,673)	478,445	(406,088)	0	614,893	(34,358)	1,036,653	1,002,295	1,211,100
이연법인세부채(자산)의 증가(감소)	38,317	34,127	(958,555)	12,392	561,538	148,655	(36,634)	248,043	145,735	193,618	0	1,010,632	78,349	(351,187)	(272,838)	931,412
기말 이연법인세부채(자산)	(898,505)	(819,038)	(1,634,038)	(2,487)	3,613,572	147,194	184,282	(1,427,630)	624,180	(212,470)	0	1,625,525	43,991	685,466	729,457	2,142,512
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이에 대한 설명		(*) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.														

당기 (단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	합계 구간 합계
이연법인세부채(자산) 순액	5,055,283	4,876,075	9,931,358

전기 (단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	합계 구간 합계

이연법인세부채(자산) 순액	2,267,807	(125,295)	2,142,512

글로벌 최저한세 도입 영향에 대한 기술

마. 글로벌 최저한세

글로벌 최저한세는 직전 4개연도 중 2개이상 연결재무제표상 매출액이 7.5억 유로 이상인 다국적 기업이 소재한 국가에서 실효세율이 15%에 미치지 못하는 경우, 그 상당액을 특정 요건을 충족하는 지배기업이 속해있는 국가의 과세관청에 납부하는 제도입니다.

회사가 소재하고 있는 대한민국은 2023년에 글로벌 최저한세 관련 세법을 제정하였으며, 2024년 1월 1일 이후 개시하는 사업연도분부터 글로벌 최저한세를 적용하여야합니다.

회사는 글로벌 최저한세 법률의 적용대상에 해당될 것으로 판단하고 있으나, 대한민국의 글로벌 최저한세 관련 세법이 2024년 1월 1일부터 시행되기 때문에 당기 중 당기법인세비용에 영향은 없습니다. 또한, 회사는 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 글로벌 최저한세 법률과 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다.

글로벌 최저한세 법률의 주된 영향을 받는 회사의 종속회사 소재 국가의 법률이 제정전이거나 구체적인 법령의 제정이 진행중이기 때문에, 보고기간종료일 현재 회사에 미칠 영향을 합리적으로 추정하기 어렵습니다. 회사와 각 종속회사는 각국의 세무 전문가들과 함께 재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있습니다.

26. 주당이익

당기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
당기순이익(손실)	25,397,099	25,397,099
보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	22,319,686	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783천주	
기본 보통주 주당이익(원)	3,739	
우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		3,077,413
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887천주
기본 우선주 주당이익(원)		3,740

전기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
당기순이익(손실)	25,418,778	25,418,778
보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	22,338,739	

가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783천주	
기본 보통주 주당이익(원)	3,742	
우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		3,080,039
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887천주
기본 우선주 주당이익(원)		3,743

희석주당이익에 대한 기술

나. 희석주당순이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

27. 현금흐름표

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		(4,092,924)
조정내역 계	법인세비용(수익)	(7,865,599)
	금융수익	(995,482)
	금융비용	1,316,292
	퇴직급여	736,004
	감가상각비	25,619,594
	무형자산상각비	2,614,189
	대손상각비(환입)	2,308
	배당금수익	(29,096,899)
	유형자산처분이익	(105,553)
	유형자산처분손실	49,044
	재고자산평가손실(환입) 등	3,558,358
	기타	74,820
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(13,215,547)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(6,883,154)
	미수금의 감소(증가)	612,652
	장단기선급비용의 감소(증가)	(339,588)
	재고자산의 감소(증가)	(4,399,456)
	매입채무의 증가(감소)	(701,579)
	장단기미지급금의 증가(감소)	(335,900)
	선수금의 증가(감소)	(18,100)
	예수금의 증가(감소)	(77,884)

	미지급비용의 증가(감소)	(1,677,917)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,076,981
	퇴직금의 지급	(702,328)
	사외적립자산의 감소(증가)	(156,245)
	기타	386,971

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		31,039,388
조정내역 계	법인세비용(수익)	4,273,142
	금융수익	(1,224,148)
	금융비용	1,565,955
	퇴직급여	974,711
	감가상각비	24,311,940
	무형자산상각비	2,605,067
	대손상각비(환입)	(178)
	배당금수익	(3,952,338)
	유형자산처분이익	(115,861)
	유형자산처분손실	18,842
	재고자산평가손실(환입) 등	2,529,351
	기타	52,905
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(6,868,269)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	12,354,628
	미수금의 감소(증가)	(711,933)
	장단기선급비용의 감소(증가)	11,033
	재고자산의 감소(증가)	(14,337,291)
	매입채무의 증가(감소)	(2,494,560)
	장단기미지급금의 증가(감소)	1,522,457
	선수금의 증가(감소)	(154,042)
	예수금의 증가(감소)	(101,231)
	미지급비용의 증가(감소)	88,828
	장단기충당부채의 증가(감소)	74,664
	퇴직금의 지급	(492,366)
	사외적립자산의 감소(증가)	(1,402,489)
	기타	(1,225,967)

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	490,240

유형자산의 본계정 대체	38,188,436
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	873,056
사채 및 장기차입금의 유동성 대체	228,492

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	(285,585)
유형자산의 본계정 대체	30,539,179
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	673,493
사채 및 장기차입금의 유동성 대체	135,753

당기 (단위 : 백만원)

		단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초		2,381,512	815,644	3,197,156
재무현금흐름		3,274,337	21,804,684	25,079,021
비현금흐름, 재무활동				
비현금흐름, 재무활동	리스신규계약	0	567,652	567,652
	기타	(30,686)	(38,390)	(69,076)
기말		5,625,163	23,149,590	28,774,753

전기 (단위 : 백만원)

		단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초		9,204,268	600,291	9,804,559
재무현금흐름		(6,700,826)	(155,264)	(6,856,090)
비현금흐름, 재무활동				
비현금흐름, 재무활동	리스신규계약	0	673,493	673,493
	기타	(121,930)	(302,876)	(424,806)
기말		2,381,512	815,644	3,197,156

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)에 대한 기술

상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액

리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	178,979
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	28,282

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	149,337
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	10,876

기업이 보유한 현금및현금성자산에 대한 경영진의 설명

회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품,단기차입금 등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 회사의 현금및현금성자산은 대부분 예금 등으로 구성되어 있습니다.

28. 재무위험관리

당기 (단위 : 백만원)

	위험																					위험 합계
	시장위험																					
	환위험							이자율위험							지분가격위험							
	기능통화 또는 표시통화						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	
	USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			
	범위							범위							범위							
	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		
시장변수의 증감	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시																	주가 1% 변동 시	
시장변수 상승 시 당기손익 증가	201,224																					
시장변수 상승 시 당기손익 감소			(25,356)																			
시장변수 하락 시 당기손익 증가				25,356																		
시장변수 하락 시 당기손익 감소		(201,224)																				
시장변수 변동에 따른 세전 기타포괄손익 변동																					17,573	

위험에 대한 노출정도에 대한 기술							회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.							이자율변동 위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.								

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술							회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생 시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 회사가 노출된 환율변동 위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으							회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.									회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통

							매 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.																활용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금 및현금성자산, 단기금융상품, 상각후 원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로구성되어 있습니다.

전기

(단위 : 백만원)

	위험																					위험 합계
	시장위험																					
	환위험							이자율위험							지분가격위험							
	기능통화 또는 표시통화						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	기능통화 또는 표시통화 합계						기능통화 또는 표시통화 합계	
	USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			USD		EUR		원화			
	범위							범위							범위							
	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위		
시장변수의 증감	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시																	주가 1% 변동 시	
시장변수 상승 시 당기손익 증가	77,795																					
시장변수 상승 시 당기손익 감소			(53,114)																			
시장변수 하락 시 당기손익 증가				53,114																		
시장변수 하락 시 당기손익 감소		(77,795)																				
시장변수 변동에 따른 세전 기타포괄손익 변동																					12,479	
위험에 대한 노출정도에 대한 기술																						

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술																						

신용위험에 대한 공시

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정・관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한, 대규모 유동성이 필요한 경우에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

당기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	32,311,019	374,370	980,835	27,454,095	1,378,061	

종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액						10,960,748
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	31,354,944	316,725	1,096,183	2,431,415	472,135	
종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액						10,793,412
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						

당기 (단위 : 백만원)

	총장부금액
부채	72,069,515
자본	224,787,774
부채비율	32.1%
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며,보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	총장부금액

부채	50,667,559
자본	209,416,191
부채비율	24.2%
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	

당기 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	6,061,451	50,071	27,363,016	1,854,503	1	5,365,519	40,694,561
공정가치				1,854,503	1	393,235	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산							4,972,284
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.				

전기 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	3,921,593	137	20,503,223	1,364,325	283	5,470,355	31,259,916
공정가치				1,364,325	283		
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산							
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

당기 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
장부금액	7,943,834	5,625,163	15,015,578	228,491	222,137	6,354	19,064	22,902,035	4,486,390	3,652,969	59,873,524
공정가치				6,757		6,757	21,695				

공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
장부금액	8,729,315	2,381,512	18,324,604	135,753	129,525	6,228	24,912	654,979	2,083,790	3,145,473	35,480,338
공정가치				6,580		6,580	27,845				
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.			리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

당기

(단위 : 백만원)

	측정 전체																				
	공정가치																				
	금융상품																				금융상품 합계
	기타포괄손익-공정가치금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타				유동성사채				사채				
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		
금융자산	1,757,336	0	97,167	1,854,503	0	0	1	1	0	0	393,235	393,235									
금융부채													0	6,757	0	6,757	0	21,695	0	21,695	

공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술																					공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. - '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 - '수준 2': 시장에서 관측 가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외) - '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술																					활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용

																					하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정를 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에

																					맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동

																					자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. (3) 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

전기

(단위 : 백만원)

	측정 전체																				
	공정가치																				
	금융상품																				금융상품 합계
	기타포괄손익-공정가치금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타				유동성사채				사채				
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		
금융자산	1,247,882	0	116,443	1,364,325	0	0	283	283													
금융부채													0	6,580	0	6,580	0	27,845	0	27,845	
공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술																					
평가기법 및 투입변수에 대한 기술																					

(단위 : 백만원)

	금융상품			
	기타포괄손익-공정가치금융자산		기타	
	삼성벤처투자㈜	㈜미코세라믹스	지분 콜옵션	
	평가기법	평가	평가기법 합계	평가	평가기법 합계	평가

	현금흐름할인법				현금흐름할인법 등				이항모형				
	관측할 수 없는 투입변수												
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	기법 합계
	범위												
	가중범위												
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.0100	0.1710											
금융자산, 공정가치													32,286

	현금흐름할인법				현금흐름할인법 등				이항모형				
	관측할 수 없는 투입변수												
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	기법 합계
	범위												
	가중범위												
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산					0.0000	0.1580							
금융자산, 공정가치													33,973

	현금흐름할인법				현금흐름할인법 등				이항모형				
	관측할 수 없는 투입변수												
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	무위험이자율, 측정투입변수	가격변동성, 측정투입변수	기법 합계
	범위												
	가중범위												
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산											0.0320	0.6950	
금융자산, 공정가치													393,235

당기 (단위 : 백만원)

	수준 3
기초	116,726
매입	27,784
매도	(343)
당기손익으로 인식된 손익	365,451
기타포괄손익으로 인식된 손익	(19,215)
기타	0
기말	490,403

전기 (단위 : 백만원)

	수준 3
기초	120,347
매입	0
매도	(12,720)
당기손익으로 인식된 손익	(108)
기타포괄손익으로 인식된 손익	22,926
기타	(13,719)
기말	116,726

(단위 : 백만원)

	측정 전체									
	공정가치									
	반복적인 공정가치측정치									
	자산									
	기타포괄손익-공정가치금융자산					기타				
	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수 합계				관측할 수 없는 투입변수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성		영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성	
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					0					97,309
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					0					(96,785)
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					2,792					0
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					(2,458)					0

관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 기술, 자산	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.						주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 당기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전 효과)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10	

29. 부문별 보고

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

당기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계	기업 전체 총계 합계

	영업부문		
	DX 부문	DS 부문	
영업수익	106,661,889	65,438,933	170,374,090
감가상각비	534,813	24,882,772	25,619,594
무형자산상각비	1,682,132	696,457	2,614,189
영업이익	5,256,921	(16,788,154)	(11,526,297)
보고부문에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계		기업 전체 총계 합계
	영업부문		
	DX 부문	DS 부문	
영업수익	117,257,647	97,102,386	211,867,483
감가상각비	542,437	23,589,388	24,311,940
무형자산상각비	1,631,289	754,791	2,605,067
영업이익	3,083,254	22,232,180	25,319,329
보고부문에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

30. 특수관계자와의 거래

전체 특수관계자
특수관계자
종속기업

당기 (단위 : 백만원)

	기업명(*1)																																											
	특수관계자																																											
	종속기업																												관계기업 및 공동기업						그 밖의 특수관계자				기타(*2)				
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Harman과 그 종속기업	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEE	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	세메스㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics GmbH (SEG)	Samsung International, Inc. (SII)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	기타 종속기업	종속기업 합계	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	관계기업 및 공동기업 합계	삼성물산㈜	그 밖의 특수관계자, 기타	그 밖의 특수관계자 합계	특수관계자 합계	삼성엔지니어링㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	대규모기업집단 소속회사 합계	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

									H)																																
매출액	347,653	29,881,238	16,989,574	938	2,823	83,033	21,587,458	4,338,706	4,892,443	671,024	3,714,751	1,496,684	2,434,796	1,449,960	15,336,448	542,912	2,085,433	1,762,387	7,285	2,668,921	3,620,706	264,826	3,500,155	1,589,366	5,070,507			50,707,430	175,047,007	201,304	65,765	68,343	36,020	601,887	973,319	23,156	468,819	491,975		1,162	4,532	200,836	206,530	
비유동자산처분	0	0	0	0	4,610	38,085	0	196	0	0	210	0	18	0	0	4,101	0	0	0	0	0	51	0	0	0			3,780	51,051	0	0	0	0	0	0	70	0	70		0	0	0	0	
매입액	1,842,995	222,087	21,813	56,890	4,109,744	8,691,615	682,687	20,044,847	10,186	0	4,636,864	0	13,251,399	13,791	0	5,209,254	2,062,771	109,697	2,245,344	7,501	7,018	6,397,400	1,261	1,175	8,132			13,212,836	82,847,307	1,801,672	786,087	374,035	907,775	968,224	4,837,793	57,652	762,644	820,296		31,957	444,657	281,667	758,281	
비유동자산매입	10,406	0	0	0	1,657	12,435	0	591	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3,689	29,552	283,411	0	31,668	1,163	9,167	325,409	5,588,270	190,405	5,778,675		2,747,278	23,479	512,899	3,286,536	
채권액(*2)	74,259	3,841,560	2,091	5,179	9,575	68,251	5,271,414	925,410	181,785	2,760	922,630	90,305	502,410	256,936	3,906,968	148,857	280,682	64,642	68,340	252,813	72,258	129,178	362,737	52,172	413,581			6,556,255	24,463,048	84,541	1,857	114,103	51	164,058	364,610	190,443	13,835	204,278		269	598	4,342	5,209	
채무액(*3)	196,686	1,119,907	1,147	9,659	303,203	687,410	209,789	2,324,691	201,966	0	297,628	46	1,377,493	1,226	281	367,007	267,659	40,118	917,707	2,021	4,448	54,694	87,718	6,266	415			2,607,878	11,087,063	418,787	86,166	50,149	429,435	183,813	1,168,350	1,876,745	149,585	2,026,330		766,329	39,223	265,721	1,071,273	

특수관계자거래에 대한 기술				(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래금액입니다.																																			(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래금액입니다. (*2) 종속기업채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.				(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래금액입니다. (*2) 종속기업채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	
기업으로의 차입에 따른 이전, 특수관계자거래																													21,990,000															

출자, 특수관계자거래																										49,318						58,982								
출자금회수, 특수관계자거래																										143,799						518								
지급결의한배당금, 특수관계자거래																																			1,650,995				128,232	
리스이용계약, 특수관계자거래																																			182,860					
리스이용자로서리스, 특수관계자거래																																			59,287					
단기급여																																								14,073
퇴직급여																																								557
기타장기급여																																								7,834

특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세내역에 대한 설명																																							아. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석16 참조).					

특수관계의 성격에 대한 기술																																											(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	

전기

(단위 : 백만원)

	기업명(*1)																																											
	특수관계자																																											
	종속기업																												관계기업 및 공동기업						그 밖의 특수관계자				기타(*2)				
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd.(SAPL)	Harman과 그 종속기업	Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief	Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	세메스㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.(SEM)	Samsung Electronics GmbH(SEG)	Samsung International, Inc.(SII)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.(SET)	Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	기타 종속기업	종속기업 합계	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	관계기업 및 공동기업 합계	삼성물산㈜	그 밖의 특수관계자, 기타	그 밖의 특수관계자 합계	특수관계자 합계	삼성엔지니어링㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	대규모기업집단 소속회사 합계	당해기업이나 당해기업의 지배기업의 주요 경영진

								(SEVT)		U.A.(SEEH)					)	(SEHC)										(SEH)																	
매출 채	283,011	35,303,291	42	0	1,053	184,796	40,907,261	8,668,668	1,588,710	0	7,439,341	2,073,972	5,804,935	1,262,369	16,490,821	628,854	1,578,349	1,529,791	8,224	2,442,869	3,865,859			788,385	4,772,554	408,409	249,142	58,705,560	194,986,266	212,376	60,343	60,325	31,194	617,779	982,017	44,359	283,122	327,481		1,490	7,530	136,969	145,989	
비유동자산 처분	0	632	0	0	0	10,644	0	0	0	0	112	0	256	0	0	2,791	0	0	0	0	0			0	0	141	0	4,198	18,774	0	767	0	0	0	767	0	188	188		0	0	0	0	
매입 채	981,927	209,912	30,982	76,891	3,663,909	9,679,473	532,962	25,941,259	9,035	0	5,798,974	0	16,441,332	2,174	47	4,830,861	2,615,512	98,891	2,283,556	6,950	6,948			2,333	5,104	2,191	0	23,123,295	96,344,518	1,672,853	919,709	422,836	931,489	881,585	4,828,472	84,635	602,014	686,649		32,677	428,907	251,907	713,491	
비유동자산 매입	0	0	0	0	2,457	5,534	0	831	0	0	0	0	50	0	0	1,680	0	0	0	0	0			0	0	0	0	2,213	12,765	348,752	120	24,874	361	10,224	384,331	7,018,252	132,512	7,150,764		3,106,154	45,864	540,591	3,692,609	
채권 채 (*2)	32,521	868,937	1,604	0	21,309	57,423	4,700,427	606,030	131,285	693	1,219,298	196,643	369,380	227,180	1,623,968	234,870	115,103	76,264	54,327	230,508	10,607			18,403	273,816	11,449	20,177	6,565,258	17,667,480	49,439	385	114,618	43	203,575	368,060	194,539	14,679	209,218		286	3,085	4,113	7,484	
채무 채 (*3)	108,011	983,709	1,812	6,537	386,640	751,693	263,757	2,396,411	283,459	0	312,243	7	1,748,670	3,037	77	358,082	379,098	0	561,368	1,093	0			0	506,872	0	11	2,226,116	11,278,703	468,830	101,960	51,199	444,017	159,668	1,225,674	2,718,294	160,305	2,878,599		1,181,947	59,352	478,136	1,719,435	

특수관계자거래에 대한 기술				(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래금액입니다.																																			(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래금액입니다. (*2) 종속기업채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.				(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래금액입니다. (*2) 종속기업채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. (*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	
기업으로의 차입에 따른 이전, 특수관계자거래																																												

출자, 특수관계자거래																										119,598						882,125							
출자금회수, 특수관계자거래																										164,503													
지급결의한배당금, 특수관계자거래																																			1,663,149				128,232	
리스이용계약, 특수관계자거래																																			20					
리스이용자로서리스, 특수관계자거래																																			46,819					
단기급여																																								14,768
퇴직급여																																								612
기타장기급여																																								5,434

특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세내역에 대한 설명																																												

특수관계의 성격에 대한 기술																																											(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	

6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 재원으로 활용하여 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 실시하였습니다. 한편, 당사는 2024년 1월 2024~2026년의 주주환원 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 당사는 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하여 연간 9.8조원 수준의 정규배당을 유지하되, 정규배당 이후에도 잔여 재원이 발생하는 경우에 추가로 환원할 계획입니다. 또한, 당사는 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 새로운 주주환원 정책을 발표하고 시행할 수 있습니다.

[주요 배당지표] (단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제55기	제54기	제53기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		14,473,401	54,730,018	39,243,791
(별도)당기순이익(백만원)		25,397,099	25,418,778	30,970,954
(연결)주당순이익(원)		2,131	8,057	5,777
현금배당금총액(백만원)		9,809,438	9,809,438	9,809,438
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		67.8	17.9	25.0
현금배당수익률(%)	보통주	1.9	2.5	1.8
	우선주	2.4	2.7	2.0
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,444	1,444	1,444
	우선주	1,445	1,445	1,445
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제55기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은

제55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제53기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
39	43	2.1	2.5

※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.4%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.9%입니다.

※ 최근 3년간은 2021년(제53기)부터 2023년(제55기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2019년(제51기)부터 2023년(제55기)까지 기간입니다. 2023년(제55기) 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 1.9%, 우선주 2.4%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	128,940	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	515,760	4.2%	A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
㈜도우인시스	회사채	사모	2020.02.28	23,000	0.5%	-	2025.02.28	미상환	-
㈜도우인시스	회사채	사모	2022.12.08	42,000	0.5%	-	2027.12.08	미상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.01.30	30,000	4.1%	A1	2023.02.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.01.30	50,000	4.0%	A1	2023.02.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.02.10	70,000	3.9%	A1	2023.03.10	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.0%	A1	2023.03.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.03.10	70,000	4.0%	A1	2023.04.10	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.03.28	45,000	4.0%	A1	2023.04.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.04.10	70,000	4.0%	A1	2023.05.10	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.05.10	70,000	4.0%	A1	2023.06.12	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.06.12	50,000	4.1%	A1	2023.07.12	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.07.25	20,000	4.1%	A1	2023.08.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.07.28	30,000	4.1%	A1	2023.08.28	상환	-
합 계	-	-	-	1,224,700	-	-	-	-	-

※ 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가㈜, 한국기업평가㈜입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,447	522,207	6,447	6,447	-	-	-	541,548
	사모	-	23,000	-	42,000	-	-	-	65,000
	합계	6,447	545,207	6,447	48,447	-	-	-	606,548

- 삼성전자㈜

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,447	6,447	6,447	6,447	-	-	-	25,788
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6,447	6,447	6,447	6,447	-	-	-	25,788

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	515,760	-	-	-	-	-	515,760
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	515,760	-	-	-	-	-	515,760

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

- ㈜도우인시스

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	23,000	-	42,000	-	-	-	65,000
	합계	-	23,000	-	42,000	-	-	-	65,000

※ ㈜도우인시스의 사모 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	128,940	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2023년 중 처분 자산은 전체의 0.1%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.
※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는
Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.
※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의
작성기준일입니다.
※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(SSL, SSM 법인 매각)

종속기업 삼성디스플레이㈜는 2020년 8월 28일자 이사회 결의에 의거 2021년 4월 1일자로 수익성 악화에 따른 LCD 사업 축소를 위하여 Samsung Suzhou Module Co.,Ltd. (SSM) 지분 100%와 Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) 지분 60%를 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)에게 매각하였습니다.

(eMagin Corporation 지분인수)

종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 Micro Display 기술 경쟁력을 확보를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation (대표자: Andrew Sculley, 소재지: New York, USA) 지분 100%를 인수하였습니다. 재무제표에 미치는 영향은 '3. 연결재무제표 주석'의 '32. 사업결합' 주석을 참조하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.04.16	2024.12.16	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.03.28	2024.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023.10.01	2024.12.16	409,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.06.01	2024.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	110,000	96,000	-	8,065	8,065	5.0%
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	777,000	917,000	239,395	81,498	320,893	48.8%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	130,000	70,000	25,649	△25,649	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023.04.28	2024.12.16	832,572	835,508	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	150,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	537,000	537,000	155,768	△155,768	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	888,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	45,000	-	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	15,600	15,600	9,664	△9,664	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	300,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	-	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	-	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	603,960	601,149	513,366	△2,389	510,977	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	계열회사	ANZ	지급보증	시설자금	2022.11.10	2025.11.09	20,000	20,000	20,000	-	20,000	7.1%
합 계							9,110,532	9,090,657	963,842	△103,907	859,935	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2023년 중 US$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2023년말 현재 미수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2023년 중 US$3,066천의 수수료를 청구하였으며, 2023년말 현재 미수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제55기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제53기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제55기말	매출채권	37,002,849	355,456	1.0%
	단기대여금	21,279	204	1.0%
	미수금	6,715,263	82,015	1.2%
	선급금	994,525	3,316	0.3%
	장기매출채권	23,889	-	0.0%
	장기미수금	759,704	209	0.0%
	장기선급금	4,964,481	9,255	0.2%
	장기대여금	239,149	77,608	32.5%
	합 계	50,721,139	528,063	1.0%
제54기말	매출채권	36,033,784	312,221	0.9%
	단기대여금	22,403	215	1.0%
	미수금	6,227,068	77,859	1.3%
	선급금	1,741,031	3,965	0.2%
	장기매출채권	204,248	-	0.0%
	장기미수금	824,468	242	0.0%
	장기선급금	2,382,711	10,969	0.5%
	장기대여금	225,983	1,206	0.5%
	합 계	47,661,696	406,677	0.9%
제53기말	매출채권	41,024,295	310,880	0.8%
	단기대여금	17,895	73	0.4%
	미수금	4,569,772	72,515	1.6%
	선급금	1,122,660	3,847	0.3%
	장기매출채권	225,739	-	0.0%
	장기미수금	1,002,404	290	0.0%
	장기선급금	1,770,999	9,003	0.5%
	장기대여금	199,577	917	0.5%
	합 계	49,933,341	397,525	0.8%

※ 연결 기준입니다.
※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제55기	제54기	제53기
기초 대손충당금(손실충당금)	406,677	397,525	388,943
순대손처리액(① - ② + ③)	14,647	16,658	25,926
① 대손처리액(상각채권액) 등	19,179	9,711	22,400
② 상각채권회수액	4	-	-
③ 기타증감액	△4,528	6,947	3,526
대손상각비 계상(환입)액	136,033	25,810	34,508
기말 대손충당금(손실충당금)	528,063	406,677	397,525

※ 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	36,531,509	359,498	39,585	96,146	37,026,738
구성비율	98.6%	1.0%	0.1%	0.3%	100.0%

※ 연결 기준입니다.
※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제55기말	제54기말	제53기말
DX 부문	제품 및 상품	7,229,898	7,712,885	8,894,766
	반제품 및 재공품	967,513	1,013,606	799,218
	원재료 및 저장품	9,608,619	10,520,293	11,384,887
	미착품	1,014,420	943,322	1,299,624
	소 계	18,820,450	20,190,106	22,378,495
DS 부문	제품 및 상품	6,476,768	6,601,087	2,490,097
	반제품 및 재공품	20,961,730	18,756,104	11,809,911
	원재료 및 저장품	3,484,046	3,639,061	2,118,424
	미착품	76,226	61,352	36,685
	소 계	30,998,770	29,057,604	16,455,117
SDC	제품 및 상품	284,394	811,518	294,777
	반제품 및 재공품	296,788	542,473	874,229
	원재료 및 저장품	564,573	788,521	810,325
	미착품	6,509	23,626	48,253
	소 계	1,152,264	2,166,138	2,027,584
Harman	제품 및 상품	725,484	799,919	533,008
	반제품 및 재공품	104,514	119,890	105,271
	원재료 및 저장품	700,011	913,085	736,109
	미착품	319,785	269,715	321,128
	소 계	1,849,794	2,102,609	1,695,516
총 계	제품 및 상품	14,553,014	16,032,226	12,280,579
	반제품 및 재공품	22,198,448	20,077,519	13,473,618
	원재료 및 저장품	13,697,354	14,979,280	14,184,841
	미착품	1,177,058	1,098,841	1,445,366
	소 계	51,625,874	52,187,866	41,384,404
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		11.3%	11.6%	9.7%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.5회	4.1회	4.5회

※ 당사 연결 기준입니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

・5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
・재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

・사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
・사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
・외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회・확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인

※ 당사는 2023년 11월 21일부터 12월 4일까지 하반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일 기준(11월말)으로 하반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2023년말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	16,120,367	16,120,367	△1,567,353	14,553,014
반제품 및 재공품	26,501,664	26,501,664	△4,303,216	22,198,448
원재료 및 저장품	15,222,937	15,222,937	△1,525,583	13,697,354
미착품	1,177,058	1,177,058	-	1,177,058
합 계	59,022,026	59,022,026	△7,396,152	51,625,874

※ 당사 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2023년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산
사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산
상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에
'기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
   파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
   이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
3) 금융보증계약
   최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
   최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
   이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제55기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	69,080,893	-	-	-	69,080,893
단기금융상품	22,690,924	-	-	-	22,690,924
단기상각후원가금융자산	608,281	-	-	-	608,281
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	27,112	-	27,112
매출채권	36,647,393	-	-	-	36,647,393
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	7,481,297	-	-	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,431,394	-	1,431,394
기타	14,294,254	-	475,244	70,777	14,840,275
계	143,321,745	7,481,297	1,933,750	70,777	152,807,569

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,319,824	-	-	11,319,824
단기차입금	504,552	-	6,610,049	7,114,601
미지급금	13,996,395	-	-	13,996,395
유동성장기부채	310,436	-	998,439	1,308,875
사채	537,618	-	-	537,618
장기차입금	-	-	3,724,850	3,724,850
장기미지급금	4,907,875	-	-	4,907,875
기타	11,330,545	49,904	33,559	11,414,008
계	42,907,245	49,904	11,366,897	54,324,046

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을

포함하고 있습니다.

2) 제54기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	49,680,710	-	-	-	49,680,710
단기금융상품	65,102,886	-	-	-	65,102,886
단기상각후원가금융자산	414,610	-	-	-	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	29,080	-	29,080
매출채권	35,721,563	-	-	-	35,721,563
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,397,012	-	-	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,405,468	-	1,405,468
기타	9,945,209	-	334,263	61,404	10,340,876
계	160,864,978	11,397,012	1,768,811	61,404	174,092,205

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	10,644,686	-	-	10,644,686
단기차입금	1,577,958	-	3,569,357	5,147,315
미지급금	16,328,237	-	-	16,328,237
유동성장기부채	215,143	-	874,019	1,089,162
사채	536,093	-	-	536,093
장기차입금	33,846	-	3,526,826	3,560,672
장기미지급금	2,289,236	-	-	2,289,236
기타	12,047,761	334,415	27,353	12,409,529
계	43,672,960	334,415	7,997,555	52,004,930

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을

포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말		제54기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	69,080,893	(*1)	49,680,710	(*1)
단기금융상품	22,690,924	(*1)	65,102,886	(*1)
단기상각후원가금융자산	608,281	(*1)	414,610	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	27,112	27,112	29,080	29,080
매출채권	36,647,393	(*1)	35,721,563	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	7,481,297	7,481,297	11,397,012	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	1,431,394	1,431,394	1,405,468	1,405,468
기타(*2)	14,840,275	546,021	10,340,876	395,667
계	152,807,569		174,092,205	
금융부채:				
매입채무	11,319,824	(*1)	10,644,686	(*1)
단기차입금	7,114,601	(*1)	5,147,315	(*1)
미지급금	13,996,395	(*1)	16,328,237	(*1)
유동성장기부채	1,308,875	6,757	1,089,162	6,580
- 유동성장기차입금	1,302,521	(*1)(*3)	1,082,934	(*1)(*3)
- 유동성사채	6,354	6,757	6,228	6,580
사채	537,618	529,254	536,093	521,129
장기차입금	3,724,850	(*1)(*3)	3,560,672	(*1)(*3)
장기미지급금	4,907,875	(*1)	2,289,236	(*1)
기타(*2)	11,414,008	83,463	12,409,529	361,768
계	54,324,046		52,004,930	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 14,294,254백만원(전기말: 9,945,209백만원)

및 금융부채 11,330,545백만원(전기말: 12,047,761백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	27,112	-	27,112
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,250,993	-	2,230,304	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	347,221	-	1,084,173	1,431,394
기타	-	130,364	415,657	546,021
금융부채:				
유동성사채	-	6,757	-	6,757
사채	-	529,254	-	529,254
기타	-	83,463	-	83,463

(단위 : 백만원)

구 분	제54기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	29,080	-	29,080
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,207,295	-	2,189,717	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	314,449	-	1,091,019	1,405,468
기타	-	373,176	22,491	395,667
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	521,129	-	521,129
기타	-	354,364	7,404	361,768

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
  (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여
  해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2023년말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	32,286	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	17.1%
㈜미코세라믹스	33,973	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	15.8%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,286,007	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.6%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	226,531	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.6%
기타:				
지분 콜옵션	393,235	이항모형	무위험 이자율	3.2%
			가격 변동성	69.5%
지분 풋옵션	22,422	이항모형	무위험 이자율	3.9%~5.2%, 2.2%
			가격 변동성	22.7%, 24.4%

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제55기	제54기
기초	3,303,227	3,430,214
매입	207,023	207,730
매도	△124,477	△207,252
당기손익으로 인식된 손익	297,680	73,782
기타포괄손익으로 인식된 손익	46,725	△197,830
기타	△44	△3,417
기말	3,730,134	3,303,227

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제55기	제54기
기초	7,404	5,438
당기손익으로 인식된 손익	619	1,966
기타	△8,023	-
기말	-	7,404

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2023년말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	161,758	-	△111,678
기타	101,749	-	△101,696	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.

'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

・환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내・외 금융 시장의 동향
・사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
・DX부문, DS부문, SDC, Harman 등 회사가 영위하는 주요 사업의 예상치 못한 급격한 여건변화
・기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내・외적 변화

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요

2023년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 지속, 지정학적 이슈 등 불확실성의 지속 및 경기둔화로 경영 여건이 악화되었습니다. 이에 따라 당사는 2023년 연결기준 매출 259조원, 영업이익 7조원, 별도기준 매출 170조원, 영업손실 12조원을 기록하였습니다.

재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 25.4%, 자기자본비율 79.8%, ROE 4.3%, 별도기준 부채비율 32.1%, 자기자본비율 75.7%, ROE 11.7% 등 견실한 재무구조를 지속하였으며, 2023년 브랜드 가치는 914억달러로 전년대비 4% 증가하여 세계 전체 기업 중 5위(2023년 11월 인터브랜드 발표 기준)를 유지하였습니다.

사업 측면에서는 갤럭시S23 시리즈, 갤럭시 Z 폴드5와 갤럭시 Z 플립5 출시 및 Neo QLED TV, BESPOKE 라인업 강화로 시장지배력 및 업계리더십을 더욱 공고히 하였으며, HBM, DDR5, LPDDR5x 등 고부가가치 제품 확대 등 핵심기술 역량을 바탕으로 부품 사업의 수익성 및 원가 경쟁력을 더욱 강화하였습니다.

2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 급변하는 IT산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)

가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제55기	제54기	증 감	증감률
[유동자산]	195,936,557	218,470,581	△22,534,024	△10.3%
· 현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710	19,400,183	39.0%
· 단기금융상품	22,690,924	65,102,886	△42,411,962	△65.1%
· 기타유동금융자산	635,393	443,690	191,703	43.2%
· 매출채권	36,647,393	35,721,563	925,830	2.6%
· 재고자산	51,625,874	52,187,866	△561,992	△1.1%
· 기타	15,256,080	15,333,866	△77,786	△0.5%
[비유동자산]	259,969,423	229,953,926	30,015,497	13.1%
· 기타비유동금융자산	8,912,691	12,802,480	△3,889,789	△30.4%
· 관계기업 및 공동기업 투자	11,767,444	10,893,869	873,575	8.0%
· 유형자산	187,256,262	168,045,388	19,210,874	11.4%
· 무형자산	22,741,862	20,217,754	2,524,108	12.5%
· 기타	29,291,164	17,994,435	11,296,729	62.8%
자산총계	455,905,980	448,424,507	7,481,473	1.7%
[유동부채]	75,719,452	78,344,852	△2,625,400	△3.4%
[비유동부채]	16,508,663	15,330,051	1,178,612	7.7%
부채총계	92,228,115	93,674,903	△1,446,788	△1.5%
[지배기업 소유주지분]	353,233,775	345,186,142	8,047,633	2.3%
[비지배지분]	10,444,090	9,563,462	880,628	9.2%
자본총계	363,677,865	354,749,604	8,928,261	2.5%
부채와 자본총계	455,905,980	448,424,507	7,481,473	1.7%
자기자본비율	79.8%	79.1%	0.7%p	
부채비율	25.4%	26.4%	△1.0%p	
재고자산회전율	3.5회	4.1회	△0.6회	

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우

정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제55기 당사 자산은 전년 대비 7조 4,815억원(1.7%) 증가한 455조 9,060억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 현금및현금성자산의 증가 19조 4,002억원 및 반도체・디스플레이 패널 사업의 대규모 시설투자에 따른 유형자산의 증가 19조 2,109억원 등입니다.

부채는 전년 대비 1조 4,468억원(1.5%) 감소한 92조 2,281억원으로, 유동부채가 2조 6,254억원(3.4%) 감소하였고 비유동부채는 1조 1,786억원(7.7%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 미지급비용이 3조 1,982억원 감소하였으며, 장기미지급금이 2조 7,350억원 증가하였습니다.

자본은 전년 대비 8조 9,283억원(2.5%) 증가한 363조 6,779억원으로, 2023년 당기순이익(지배지분) 15조 4,871억원 및 배당금의 지급 9조 8,094억원 등으로 이익잉여금이 8조 7,058억원 증가하였으며, 해외사업환산차이 등으로 인해 기타자본항목이 8,144억원 감소하였습니다.

재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 0.7%p 증가한 79.8%, 부채비율이 전년 대비 1.0%p 감소한 25.4%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다.

나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제55기	제54기	증 감	증감률
매출액	258,935,494	302,231,360	△43,295,866	△14.3%
매출원가	180,388,580	190,041,770	△9,653,190	△5.1%
매출총이익	78,546,914	112,189,590	△33,642,676	△30.0%
판매비와관리비	71,979,938	68,812,960	3,166,978	4.6%
영업이익	6,566,976	43,376,630	△36,809,654	△84.9%
기타수익	1,180,448	1,962,071	△781,623	△39.8%
기타비용	1,083,327	1,790,176	△706,849	△39.5%
지분법이익	887,550	1,090,643	△203,093	△18.6%
금융수익	16,100,148	20,828,995	△4,728,847	△22.7%
금융비용	12,645,530	19,027,689	△6,382,159	△33.5%
법인세비용차감전순이익	11,006,265	46,440,474	△35,434,209	△76.3%
법인세비용	△4,480,835	△9,213,603	4,732,768	△51.4%
당기순이익	15,487,100	55,654,077	△40,166,977	△72.2%
・지배기업 소유주지분	14,473,401	54,730,018	△40,256,617	△73.6%
・비지배지분	1,013,699	924,059	89,640	9.7%

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우

정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제55기 당사 매출액은 메모리 등 부품 사업의 약세로 전년 대비 43조 2,959억원(14.3%) 감소한 258조 9,355억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 전년 대비 36조 8,097억원(84.9%) 감소한 6조 5,670억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 35조 4,342억원(76.3%) 감소한 11조 63억원, 당기순이익은 전년 대비 40조 1,670억원(72.2%) 감소한 15조 4,871억원을 기록하였습니다.

수익성 지표 측면에서는 ROE가 전년 대비 12.6%p 감소한 4.3%, 매출액순이익률이 전년 대비 12.4%p 감소한 6.0%이나, 지속적으로 견실한 재무구조를 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

[부문별 영업실적 분석]

[단위 : 백만원]

구분	부문	제55기		제54기		증감(률)	
		금액	비중	금액	비중	금액	(%)
매출	DX 부문	169,992,337	65.7%	182,489,720	60.4%	△12,497,383	△6.8%
	DS 부문	66,594,471	25.7%	98,455,270	32.6%	△31,860,799	△32.4%
	SDC	30,975,373	12.0%	34,382,619	11.4%	△3,407,246	△9.9%
	Harman	14,388,454	5.6%	13,213,694	4.4%	1,174,760	8.9%
	전사 매출	258,935,494	100.0%	302,231,360	100.0%	△43,295,866	△14.3%
영업이익	DX 부문	14,384,705	219.0%	12,746,074	29.4%	1,638,631	12.9%
	DS 부문	△14,879,458	△226.6%	23,815,810	54.9%	△38,695,268	△162.5%
	SDC	5,566,478	84.8%	5,952,973	13.7%	△386,495	△6.5%
	Harman	1,173,702	17.9%	880,548	2.0%	293,154	33.3%
	전사 영업이익	6,566,976	100.0%	43,376,630	100.0%	△36,809,654	△84.9%

※ 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(DX 부문)

DX 부문의 제55기 매출은 경기둔화 우려로 전반적인 구매심리가 위축되어 169조 9,923억원으로 전년 대비 12조 4,974억원(6.8%) 감소하였으나, 영업이익은 플래그십 스마트폰, Neo QLED TV 등 프리미엄 제품 중심으로 제품 Mix를 개선해 14조 3,847억원으로 전년 대비 1조 6,386억원(12.9%) 증가하였습니다.

DX 부문의 영상디스플레이/생활가전 사업은 프리미엄 기술력을 바탕으로 한 Neo QLED TV 등 프리미엄 제품, 소비자의 경험을 중시하는 라이프스타일(Lifestyle)에 맞춰 출시한 Lifestyle TV와 BESPOKE 가전 등 프리미엄 제품을 중심으로 성장을 지속하고 있습니다.

영상디스플레이 사업은 프리미엄 중심의 사업 운영을 통해 75인치 이상의 대형 제품 시장 점유율을 계속 늘려가고 있으며, 가정 내 전자기기들과의 자동 연동 서비스 등 미래형 AI 스크린 체험들을 새롭게 제공하고 있습니다. 이와 함께 더테라스, 더프리미어 등 MZ 세대의 취향을 저격하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 상업용 마이크로 LED, The Wall 등 B2B 신제품의 매출 기여도 역시 증가하고 있습니다.

이러한 신제품에 대한 긍정적인 반응과 안정적인 공급망 관리를 바탕으로 글로벌 TV 시장에서는 2006년부터 2023년까지 18년 연속 세계 1위를 유지하며, 업계 리더로서의 위상을 지키고 있습니다. 2024년에는 마이크로 LED 제품 라인업을 확대하여 10만불 이상의 초고가 디스플레이 시장을 만들겠습니다. 또한, 투명 마이크로 LED 양산화를 앞당겨 스크린의 새로운 이정표를 제시하겠습니다.

생활가전 사업은 친환경・고효율 기술을 통해 제품의 기본 성능 우위와 함께, 변화하는 라이프스타일에 대한 깊은 이해를 바탕으로 소비자의 삶을 편리하게 하는 제품과 서비스를 지속 출시하고 있습니다. 또한 Bixby와 SmartThings를 중심으로 다양한 제품 및 서비스와 연동하는 스마트 가전을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있습니다.

2024년에도 AI 기능 및 에너지 절감 기술로 BESPOKE 제품 라인업 강화와 글로벌 판매를 가속화하고 새로운 폼팩터를 적용하여 차별화된 제품을 지속 출시하는 등의 경쟁력 우위를 기반으로 글로벌 가전 브랜드로서 시장을 선도해 나가겠습니다. 더불어, 시스템에어컨, 빌트인 등 B2B 사업 역시 친환경 기능 차별화, 고객 맞춤형 제품 도입 등을 통해 수주 경쟁력을 강화하여 성장세를 이어 나가겠습니다.

DX 부문의 MX(Mobile eXperience) 사업은 지정학적 이슈의 장기화, 인플레이션 및 경기 침체의 영향 등 어려운 시장 상황에서도 플래그십 스마트폰 매출이 성장하고 스마트폰 내 플래그십 매출 비중이 확대되는 등 소기의 성과를 달성했습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업과 Galaxy Ecosystem 제품군을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

2023년 출시한 갤럭시 S23 시리즈는 소비자가 일상에서 체감할 수 있는 제품 경험을 한 단계 높여 당사의 기술 리더십을 공고히 하고자 노력하였습니다. 특히, 갤럭시 S23 Ultra는 2억 화소 기반의 더욱 개선된 야간 촬영 및 Zoom 기능을 제공하고, 고용량 메모리 및 친환경 소재의 적용을 확대하였습니다. 또한, '갤럭시 Z 폴드5'와 '갤럭시 Z 플립5'는 사용자 관점에서 각 제품의 핵심 경험인 멀티태스킹과 Flex Mode의 완성도를 더욱 높였습니다. 스마트폰 외에도 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 워치와 풍부한 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다. 또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십을 강화하고 있으며, 당사의 방대한 글로벌 인스톨드 베이스(Installed-base) 기반 서비스 사업 강화를 통해 수익 구조를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

2024년에도 당사는 새로운 모바일 AI 경험 제공을 통해 모바일 시장을 선도해 나가고, 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 견조한 실적을 달성하겠습니다.

(DS 부문)

DS 부문의 제55기 매출은 66조 5,945억원으로 반도체 판가 하락 및 고객사의 재고 조정으로 수요 부진 등 어려운 시장 환경 속에 전년 대비 31조 8,608억원(32.4%) 감소하였으며, 영업손실은 14조 8,795억원으로 전년 대비 38조 6,953억원(162.5%) 감소하였습니다.

메모리 사업은 거시경제의 불확실성에도 불구하고 기술 리더십을 기반으로 당사의 입지를 견고히 하고, 시장 수요에 적기 대응하며 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 2024년은 금리 정책, 지정학 리스크 등 여러 변수들이 계속 존재할 것으로 예상되나, 전반적인 메모리 업황의 회복세가 전망되고 있는 만큼 시장 상황을 지속 관찰하며 변화에 선제적으로 대응하도록 하겠습니다.

DRAM은 세계 최초 Multi-step EUV(극자외선) 기술이 적용된 DRAM 양산 체계를 선제적으로 갖추어 기술경쟁력을 한층 강화하고, 고부가가치・고용량 제품 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통한 질적 성장에 주력하고 있습니다. 또한, 당사는 On-Device AI 확산에 따른 PC・모바일 중심의 탑재량 성장과 팬데믹 초기 판매된 제품의 교체 주기 도래 등 Set 제품 수요에 적극적으로 대응하고, HBM(High Bandwidth Memory)의 경우 HBM3와 HBM3E의 선단 제품 비중을 지속 확대하고 차세대 제품인 HBM4와 고객 맞춤형 HBM도 함께 개발하여 HBM 시장에서의 입지를 지속 강화해 나가겠습니다.

NAND는 앞선 기술력의 8세대 Vertical NAND 제품으로의 전환과 더불어 2024년 9세대 V-NAND 제품 채용을 추진하여 선단 제품 라인업 확보를 통한 기술 경쟁력을 강화하고, 모바일향 QLC 시장에 최초 진입함과 동시에 Generative AI향 Gen5 SSD 초기 시장도 함께 선도할 계획입니다.

System LSI는 2023년에도 스마트폰 수요 회복 지연 및 모바일 업계 재고 조정 지속되었으나, 하반기는 MX사 갤럭시향 부품 공급 및 중국 OEM 수요 개선으로 시황이 다소 회복되었으며, 핵심 기술 경쟁력을 강화하고 원가 경쟁력을 개선하는 등 지속 성장 기반을 구축하여 고객 확대를 계속하면서 미래 시장 변화에 대비하도록 하겠습니다. SOC는 On-Device AI를 탑재한 모바일 SOC 신제품을 출시하고 자동차향 SOC 등 라인업을 확대하여 고객 추가 확보를 진행하고 있으며, 3나노 적용 제품과 차세대IP 기술 개발 등 미래 준비도 지속하고 있습니다. 이미지센서 제품의 경우 미세 픽셀 성능 기반의 2억 화소 고부가 제품군 시장에서 카메라 줌 성능 차별화를 선도하고
있으며, 자율주행, XR 가상현실기기 등 신시장 진입을 위한 제품 라인업 다각화도 추진 중입니다.

파운드리는 2022년 하반기부터 이어지고 있는 시장 침체에 따른 수요 약세 및 반등 지연으로 어려운 경영 여건이 지속될 것으로 전망하고 있으나, 당사는 시장 회복에 대비하여 사업 전 영역에서 대책을 준비하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. Advnaced 노드는 중장기 수요 확보가 중요한 만큼 기술 경쟁력 강화와 더불어 수요 대응을 위한 공급 능력 확대 또한 시장 상황을 지속 관찰하며 선제 대응이 가능하도록 면밀히 살펴보고 있습니다. Mature 노드는 공정/제품 포트폴리오 강화를 통해 다양한 고객을 유치하는 한편, 고수익 제품 확대와 믹스 최적화를 통해 원가 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠습니다.

(SDC)

SDC의 제55기 매출은 30조 9,754억원으로 인플레이션, 경기침체 우려 등에 따른 소비심리 위축으로 전년 대비 3조 4,072억원(9.9%) 감소하였으며, 영업이익은 전년 대비 3,865억원(6.5%) 감소한 5조 5,665억원입니다.

중소형 패널 사업은 인플레이션, 금리상승, 경기침체 우려 등에 따른 소비심리 위축으로 스마트폰 수요 감소에도 불구, High-end 제품 중심의 운영으로 견조한 실적을 달성하였습니다. Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 고도화되는 소비자의 니즈에 적극 대응하였으며, 차별화된 기술과 성능으로 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

대형 패널 사업은 QD-OLED TV와 모니터 제품이 프리미엄 라인업에 포지셔닝 하였고 지속적으로 고객사와 제품 라인업을 다변화하고 있습니다.

2024년은 글로벌 경기 부진 및 지역 갈등 지속으로 시장의 정체가 예상되며, 정체된 스마트폰 시장 내에서도 패널 업체간 경쟁이 더욱 치열해지는 등 어려운 사업 환경이
예상됩니다. 이러한 상황에도 당사는 지속적인 신기술 개발과 혁신 리더십을 강화하여 대응하도록 하겠습니다. 중소형은 스마트폰 절대 우위 유지와 더불어 IT(태블릿/노트북), Auto 등 미래 성장 동력을 굳건히 다지고, 대형은 모니터 시장 확대와 효율 극대화를 통해 손익 개선해 나가겠습니다.

(Harman)

Harman의 제55기 매출은 14조 3,885억원으로 전년 대비 1조 1,748억원(8.9%) 증가하였으며, 영업이익은 1조 1,737억원으로 전년 대비 2,932억원(33.3%) 증가하였습니다. 전장 고객사의 수주 확대와 포터블 스피커 등 소비자 오디오 및 카오디오 판매도 호조를 이어가며 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.

거시경제환경 악화에도 불구하고, 당사가 Harman을 인수한 이후 전략 사업인 전장부품 및 소비자 오디오에서는 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. Harman은 자체적인 혁신과 당사 다른 부문의 모바일・IT・디스플레이・반도체 기술과의 융합을 통해 사업역량을 확대할 수 있었습니다.

당사는 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편, 프리미엄 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지하고 있습니다. 인포테인먼트 분야에서는 디지털콕핏으로의 전환에 선행 대응함으로써 시장을 선점하였으며, 차별화된 기술 개발을 통해 5G TCU(Telematics Control Unit)를 업계 최초로 수주하는 등 성과를 달성했습니다. 이러한 기술혁신을 바탕으로 향후 자율주행차 시대에 대비하여 더 편리하고 즐겁고 안전한 차량 내 사용자경험(In-Cabin Experience)을 제공하는데 사업 역량을 집중할 것입니다.

당사의 소비자오디오 브랜드는 오디오 시장에서 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 특히, JBL 브랜드는 2015년부터 글로벌 블루투스 스피커에서 판매량 기준 8년 연속 시장 1위를 차지했으며, 무선 이어폰 시장에서도 괄목할만한 성장세를 이어가고 있습니다. 앞으로 지속적으로 새로운 사용자 경험을 제공함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하겠습니다.

2024년은 Global GDP 성장률이 작년 대비 감소하고, 자동차 및 오디오 시장 성장 역시 둔화되어 경영 환경이 악화될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 경영환경 변화 대응력을 강화하고 글로벌 경쟁력을 갖추는 동시에 기술 혁신을 가속화하여 제품 및 원가경쟁력을 강화하는 한편, 견실한 경영실적을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

다. 신규 사업 및 중단 사업

해당사항 없습니다.

라. 조직의 변경

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE부문과 IM부문을 DX부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

<table>
<tr><th></th><th>변경전</th><th>변경후</th></tr>
<tr><td rowspan="5">사업
조직</td><td>CE 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기)</td><td rowspan="2">DX 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기,
Mobile eXperience, 네트워크)</td></tr>
<tr><td>IM 부문
(무선, 네트워크)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry,
디스플레이 패널)</td><td>DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry)</td></tr>
<tr><td>SDC
(디스플레이 패널)</td></tr>
<tr><td>Harman 부문</td><td>Harman</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지역
총괄</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td></tr>
<tr><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td></tr>
</table>

마. 환율변동 영향

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

[각 통화별 기말환율] (단위 : 원)

구 분	제55기	제54기	변동	변동률
USD	1,289.40	1,267.30	22.10	1.7%
EUR	1,426.59	1,351.20	75.39	5.6%

[△는 부(-)의 값임]

기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기		제54기	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	418,776	△418,776	258,655	△258,655
EUR	151,740	△151,740	92,546	△92,546

[△는 부(-)의 값임]

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다.

또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

바. 자산 손상 인식

당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.

현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다.
동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며, 회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.

당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 854억원, 무형자산 54억원 등입니다.

☞ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과
'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'의 '2. 타법인출자 현황'(별도 기준)을
참고하시기 바랍니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 당기말 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

가. 유동성 현황

당기말 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하며, Cash Coverage(유동자금÷차입금)는 728%입니다.

구 분	제55기	제54기
Cash Coverage(유동자금÷차입금)	728%	1,115%

(단위 : 백만원)

구 분	제55기	제54기	증감
유동자금:			
현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710	19,400,183
단기금융상품	22,690,924	65,102,886	△42,411,962
단기상각후원가금융자산	608,281	414,610	193,671
단기당기손익-공정가치금융자산	27,112	29,080	△1,968
소 계	92,407,210	115,227,286	△22,820,076
차입금:			
단기차입금	7,114,601	5,147,315	1,967,286
유동성장기부채	1,308,875	1,089,162	219,713
사채	537,618	536,093	1,525
장기차입금	3,724,850	3,560,672	164,178
소 계	12,685,944	10,333,242	2,352,702
Net Cash(유동자금-차입금)	79,721,266	104,894,044	△25,172,778

※ 유동성장기부채는 유동성장기차입금과 유동성사채입니다. [△는 부(-)의 값임]

당사는 당기말 현재 92조 4,072억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 단기금융상품, ③ 단기상각후원가금융자산, ④ 단기당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 115조 2,273억원 대비 22조 8,201억원 감소하였습니다.

당기말 현재 당사 차입금(사채 포함)은 12조 6,859억원으로 전기말 10조 3,332억원 대비 2조 3,527억원 증가하였습니다.

당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 44조 1,374억원이 유입되었고, 유・무형자산의 취득 60조 5,342억원, 배당금 지급 9조 8,645억원 등이 유출되었으며,
Net Cash(유동자금-차입금)는 79조 7,213억원으로 전기말 104조 8,940억원 대비 25조 1,728억원 감소하였습니다.

나. 자금 조달과 지출

(차입금 내역)

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	제55기	제54기
단기차입금:				
담보부차입금	우리은행 등	0.0~17.3	6,610,049	3,569,357
무담보차입금	씨티은행 등	0.0~62.2	504,552	1,577,958
계			7,114,601	5,147,315
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP 등	36.1~61.5	304,082	208,915
리스부채	CSSD 등	4.3	998,439	874,019
계			1,302,521	1,082,934
장기차입금:				
은행차입금	-	-	-	33,846
리스부채	CSSD 등	4.3	3,724,850	3,526,826
계			3,724,850	3,560,672

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	제55기	제54기
US$ denominated Straight Bonds	1997.10.02	2027.10.01	7.7	25,788 (US$ 20,000천)	31,683 (US$ 25,000천)
US$ denominated Debenture Bonds	2015.05.11	2025.05.15	4.2	515,760 (US$ 400,000천)	506,920 (US$ 400,000천)
소 계				541,548	538,603
사채할증발행차금(사채할인발행차금)				2,424	3,718
계				543,972	542,321
차감: 유동성사채				△6,354	△6,228
비유동사채				537,618	536,093

[△는 부(-)의 값임]

(차입금의 차입 및 상환)

당사의 단기차입금은 주로 매출채권할인 규모에 따라 증가 또는 감소하고 있습니다.
당사는 당기 중 단기차입금은 1조 9,673억원이 증가하였으며, 사채 및 장기차입금(유동성 포함)은 리스부채 증가 등으로 3,854억원 증가하였습니다.

(차입금의 상환계획)

(단위 : 백만원)

상환연도	금액
2024년	8,596,881
2025년	1,487,473
2026년	827,998
2027년	632,258
2028년 이후	1,822,019
계	13,366,629

※ 상환계획 금액은 사채의 할증발행차금과 할인발행차금, 리스부채의 현재가치할인차금을 고려하기 전 금액입니다.

(사채관리계약 이행현황)

당사가 발행한 공모사채는 투자자 보호를 위하여 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다.

5. 부외거래

당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 이 개정사항은 회계정책의 변경을 수반하는 것은 아니지만, 연결재무제표에 공시되는 회계정책 정보에 영향을 미칩니다. 또한중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서2
'중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다. 당사는 해당 기준서 개정내용에 따라 주석2에서 당사의 중요한 회계정책 정보를 설명하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래 당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

경제협력개발기구(OECD)가 발표한 필라2 모범규칙을 시행하기 위하여 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법 등에서 생기는 법인세에 기업회계기준서 제1012호 '법인세'를 적용한다는 점을 명확히 합니다.

다만 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 이연법인세 회계처리 요구사항에 한시적 예외 규정을 도입하여 필라2 법인세와 관련되는 이연법인세자산 및 부채를 인식하지
아니하고 이에 대한 정보도 공시하지 아니합니다.

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항

환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.

당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 종업원 관련 유의한 변동사항은 없습니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항

당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항

환율 변동 리스크 관리를 위하여 해외법인은 기능통화가 아닌 외화 포지션에
대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다.

당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와
'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 감사를 수행하였고 감사의견은 적정입니다. 또한, 안진회계법인은 당사의 제53기, 제54기 감사를 수행하였으며, 감사의견은 모두 적정입니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

[회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제55기 (당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제53기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

※ 감사의견은 별도・연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황] (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제55기 (당기)	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	85,700	7,800	85,036
제54기 (전기)	안진회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	8,424	78,146
제53기 (전전기)	안진회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	7,900	76,741	7,900	76,999

(제55기 일정)

구 분		일 정
제55기 1분기	사전검토	2023.03.06 ~ 2023.03.29
	본검토	2023.04.07 ~ 2023.05.12
제55기 2분기	사전검토	2023.06.05 ~ 2023.06.30
	본검토	2023.07.07 ~ 2023.08.11
제55기 3분기	사전검토	2023.09.06 ~ 2023.09.27
	본검토	2023.10.10 ~ 2023.11.14
시스템 및 자동 내부통제 감사		2023.04.03 ~ 2024.01.31
조기입증감사(연중감사)		2023.03.06 ~ 2023.12.29
내부회계관리제도 감사		2023.04.03 ~ 2024.01.31
조기입증감사 절차 업데이트 및 재무제표 감사		2024.01.02 ~ 2024.02.19

※ 별도・연결 재무제표 검토 및 감사와 내부회계관리제도 감사에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황] (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제55기 (당기)	2017.02 2018.09 2019.05 2023.05	세무자문업무(해외종속기업) 세무자문업무(해외종속기업) 세무자문업무(해외종속기업) ESG인증업무(국내종속기업)	2023.01~2023.12 2023.01~2023.12 2023.01~2023.12 2023.05~2023.07	202 27 79 25	삼정회계법인
제54기 (전기)	-	-	-	-	-
제53기 (전전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2021.01~2021.12	394	안진회계법인

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2023.01.27	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	・핵심감사사항 등 중점 감사사항 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2023.04.25	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	・분기 검토 경과 보고 ・연간 회계감사 계획 ・기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
3	2023.07.25	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 선정 계획 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
4	2023.10.27	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 선정 계획 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
5	2024.01.29	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 등 중점 감사사항 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

※ 내부감사기구와 2023년 1월 논의한 감사인은 안진회계법인이며, 2023년 4월 이후 논의한 감사인은 삼정회계법인입니다.

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

당사는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정한 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 이에 따라 당기부터 당사 회계감사인은 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경되었습니다.

제55기말(당기말) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 당기 중 국내 종속기업 가운데 삼성디스플레이㈜ 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로, 에스유머티리얼스㈜는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다.

전기 중 설립된 종속기업 ㈜희망별숲은 삼정회계법인(KPMG)으로, Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ), DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED가 KPMG를, 당기 중 설립된 SVIC 62호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 종속기업의 회계감사인 변경 및신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스씨에스㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자판매㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자로지텍㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
㈜도우인시스	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
지에프㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
㈜미래로시스템	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
에스유머티리얼스㈜	한영회계법인(E&Y)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Deloitte	KPMG
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	Deloitte	KPMG
Samsung International, Inc. (SII)	Deloitte	KPMG
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Deloitte	KPMG

Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics GmbH (SEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	Deloitte	KPMG
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	Deloitte	KPMG
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	Deloitte	KPMG
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Deloitte	KPMG
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Deloitte	KPMG
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Deloitte	KPMG
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Deloitte	KPMG
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Deloitte	KPMG
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	Deloitte	KPMG
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Deloitte	KPMG
Samsung Japan Corporation (SJC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	PwC	KPMG
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	PwC	KPMG
Samsung Research America, Inc (SRA)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	PwC	KPMG
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	PwC	KPMG
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	PwC	KPMG
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	PwC	KPMG
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	PwC	KPMG
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	PwC	KPMG
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	PwC	KPMG
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	PwC	KPMG
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	PwC	KPMG
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	PwC	KPMG
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	PwC	KPMG
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	PwC	KPMG
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	PwC	KPMG
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	PwC	KPMG
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	PwC	KPMG
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	PwC	KPMG
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	PwC	KPMG
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	PwC	KPMG
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	PwC	KPMG
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	E&Y	KPMG
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	KPP Co., Ltd	KPMG

제54기말(전기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 종속기업 Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

또한, 제53기말(전전기) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 종속기업 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)와 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.(SETK-P)가 Deloitte를, 지에프㈜가 안진회계법인(Deloitte)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)이 Deloitte에서 E&Y로 감사인을 변경하였으며, ㈜도우인시스가 삼덕회계법인에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임및 변경은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항
제55기 (당기)	삼정회계법인	(별도 내부회계관리제도) 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. (연결 내부회계관리제도) 회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제54기 (전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제53기 (전전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 5인(한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리하여, 2022년 3월 김한조 사외이사를 이사 간 의견 조율과 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단해 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장・위원장	주요 역할
이사회	사내이사 5명, 사외이사 6명	한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배, 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	김한조 (사외이사)	・법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ・경영진의 업무집행 감독
경영위원회	사내이사 5명	한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배	한종희 (사내이사)	・경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의・결의
감사위원회	사외이사 3명	김한조, 김선욱, 김종훈	김한조 (사외이사)	・재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
사외이사 후보추천위원회	사외이사 3명	김선욱, 허은녕, 유명희	김선욱 (사외이사)	・사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱, 김한조, 김종훈	김선욱 (사외이사)	・자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고
보상위원회	사외이사 3명	김종훈, 김한조, 김준성	김종훈 (사외이사)	・이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	김한조 (사외이사)	・환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

☞ 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 김한조 사외이사가 이사회 의장으로 선임되었고,
김준성 이사가 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로, 사내이사 전원이 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로,
김종훈 사외이사를 보상위원회 위원으로 선임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임된 허은녕, 유명희 사외이사가 당일 개최된 이사회를 통해
지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 한종희 사내이사가 경영위원회 위원으로,
허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2024년 1월 29일 사외이사후보추천위원회에서 김선욱 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
11	6	-	-	-

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명										
			사내이사					사외이사					
			한종희 (출석률 :100%)	경계현 (출석률 :75%)	노태문 (출석률 :88%)	박학규 (출석률 :100%)	이정배 (출석률 :100%)	김한조 (출석률 :100%)	김선욱 (출석률 :100%)	김종훈 (출석률 :100%)	김준성 (출석률 :100%)	허은녕 (출석률 :100%)	유명희 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부										
'23.01.31 (1차)	1. 2022년(제54기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 삼성디스플레이㈜와 임차계약 체결의 건 ※ 보고사항 ① 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	불참 불참	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'23.02.14 (2차)	1. 삼성디스플레이㈜와 자금 거래의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 제54기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 □ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인과의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 제1호: 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호: 사내이사 한종희 선임의 건 □ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 2023년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	5. 학교법인 충남삼성학원 후원금 출연의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	6. 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	7. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'23.03.15 (3차)	1. 대표이사 선정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'23.04.27 (4차)	1. 2023년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 스마트공장 지원사업 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'23.07.27 (5차)	1. 2023년 반기 보고서 및 2분기 배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 사회공헌 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 모바일 기기보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'23.08.18 (6차)	1. 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 ※ 보고사항 ① 한국경제인협회 동참 요청 관련 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'23.10.31 (7차)	1. 2023년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 삼성디스플레이㈜와 부동산 임대계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 삼성디스플레이㈜와 실시권 허락 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 삼성디스플레이㈜ 그린2동 매입의 건 ※ 보고사항 ① 최고경영자 승계 후보군 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'23.11.30 (8차)	1. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 퇴직연금 불입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 2024년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	5. 희망2024 나눔 캠페인 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	6. Samsung Global Goals 기부금 출연의 건 ※ 보고사항 ① 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건 ② 준법점검 결과 보고의 건 ③ 준법문화 구축방안 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 5명	한종희(위원장), 경계현, 노태문, 박학규, 이정배	하단 기재내용 참조	· 한종희 사내이사 위원장 선임('23.04.27)
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱(위원장), 김한조, 김종훈	하단 기재내용 참조	· 김선욱 사외이사 위원장 선임('21.04.27)
보상위원회	사외이사 3명	김종훈(위원장), 김한조, 김준성	하단 기재내용 참조	· 김종훈 사외이사 위원장 선임('23.01.27)
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조(위원장), 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	하단 기재내용 참조	· 김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28)

※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
※ 경영위원회 등 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다.

(경영위원회)

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항
 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
 2) 주요 경영전략
 3) 사업계획・사업구조 조정 추진
 4) 해외 지점・법인의 설치, 이전 및 철수
 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
 6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
 7) 기타 주요 경영현황
 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
 9) 지배인의 선임 또는 해임
 10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
 13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
 14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
 15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지
 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
- 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래 기준 금액 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위 (기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회)

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
  · 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
  ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우에는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
  · 내부거래 직권조사 명령권
  · 내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회)

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
  · 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  · 등기이사에 대한 보상체계
  · 기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회)

- 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
  - 회사의 지속가능경영과 관련된 사항
    1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책
    2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고
    3) 지속가능경영보고서 발간 계획
  - 주주가치 제고와 관련된 사항
    1) 주주환원 정책 사전 심의
    2) 주주권익 관련 주요 사안 보고
  - 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항
  - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
  - 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명				
				한종희 (출석률: 100%)	경계현 (출석률: 88%)	노태문 (출석률: 88%)	박학규 (출석률: 100%)	이정배 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부				
경영위원회	'23.01.19	1. 라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 임원 성과 인센티브 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'23.04.27	1. 경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 해외법인(중국) 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 해외법인(유럽) 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'23.05.15	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		2. 해외법인 지분인수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
	'23.08.11	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. Foundry 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. Foundry(화성) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 반도체연구소(평택) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 반도체연구소 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'23.10.12	1. Foundry(화성) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. AVP 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'23.11.21	1. 평택캠퍼스 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'23.11.24	1. Foundry(평택) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 반도체연구소(기흥) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 슈퍼컴퓨팅센터 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'23.12.20	1. 라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		2. 모바일 기기보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명		
				김선욱 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부		
내부거래 위원회	'23.01.27	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성디스플레이㈜와 임차계약 체결의 건 2. 2022년 4분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -
	'23.02.10	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 생산물 배상책임 보험 가입의 건 ② 삼성디스플레이㈜와 자금 거래의 건	-	-	-	-
	'23.04.25	1. 2023년 1분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-
	'23.07.25	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 사회공헌 기부금 출연의 건 ② 모바일 기기보험 가입의 건 2. 2023년 2분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -
	'23.08.18	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 국내 사업장 패키지보험 가입의 건	-	-	-	-
	'23.10.27	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성디스플레이㈜와 부동산 임대계약 변경의 건 ② 삼성디스플레이㈜와 실시권 허여 계약 체결의 건 ③ 삼성디스플레이㈜ 그린2동 매입의 건 2. 2023년 3분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -
	'23.11.28	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 퇴직연금 불입의 건 ② 2024년도 대규모 상품・용역거래 승인의 건	-	-	-	-

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명		
				김종훈 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김준성 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부		
보상 위원회	'23.01.27	1. 보상위원회 위원장 선임의 건 2. 2023년 사내이사 개별 보수체계 및 고정연봉 심의의 건 3. 2023년 이사보수 한도 심의의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

(지속가능경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명					
				김한조 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	김준성 (출석률: 100%)	허은녕 (출석률: 100%)	유명희 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부					
지속가능 경영위원회	'23.01.31	1. IR 동향 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
	'23.04.27	1. IR 동향 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		2. ESG 정보공개 요구 현황 및 대응(안)	-	-	-	-	-	-	-
		3. EU 공급망실사지침 대응 현황	-	-	-	-	-	-	-
	'23.07.25	1. IR 동향	-	-	-	-	-	-	-
		2. The UniverSE추진 현황	-	-	-	-	-	-	-
		3. 전사 Accessibility 추진 현황	-	-	-	-	-	-	-
	'23.10.27	1. IR 동향	-	-	-	-	-	-	-
		2. 신환경경영전략 1주년 주요 성과	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보 중 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토해서 주주총회의 회의목적 사항으로 확정합니다.

이사 선임에 있어서는 관련 법령과 정관에 정한 요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 재무, 법률, IT, ESG, 금융, 투자, 환경, 에너지, 국제통상 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

직 명	성 명	임 기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	한종희	'20.03~'26.03 (1회)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, DX부문장으로서 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	경계현	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	DS부문장으로서, DRAM, Flash, Solution 메모리 3대 제품을 모두 섭렵한 기술력을 보유하고 있으며, 소통과 공감을 통해 조직의 근본적인 체질을 개선하고 세계 반도체시장 1위 지위를 굳건히 강화 하는데 가장 적임자로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	노태문	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 갤럭시 S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	MX사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	박학규	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	주요 사업부들의 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고, 폭넓은 안목으로 사업혁신을 성공적으로 이끌었음. 현재는 DX부문 경영지원실장으로서,사업 성과창출을 위해 핵심 스탭 기능과 진단 및 리스크 관리역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	이정배	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년 연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	메모리사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사외이사	김한조	'19.03~'25.03 (1회)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생・나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김선욱	'18.03~'24.03 (1회)	법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김종훈	'18.03~'24.03 (1회)	IT 분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김준성	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	허은녕	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	에너지・자원・환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	유명희	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로 회사의 주요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소통할 수 있을 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 위원회는 사외이사 3인(김선욱, 허은녕, 유명희)으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.

사외이사 후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고
있습니다.

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명		
				김선욱 (출석률: -)	허은녕 (출석률: -)	유명희 (출석률: -)
				찬 반 여 부		
사외이사 후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2024년 1월 29일 사외이사 후보추천위원회에서 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었고, 사외이사 후보추천일을 2024년 2월 19일로 결정하였습니다.

※ 2024년 2월 19일 사외이사 후보추천위원회에서 심의하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 1인과 사외이사 후보 1인을 추천하였습니다.

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역
이사회 사무국	4	· 부사장1명(18년 11개월 / 1년 1개월), · 직원(Principal Professional) 2명 (평균18년 11개월/ 평균5년 8개월) · 직원(Professional) 1명 (6년 11개월 / 10개월)	· 주주총회, 이사회, 이사회내 위원회 운영 지원 · 사외이사 교육 및 직무수행 지원 · 이사 후보군 데이터베이스 구축 · 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공 · 회의 진행을 위한 실무 지원 · 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.28	MX사업부	김한조, 김선욱, 박병국, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 전략제품 소개 등
2022.07.28	Memory 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 생산라인 소개 등
2022.08	SEUK, SRUK, SEF, SENA, SEH	김한조, 김선욱, 김종훈	코로나19 감염 (김준성 이사)	· 경영현황 보고 및 주요 현안 질의 · TV 생산라인 및 영업 현장 방문 등
2022.11.30	Foundry 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사
2023.01.31	Samsung Research, 디자인경영센터	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· DX부문 R&D 현황 보고 및 CTO 간담회 등
2023.04.27	생활가전 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 광주사업장 운영 현황 보고 및 현장 답사
2023.07.27	S.LSI 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 중장기 사업전략 보고 등
2023.08	SEDA, SECH, SELA, SEM	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 경영현황 보고 및 주요 현안 질의, 내부통제활동 평가 · 생산라인 및 마케팅 현장 방문, 임직원 간담회
2023.10.31	VD 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 사업부 경영현황 및 사업전략 보고 등

※ 사외이사의 현업 일정 등으로 회사가 준비한 사업부나 법인 방문, 교육 등의 프로그램에 현장 참석이 어려운 경우 교육자료 등을 제공하고 있습니다.

② 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.27	경영지원실	김준성	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2022.11.28	경영지원실	허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023.03.15	인력개발원	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 회사 역사, 경영철학 등 회사경영 관련 주요사항
2023.04.25	글로벌마케팅실 글로벌EHS센터	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 마케팅 활동의 이해 · EHS 관리 현황 및 환경 경영의 이해
2023.10.27	사회공헌단 청년S/W아카데미 창의개발센터	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 희망디딤돌 등 CSR 활동의 이해 · SSAFY 프로그램 소개 · C-Lab 소개 및 활동 소개

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2023년말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

성명	사외이사 여부	경력	회계・재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
김한조	예	・하나금융나눔재단 이사장('22~현재) ・하나금융공익재단 이사장('19~'21) ・하나금융나눔재단 이사장('15~'19) ・㈜하나금융지주 부회장('15~'16) ・㈜한국외환은행 은행장('14~'15) ・외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)	예	4호 유형 (금융기관・정부・증권유관기관 등 경력자)	・㈜하나금융지주 부회장('15~'16) ・㈜한국외환은행 은행장('14~'15) ・외환캐피탈㈜ 사장('13~'14) ・㈜한국외환은행 - 기업사업그룹장('12~'13) - 지점장('99~'02, '04~'05)
김선욱	예	・이화여대 법학전문대학원 명예교수('18~현재) ・이화여대 법학과(법학전문대학원) 교수('95~'18) ・이화여대 총장('10~'14) ・법제처 처장('05~'07)	-	-	-
김종훈	예	・Kiswe Mobile 공동 창업자 및 회장('13~현재) ・Alcatel-Lucent 최고전략책임자(CSO)('11~'13) ・Alcatel-Lucent Bell 연구소 사장('05~'13) ・University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수('02~'13) ・Lucent Technologies 사장('98~'01) ・Yurie Systems 창업자, 회장 및 CEO('92~'98)	-	-	-

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계・재무전문가 유형입니다.

・4호 유형: 금융기관・정부・증권유관기관 등에서 회계・재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한・책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원 중 김선욱 위원은 사외이사후보추천위원회에서 감사위원이 되는 이사로 추천되고 이어 이사회에서 감사위원 후보로 확정되었으며, 김한조 위원과 김종훈 위원은 이사회에서 감사위원으로 추천되어 모두 사외이사로서 주주총회의 결의로 선임되었습니다. 또한 이들은 재무전문가(김한조 위원), 법률전문가(김선욱 위원), 글로벌 경영전문가(김종훈 위원)로서의 전문성과 경험을 가지고, 당사 및 당사의 최대주주 또는 주요 주주와의 관계에서 독립적인 지위로 감사위원회 활동을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 선정되었습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등
3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김한조 위원)	「상법」 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김한조 위원)	
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」 제542조의11 제3항

(기준일 : 2023년 12월 31일)

성 명	감사위원회 위원 임기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 겸직 현황
김한조	'19.03~'25.03 (1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김선욱	'18.03~'24.03 (1회)	법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김종훈	'22.03~'24.03 (해당사항 없음)	글로벌 경영전문가으로서 여러 기업을 투명하고 공정하게 운영한 경험을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	Kiswe Mobile 회장 (13년~현재)

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는
신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				김한조 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부		
감사 위원회	'23.01.27	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
		2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-
		3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-
		4. 2022년(제54기) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	-	-	-
		5. 2022년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	-	-
		6. 2022년 4분기 대외후원금 현황 보고의 건	-	-	-	-
		7. 2022년 감사실적 보고의 건	-	-	-	-
	'23.02.10	1. 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건	-	-	-	-
		2. 2022년 내부감시장치 가동현황 보고의 건	-	-	-	-
	'23.04.25	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-
		2. 2022년 외부감사 이행 평가 보고의 건	-	-	-	-
		3. 2023년 1분기 보고서 보고의 건	-	-	-	-
		4. 2023년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	-	-
		5. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건	-	-	-	-
		6. 2023년 1분기 대외 후원금 현황 보고의 건	-	-	-	-
		7. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건	-	-	-	-
	'23.07.25	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-
		2. 2023년 반기 보고서 보고의 건	-	-	-	-
		3. 2023년 2분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	-	-
		4. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 건	-	-	-	-
		5. 2023년 2분기 대외 후원금 현황 보고의 건	-	-	-	-
		6. 2023년 상반기 감사실적 보고의 건	-	-	-	-
		7. 2023년 내부회계관리제도 평가활동 보고 및 업무규정 제정의 건	가결	-	-	-
	'23.10.27	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-
		2. 2023년 3분기 보고서 보고의 건	-	-	-	-
		3. 2023년 3분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	-	-
		4. 2023년 3분기 대외 후원금 현황 보고의 건	-	-	-	-

※ 당사 외부감사인이 감사위원회 승인 대상 비감사용역을 수행하지 않았음을 검토하여 보고한 안건으로,
감사위원회는 감사위원 간 논의를 거쳐 승인 대상 비감사용역을 수행하지 않았음을 최종 확인하였습니다.

라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2021.07.27	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	연결 내부회계관리제도 도입
2022.05.25	재경팀, 외부전문가	김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도와 감사위원회의 역할
2022.07.26	외부전문가	김한조 김선욱 김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도 조직운영 관련 해외 선진 사례
2023.10.27	외부전문가	김한조 김선욱 김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도 생성형 AI 활용 등 고도화 방안

바. 감사위원회 지원조직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사팀	4	부사장 1명(1개월), 직원(Principal Professional) 1명(6년), 직원(Senior Professional) 2명(평균 3년 5개월)	감사위원회 지원
내부회계 평가지원그룹	4	부사장 1명(5년), 변호사 1명(2년 9개월) 직원(Principal Professional) 1명(7개월), 직원(Senior Professional) 1명(7개월)	내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

사. 준법지원인에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구 분		내 용
1. 인적사항 및 주요경력	성명	박정호
	출생연월	1971.09
	성별	남
	담당업무	삼성전자㈜ Compliance팀장('22.12～현재)
	주요경력	'04.05 : 삼성전자㈜ 경영지원실 인사팀 변호사 '14.12 : 삼성전자㈜ 법무실 법무팀 상무대우 '18.03 : 삼성전자㈜ DS부문 법무지원팀 상무대우 '20.01 : 삼성전자㈜ Compliance팀 상무대우 '22.12 : 삼성전자㈜ Compliance팀장 부사장대우
	학력	서울대 법학(학사) 미시간주립대 대학원 노사관계학(석사)
2. 이사회 결의일		2022.12.20
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

※ 준법지원인은 관련 법령「상법」제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을 충족하고 있습니다.

아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기・비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

점검일시		점검내용	점검분야	점검 및 처리 결과
'23.1분기	'23.01.	국내 품질조직 준법 점검	영업비밀, 기술유용 등	전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 사내 정책 등에 따라 보완함
	'23.03.	국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'23.2분기	'23.05.	해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	
		고객사 영업비밀 침해 리스크 점검	영업비밀	
	'23.06.	해외 판매법인 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'23.3분기	'23.07.	국내 영업조직 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
	'23.08.	대외후원금 및 내부거래 리스크 점검	반부패, 공정거래	
		자회사 준법 점검	영업비밀, 개인정보 등	
	'23.09.	특허출원 프로세스 점검	기술유용, 영업비밀 등	
		온라인 판매 사이트 준법 점검	소비자 보호, 다크패턴	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'23.4분기	'23.10.	대외후원금 및 내부거래 리스크 점검	반부패, 공정거래	
		해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	
	'23.11.	특허출원 프로세스 점검	기술유용, 영업비밀 등	
	'23.12.	국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	

※ 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

※ 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

자. 준법지원인 지원 조직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
Compliance팀 등	67	상무 2명(평균 6년 7개월), 직원(Principal Professional/Engineer) 17명(평균 8년 11개월), 변호사 12명(평균 5년), 직원(Senior Professional) 34명(평균 5년 7개월), 직원(Professional) 2명(평균 2년 4개월)	준법지원인 주요 활동 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2023년말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며,
2023년 3월 15일 제54기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.
당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.
당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제54기('22년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

2023년말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(603,811,048주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,365,971,502주입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	5,969,782,550	-
	우선주	822,886,700	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	822,886,700	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	603,324,100	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 508,157,148주, 삼성화재해상보험㈜ 88,802,052주, 삼성복지재단 4,484,150주, 삼성문화재단 1,880,750주)
	보통주	486,948	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 특별계정 일부)
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	5,365,971,502	-
	우선주	-	-

※ 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(603,324,100주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞ (주) 제8조 6항 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. ☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자) 1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다. 2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임・직원(「상법」 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 임・직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게「상법」이 허용하는 한도내에서

	「상법」 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임・직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립・경영・해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임・직원으로 하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임・직원은 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다. 4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다. 5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다. 6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다. 7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① 임・직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 ② 임・직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 ③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우
결 산 일	12월 31일
정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)
주주의 특전	없음
공고 방법	중앙일보

※ 2019년 9월 16일「주식・사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

※ 당사는 정관에 의거 중앙일보에 공고하고 있으며, 당사 홈페이지(https://www.samsung.com/sec/ir)에도 게재하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2023년 12월 31일)

주총일자	안 건	결의내용
제54기 정기주주총회 (2023.03.15)	1. 제54기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 한종희 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결
제54기 임시주주총회 (2022.11.03)	1. 사외이사 선임의 건 1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건 1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건	 가결 가결
제53기 정기주주총회 (2022.03.16)	1. 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건 2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건 2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건 2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
제52기 정기주주총회 (2021.03.17)	1. 제52기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 박병국 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 김종훈 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 김기남 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 김현석 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 고동진 선임의 건 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	보통주	10,246,942	0.17	8,097,938	0.14	장내매매
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	우선주	403,278	0.05	417,085	0.06	장내매매
삼성물산㈜	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험㈜	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	117,302,806	1.96	117,302,806	1.96	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	우선주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이부진	계열회사 임원	보통주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	최대주주의 특수관계인	우선주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이서현	최대주주의 특수관계인	보통주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한종희	계열회사 임원	우선주	15,000	0.00	15,000	0.00	-
경계현	계열회사 임원	보통주	18,050	0.00	21,050	0.00	장내매매
노태문	계열회사 임원	보통주	13,000	0.00	13,000	0.00	-
박학규	계열회사 임원	보통주	22,500	0.00	22,500	0.00	-
이정배	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	15,000	0.00	-
김한조	계열회사 임원	보통주	3,655	0.00	3,655	0.00	-
계		보통주	1,237,981,437	20.74	1,235,835,433	20.70	-
		우선주	1,067,128	0.13	1,080,935	0.13	-

※ 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.)

※ 2023년 12월 31일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 최대주주의 특수관계인(홍라희, 이부진, 이서현) 소유주식 중 일부에 대해 2023년 10월 31일자로 유가증권처분신탁 계약을 체결하였으며, 2024년 1월 11일자로 신탁주식 처분이 완료되었습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 2023년 11월 3일자 및 2024년 1월 15일자 '주식등의 대량보유상황보고서(일반)'를 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성생명보험㈜ (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
전화번호: 1588-3114
홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험㈜	88,408	전영묵	0.00	-	-	삼성물산㈜	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2023년 12월 31일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.16	전영묵	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이건희	-
2021.04.29	-	-	-	-	삼성물산㈜	19.34

※ 2021년 4월 29일 최대주주(2020년 10월 25일 별세)가 소유하던 주식에 대한 상속으로 인하여 최대주주가 삼성물산㈜으로 변경되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험㈜
자산총계	314,655,050
부채총계	270,317,609
자본총계	44,337,441
매출액	30,937,013
영업이익	2,398,377
당기순이익	2,033,709

※ 재무현황은 2023년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 사업현황 등

삼성생명보험㈜은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.
또한, 주요 종속기업인 삼성카드㈜는 여신전문금융업(신용카드업・시설대여업・할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성생명보험㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간
1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
전화번호: 02-2145-5114
홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산㈜	146,861	고정석	0.00	-	-	이재용	18.26
		오세철	0.00	-	-	-	-
		정해린	0.00	-	-	-	-

※ 2023년 12월 31일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.19	고정석	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	오세철	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이재용	18.13
2023.03.17	한승환	-	-	-	-	-
2023.03.17	정해린	0.00	-	-	-	-
2023.04.21	-	-	-	-	이재용	18.26

※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며,
고정석 대표이사가 재선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(17.48%→18.13%)되었습니다.

※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각(보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.13%→18.26%)되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산㈜
자산총계	66,127,029
부채총계	26,229,919
자본총계	39,897,109
매출액	41,895,681
영업이익	2,870,174
당기순이익	2,719,106

※ 재무현황은 2023년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 사업현황 등

삼성물산㈜은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2021.04.29	삼성생명보험㈜	1,263,050,053	21.16	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며,
의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

4. 주식의 분포 현황

가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	삼성생명보험㈜	516,255,086	8.65	특별계정 포함
	국민연금공단	434,549,036	7.28	-
	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03	2019년 1월 28일 기준
	삼성물산㈜	298,818,100	5.01	-
우리사주조합		-	-	-

※ 5% 이상 주주는 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을
참고하시기 바랍니다.
※ BlackRock Fund Advisors의 소유주식수 및 지분율은 2019년 2월 7일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에
공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	4,672,039	4,672,130	99.99	4,017,892,514	5,969,782,550	67.30	-

※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류			'23.07월	'23.08월	'23.09월	'23.10월	'23.11월	'23.12월
보통주	주가	최 고	73,400	71,100	72,000	70,500	72,800	78,500
		최 저	69,500	66,300	68,400	66,000	68,600	71,200
		평 균	71,348	67,686	70,168	67,911	71,409	73,811
	거래량	최고(일)	30,016,221	20,087,090	29,738,235	25,209,349	22,228,489	27,567,593
		최저(일)	9,732,730	5,824,628	9,897,840	9,724,086	6,676,685	8,123,087
		월 간	303,283,444	258,464,791	283,534,308	290,080,133	273,455,511	254,875,780
우선주	주가	최 고	60,300	58,100	58,100	55,700	58,000	62,300
		최 저	57,400	54,000	54,200	53,000	55,600	57,300
		평 균	59,086	55,586	56,589	54,358	57,177	59,311
	거래량	최고(일)	2,275,284	2,440,052	2,803,240	2,331,421	2,131,331	2,241,939
		최저(일)	564,879	546,924	552,257	593,828	439,370	857,002
		월 간	21,483,981	22,531,530	23,087,718	21,141,990	22,430,034	24,240,536

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)] (단위 : US$, 원, DR)

종 류				'23.07월	'23.08월	'23.09월	'23.10월	'23.11월	'23.12월
보통주	주가	최고	US$	1,442.00	1,363.00	1,347.00	1,292.00	1,403.00	1,506.00
			₩환산	1,840,280	1,736,189	1,788,547	1,746,655	1,815,482	1,949,366
		최저	US$	1,339.00	1,228.00	1,253.00	1,223.00	1,277.00	1,349.00
			₩환산	1,750,475	1,647,485	1,685,034	1,650,316	1,723,439	1,756,128
		평균	US$	1,389.81	1,275.82	1,305.05	1,253.27	1,365.95	1,408.63
			₩환산	1,787,761	1,682,882	1,737,401	1,692,120	1,791,140	1,835,183
	거래량	최고(일)		15,097	15,039	12,554	10,088	17,847	17,444
		최저(일)		3,259	3,197	3,759	3,905	2,779	4,984
		월 간		171,510	181,494	152,689	168,362	222,854	200,660

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고・최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)] (단위 : US$, 원, DR)

종 류				'23.07월	'23.08월	'23.09월	'23.10월	'23.11월	'23.12월
우선주	주가	최고	US$	1,184.00	1,122.00	1,088.00	1,022.00	1,116.00	1,190.00
			₩환산	1,499,062	1,429,204	1,435,290	1,377,963	1,444,550	1,540,336
		최저	US$	1,106.00	1,010.00	994.00	974.00	1,030.00	1,084.00
			₩환산	1,445,874	1,355,016	1,336,731	1,309,835	1,390,088	1,421,883
		평균	US$	1,147.24	1,051.36	1,053.29	1,001.23	1,093.55	1,129.05
			₩환산	1,475,733	1,386,813	1,402,232	1,351,818	1,433,937	1,470,944
	거래량	최고(일)		1,158	2,390	5,625	1,717	1,835	1,358
		최저(일)		245	215	122	220	265	94
		월 간		12,354	16,767	21,445	17,834	19,117	15,661

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고・최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
한종희	남	1962.03	부회장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DX 부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장	15,000	-	계열회사 임원	46개월	2026.03.17
경계현	남	1963.03	사장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DS 부문 경영전반 총괄)	· 서울대 제어계측공학 박사 · 삼성전자 DS부문장	21,050	-	계열회사 임원	22개월	2025.03.15
노태문	남	1968.09	사장	사내 이사	상근	· MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	13,000	-	계열회사 임원	22개월	2025.03.15
박학규	남	1964.11	사장	사내 이사	상근	· CFO	· KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장	22,500	-	계열회사 임원	22개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	사장	사내 이사	상근	· 메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	15,000	-	계열회사 임원	22개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외 이사	비상근	· 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융나눔재단 이사장	3,655	-	계열회사 임원	58개월	2025.03.19
김선욱	여	1952.12	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수	-	-	계열회사 임원	70개월	2024.03.22
김종훈	남	1960.08	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Maryland대 신뢰성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장	-	-	계열회사 임원	70개월	2024.03.22
김준성	남	1967.10	이사	사외 이사	비상근	· 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르투자청 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	22개월	2025.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외 이사	비상근	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	-	-	계열회사 임원	14개월	2025.11.02
유명희	여	1967.06	이사	사외 이사	비상근	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 서울대 국제대학원 객원교수	-	-	계열회사 임원	14개월	2025.11.02

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.

☞ 등기임원 변동에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사 후보자 해당여부	주요경력	선・해임 예정일	최대주주와의 관계
선임	신제윤	남	1958.03	사외이사 (감사위원회 위원 제외)	・기획재정부 제1차관(2011~2013) ・금융위원회 위원장(2013~2015) ・국제자금세탁방지기구(FATF) 의장 (2015~2016) ・외교부 국제금융협력대사(2017~2018) ・(사)청소년금융교육협의회 회장(2017~2023) ・법무법인(유한) 태평양 고문(2017~현재)	2024.03.29	-
선임	조혜경	여	1964.07	감사위원회 위원	・한성대 AI응용학과 교수(1996~현재) ・한국로봇산업진흥원 이사(의장)(2012~2015) ・제어로봇시스템학회 부회장(2020~2021) ・한국로봇학회 회장(2022~2022) ・한국공학한림원 정회원(2023~현재)	2024.03.20	-
선임	유명희	여	1967.06	감사위원회 위원	・Vanderbilt대 법학 박사(2002) ・서울대 국제대학원 객원교수(2022~현재)	2024.03.20	계열회사 임원

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제55기 정기주주총회의 안건으로,
향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

다. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장	2013년~현재
유명희	사외이사	HD현대건설기계	사외이사	2022년~현재

라. 미등기임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주와의 관계	재직 기간
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관계인	
전영현	남	1960.12	부회장	상근	미래사업기획단장	삼성SDI, 이사회의장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	40
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	사장	상근	Global Public Affairs실장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	제조&기술담당	글로벌인프라총괄	연세대(박사)	계열회사 임원	
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산, 건설부문 커뮤니케이션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	13
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
승현준	남	1966.06	사장	상근	Samsung Research 글로벌 R&D협력담당	Samsung Research 담당임원	Harvard Univ.(박사)	계열회사 임원	
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	사장	상근	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	글로벌마케팅실장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이원진	남	1967.08	사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산, 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	13
강동구	남	1976.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	

강동훈	남	1970.12	부사장	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강문수	남	1969.08	부사장	상근	AVP사업팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	54
강석채	남	1971.06	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	Samsung Research Robot센터장	무선 개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
강신봉	남	1970.01	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터장	위대한상상, CEO	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	12
강태우	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	46
고승환	남	1962.09	부사장	상근	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	메모리 인사팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형종	남	1970.11	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	반도체연구소 Logic TD실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
권오상	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권환준	남	1971.09	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Qualcomm, Sr. Director	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	22
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 법무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	50
김경희	여	1969.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	

김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	25
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1969.06	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 People팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김성은	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	48
김성한	남	1970.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연성	남	1966.05	부사장	상근	생활가전 지원팀장	한국총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략지원담당	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스, 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	30
김용수	남	1971.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀장	Google, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	1

김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김용주	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 중대형사업부 지원팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
김우평	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-AVP 연구소장	TSP총괄 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	18
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	TSP총괄 GPO팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS, 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
김일룡	남	1974.02	부사장	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SELA법인장	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 기획팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종헌	남	1966.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	Foundry 인사팀장	육사(학사)	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김중정	남	1973.11	부사장	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	
김찬우	남	1976.04	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
김창업	남	1969.08	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김평진	남	1973.12	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(학사)	계열회사 임원	

김학상	남	1966.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형로	남	1973.01	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	25
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	23
더못라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSE총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical Coll.(학사)	계열회사 임원	
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	SEIB법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	35
도현호	남	1967.10	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Applied Materials, Managing Director	서울대(박사)	계열회사 임원	22
디페쉬	남	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
류경동	남	1970.01	부사장	상근	SAIT System Research Center장	SAIT 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	4
린준청	남	1970.07	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	Skytech, CEO	NTUST(박사)	계열회사 임원	12
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	22
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	
문승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	

문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생산기술연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문창록	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박건태	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	34
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박성준	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박세근	남	1974.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	48
박수남	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실장	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	
박순철	남	1966.07	부사장	상근	지원팀장	Mobile eXperience 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	36
박정호	남	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	

박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	53
박태상	남	1975.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박현정	남	1969.12	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박형원	남	1966.09	부사장	상근	System LSI Global Operation실장	System LSI 품질팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
반효동	남	1967.06	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
발라지	남	1969.09	부사장	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 상품기획실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
배일환	남	1970.07	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	부사장	상근	신사업T/F장	지원팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
서보철	남	1972.01	부사장	상근	Mobile eXperience Global운영팀장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	부사장	상근	DS부문 IP팀 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	37
서한석	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서행룡	남	1967.09	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
성덕용	남	1973.09	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
성일경	남	1964.01	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	북미총괄 지원팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실장	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사수료)	계열회사 임원	

송명주	여	1970.02	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	TSE-S법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
송병무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	제조&기술담당 AVP제조기술센터장	TSP총괄 TP센터장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	57
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터장	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승원	남	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	36
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신유균	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 CTO 담당임원	반도체연구소 차세대연ㄱ누실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Technical Univ. of Munich(박사)	계열회사 임원	4
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience People팀장	영상디스플레이 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심재현	남	1972.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터장	SESS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실장	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안유정	여	1974.08	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Waymo, Head of Design	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	2
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	

양병덕	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소장	생산기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	세종대(학사)	계열회사 임원	
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄대현	남	1966.03	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
엄재훈	남	1966.06	부사장	상근	상생협력센터장	DS부문 DS대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여태정	남	1970.06	부사장	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS, 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오재균	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 지원팀장	System LSI 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	TSP총괄 지원팀장	清華大(석사)	계열회사 임원	
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	System LSI 지원팀장	메모리 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
왕통	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大(학사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 개인정보보호팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기 전략마케팅팀장	삼성메디슨 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	13

유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 S/W개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	38
육근성	남	1968.08	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	21
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Qualcomm, Senior Director	연세대(학사)	계열회사 임원	20
윤영조	남	1975.02	부사장	상근	Global Public Affairs실 담당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	45
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤종식	남	1961.09	부사장	상근	Foundry 담당임원	Foundry 기술개발실장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
윤주한	남	1970.05	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	전장사업팀장	기획팀 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄, CSO	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤하룡	남	1971.12	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이광렬	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(학사)	계열회사 임원	
이규호	남	1969.06	부사장	상근	People팀 담당임원	영상디스플레이 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
이동기	남	1969.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	

이동우	남	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 개발팀장	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	
이병원	남	1972.05	부사장	상근	IR팀 담당임원	기획재정부, 부이사관	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	2
이상도	남	1969.03	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이상원	남	1971.07	부사장	상근	서남아총괄 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Intel, Sr. Principal Engineer	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	17
이석원	남	1970.07	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이석준	남	1965.07	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI AP개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이승엽	남	1968.08	부사장	상근	아프리카총괄	SEIN-S법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	34
이영수	남	1972.01	부사장	상근	생산기술연구소장	SEVT 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영웅	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	9
이영호	남	1967.07	부사장	상근	중국사업혁신팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명, 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mercedez-Benz, CDO of China	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	13
이재범	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 기획팀장	영상디스플레이 기획팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	

이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI사업팀장	System LSI LSI개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이정삼	남	1967.06	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	36
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	12
이제석	남	1969.01	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	3
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터장	디바이스플랫폼센터 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀장	혁신센터장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종호	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 담당임원	메모리 DRAM개발실장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이주형	남	1972.08	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	52
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀장	Samsung Research 차세대가전연구팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	Global EHS실장	생활가전 CX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 개발팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	
이지별	남	1971.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	Meta, Creative Director	Parsons School of Design(학사)	계열회사 임원	17
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 Flash개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이청용	남	1968.12	부사장	상근	SAVINA-S법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산, 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	부사장	상근	SRA 담당임원	TSP총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	39

이헌	남	1969.02	부사장	상근	SEIN-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이헌	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEF 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이형우	남	1970.03	부사장	상근	북미총괄 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	46
임근휘	남	1973.05	부사장	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권, 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	25
임석환	남	1974.11	부사장	상근	DSRA-S.LSI 연구소장	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
임성택	남	1966.06	부사장	상근	한국총괄	중동총괄	연세대(학사)	계열회사 임원	
임성택	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀장	기획팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	13
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	57
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실장	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장종산	남	1964.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	45
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	Global CS센터장	로봇사업팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	삼성글로벌리서치, 글로벌전략실 담당임원	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	13
전신애	여	1973.08	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	SAIT Material Research Center 담당Master	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
전필규	남	1968.11	부사장	상근	창의개발센터장	삼성경제연구소, 리더십팀장	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	1
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 IP팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	37
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry 담당임원	Foundry CTO	서울대(박사)	계열회사 임원	

정상섭	남	1966.11	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터장	SAS법인장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정서형	남	1967.05	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
정성택	남	1976.09	부사장	상근	미래사업기획단內	신사업T/F장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	17
정용준	남	1969.10	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실장	SEA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Apple, Sr. Engineering Mgr	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	14
정진국	남	1975.10	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀	System LSI SOC개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	37
정현준	남	1964.06	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	영상디스플레이 Micro LED팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
정혜순	여	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	남	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
조기열	남	1971.03	부사장	상근	법무실 법무팀장	삼성디스플레이, 법무실장	경찰대(학사)	계열회사 임원	1
조기재	남	1967.01	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀장	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	System LSI A-Project팀장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대(학사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	중동총괄	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1970.11	부사장	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	건국대(박사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	북미총괄 People팀장	네트워크 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	

조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성SDI, 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	21
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SEUK법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조학주	남	1969.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주드버클리	남	1970.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEA EVP	Queensland Univ.(학사)	계열회사 임원	25
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스, 고객지원실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	48
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
차경환	남	1972.04	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소, 연구조정실 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	28
채원철	남	1966.05	부사장	상근	MX사업부 Digital Wallet팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
최강석	남	1965.12	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Univ of California, Irvine(학사)	계열회사 임원	50
최경세	남	1969.04	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실장	TSP총괄 Package개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최동준	남	1972.05	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터장	서울대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	52
최순	남	1970.10	부사장	상근	SIEL-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명, 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	13

최완우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라설비자동화T/F장	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	CSS사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	SESA법인장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진한	남	1973.05	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	AMAT, Managing Director	Univ. of Arizona(박사수료)	계열회사 임원	14
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 Solution개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	SAIT AI Research Center장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
패트릭쇼메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
편정우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
한지니	여	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	40
한진만	남	1966.10	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	메모리 전략마케팅실장	서울대(학사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 기획팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
허성회	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
현상진	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실장	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
홍경선	남	1970.08	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
홍기채	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	계열회사 임원	30
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터장	아프리카총괄	중앙대(학사)	계열회사 임원	

홍석준	남	1970.07	부사장	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	7
홍성민	남	1969.06	부사장	상근	Foundry People팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Research Center장	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사 임원	7
황기현	남	1967.06	부사장	상근	제조&기술담당 Common Tech센터장	제조담당 제조시너지팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황완구	남	1972.02	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	삼성바이오로직스 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
황인철	남	1977.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE영업팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	제조&기술담당 평택단지장	제조&기술담당 메모리제조기술센터장	인하대(학사)	계열회사 임원	
황희돈	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	28
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
강동우	남	1971.04	상무	상근	제조&기술담당 AVP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터장	한양대(석사)	계열회사 임원	48
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	13
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	25
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	48
강보경	여	1976.12	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI Design Platform개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
강상용	남	1972.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	48
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	33

강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청, 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	6
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
강정대	남	1970.09	상무	상근	재경팀 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
강태규	남	1972.01	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	IR팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
강태형	남	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Dell, Director	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	5
강혁	남	1984.10	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
강희성	남	1970.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	Flex, Sr. Director	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	13
고승범	남	1971.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
고얄시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	41
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	55
고의중	남	1972.02	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	25
고정욱	남	1976.02	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	48
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
고택균	남	1971.05	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	37
고현목	남	1980.02	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	1
고형석	남	1972.09	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	
공병진	남	1971.09	상무	상근	SEM-P법인장	SIEL-P(C)공장장	항공대(학사)	계열회사 임원	37
곽원근	남	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	1
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30

구봉진	여	1971.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
구윤본	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 담당임원	메모리 제조기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	51
권기덕	남	1972.07	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	37
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	37
권기록	남	1974.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	2
권기성	남	1975.01	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	2
권상욱	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대가전연구팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
권순범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	48
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	37
권영훈	남	1972.02	상무	상근	SEA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30
권오겸	남	1977.08	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
권욱	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Lazada, CMO	서울대(석사)	계열회사 임원	19
권정현	남	1980.03	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager	서울대(박사)	계열회사 임원	11
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEHC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	포항공대(학사)	계열회사 임원	37
권태훈	남	1971.02	상무	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	48
권혁우	남	1973.07	상무	상근	DX부문 Global Public Affair실 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	18
권형석	남	1973.02	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	37
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	SEH-P 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	25

김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
김경준	남	1969.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
김경태	남	1973.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	37
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	13
김경택	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	25
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	13
김구영	남	1975.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	25
김기수	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김기수	남	1976.05	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
김기언	남	1972.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	13
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	45
김대신	남	1970.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김대우	남	1970.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	SME법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	13
김덕헌	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	47
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	48
김도기	남	1975.05	상무	상근	DS부문 CTO People팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 People팀장	숭실대(학사)	계열회사 임원	13
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	25
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	25
김동준	남	1973.05	상무	상근	제조&기술담당 담당임원	TSLED법인장	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	33
김륭	남	1971.12	상무	상근	생활가전 People팀장	People팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	37
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	37

김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	25
김문수	남	1977.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	37
김민우	남	1978.06	상무	상근	TSE-S 담당임원	SESP법인장	한양대(학사)	계열회사 임원	37
김범준	남	1977.03	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	1
김범진	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEAU 담당임원	Southern Illinois Univ.(석사)	계열회사 임원	
김병승	남	1976.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	메모리 품질실실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	2
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	22
김보창	남	1977.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	13
김봉수	남	1971.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	37
김상윤	남	1969.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Synopsys, Technical Member	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	47
김상윤	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SECE법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	37
김상현	남	1978.10	상무	상근	SEI 담당임원	SEB법인장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	1
김석영	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	2
김석희	남	1971.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	37
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	13
김선정	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	25
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	네트워크 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	25
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	13
김세훈	남	1975.01	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	13
김수연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	1
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
김수홍	남	1972.11	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	

김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	48
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	단국대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사 임원	37
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
김연정	남	1975.12	상무	상근	SEV 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	25
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	7
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	13
김영정	남	1972.03	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
김영주	남	1973.07	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	25
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	47
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	37
김용성	남	1973.09	상무	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
김용완	남	1970.04	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	메모리 Global운영팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	48
김용찬	남	1969.03	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	25
김용훈	남	1972.11	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	37
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	25
김원우	남	1970.03	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEDA-S 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	48
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유나	여	1979.01	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	SRPOL연구소장	포항공대(박사)	계열회사 임원	25

김윤재	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	37
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	13
김인철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	DX부문 경영지원실 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	2
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김재관	남	1976.01	상무	상근	SRA 담당임원	지원팀 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	1
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	48
김재윤	남	1970.07	상무	상근	전장사업팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	37
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석변호사	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	13
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	27
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김정헌	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	14
김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대(학사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종현	남	1975.11	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	1
김종현	남	1972.12	상무	상근	중동총괄 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	1
김종훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김종희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	NXP, Principal	포항공대(박사)	계열회사 임원	2

김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	13
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI Project Management팀장	System LSI SOC개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준성	남	1975.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	13
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SERK법인장	SEHC 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
김지영	남	1970.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	13
김지윤	여	1975.02	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	
김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당임원	서강대(박사수료)	계열회사 임원	25
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대(학사)	계열회사 임원	25
김진기	남	1972.01	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	25
김진성	남	1971.02	상무	상근	SEVT 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	48
김진주	남	1969.05	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEIB 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	37
김창용	남	1973.04	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SAIT People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	25
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철주	남	1976.07	상무	상근	SRUK연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
김태경	남	1971.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	Intel, Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	8
김태균	남	1976.02	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	25
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	32
김태영	남	1976.03	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	Kanazawa Univ.(박사)	계열회사 임원	2
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀장	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김태정	남	1972.12	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	37
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	

김태훈	남	1970.10	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	37
김한조	남	1973.09	상무	상근	의료기기 지원팀장	SEA 담당부장	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	1
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	25
김현	남	1968.07	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	SEVT 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	25
김현기	남	1973.01	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	13
김현덕	남	1981.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	Meta, Software Engineer	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	12
김현석	남	1976.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	25
김현수	남	1970.09	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SR 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현종	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	37
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀장	한국총괄 CE영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김현철	남	1969.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀 담당임원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	48
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	48
김형옥	남	1979.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
김형재	남	1970.12	상무	상근	SEM-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김형준	남	1972.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	숭실대(석사)	계열회사 임원	25
김호균	남	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	52
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김훈식	남	1981.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	2
김희승	남	1970.09	상무	상근	System LSI People팀장	DS부문 People팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	48
김희열	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	2
나원만	남	1975.06	상무	상근	SEM-P 담당임원	SEM-P 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	1

나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	48
남경인	남	1973.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
남덕우	남	1974.11	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당부장	동국대(학사)	계열회사 임원	2
남정만	남	1967.06	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
남태호	남	1969.03	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	한국토지주택공사, 부장	경북대(박사수료)	계열회사 임원	6
노경래	남	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	28
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	48
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	37
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	37
노태현	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
다니엘아라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	13
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	37
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	37
류일곤	남	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류효겸	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	38
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	48
명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	48
명승일	남	1976.11	상무	상근	지원팀 담당임원	북미총괄 지원팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	1
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	48
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문석진	남	1974.06	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	계명대(학사)	계열회사 임원	2
문준기	남	1975.02	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	1

문진옥	남	1971.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	48
문태호	남	1974.11	상무	상근	AVP사업팀 품질팀장	AVP사업팀 품질팀 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	2
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원, 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	25
민재호	남	1976.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
민현진	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	37
박두건	남	1981.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	14
박래순	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	삼성전기, 인사지원그룹장	Peking Univ.(석사)	계열회사 임원	17
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	37
박민철	남	1972.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	13
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
박봉태	남	1974.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	48
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상도	남	1973.12	상무	상근	People팀 담당임원	북미총괄 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	48
박상영	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	Samsung Research People팀 담당부장	아주대(석사)	계열회사 임원	1
박상욱	남	1978.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	25
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
박성우	남	1976.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	중앙일보, 법조팀장	Univ. Of Chicago(석사)	계열회사 임원	1
박성철	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	13
박영민	남	1975.12	상무	상근	SCIC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	1

박은중	남	1976.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	1
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	37
박재범	남	1977.08	상무	상근	메모리 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
박재성	남	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	13
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	37
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
박정미	여	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	남	1974.01	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	48
박정호	남	1974.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	48
박제영	남	1969.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당부장	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	25
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	25
박종욱	남	1968.11	상무	상근	Global CS센터 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박준수	남	1967.08	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	16
박준영	남	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	SEBN법인장	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	37
박준호	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진표	남	1972.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬형	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	13
박창서	남	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	34
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
박철민	남	1971.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	47
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	

박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	25
박충신	남	1973.09	상무	상근	People팀 담당임원	의료기기 People팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	37
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	25
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	48
박현준	남	1978.01	상무	상근	구주총괄 People팀장	사업지원T/F 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	13
박형민	남	1977.03	상무	상근	SEA 담당임원	SEAD법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	37
박형신	여	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	1
박호우	남	1971.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
박환홍	남	1973.10	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	1
박훈철	남	1974.05	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	25
박희걸	남	1972.08	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	35
반수형	남	1972.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	13
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	48
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	
배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
배상기	남	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	48
배승준	남	1976.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
배윤수	남	1974.12	상무	상근	재경팀 담당임원	기획팀 담당부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	1
배학범	남	1963.08	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	SESK법인장	경희대(학사)	계열회사 임원	
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	37
백기열	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS, 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	13
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대가전연구팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	25
백일섭	남	1968.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	

백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	48
백혜성	여	1980.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	1
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	생활가전 디자인팀장	제주대(학사)	계열회사 임원	
서경헌	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	25
서상원	남	1979.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Apple, Engineer/Manager	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	14
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	48
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global CS센터 담당임원	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	25
서정현	남	1974.04	상무	상근	SCS 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	48
서창우	남	1974.06	상무	상근	SEF 담당임원	SEBN 담당부장	Manchester(석사)	계열회사 임원	13
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	22
서현석	남	1974.06	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	1
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	26
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
선종우	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	2
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 수석	한양공고(고교)	계열회사 임원	25
소재민	남	1983.04	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	전남대(석사)	계열회사 임원	37
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	25

손영아	여	1973.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SELA 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	13
손영웅	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	48
손왕익	남	1984.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
손용우	남	1968.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
손준호	남	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	13
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
손현석	남	1976.03	상무	상근	SEH-P법인장	SEH-P 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	13
손호민	남	1969.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	48
손호성	남	1968.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	37
송명숙	여	1972.11	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송문경	여	1977.08	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당부장	한동대(학사)	계열회사 임원	1
송방영	남	1974.10	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
송보영	여	1976.10	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	13
송상철	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	34
송영근	남	1970.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터 담당임원	Intel, Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	12
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	13
송윤종	남	1971.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
송정우	남	1977.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	13
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	48

쉐인헉비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	37
신대중	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEDA-P(C)공장장	경북대(학사)	계열회사 임원	48
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국해양대(학사)	계열회사 임원	13
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	37
신병무	남	1970.08	상무	상근	SEEG-S법인장	SEGR법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	1
신상용	남	1973.05	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	13
신승주	남	1972.04	상무	상근	SEASA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	48
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	25
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	13
신의장	남	1971.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	10
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	37
신현석	남	1969.05	상무	상근	신사업T/F 담당임원	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
심승환	남	1974.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Apple, Sr. Development Manager	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	7
심우철	남	1982.06	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Dupont Korea, 상무	서강대(학사)	계열회사 임원	15
심호준	남	1977.12	상무	상근	DS부문 상품기획실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	25
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	37
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	37
안성준	남	1975.01	상무	상근	System LSI S/W Engineering팀장	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
안승환	남	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
안신헌	남	1972.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	25
안영모	남	1973.10	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	1

안용석	남	1974.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 DRAM TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	13
안재용	남	1977.02	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	감사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
안주원	여	1977.03	상무	상근	생활가전 기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	13
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	AWS, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	27
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	13
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	13
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	37
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양종훈	남	1974.05	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	13
양준철	남	1972.06	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	48
양진기	남	1971.05	상무	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	48
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	25
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	37
염부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
염종범	남	1977.06	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	13
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	25
오상진	남	1977.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	25
오석민	여	1974.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	디자인경영센터 담당임원	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	48
오승훈	남	1968.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	충남대(학사)	계열회사 임원	13
오용찬	남	1972.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	13

오정환	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	13
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	37
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	48
오형석	남	1970.09	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	25
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	13
우준명	남	1980.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	2
우현수	남	1973.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 수석	연세대(학사)	계열회사 임원	2
우형동	남	1970.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원석준	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	25
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	28
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	37
유성종	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
유성호	남	1973.02	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임원	System LSI 지원팀 담당부장	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	25
유송	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	25
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	48
유한종	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	SEF 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	37
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	48
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	19
윤기영	남	1974.11	상무	상근	SEBN법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	1
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	계열회사 임원	25

윤상용	남	1976.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	2
윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	35
윤석호	남	1972.07	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤석호	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	한국기계연구원, 열에너지솔루션실장	서울대(박사)	계열회사 임원	12
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	구주총괄 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	25
윤성현	남	1973.05	상무	상근	SIEL-P(C)공장장	SEMA법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	1
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사 임원	12
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	13
윤송호	남	1974.10	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	25
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	51
윤여완	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	37
윤우근	남	1972.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	35
윤원주	남	1978.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	2
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SELV법인장	SERC 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	48
은성민	남	1977.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	13
이강규	남	1972.09	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI Global운영팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	48
이강호	남	1977.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Global Foundries, Principal Member of Technical Staff	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	1
이경준	남	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	25
이계복	남	1969.06	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	SEM-P법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	48

이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	25
이관수	남	1969.11	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	25
이광재	남	1974.03	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	1
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대(학사)	계열회사 임원	48
이규영	남	1968.10	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	48
이규철	남	1973.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생산기술연구소 수석	서울산업대(학사)	계열회사 임원	1
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	48
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	36
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	37
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	37
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	49
이동헌	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	고려대(학사)	계열회사 임원	
이두희	남	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	13
이명재	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	HEC Paris(석사)	계열회사 임원	1
이명준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 수석	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	2
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이범섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	25
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	13
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	37

이병철	남	1972.11	상무	상근	의료기기 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	13
이병헌	남	1974.11	상무	상근	기획팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	25
이병현	남	1977.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	37
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	13
이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	54
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상육	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상호	남	1973.01	상무	상근	SAMCOL법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	13
이상희	남	1974.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	25
이선웅	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEH-S법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	1
이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
이성원	남	1978.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	16
이성원	남	1976.03	상무	상근	Samsung Research SoC Architecture팀장	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	27
이성준	남	1981.10	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	AMD, Director	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	3
이성훈	남	1975.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 Flash TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	13
이수용	남	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당 Master	한양대(석사)	계열회사 임원	17
이승관	남	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대(학사)	계열회사 임원	47

이승목	남	1973.09	상무	상근	SAIT People팀장	System LSI People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
이승민	남	1981.03	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Meta, Principal Designer	MIT(석사)	계열회사 임원	3
이승준	남	1974.04	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	13
이승철	남	1977.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	6
이승철	남	1975.12	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	37
이승환	남	1971.05	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	25
이승환	남	1980.07	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
이승훈	남	1976.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이애영	여	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
이영아	여	1983.03	상무	상근	생활가전 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Carnegie Mellon Univ.(학사)	계열회사 임원	1
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영학	남	1974.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	혁신센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	13
이우용	남	1975.10	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	13
이원용	남	1978.11	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	13
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	37
이윤성	남	1971.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	37
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	37
이의형	남	1975.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	48
이재호	남	1974.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	서강대(석사)	계열회사 임원	1
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	25
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	

이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	52
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	37
이정자	여	1969.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정주	남	1976.07	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	P&G, Sr. Director	고려대(학사)	계열회사 임원	6
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 People팀장	한국총괄 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	25
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	48
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	14
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	48
이종필	남	1973.11	상무	상근	Systsem LSI SOC사업팀 AP개발실 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	충남대(석사)	계열회사 임원	48
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	48
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	37
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	26
이중원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
이지석	남	1978.04	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	LAM Research, Director	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	5
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	25
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	48
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	37
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 DS대외협력팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	25
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	48

이창엽	남	1970.04	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이창원	남	1972.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	25
이치훈	남	1969.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이태호	남	1974.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	원광대(석사)	계열회사 임원	1
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	22
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이혁	남	1973.02	상무	상근	기획팀 담당임원	Bloom T/F 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	7
이현동	남	1972.02	상무	상근	SESAR법인장	SELV법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	25
이현수	남	1980.12	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	37
이현정	여	1977.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이현정	여	1971.11	상무	상근	SCIC 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	25
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이홍빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	명지대(학사)	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	24
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌EHS/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
임백준	남	1968.07	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
임산	남	1973.03	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
임성수	남	1978.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
임순규	남	1979.07	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 대형 지원팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	13
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	37
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	

임윤모	남	1977.10	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	1
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	37
임전식	남	1969.08	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	42
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
장경모	남	1977.10	상무	상근	SEG 담당임원	구주총괄 지원팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	1
장경훈	남	1970.02	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 품질실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	48
장소연	여	1971.06	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	37
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 DR사업팀장	의료기기 Global CS팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	37
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ법인장	SEJ 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	13
장윤희	남	1974.09	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience Global제조센터 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	13
장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(석사)	계열회사 임원	13
장준희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEASA법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	37
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	41
장흥민	남	1972.06	상무	상근	Global CS센터 담당임원	동남아총괄 CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
저메인클라우제	남	1982.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	13
전대호	남	1971.01	상무	상근	제조&기술담당 People팀장	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	37
전범준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 지원팀 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	13
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	

전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	25
전소영	여	1974.05	상무	상근	IR팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	37
전승수	남	1976.07	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	생활가전 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	37
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 수석	Univ. Of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	13
전진규	남	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SENA 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	37
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
전형민	남	1974.03	상무	상근	SEAU 담당임원	SENZ법인장	중앙대(학사)	계열회사 임원	1
전형준	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	16
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	25
정광민	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEPR법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	25
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산, 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	25
정광희	남	1971.08	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	25
정다운	남	1980.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	48
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	숭실대(학사)	계열회사 임원	27
정상일	남	1967.09	상무	상근	제조&기술담당 Sensor제조기술팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정석희	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	1
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
정성원	남	1971.12	상무	상근	SEWA법인장	SCA법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	25
정성훈	남	1976.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	2
정세환	남	1973.10	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한국해양대(학사)	계열회사 임원	1
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	

정승일	남	1973.08	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	13
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	25
정연일	남	1975.06	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	13
정영환	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	복단대(석사)	계열회사 임원	13
정용덕	남	1976.09	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
정원석	남	1971.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	48
정원철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
정유진	여	1970.06	상무	상근	SENA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	48
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	48
정인호	남	1975.02	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	48
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	25
정일규	남	1968.05	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	25
정재용	남	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	37
정준수	남	1970.09	상무	상근	SEEG-P법인장	SERK법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	25
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
정직한	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Mythical Games, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	3
정진희	여	1977.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	1
정춘화	남	1974.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 수석	고려대(학사)	계열회사 임원	2
정한기	남	1976.05	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	13
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	25

정홍욱	남	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Hitotsubashi Univ.(석사)	계열회사 임원	1
제이콥	남	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	48
제임스휘슬러	남	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melville High School(고교)	계열회사 임원	25
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI CP개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
조강욱	남	1977.08	상무	상근	북미총괄 지원팀장	동남아총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	13
조근수	남	1976.06	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	1
조근휘	남	1974.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	2
조나단림	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Microsoft, Sales Director	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	4
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	12
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조성제	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 담당부장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	13
조성훈	남	1976.01	상무	상근	People팀 담당임원	생활가전 People팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	48
조성희	남	1974.08	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	13
조영석	남	1976.11	상무	상근	전장사업팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	13
조영진	남	1979.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
조용호	남	1970.03	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조욱래	남	1972.03	상무	상근	제조&기술담당 지원팀장	DS부문 재경팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	37
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마컴팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	37
조은경	여	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	삼성카드, 신용관리담당	성균관대(석사)	계열회사 임원	1
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스, 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	25
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	48

조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	13
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	37
조철호	남	1971.07	상무	상근	SETK법인장	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	13
조호근	남	1977.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	13
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsing Research Global AI센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	23
조희권	남	1976.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	SEA 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire(학사)	계열회사 임원	
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현태	남	1972.12	상무	상근	TSE-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	울산대(학사)	계열회사 임원	25
주형빈	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략	SESAR법인장	경희대(학사)	계열회사 임원	37
지송하	여	1973.01	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	Mobile eXperience사업부 개발실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	13
차도헌	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	48
차이위엔천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	TEXAS INSTRUMENTS, Selection Manager	NTUST(석사)	계열회사 임원	15
찰리장	남	1973.10	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	SRA SVP	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	1
채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	8
천기철	남	1970.09	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	37
천상필	남	1969.05	상무	상근	Global Public Affairs실 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	48
천홍문	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	1
최경수	남	1971.12	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	37
최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
최명진	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	1

최민기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당부장	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	1
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
최병희	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SETK법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	37
최삼종	남	1973.03	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	37
최상선	남	1975.03	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	25
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	25
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
최연호	남	1975.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	1
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	37
최영준	남	1967.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LG전자, 자문역	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	41
최원경	여	1973.08	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	48
최원서	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	1
최유라	여	1978.12	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	삼성전기 혁신센터장	IMD(석사)	계열회사 임원	1
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	25
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	13
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	충남대(학사)	계열회사 임원	13
최재혁	남	1974.06	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	37
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	13

최종근	남	1978.01	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	2
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	37
최종민	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
최진필	남	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	48
최창훈	남	1972.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SIEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	25
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	남	1974.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	13
최청호	남	1976.11	상무	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	12
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
최현호	남	1979.06	상무	상근	SAIT Material Research Center 담당임원	종합기술원 Material연구센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	37
최호규	남	1968.12	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
최효석	남	1981.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	2
추민기	남	1975.10	상무	상근	SECE법인장	SEUZ법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	13
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	25
카리야타 카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	東北大(박사)	계열회사 임원	14
코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
하현재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 담당부장	광운대(학사)	계열회사 임원	13
한규희	남	1974.01	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	13
한상섭	남	1972.04	상무	상근	북미총괄 CS팀장	Global CS센터 담당임원	광운대(석사)	계열회사 임원	25
한상연	남	1969.01	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	13

한석근	남	1978.09	상무	상근	SESK법인장	SERK법인장	경기대(학사)	계열회사 임원	1
한의택	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	48
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한종호	남	1976.01	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	37
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	48
한진우	남	1980.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	NASA, Senior Scientist	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	20
함선규	남	1970.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	13
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	14
허정철	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	1
허준	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	13
허준영	남	1977.02	상무	상근	네트워크 People팀장	구주총괄 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	25
허준회	남	1979.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	30
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허진욱	남	1971.09	상무	상근	Global CS센터	북미총괄 CS팀장	한양대(박사)	계열회사 임원	37
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	SECA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	37
헨릭얀손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 담당임원	Ericsson, VP	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	12
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
현재웅	남	1975.09	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	Fusion-io, Fellow	RPI(석사)	계열회사 임원	5
현정혁	남	1977.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	13
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	

홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	25
홍연석	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEIN-P법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	25
홍영주	남	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	25
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	
홍정호	남	1969.02	상무	상근	SEF 담당임원	의료기기 지원팀장	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	
홍준식	남	1971.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	37
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	48
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	48
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	기획팀 담당임원	창의개발센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	남	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	
황영삼	남	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	13
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	48
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	13
황호송	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	37

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식)97,839,319주(이재용 회장 97,414,196주 등), 우선주(의결권 없는 주식)173,942주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

바.미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분 (사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	김유승	남	1978.02	상무	네트워크 개발팀 담당임원	계열회사 임원
	김정수	남	1983.09	상무	영상디스플레이 개발팀 담당임원	계열회사 임원
	송택상	남	1978.03	상무	메모리 DRAM개발실 담당임원	계열회사 임원
	전희정	여	1977.09	상무	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	계열회사 임원
	정주영	남	1977.07	상무	경영혁신센터 담당임원	계열회사 임원
	최원호	남	1981.02	상무	메모리 DRAM개발실 담당임원	계열회사 임원
임원사임	승현준	남	1966.06	사장	Samsung Research 글로벌R&D협력담당	계열회사 임원
	이원진	남	1967.08	사장	Mobile eXperience 서비스Biz팀 담당임원	계열회사 임원
	권오상	남	1967.04	부사장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	계열회사 임원
	권환준	남	1971.09	부사장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	계열회사 임원
	김찬우	남	1976.04	부사장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	계열회사 임원
	임근휘	남	1973.05	부사장	Big Data센터 담당임원	계열회사 임원
	정서형	남	1967.05	부사장	네트워크 개발팀 담당임원	계열회사 임원
	최강석	남	1965.12	부사장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	계열회사 임원
	한지니	여	1969.04	부사장	Mobile eXperience Digital Wallet팀 담당임원	계열회사 임원
	박종욱	남	1968.11	상무	Global CS센터 담당임원	계열회사 임원
	박희걸	남	1972.08	상무	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	계열회사 임원
	배학범	남	1963.08	상무	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	계열회사 임원
	백일섭	남	1968.08	상무	Global CS센터 담당임원	계열회사 임원
	이계복	남	1969.06	상무	생활가전 Global제조팀 담당임원	계열회사 임원
	임백준	남	1968.07	상무	Samsung Research 담당임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

사. 직원 등의 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
DX	남	37,962	-	324	-	38,286	16.5	-	-	30,499	13,403	43,902	-
DX	여	12,202	220	97	-	12,299	13.3	-	-				-
DS	남	53,372	-	148	-	53,520	10.8	-	-				-
DS	여	20,671	180	28	-	20,699	11.1	-	-				-
성별합계	남	91,334	-	472	-	91,806	13.2	11,530,492	128				-
성별합계	여	32,873	400	125	-	32,998	11.9	2,947,780	97				-
합 계		124,207	400	597	-	124,804	12.8	14,478,272	120				-

※ 본사 기준이며, 휴직자는 포함하고 등기임원 11명(사내이사 5명, 사외이사 6명)은 제외한 기준입니다.

※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 120,509명(남: 90,109명, 여: 30,400명) 기준으로 산출하였습니다.

아. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	1,015	705,410	726	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 하였으며, '미등기임원 현황'의 임원 중 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 인원은 제외하였습니다.

※ 연간급여 총액과 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의

근로소득 기준입니다.

※ 연간급여 총액은 성과급 지급 실적을 포함하고 있으며, 성과급 지급 시점은 매년 상이합니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 970명을 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사・감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	48,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.
※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2023년 3월 15일 주주총회 결의를 통해 승인받은
이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.

(2) 보수지급금액

(2-1) 이사・감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
11	23,227	2,112	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임한
등기이사・사외이사・감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	22,009	4,402	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	620	207	-
감사위원회 위원	3	598	199	-
감사	-	-	-	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(3) 보수지급기준

당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	보수지급기준
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	・급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정 ・설・추석상여: 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브: ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ・복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	・급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정 ・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
감사위원회 위원	・급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정 ・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

<보수지급금액 5억원 이상인 이사・감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
한종희	대표이사	6,904	-
경계현	대표이사	2,403	-
노태문	이사	6,193	-
박학규	이사	3,792	-
이정배	이사	2,717	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임
또는 퇴임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원 기준입니다.
※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여
산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 한종희	근로소득	급 여	1,467	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 101백만원, 3월 181백만원, 4월부터 12월까지 매월 121백만원을 지급
		상 여	5,306	・설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 B2B 사업 강화 및 제품간 시너지 확대로 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	130	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 경계현	근로 소득	급 여	1,205	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 83백만원, 3월 149백만원, 4월부터12월까지 매월 99백만원을 지급
		상 여	1,109	· 설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 · 목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ※2023년 지급률 0% · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 DS부문 매출액 66.6조원, 영업손실 14.9조원을 기록한 점과, 비계량 지표 관련하여 메모리-Logic-PKG 연계 신사업 발굴, 해외현지 고객 대응 역량 강화 등을 통해 반도체 사업 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	89	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이사 노태문	근로 소득	급 여	1,254	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 94백만원, 3월 132백만원, 4월부터12월까지 매월 104백만원을 지급
		상 여	4,824	· 설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 · 목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 MX사업 매출액 108.6조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 모바일 기술 혁신과 효과적인 마케팅을 통해 양호한 실적을 견인했고, 선제적인 미래시장 대응으로 성장 기반을 마련한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	116	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-

	기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이사 박학규	근로 소득	급 여	1,025	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 74백만원, 3월 118백만원, 4월부터12월까지 매월 85백만원을 지급
		상 여	2,662	· 설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 · 목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 저성장 시대에 효율적 자원 운영을 통해 견조한 실적 달성을 지원했고, 신기술과 신사업 등 신성장 동력 발굴에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	104	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이사 이정배	근로 소득	급 여	1,006	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 69백만원, 3월 124백만원, 4월부터12월까지 매월 83백만원을 지급
		상 여	1,591	· 설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 · 목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ※2023년 지급률 0% · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 메모리사업 매출액 44.1조원을 기록한 점과, 비계량 지표 관련하여 메모리 제품 라인업 확대 및 신규 고객 확보 등을 통해 사업 확대 및 경쟁력 제고의 기반을 마련한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	121	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-

	기타소득	-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
김기남	고문	17,265	-
이원진	상담역	8,600	-
진교영	고문	8,485	-
한종희	대표이사	6,904	-
노태문	이사	6,193	-

※ 보수총액은「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김기남	근로소득	급 여	1,680	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 11월까지 매월 144백만원, 12월 101백만원을 지급
		상 여	2,445	・설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ※2023년 지급률 0% ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 DS부문 매출액 66.6조원, 영업손실 14.9조원을 기록한 점과, 비계량 지표 관련하여 국내외 R&D 교류, 미래기술 센싱을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	149	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		12,990	・임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 144백만원, 임원 근무기간 25년에

			지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이원진	근로 소득	급 여	2,143	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 평균 179백만원을 지급
		상 여	3,912	・설/추석상여 : 평균 164백만원을 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 2회 분할지급 ・성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(게임/미디어/광고 서비스 강화, 서비스 파트너십 강화 등) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 VD사업 매출액 30.4조원을 달성한 점과 MX사업의 관련 업무 매출액, 담당 서비스사업 성장률을 고려하였고, 비계량 지표 관련하여 기존 제품 중심의 사업 구조에서 벗어나 서비스 사업의 지속가능한 성장 기반을 마련한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	115	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		2,431	・임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 208백만원, 임원 근무기간 10년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
진교영	근로 소득	급 여	1,010	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월 89백만원, 2월부터 11월까지 85백만원, 12월 68백만원을 지급
		상 여	2,116	・설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ※2023년 지급률 0% ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 DS부문 매출액 66.6조원, 영업손실 14.9조원을 기록한 점과, 비계량 지표 관련하여 사업에 필요한 미래기술 발굴, 중장기 R&D 전략

				제시, 신기술 확보 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	101	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		5,259	・임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 83백만원, 임원 근무기간 19년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
한종희	근로소득	급 여	1,467	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 101백만원, 3월 181백만원, 4월부터 12월까지 매월 121백만원을 지급
		상 여	5,306	・설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 B2B 사업 강화 및 제품간 시너지 확대로 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	130	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
노태문	근로소득	급 여	1,254	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 94백만원, 3월 132백만원, 4월부터 12월까지 매월 104백만원을 지급
		상 여	4,824	・설/추석 상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급

				※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2023년 MX사업 매출액 108.6조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 모바일 기술 혁신과 효과적인 마케팅을 통해 양호한 실적을 견인했고, 선제적인 미래시장 대응으로 성장 기반을 마련한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	116	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

2023년말 현재 이사・감사・업무집행지시자 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비 고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
업무집행지시자	1,158	-	-
계	1,169	-	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단에 소속된 회사(요약)

당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서, 2023년말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 1개 회사(㈜미래로시스템)가 증가하고 1개 회사(성균관대학교기술지주㈜)가 감소하여 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
삼성	17	46	63

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간 출자현황

[국내]

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	삼성물산㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성생명보험㈜	삼성에스디아이㈜	삼성에스디에스㈜	삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜	삼성엔지니어링㈜	삼성전기㈜	삼성전자㈜	삼성중공업㈜	삼성증권㈜	삼성카드㈜	삼성화재해상보험㈜
삼성물산㈜		43.1	19.3		17.1		7.0		5.0	0.1			
삼성바이오로직스㈜													
삼성생명보험㈜	0.1	0.1		0.1	0.1	19.5	0.1	0.2	8.6	3.1	29.4	71.9	15.0
삼성에스디아이㈜							11.7			0.4			
삼성에스디에스㈜													
삼성전기㈜										2.1			
삼성전자㈜		31.2		19.6	22.6			23.7		15.2			
삼성중공업㈜													
삼성증권㈜						1.8							
삼성카드㈜													
삼성화재해상보험㈜						18.7	0.2		1.5				
㈜에스원						0.8							
㈜제일기획										0.1			
㈜호텔신라													
삼성디스플레이㈜													
삼성자산운용㈜													
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치													
Harman International Industries, Inc.													
계	0.1	74.3	19.3	19.7	39.7	40.8	19.0	23.9	15.1	20.9	29.4	71.9	15.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	㈜멀티캠퍼스	㈜에스원	㈜제일기획	㈜호텔신라	삼성디스플레이㈜	삼성메디슨㈜	삼성바이오에피스㈜	삼성벤처투자㈜	삼성생명서비스손해사정㈜	삼성선물㈜	삼성액티브자산운용㈜	삼성에스알에이자산운용㈜	삼성웰스토리㈜
삼성물산㈜								16.7					100.0
삼성바이오로직스㈜							100.0						
삼성생명보험㈜	0.0	5.4	0.4	7.5					99.8			100.0	
삼성에스디아이㈜		11.0		0.1	15.2			16.3					
삼성에스디에스㈜	47.2												
삼성전기㈜								17.0					
삼성전자㈜			25.2	5.1	84.8	68.5		16.3					
삼성중공업㈜								17.0					
삼성증권㈜		1.3		3.1				16.7		100.0			
삼성카드㈜		1.9	3.0	1.3									
삼성화재해상보험㈜		1.0											
㈜에스원													
㈜제일기획													
㈜호텔신라													
삼성디스플레이㈜													
삼성자산운용㈜											100.0		
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치	15.2												
Harman International Industries, Inc.													
계	62.4	20.7	28.7	17.0	100.0	68.5	100.0	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	삼성자산운용㈜	삼성전자로지텍㈜	삼성전자서비스㈜	삼성전자서비스씨에스㈜	삼성전자판매㈜	삼성카드고객서비스㈜	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	삼성헤지자산운용㈜	삼성화재서비스손해사정㈜	삼성화재애니카손해사정㈜	세메스㈜	수원삼성축구단㈜
삼성물산㈜												
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜	100.0											
삼성에스디아이㈜												
삼성에스디에스㈜												
삼성전기㈜												
삼성전자㈜		100.0	99.3		100.0						91.5	
삼성중공업㈜												
삼성증권㈜												
삼성카드㈜						100.0						
삼성화재해상보험㈜									100.0	100.0		
㈜에스원												
㈜제일기획												100.0
㈜호텔신라												
삼성디스플레이㈜							50.0					
삼성자산운용㈜								100.0				
삼성전자서비스㈜				100.0								
㈜미라콤아이앤씨												
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.												
계	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	91.5	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	스테코㈜	신라에이치엠㈜	에스디플렉스㈜	에스비티엠㈜	에스원씨알엠㈜	에스유머티리얼스㈜	에스코어㈜	에스티엠㈜	에이치디씨신라면세점㈜	오픈핸즈㈜	제일패션리테일㈜	㈜미라콤아이앤씨	㈜삼성글로벌리서치
삼성물산㈜											100.0		1.0
삼성바이오로직스㈜													
삼성생명보험㈜													14.8
삼성에스디아이㈜			50.0					100.0					29.6
삼성에스디에스㈜							81.8			100.0		83.6	
삼성전기㈜													23.8
삼성전자㈜	70.0												29.8
삼성중공업㈜													1.0
삼성증권㈜													
삼성카드㈜													
삼성화재해상보험㈜													
㈜에스원					100.0		0.6					0.6	
㈜제일기획							5.2					5.4	
㈜호텔신라		100.0		100.0					50.0				
삼성디스플레이㈜						50.0							
삼성자산운용㈜													
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨							0.5						
㈜삼성글로벌리서치													
Harman International Industries, Inc.													
계	70.0	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	88.1	100.0	50.0	100.0	100.0	89.6	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	㈜삼성라이온즈	㈜삼성생명금융서비스	㈜삼성화재금융서비스보험대리점	㈜삼우종합건축사사무소	㈜서울레이크사이드	㈜시큐아이	㈜씨브이네트	㈜에스에이치피코퍼레이션	㈜하만인터내셔널코리아	㈜휴먼티에스에스	㈜희망별숲	㈜미래로시스템
삼성물산㈜				100.0	100.0	8.7	40.1					
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜		100.0										
삼성에스디아이㈜												
삼성에스디에스㈜						56.5	9.4					
삼성전기㈜												
삼성전자㈜											100.0	
삼성중공업㈜												
삼성증권㈜												
삼성카드㈜												
삼성화재해상보험㈜			100.0									
㈜에스원										100.0		
㈜제일기획	67.5											
㈜호텔신라								100.0				
삼성디스플레이㈜												
삼성자산운용㈜												
삼성전자서비스㈜												
㈜미라콤아이앤씨												
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.									100.0			
계	67.5	100.0	100.0	100.0	100.0	65.2	49.5	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

[해외]

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %)

출자회사	피출자회사	지분율(%)
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO AUSTIN INC	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO (KL) SDN. BHD.	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Equipment Trading Solutions Group, LLC	70.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Belle River Wind LP	42.5
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	North Kent Wind 1 LP	35.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	South Kent Wind LP Inc.	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	Monument Power, LLC	100.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 2 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 3, LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung Solar Energy 2 LLC	5S ENERGY HOLDINGS, LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, S.R.O	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	99.9
Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	70.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	0.2
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0

S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	100.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Vista NEXT Limited	51.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	WELVISTA COMPANY LIMITED	30.0
CHEIL HOLDING INC.	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	75.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	6.8
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
삼성전자(주)	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자(주)	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Asia Pte. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0

삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성바이오로직스(주)	Samsung Biologics America, Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis United States Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis NL B.V.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Biopeis TW Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis HK Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이(주)	Samsung Display America Holdings, Inc	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Noida Private Limited	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novaled GmbH	9.9
세메스(주)	SEMES America, Inc.	100.0
세메스(주)	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	TeleWorld Solutions, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0

Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Federal, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Samsung Display America Holdings, Inc	eMagin Corporation	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Financial Group LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Roon Labs, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services AB.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Harman Financial Group LLC	Harman International (India) Private Limited	0.0
Harman Financial Group LLC	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.1
Harman Financial Group LLC	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa Ltd.	100.0

Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkiye	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Ukraine	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Corephotonics Ltd.	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Apostera UA, LLC	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Deutschland GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. KG	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services GmbH	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0

Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Harman France SNC	0.0
Harman Connected Services AB.	Harman Finland Oy	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	FOODIENT LTD.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novaled GmbH	40.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	100.0

Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	42.0
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	43.1
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	98.4
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronics Panama. S.A.	100.0
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	0.0
삼성에스디아이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Hungary., Zrt.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI India Private Limited	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	65.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	80.0

삼성에스디아이(주)	STARPLUS ENERGY LLC.	51.0
삼성에스디아이(주)	Novaled GmbH	50.1
삼성에스디아이(주)	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0
삼성에스디아이(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI India Private Limited	0.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics GmbH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	99.9
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	0.0
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	0.1
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	100.0
삼성화재해상보험(주)	PT. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	75.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험 (중국) 유한공사	37.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Rus LLC	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험(주)	Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	48.9
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0

삼성자산운용(주)	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산(주)	QSSC, S.A. de C.V.	80.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Lima S.A.C.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산(주)	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산(주)	POSS-SLPC, S.R.O	50.0
삼성물산(주)	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산(주)	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Poland LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산(주)	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산(주)	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	93.0
삼성물산(주)	Samsung C&T India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산(주)	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	100.0
삼성물산(주)	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	70.0
삼성물산(주)	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	25.0
삼성물산(주)	CHEIL HOLDING INC.	40.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	30.0

삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	10.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	81.6
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	82.4
WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	WELVISTA COMPANY LIMITED	70.0
Pengtai Greater China Company Limited	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	100.0
Pengtai Greater China Company Limited	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	Beijing Pengtai Borui E-commerce Co.,Ltd.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Medialytics Inc.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	100.0

삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	50.0
삼성에스디에스(주)	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda.	99.7
삼성에스디에스(주)	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda.	0.3
Samsung SDS Europe, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	0.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Project Management Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Hungary Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Italy S.R.L.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Limited	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Global Private Limited	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	99.8
삼성엔지니어링(주)	Muharraq STP Company B.S.C.	6.6
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	65.0

삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.A	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering India Private Limited	Samsung Engineering Global Private Limited	0.0
Samsung Engineering India Private Limited	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	89.9
Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	49.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Pengtai Greater China Company Limited	98.8
(주)제일기획	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	Iris Worldwide Holdings Limited	100.0
(주)제일기획	CHEIL EUROPE LIMITED	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	CHEIL SPAIN S.L	100.0
(주)제일기획	Cheil Benelux B.V.	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Private Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
(주)제일기획	Cheil New Zealand Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Australia Pty Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL CHINA	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
(주)제일기획	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa (Pty) Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0

(주)제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	100.0
(주)제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Egypt LLC	99.9
(주)제일기획	Cheil Maghreb LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	100.0
(주)제일기획	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	98.0
(주)제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
(주)제일기획	Cheil Peru S.A.C.	100.0
(주)제일기획	CHEIL ARGENTINA S.A.	98.0
(주)제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
(주)호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
에스비티엠(주)	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
삼성벤처투자(주)	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris (USA) Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	89 Degrees, Inc.	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Private Limited	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	2.0
Iris Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	WDMP Limited	49.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0

Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte. ltd.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Sydney PTY Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Beattie McGuinness Bungay Limited	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Germany GmbH	Centrade Integrated SRL	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil HU Kft.	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	100.0
Cheil India Private Limited	Experience Commerce Software Private Limited	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	100.0
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Retail Limited	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	BNY Trading Hong Kong Limited	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ-LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil MEA FZ-LLC	Cheil Egypt LLC	0.1
Cheil South Africa (Pty) Ltd	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa (Pty) Ltd	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ-LLC	ONE RETAIL EXPERIENCE KOREA LIMITED	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX India Private Limited	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	100.0
ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	One RX India Private Limited	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	CHEIL ARGENTINA S.A.	2.0

다. 관련법령상의 규제내용 등

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등
① 지정시기: 2023년 5월 1일
② 규제내용 요약
・상호출자의 금지
・계열사 채무보증 금지
・금융・보험사의 계열사 의결권 제한
・대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
・비상장사 중요사항 공시
・기업집단 현황 등에 관한 공시

라.회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

겸직자		계열회사 겸직현황		
성명	직위	기업명	직위	상근 여부
김용관	부사장	삼성메디슨㈜	대표이사	상근
육근성	부사장	삼성전자판매㈜	감사	비상근
		삼성전자로지텍㈜	감사	비상근
		삼성전자서비스㈜	감사	비상근
유규태	부사장	삼성메디슨㈜	사내이사	상근
유한종	상무	㈜삼성글로벌리서치	감사	비상근
조기재	부사장	삼성디스플레이㈜	감사	비상근
오종훈	부사장	세메스㈜	감사	비상근
황희돈	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근
성덕용	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근
오재균	부사장	스테코㈜	감사	비상근
박동욱	상무	스테코㈜	기타비상무이사	비상근
이치훈	상무	㈜미래로시스템	기타비상무이사	비상근

2. 타법인 출자 현황(요약)

2023년말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 2,469억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	21	81	102	58,678,404	-35,500	535,650	59,178,554
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	5	31	36	83,453	-861	-14,204	68,388
계	26	112	138	58,761,857	-36,361	521,446	59,246,942

※ 별도 기준입니다.

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2023년말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.04.16	2024.12.16	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.03.28	2024.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023.10.01	2024.12.16	409,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.06.01	2024.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	110,000	96,000	-	8,065	8,065	5.0%
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	777,000	917,000	239,395	81,498	320,893	48.8%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	130,000	70,000	25,649	△25,649	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023.04.28	2024.12.16	832,572	835,508	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	150,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	537,000	537,000	155,768	△155,768	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	888,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	45,000	-	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	15,600	15,600	9,664	△9,664	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	300,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	-	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	-	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
합 계							8,146,572	8,129,508	430,476	△101,518	328,958	

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2023년 중 US$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2023년말 미수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2023년 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각/매입	2023.10.31	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	50,521	26,222
SDC	계열회사	자산매입	2023.11.01	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	10,406	-
SESS	계열회사	자산매각/매입	2023.12.24	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	6,285	785
SAS	계열회사	자산매각/매입	2023.12.19	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	6,267	2,014
SEHC	계열회사	자산매각	2023.11.21	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	4,102	77
TSLED	계열회사	자산매각/매입	2023.11.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	973	601
SEV	계열회사	자산매각/매입	2023.10.30	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	792	△4
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2023.12.19	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	787	148
SIEL	계열회사	자산매각	2023.08.04	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	210	38
SESK	계열회사	자산매각	2023.07.05	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	153	-

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일・30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 2023년 중 계열회사인 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SEA	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.12	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	30,103,325
SEVT	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.12	스마트폰 매출입 등	24,383,553
SSI	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.12	반도체 매출 등	22,270,145
SEV	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.12	스마트폰 매출입 등	15,686,195
SSS	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.12	반도체 매출 등	13,520,403

※ 별도 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2023년말 현재 제품경쟁력 제고, 상생경영을 위한 협력사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,353억원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	계정과목	대여금 변동 내역		
			기초	증감	기말
㈜이랜텍 등	협력업체 및 종업원	단기대여금	47,161	△1,092	46,069
대덕전자㈜등	협력업체 및 종업원	장기대여금	92,898	△3,645	89,253
합 계			140,059	△4,737	135,322

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 대여금은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜ 등)는 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.04.16	2024.12.16	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.03.28	2024.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023.10.01	2024.12.16	409,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.06.01	2024.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	110,000	96,000	-	8,065	8,065	5.0%
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	777,000	917,000	239,395	81,498	320,893	48.8%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	130,000	70,000	25,649	△25,649	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023.04.28	2024.12.16	832,572	835,508	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	150,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	537,000	537,000	155,768	△155,768	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	888,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	45,000	-	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	15,600	15,600	9,664	△9,664	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.12.16	300,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	-	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	-	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	603,960	601,149	513,366	△2,389	510,977	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	계열회사	ANZ	지급보증	시설자금	2022.11.10	2025.11.09	20,000	20,000	20,000	-	20,000	7.1%
합 계							9,110,532	9,090,657	963,842	△103,907	859,935	

※ 연결 기준입니다.SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다. 또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다.당사는 2023년 중 US$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2023년말 미수취하였습니다. 한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2023년 중 US$3,066천의 수수료를 청구하였으며, 2023년말 미수취하였습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사・사법기관의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	횡령·배임등 금액	근거 법령
2021.01.25	서울고등법원 (파기환송심)	당사 임직원	징역	-	약 8,681	「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」
2021.02.04	대법원	당사 임직원	징역	-	-	「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등
		자회사 및 임직원 (삼성전자서비스㈜)	벌금, 징역	50	-	「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등, 「조세범처벌법」 제10조
2022.07.07	광주지방법원	당사 임직원	벌금	6	-	「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률」 제33조 7호, 제34조, 제18조 1항 등
2023.02.09	광주지방법원	당사 및 당사 임직원	벌금	25		「구.산업안전보건법」 제10조 제1항, 「 산업안전보건법」 제57조 제1항 등

대법원은 '박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건'에서 당사 임원 5명(이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무)의 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(횡령) 등의 혐의와 관련하여, 2019년 8월 29일 고등법원의 원심판결 중 일부를 파기하고 서울고등법원에 환송하였습니다. 서울고등법원은 2021년 1월 18일 파기 환송심에서 이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장에 대해 징역 2년 6개월, 박상진 前사장, 황성수 前전무에 대해 징역 2년 6개월(집행유예 4년)을 선고하였으며, 위 판결은 2021년 1월 25일 확정되었습니다. 이후 법무부가 2022년 8월 15일 국가의 성장동력을 주도하는 주요 경제인을 엄선하여 특별사면을 단행하면서 이재용 부회장을 사면법에 따라 복권하였고, 당사 이사회가 2022년 10월에 미래기술투자, 글로벌 파트너쉽 강화 등을 위해 이재용 부회장에게 회장의 역할을 부여하였습니다.
한편, 당사는 재발 방지를 위하여 대외후원금 집행 관련 프로세스를 강화하고 외부 독립 조직인 삼성 준법감시위원회를 신설하였습니다.

대법원이 2021년 2월 4일 당사 및 당사 임직원의「노동조합 및 노동관계조정법」제90조, 제81조 등 위반 혐의에 관해 상고기각 판결을 내림에 따라 서울고등법원이 2020년 8월 10일 선고한 당사 A부사장(근속연수 29년) 징역 1년 4개월, B前부사장 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), C부사장(근속연수 34년) 징역 10개월(2년간 집행유예), D前부사장 징역 1년(2년간 집행유예), E전무(근속연수 32년) 징역 1년, F전무(근속연수 24년) 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), G상무(근속연수 27년) 징역 10개월(2년간 집행유예), H상무(근속연수 18년) 징역 10개월(2년 집행유예)형이 확정되었고, 당사 및 당사의 前이사회 의장(근속연수 39년) 등은 무죄로 확정되었습니다. 또한 위 사건에서 자회사 삼성전자서비스㈜ 및 임직원의「노동조합 및 노동관계조정법」제90조, 제81조 등 위반과 허위 세금 계산서 수수에 대한「조세범처벌법」제10조 위반(위반금액 약 1,678백만원) 혐의에 대해 삼성전자서비스㈜ 벌금 50백만원(추징세액 약 97백만원), 삼성전자서비스㈜ 前대표이사(근속연수 4년) 징역 1년 4개월, I전무(근속연수 11년) 징역 1년, J상무(근속연수 21년) 징역 10개월(2년간 집행유예)의 형이 확정되었습니다. 당사는 행동규범 등에 노동3권 보장을 명시하고 부당노동행위 예방
관련 전 임직원 교육을 실시하는 등 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다.

광주지방법원 순천지원은 2021년 1월 20일「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제18조 등 위반으로 당사 직원 A프로(근속연수 11년), B프로(근속연수 8년)에게 각 벌금(3백만원)을 선고하였고, 광주지방법원은 2022년 7월 7일 이 사건 항소심에서 항소 기각 판결을 선고하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

광주지방법원은 2023년 2월 9일「구.산업안전보건법」제10조 제1항,「산업안전보건법」제57조 제1항 등 위반으로 당사 및 당사 직원 5명에 대해 약식명령을 발령하였습니다. 당사 및 당사 직원 5명은 이에 대해 정식재판을 청구하지 않아 해당 약식명령은 확정되었고(당사 벌금 15백만원, 당사 직원 벌금 각 2백만원), 당사는 벌금 납부를 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

나. 행정기관의 제재현황

(1) 공정거래위원회의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2021.06.22	공정거래위원회	당사 및 당사 임직원	검찰고발	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.08.27	공정거래위원회	당사	시정조치 과징금	101,217	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
		자회사 (삼성디스플레이㈜)	시정조치 과징금	22,857	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.11.17	공정거래위원회	자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜)	과태료	2.4	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시)
2022.03.17	공정거래위원회	당사 임직원	경고	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항
2022.06.27	공정거래위원회	당사	과태료	10	「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항

공정거래위원회는 2021년 6월 22일 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 검찰에 당사 및 퇴직 임원인 최지성 전 미래전략실장을「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 위반 혐의로 고발하였습니다.

또한 당사와 삼성디스플레이㈜는 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조 제1항 제7호 위반 혐의로 공정거래위원회로부터 2021년 8월 27일 시정조치 및 과징금(당사: 1,012억 17백만원, 삼성디스플레이㈜: 228억 5천 7백만원) 처분을 받았습니다. 동 처분에 대해 현재 행정소송이 진행 중이며, 시정조치에 대해 2022년 1월 27일 집행정지 결정이 확정되었습니다.

공정거래위원회는 2021년 11월 5일 당사의 자회사인 삼성전자서비스씨에스㈜의 대규모 기업집단 현황 공시 자진 정정공시(이사회 구성원 누락) 관련하여「독점규제및 공정거래에 관한 법률」제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시) 위반으로 과태료(2.4백만원)를 부과하였으며, 삼성전자서비스씨에스㈜는 2021년 11월 17일 이를 납부하였습니다. 삼성전자서비스씨에스㈜는 재발 방지를 위하여 담당자 추가 배치 등 내부관리 기준을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제31조 제4항에 따른 2018년과 2019년 지정자료 제출시 삼성카드㈜의 사외이사가 지배하는 회사인 발벡케이피엘코리아㈜, 발벡케이피엘파트너스㈜, 발벡케이피엘자산운용㈜ 3개사를 상호출자제한기업집단「삼성」의 소속회사에서 누락했다는 이유로 2022년 3월 17일 당사의 이재용 부회장에 대해「경고」처분 하였습니다.

당사는 2022년 6월 27일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 위반 혐의로 과태료 1천만원을 부과 받았으며, 이에 대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

당사는 공정거래법, 표시광고법, 대리점법 등 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 관련 예방교육을 시행하고 있습니다.

(2) 기타 행정・공공기관(금융감독・과세 당국 등 포함)의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2021.03.02	환경부	당사 (광주사업장)	녹색기업 지정취소	-	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3 제1항 제1호
2021.08.10	법무부	당사	과태료	0.1	「출입국관리법」 제19조
2021.04.01	고용노동부	자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜)	과태료	1	「고용보험법」 제15조
2021.09.29	고용노동부	자회사 (삼성전자서비스㈜)	부분작업중지명령, 과태료	14	「산업안전보건법」 제16조 제1항, 제41조 제7항, 제53조 제3항, 제114조 제3항
2021.11.23	고용노동부	자회사 (삼성디스플레이㈜)	과태료	0.2	「산업안전보건법」 제46조 제1항
2022.10.13	광주광역시청	당사 (광주사업장)	과태료	3.2	「대기환경보전법」 제39조 제1항
2022.12.14	환경부	당사 (한국총괄)	과태료	2.0	「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제17조 제2항
2022.12.22	환경부	당사 (광주사업장)	과태료	1.6	「대기환경보전법」 제31조 제1항
2022.12.23	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.08	「산업안전보건법」 제37조 제1항
2023.01.16	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.16	「산업안전보건법」 제37조 제1항, 제115조 제2항
2022.04.21	고용노동부	당사 (온양사업장)	과태료	0.6	「산업안전보건법」 제46조 제1항 등
2023.08.16	구미소방서	당사 (구미사업장)	조치명령	-	「위험물안전관리법」 제5조 제1항, 제6조 제1항
2023.08.18	개인정보 보호위원회	당사	과징금	875.6	「개인정보보호법」 제29조, 동법 시행령 제48조의2 제1항 제2호
			과태료	2.4	
2023.08.23	광주광역시청	당사 (광주사업장)	과태료	2.0	「대기환경보전법」 제31조 제2항
2023.09.04	산업통상자원부	자회사 (삼성메디슨㈜)	교육명령 (2인)	-	「대외무역법」 제19조, 제31조, 제49조

당사는 2018년 녹색기업으로 지정된 광주사업장에 대해 2021년 3월 2일 환경부 영산강유역환경청으로부터 대기오염물질 측정값과 관련하여 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호를 이유로 녹색기업 지정취소를 통보받았습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2021년 8월 10일 「출입국관리법」 제19조 1항 (외국인을 고용한 자 등의 신고의무)에 따른 외국인 고용 변동사실 신고의무를 위반하여 수원출입국・외국인청으로부터 과태료(10만원)가 발생하였으며, 자진납부 완료하였습니다. 당사는 퇴직프로세스 개선을 통해 외국인 퇴직자의 고용변동 신고기한을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2022년 2월 21일부터 2월 23일까지 진행된 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태 정기평가와 관련하여 PSM 평가 등급은 한 단계 향상되었으나, 4월 21일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(60만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부에 개선 결과를 제출하였으며, PSM 혁신조직을 신설하여 인허가, 설계 반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

2022년 7월 7일 광주지방법원에서 당사 임직원 2명에게 「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반에 대한 선고가 완료 됨에 따라 2022년 10월 13일 광주광역시청으로부터 대기오염물질 자가측정결과 기록과 관련하여「대기환경보전법」제39조 (자가측정) 제1항 위반으로 과태료(3.2백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2022년 11월 28일부터 29일까지 광주사업장에 대한 환경부의 대기방지시설 감독과 관련하여, 2022년 12월 22일「대기환경보전법」제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제1항 위반으로 과태료(1.6백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 대기방지시설 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 환경부로부터 2022년 12월 14일「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제17조 (배출권 할당의 취소) 제2항 위반으로 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 납부 완료하였습니다. 당사는 온실가스 배출 사업장 현황 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2022년 12월 19일부터 21일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2022년 12월 23일「산업안전보건법」제37조 (안전보건표지의 설치・부착) 제1항 위반으로 과태료(8만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 또한, 2023년 1월 9일부터 11일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2023년 1월 16일「산업안전보건법」제115조 (물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) 제2항, 제37조 (안전보건표지의 설치・부착) 제1항 위반으로 과태료(16만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 안전표지판 설치 및 부착 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 구미소방서로부터 2023년 8월 16일 구미사업장에 대한 「위험물안전관리법」제5조 (위험물의 저장 및 취급의 제한) 제1항 및 제6조 (위험물시설의 설치 및 변경 등) 제1항 위반으로 조치명령을 받아 위험물취급소 설치허가신청 등 조치를 완료하였습니다. 당사는 위험물 시설에 대해 인허가 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 개인정보보호위원회로부터 2023년 8월 18일「개인정보보호법」제29조 (안전조치의무) 및 동법 시행령 제48조의2 (개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 특례) 제1항 제2호 위반으로 시정조치 처분과 과징금 875.6백만원 및 과태료 2.4백만원을 부과 받았으며, 납부 완료하였습니다. 당사는 시스템 운영 협력업체 대상 교육 및 보안관련 계약을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 광주광역시청으로부터 2023년 8월 23일 광주사업장에 대한 「대기환경보전법」제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제2항 위반으로 행정처분(경고) 및 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 과태료는 납부 완료하였습니다. 당사는 대기 배출시설과 방지시설의 운영 상황에 대한 전산 입력 관리 프로세스를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스씨에스㈜는 고용보험 취득신고를 지연 신고하여 고용노동부 중부지방고용노동청으로부터 2021년 4월 1일「고용보험법」제15조(피보험자격에 관한 신고 등) 위반으로 과태료(1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 삼성전자서비스씨에스㈜는 재발 방지를 위하여 고용보험법 개정사항에 대해 주기적으로 검토하고 담당자 실무 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스㈜는 2021년 9월 28일 세탁기 수리 중 발생한 작업자의 감전사와 관련하여, 2021년 9월 29일 고용노동부 서울지방고용노동청 서울남부지청으로부터 「산업안전보건법」제53조(고용노동부장관의 시정조치 등)에 따른 부분작업중지 명령을 받았습니다. 이에 삼성전자서비스㈜는 전국 사업장에 대한 안전보건조치 개선 대책(안)을 제출하여 2021년 11월 10일부로 부분작업중지명령이 해제되었습니다. 또한 2021년 11월 15일 「산업안전보건법」제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항 등 위반으로 과태료 14백만원이 발생하였으며, 2021년 12월 28일 과태료를 자진납부 완료하였습니다.

삼성디스플레이㈜는 2021년 11월 15일부터 11월 16일까지 진행된 기흥사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여 2021년 11월 23일 「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료 16만원이 발생하였으며, 자진 납부 완료하였습니다.

삼성메디슨㈜는 상황허가 대상 일부 품목에 대해 산업통상자원부의 사전 허가를 받지 않고 수출하여 2023년 9월 4일 산업통상자원부로부터「대외무역법」제19조(전략물자의 고시 및 수출허가 등) 등 위반으로 교육명령(2인) 행정처분을 부과받았으며, 2023년 11월 7일 산업통상자원부의 교육과정을 이수하였습니다. 삼성메디슨㈜는 재발 방지를 위하여 전략물자 관리담당자의 교육활동을 강화하고 내부 프로세스를 보완하는 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

해당사항 없습니다

라. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

나. 대외후원 현황

현 황	금 액	내 용	비 고
2021년 사회공헌 매칭기금 운영계획	116.1억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2021년 회사매칭기금으로 116.1억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2021.02.16 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	24.46억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	601억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 115억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 응급헬기 운영 지원 (삼성생명공익재단, 299억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 37억원)	2021.04.29 이사회 결의
DS 부문 우수협력사 인센티브	약 632억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
국제기능올림픽 후원	150만 유로 (약 20.9억원)	· 제46회 중국 상하이 국제기능올림픽대회 및 국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	2021.10.28 이사회 결의
공동투자형 기술개발 협약기금 출연	150억원	· 중소벤처기업부 주관 공동투자형 기술개발사업 참여 · 중소벤처기업부와 협약기금을 조성, 협약기금은 중소기업이 제안한 로봇・AI / 바이오헬스 / 시스템 반도체, 소재부품장비 국산화 관련 과제 평가 후 최종 선정된 중소기업에 지급	
희망2022 나눔캠페인 기부금 출연	256억원	· 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연	2021.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$2,689,094 (약 32.0억원)	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	
2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획	117.5억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2022년 회사매칭기금으로 117.5억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2022.02.15 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	23.24억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	468억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 44억원) · 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 232억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 42억원)	2022.04.28 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	약 740억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	

서울대 반도체공동연구소 운영비 기부금 출연	50억원	· 서울대학교 반도체공동연구소의 교육 장비 인프라 및 연구 인력 채용을 위한 운영비 지원	2022.07.28 이사회 결의
이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축 성금	40억원	· 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축을 위해 총 40억원을 사단법인 전국재해구호협회에 현금 기부	2022.11.03 이사회 결의
희망2023 나눔캠페인 기부금 출연	183.7억원	· 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연	2022.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$7,188,329 (약 95.7억원)	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	
국제기능올림픽 후원	165만 유로 (약22.5억원)	· 제47회 프랑스 리옹 국제기능올림픽대회 및 국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	
2023년 사회공헌 매칭기금 운영계획	123.4억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2023년 회사매칭기금으로 123.4억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2023.02.14 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	23.78억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
스마트공장 지원사업 추진	224억원	· 스마트공장 지원을 통한 국내 제조경쟁력 강화 및 지역균형 발전에 기여	2023.04.27 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	801억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
삼성복지재단 등 기부금 출연	328.3억원	· 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 171.9억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 122.4억원) · 과학(물리・수학)/과학(화학・생명)/공학/의학/예술/사회봉사 6개 부문 시상(호암재단, 34억원)	2023.07.27 이사회 결의
희망2024 나눔 캠페인 기부금 출연	86.5억원	· 연말 이웃사랑 성금 모금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2023.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$4,366,270 (56.8억원)	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	

※ 대외후원 현황 및 금액은 이사회 결의 기준으로 기재하였습니다.

다. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기업 지정' 및 '녹색기술 인증'을 확대하고 있습니다. 특히 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스배출량'과 '에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며,「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 2023년말 현재(별도 기준) 수원사업장, 구미사업장, 기흥・화성사업장, 평택사업장, 온양사업장이 녹색기업으로 지정되어 있습니다. 한편, 2021년 3월 광주사업장은「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.

(녹색기술 인증)

당사는「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」제60조 (녹색기술・녹색산업의 표준화 및 인증 등) 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사는 인증 제도가 시작된 2010년부터 지속적으로 녹색기술을 발굴하여 인증을 취득해왔으며 2023년말 기준 총 7건의 녹색기술에 대한 유효 인증을 보유하고 있고 해당 녹색기술이 적용된 179개 모델에 대해 '녹색기술제품 확인' 인증을 보유 중입니다.

2023년말 현재 녹색기술 인증 현황은 다음과 같습니다.

인증번호	기술 명칭	인증일자	유효기간
GT-23-01728	배출가스 저감장치가 적용된 히트펌프의 고효율 운전을 위한 저부하 운전 촉매 활성화 기술	2023.07.27	2026.07.26
GT-20-00880	고효율 히트펌프와 열교환기를 적용한 의류건조기 에너지 효율 향상 기술	2020.05.21	2026.05.20
GT-20-00826	미세 다공 홀 구조가 적용된 천장형 무풍 에어컨 기술	2020.01.30	2026.01.29
GT-22-01562	노점 온도를 이용한 절전 제습 기술	2022.11.24	2025.11.23
GT-19-00664	Self Wake-Up 기능을 갖는 모니터 대기전력 저감 기술	2019.05.16	2025.05.15
GT-21-01256	프린터 및 복합기의 슬립모드 소비전력 저감 기술	2021.11.18	2024.11.17
GT-21-01248	고효율 전력 변환 기술을 활용한 노트북 대기전력 저감 기술	2021.10.14	2024.10.13

※ 별도 기준입니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장 기본법」제27조 (관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조3항 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제24조 (배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO_2-eq)	13,618,815	14,925,733	14,515,620
에너지(TJ)	240,275	222,877	200,942

※ 별도 기준입니다.
※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 2023년 배출량 및 에너지 사용량은 집계 및 검증 전으로 전망치로 반영하였습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 (할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당합니다.

라. 건강친화기업 인증

당사는 임직원 건강증진을 위해 사내부속의원, 물리치료실, 근골격계예방센터, 마음건강클리닉 등 다양한 의료시설을 운영하고 있고, 건강증진 프로그램을 통해 직원 스스로가 건강관리를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 인정받아 DS 부문은 「국민건강증진법」 제6조의2 제1항에 따라 2022년 12월 7일 보건복지부 장관으로부터 건강친화기업 인증을 취득하였습니다(유효기간 : 2022년 12월 7일 ~ 2025년 12월 6일).

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사의 연결대상 종속기업은 2023년말 현재 232개사입니다. 전년말 대비 6개 기업이 증가하고 6개 기업이 감소하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	1978. 07	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA	전자제품 판매	41,926,899	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	O
Samsung International, Inc. (SII)	1983. 10	333 H Street, Suite 6000, Chula Vista, California, USA	전자제품 생산	1,690,752	상동	O
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	1988. 03	Parque Ind., El Florido 1ra y 2da Secc, Tijuana, B.C., Mexico	전자제품 생산	190,798	상동	O
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	2017. 08	284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina, USA	가전제품 생산	863,840	상동	O
Samsung Research America, Inc (SRA)	1988. 10	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	R&D	984,163	상동	O
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	해외자회사 관리	257,924	상동	O
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	신기술사업자, 벤처기업 투자	370,961	상동	O
NeuroLogica Corp.	2004. 02	14 Electronics Ave., Danvers, Massachusetts, USA	의료기기 생산 및 판매	243,481	상동	O
Samsung HVAC America, LLC	2001. 07	776 Henrietta Creek Road, Suite 100, Roanoke, Texas, USA	에어컨공조 판매	113,088	상동	O
Joyent, Inc.	2005. 03	645 Clyde Avenue, Suite 502, Mountain View, California, USA	클라우드서비스	202,727	상동	O
SmartThings, Inc.	2012. 04	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	스마트홈 플랫폼	220,123	상동	O
TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	2002. 05	14850 Conference Center, Suite 250, Chantilly, Virginia, USA	네트워크장비 설치 및 최적화	32,371	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	1983. 07	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	반도체・디스플레이 패널 판매	12,796,440	상동	O
Samsung Federal, Inc. (SFI)	2023. 05	3655 N. First St., San Jose, California, USA	R&D	1,263	상동	X
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1996. 02	12100 Samsung Blvd., Austin, Texas, USA	반도체 생산	16,714,945	상동	O
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	2016. 06	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	해외자회사 관리	558,656	상동	O
SEMES America, Inc.	1998. 10	13400 Immanuel Rd., Pflugerville, Texas, USA	반도체 장비 서비스	2,529	상동	X
Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	2023. 05	3655 N 1st St San Jose, California, USA	해외자회사 관리	307,429	상동	O
eMagin Corporation	2000. 03	700 South Drive Suite # 201 Hopewell Junction, NY, USA	디스플레이 패널 개발 및 생산	370,378	상동	O

Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	1980. 07	2050 Derry Rd. West, Mississauga, Ontario, Canada	전자제품 판매	1,302,924	상동	O
AdGear Technologies Inc.	2010. 08	800 Rene-Levesque Blvd W Suite 1000, Quebec, Canada	디지털광고 플랫폼	161,458	상동	O
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1994. 10	Av. Dos Oitis, 1.460, Distrito Industrial II CEP: 69.007-002 Manaus, Amazonas Brazil	전자제품 생산 및 판매	5,542,627	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1995. 07	General Mariano Escobedo 476, col. Anzures CP. 11590 Miguel Hidalgo, Cuidad de Mexico	전자제품 판매	2,153,032	상동	O
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	2012. 12	Avenida Benito Juarez 119 KM 28.5 Santa Rosa Jauregui, CP. 76220. Queretaro, Mexico	가전제품 생산	1,324,763	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	1989. 04	Costa del Este, Av. La Rotonda, Business Park Torre V, Piso 7. Panama City, Panama	전자제품 판매	643,286	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	1995. 05	9850 NW 41st St. #350, Doral, Florida, USA	전자제품 판매	553,965	상동	O
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	1997. 03	Carrera 7 #114-43 Oficina 607, Bogota, Colombia	전자제품 판매	463,772	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	1996. 06	Bouchard 710 Piso #7, Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	83,075	상동	O
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	2002. 12	Cerro El Plomo 6000, Piso 6, Las Condes, Region Metropolitana, Chile	전자제품 판매	524,530	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	2010. 04	Av. Rivera Navarrete 501 Piso 6, San Isidro, Lima, Peru	전자제품 판매	295,477	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	2010. 05	Calle La Guairita Edif Centro Profesional Eurobuilding Piso 4 Of 4-E Urb Urbanizacion Chuao Caracas Miranda, Venezuela	마케팅 및 서비스	168	상동	X
Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	2012. 07	Costa del Este, Av. La Rotonda, Business Park Torre V, Piso 8. Panama City, Panama	컨설팅	5,864	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980. 01	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	16,329,845	상동	O
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981. 06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA	오디오제품 생산, 판매, R&D	3,137,078	상동	O
Harman Connected Services, Inc.	2002. 02	636 Ellis St., Mountain View, California, USA	Connected Service Provider	2,265,938	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004. 09	636 Ellis St., Mountain View, California, USA	Connected Service Provider	-	상동	X
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	2005. 07	Av. Cupiuba 401, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas, Brazil	오디오제품 생산, 판매	196,081	상동	O
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997. 02	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 생산	261,655	상동	O
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	1958. 11	BR-386 KM 435, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brazil	오디오제품 판매, R&D	304,138	상동	O
Harman Financial Group LLC	2004. 06	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	Management Company	1	상동	X
Harman International Industries Canada Ltd.	2005. 05	2900-550 Burrard St., Vancouver, British Columbia, Canada	오디오제품 판매	326	상동	X

Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	2014. 12	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 판매	47,811	상동	X
Harman KG Holding, LLC	2009. 03	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional, Inc.	2006. 07	8500 Balboa Blvd., Northridge, California, USA	오디오제품 판매, R&D	898,008	상동	O
Roon Labs, LLC.	2015. 01	400 Atlantic Street, 4th Floor Stamford, CT 06901	오디오제품판매	69,748	상동	X
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014. 12	89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	13,652	상동	X
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017. 09	23 Lime Tree Bay Av., Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	8,141	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1995. 07	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, UK	전자제품 판매	2,902,722	상동	O
Samsung Electronics Ltd. (SEL)	1999. 01	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, UK	해외자회사 관리	7,212	상동	X
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	1997. 04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체・디스플레이 패널 판매	109,216	상동	O
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1984. 12	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	전자제품 판매	2,097,706	상동	O
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	1982. 02	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	해외자회사 관리	438,172	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	1987. 12	Einsteinstrasse 174, 81677 Munich, Germany	반도체・디스플레이 패널 판매	1,024,701	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	1986. 01	6 Rue Fructidor, 93400 Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,265,823	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	1991. 04	Via Mike Bongiorno 9, Milano, Italy	전자제품 판매	1,053,955	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	1989. 01	Parque Empresarial Omega Edf. C Av. de Barajas 32, Alcobendas, Madrid, Spain	전자제품 판매	1,266,167	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	1982. 09	Lagoas, Edificio 5B, Piso 4, Porto Salvo, Portugal	전자제품 판매	304,248	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	1989. 10	Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,426,079	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1991. 05	Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands	물류	1,639,004	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1995. 07	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,794,552	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	해외자회사 관리	9,660,481	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	1992. 03	Box 1235, 16428, Kista, Sweden	전자제품 판매	591,101	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	2002. 06	Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia	TV・모니터 생산	928,129	상동	O
Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	2007. 03	Voderady 401, Voderady, 919 42, Slovakia	디스플레이 패널 임가공	29,695	상동	X
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	1996. 04	ul.Postepu 14, Warszawa, Poland	전자제품 판매	1,384,273	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	2010. 02	ul. Mickiewicza 52, Wronki, Poland	가전제품 생산	882,673	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	2007. 09	Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cladire A, etajul 5, Bucuresti, sector 1, Romania	전자제품 판매	460,478	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	2002. 01	Praterstraße 31, Vienna, Austria	전자제품 판매	519,776	상동	O

Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	2013. 05	Giesshuebelstrasse 30, 8045 Zurich, Switzerland	전자제품 판매	264,260	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	2010. 01	V Parku 14, Prague, Czech Republic	전자제품 판매	391,308	상동	O
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	2001. 10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	131,129	상동	O
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	2010. 04	24A Kifissias avenue., 15125 Maroussi Athens Greece	전자제품 판매	153,107	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	2017. 04	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	에어컨공조 판매	273,604	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	2004. 02	Torshamnsgatan 48, 16440, Kista, Sweden	R&D	28,657	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	2012. 09	Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Oest, Denmark	R&D	28,791	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	2012. 09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Rd., Cambridge, UK	R&D	210,343	상동	O
SAMSUNG Zhilabs, S.L.	2008. 11	Av. Josep Tarradellas, 123 3º C, 08029 Barcelona, Spain	네트워크 Solution 개발, 판매	11,879	상동	X
FOODIENT LTD.	2012. 03	483 Green Lanes, London, England, UK	R&D	10,004	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	2006. 10	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia	전자제품 판매	839,493	상동	O
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	2007. 07	Russia, Kaluzhskaya oblast, Borovskiy rayon, d. Koryakovo, Pervyi Severny proezd, Vladeniye 1	TV 생산	1,030,743	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	2008. 09	75A, Zhylianska St., Kiev, Ukraine	전자제품 판매	280,470	상동	O
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	2022. 02	57, Hetman Pavlo Skoropadskyi str., Kyiv, 01032, Ukraine	R&D	9,454	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	2008. 09	3rd floor, 115 Zheltoksan street, Almaly district, Almaty City, Kazakhstan	전자제품 판매	362,213	상동	O
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	1997. 01	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,913	상동	X
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	2011. 11	12, building 1, Dvintsev St., Moscow, Russia	R&D	49,646	상동	X
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	2014. 10	1065 Bridge Plaza Biz Centre 12F, 6 Bakikhanov St., Baku, Azerbaijan	마케팅	2,632	상동	X
Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ)	2022. 03	64, Oloy Bozori Berk Street, Yunusabad District, Tashkent, Uzbekistan	마케팅	91,356	상동	O
AKG Acoustics Gmbh	1947. 03	254, Laxenburger St., Vienna, Austria	오디오제품 생산, 판매	356,482	상동	O
Apostera UA, LLC	2020. 10	3 Sumska St., Kyiv, Ukraine	Connected Service Provider	1,037	상동	X
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	2012. 11	C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain	오디오제품 판매	1,254	상동	X
Harman Becker Automotive Systems GmbH	1990. 07	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	오디오제품 생산, 판매, R&D	3,949,170	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005. 12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), Italy	오디오제품 판매	879	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1994. 08	Holland Fasor 19-HU, Szekesfehervar, H-8000 Hungary	오디오제품 생산, R&D	3,230,387	상동	O
Harman Belgium SA	1967. 04	4 Drukperstraat, Brussels, Belgium	오디오제품 판매	2,993	상동	X

Harman Connected Services AB.	1984. 10	24 Nordenskioldsgatan, Malmo, Sweden	Connected Service Provider	11,306	상동	X
Harman Finland Oy	1998. 07	Hermiankatu 1 A, Tampere, Finland	Connected Service Provider	379	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005. 12	45 Wittener Str., Bochum, Germany	Connected Service Provider	52,425	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007. 06	UL Kasprzaka 6, Lodz, Poland	Connected Service Provider	11,538	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008. 09	Devonshire House, 60 Goswell Rd., London, UK	Connected Service Provider	55,034	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995. 12	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands	오디오제품 판매	497,888	상동	O
Harman Deutschland GmbH	1998. 03	Parkring 3 B. Munich, Garching, Germany	오디오제품 판매	13,602	상동	X
Harman France SNC	1995. 11	12 bis, rue des Colonnes-du-Trone, Paris, France	오디오제품 판매	166,979	상동	O
Harman Holding Gmbh & Co. KG	2002. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	Management Company	5,848,586	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012. 06	Holland Fasor 19-HU, Szekesfehervar. H-8000 Hungary	Financing Company	46,365	상동	X
Harman Inc. & Co. KG	2012. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	4,619,985	상동	O
Harman International Estonia OU	2015. 05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, Estonia	R&D	1	상동	X
Harman International Industries Limited	1980. 03	Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK	오디오제품 판매, R&D	77,383	상동	O
Harman International Romania SRL	2015. 02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metroffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sec. 2, Bucharest, Romania	R&D	13,910	상동	X
Harman Management Gmbh	2002. 04	Becker Goering St. 16, Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional Kft	2014. 12	Uszogi kiserdo utca 1/C, Pecs 7630, Hungary	오디오제품 생산, R&D	59,000	상동	X
Harman Professional Denmark ApS	1987. 07	Olof Palmes Alle 18., Aarhus, Denmark	오디오제품 판매, R&D	54,778	상동	X
Red Bend Software SAS	2002. 10	Immeuble 15 place Georges Pompidou, MontignyLe Bretonneux, France	소프트웨어 디자인	8,162	상동	X
Studer Professional Audio GmbH	2003. 11	Althardstrasse 30, Regensdorf, Switzerland	오디오제품 판매, R&D	476	상동	X
Harman Connected Services OOO	1998. 11	8 Kovalikhinskaya St., Nizhny Novgorod, Russia	Connected Service Provider	27,181	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011. 08	RS 12/1 Dvintsev street, Moscow, Russia	오디오제품 판매	38,224	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	1995. 05	Office No. FZJOA2111, Jebel Ali Free Zone, P. O. Box 61247, Dubai - UAE	전자제품 판매	1,027,977	상동	O
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	1984. 12	Defterdar Mah. Otakcilar Cad. Sinpas Flatofis Apt.No.78/46, Eyupsultan, Istanbul, Turkiye	전자제품 판매	793,352	상동	O
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	2021. 02	Mimar Sinan Mah. 103. Cadde No:72 Kapakli, Tekirdag, Turkiye	전자제품 생산	134,709	상동	O
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	2009. 07	Building No.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St., Amman, Jordan	전자제품 판매	444,609	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	2009. 11	Lotissement La Colline 2, Lot 12, 4eme etage, Sidi Maarouf, 20190 Casablanca, Morocco	전자제품 판매	352,506	상동	O

Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	2012. 07	62815 Piece No. 98, Engineering Sector, Kom Abu Radi, Al Wasta, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	1,348,469	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	2012. 09	6th fl, Building C, Aharon Bart St 22, Petah Tikva, Israel	마케팅	22,070	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	2012. 09	2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy, Tunis, Tunisia	마케팅	4,885	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	2012. 11	Samsung Office 2nd Flr., 26 FCC, Syed Maratba Ali Road, Gulberg IV, Lahore- 54660, Pakistan	마케팅	3,393	상동	X
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	2019. 11	Hamad Tower, Olaya District, Riyadh, Saudi Arabia	전자제품 판매	428,067	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	2007. 10	Derech Menachem Begin 146, Tel Aviv-Yafo Israel	R&D	162,934	상동	O
Corephotonics Ltd.	2012. 01	Derech Menachem Begin 146, Tel Aviv-Yafo Israel	R&D	24,159	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	1994. 06	2929 Winnie Mandela Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa	전자제품 판매	527,416	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	2014. 07	35 Umkhomazi Drive, La Mercy, Kwa-Zulu Natal, South Africa	TV・모니터 생산	87,759	상동	O
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	2010. 03	14 floor, One 6 Temple, 16 Olu Holloway Rd, Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	23,348	상동	X
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	2011. 12	3rd Floor , West End Towers Muthangari Drive off Waiyaki Way P.O. Box 27577-00506 Nairobi, Kenya	마케팅	18,072	상동	X
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002. 01	International Financial Services Ltd, IFS Court, TwentyEight CyberCity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	56,523	상동	X
Harman Connected Services Morocco	2012. 04	Technopark, Route Nouaceur, Rs 114 & CT1029, Casablanca, Morocco	Connected Service Provider	73	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009. 10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	95,209	상동	O
Red Bend Ltd.	1998. 02	4 HaCharash St., Neve Ne'eman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	오디오제품 생산	110,476	상동	O
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	2006. 07	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	해외자회사 관리	22,234,942	상동	O
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	2020. 10	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	전자제품 판매	658,918	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	2003. 05	Level 15, Mercu2, No.3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	618,803	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	1995. 03	Tuanku Jaafar Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산	26,388	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	1989. 09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park, Port Klang, Selangor, Malaysia	가전제품 생산	313,767	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	1995. 01	25th Floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	전자제품 판매	110,276	상동	O

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	2008. 03	Yen Phong Industrial Zone 1. Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh Province, Vietnam	전자제품 생산	7,301,860	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	2013. 03	Yen Binh Industrial Park, Dong Tien Ward, Pho Yen City, Thai Nguyen Province, Vietnam	통신제품 생산	12,554,481	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	2015. 02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	4,043,677	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	2014. 07	Yen Phong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam	디스플레이 패널 생산	7,383,485	상동	O
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	2022. 06	Lot CN9, Song Cong II Industrial Zone, Tan Quang, SongCong, Thai Nguyen, Vietnam	디스플레이 패널 부품 생산	96,061	상동	O
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	1991. 08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	1,110,178	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	2003. 03	TCC Batavia Building Tower One 21st Floor, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220, Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	75,638	상동	O
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1988. 10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung A.Sriracha Chonburi, Thailand	전자제품 생산 및 판매	3,039,379	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	2016. 09	3F Kolao Tower 2, 23 Singha Rd., Vientiane, Laos	마케팅	1,318	상동	X
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	1996. 03	9F Science Hub Tower 4, 1110 Campus Avenue, Mckinley Hill Cyberpark, Fort Bonifacio, Taguig City, Philippines	전자제품 판매	372,478	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	1987. 11	3 Murray Rose Avenue, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia	전자제품 판매	612,161	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	2013. 09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, New Zealand	전자제품 판매	204,114	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1995. 08	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India	전자제품 생산 및 판매	7,738,259	상동	O
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	2012. 01	6th Floor, Salarpuria Sattva Magnificia, Old Madras Road, Bengaluru, Karnataka, India	마케팅	1,429	상동	X
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	2019. 07	B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India	디스플레이 패널 생산	675,743	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	2005. 05	Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India	R&D	430,987	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	2010. 08	Gualshan-1, Gulshan Ave., Dhaka, Bangladesh	R&D	17,625	상동	X
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	2017. 11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal	서비스	1,263	상동	X
Samsung Japan Corporation (SJC)	1975. 12	2 Chome-16-4, Konan, Minato City, Tokyo, Japan	반도체・디스플레이 패널 판매	1,013,103	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	1992. 08	2-7, Sugasawa-cho, Tsurumi-ku, Yokohama 230-0027, Japan	R&D	136,782	상동	O

Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	2008. 09	Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	전자제품 판매	705,460	상동	O
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002. 04	Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli, Bangalore, India	Connected Service Provider	353,291	상동	O
Harman International (India) Private Limited	2009. 01	Plot No. 9, Phase I , Doddenakkundi Industrial Area, K.R. Puram Hobli, Bangalore, India	오디오제품 판매, R&D	395,349	상동	O
Harman International Industries PTY Ltd.	2014. 12	Warehouse 25 26-18, Roberna St., Moorabbin, Victoria, Australia	해외자회사 관리	-4,549	상동	X
Harman International Japan Co., Ltd.	1991. 06	14F Sumitomo Fudosan Akihabara-ekimae, Kanda, Chiyoda, Tokyo, Japan	오디오제품 판매, R&D	72,958	상동	X
Harman Singapore Pte. Ltd.	2007. 08	108, Pasir Panjang Rd., #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore	오디오제품 판매	15,187	상동	X
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1996. 03	23 / F, 25 / F, -6-57 / F 101, Building 1, No.31, Jinghui Street, Chaoyang District, Beijing, China	전자제품 판매	10,222,557	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	1988. 09	RM03, 8/F & 33/F & RM 03-04 39/F Central Plaza, 18 Habour Road, Wanchai, Hong Kong	전자제품 판매	985,438	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1994. 11	10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan	전자제품 판매	1,797,627	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	1993. 04	5F-A, Block A, Investment Service Center, Microelectronics Industrial Zone, No. 1 Qianxuesen Road, Jingang Road, Xiqing District, Tianjin, China	TV・모니터 생산	382,260	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	636,160	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	1995. 04	No.218 Jiepu Road, Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China	가전제품 생산	488,014	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	2002. 09	No.198, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	전자제품 생산, R&D	94,528	상동	O
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	2001. 03	No.9 WeiWu Rd. Micro Electronic Industrial Park, Xiqing, Tianjin, China	통신제품 생산	646,732	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	2000. 09	RM1503,15F No.12 Taiyanggong Mid Rd Chaoyang, Beijing China	R&D	131,677	상동	O
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	2004. 05	5-12F, 6Bldg., Chuqiaocheng, 57#Andemen St., Nanjing, China	R&D	33,031	상동	X
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	2010. 01	Building 1, Xuesong Center, No.2509 Kaichuang Avenue, Huangpu District, Guangzhou, China	R&D	43,195	상동	X
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	2013. 03	21F,22F,23F, Building 2C, Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, China	R&D	38,382	상동	X

Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	2001. 10	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China	반도체・디스플레이 패널 판매	5,262,086	상동	O
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	2012. 09	No.1999, Xiaohe Rd., Changan, Xian, China	반도체 생산	15,808,283	상동	O
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	2016. 04	Room 708, 7F Clearance Service Center, High-tech free trade zone, Xi'an, China	반도체・디스플레이 패널 판매	854,932	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	1994. 12	No.337,Fengli Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	반도체 임가공	869,225	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	2009. 05	#6 Weisi Road, Microelectronics Industrial Park, Xiqing District, Tianjin, China	LED 생산	257,820	상동	O
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	2003. 04	No.337, Fengli Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China	R&D	89,911	상동	O
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2001. 11	6 Hujing Road, Houjie, Dongguan Guangdong, China	디스플레이 패널 생산	752,934	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	2004. 06	No.25, Mip Fourth Rd., Xiqing, Tianjin, China	디스플레이 패널 생산	583,728	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013. 07	#A501, ZTE PLAZA, No.10 Tangyan South Rd., Gaoxin, Xian, China	반도체・FPD 장비 서비스	3,588	상동	X
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	2021. 12	#409, Building 2, No. 599, Wanzhen Road, Zhenxinxincun St., Jiading District, Shanghai, China	신기술사업자, 벤처기업 투자	10,314	상동	X
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011. 03	No.68, First Yinquan Rd., Zhengxing, Dandong, China	오디오제품 생산	214,710	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	2013. 03	Room 20314, DoubleWarehouse, No. 95, Qiming Road, Suzhou, Industrial Park, China	오디오제품 판매	5,795	상동	X
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006. 09	No.125, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	오디오제품 생산, R&D	465,961	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010. 10	Suite 2903B, Level 29, 288, West Nanjing Rd., Huangpu, Shanghai, China	오디오제품 판매	367	상동	X
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	2007. 08	Unit 01-10 of Floor 14, Unit 01-10 of Floor 15, No.383 Jiaozi Avenue, High-tech District, Chengdu, China	Connected Service Provider	12,426	상동	X
Harman Holding Limited	2007. 05	Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong	오디오제품 판매	648,529	상동	O
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	2009. 06	30F, Chong Hing Finance Center, 288 Nanjing Road West, Huangpu District, Shanghai, China	오디오제품 판매, R&D	685,227	상동	O
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	2004. 09	14F, China Merchants Bureau Port Building, Merchants St., Nanshan, Shenzhen, China	오디오제품 판매, R&D	40,712	상동	X
삼성디스플레이㈜	2012. 04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)	디스플레이 패널 생산 및 판매	65,328,568	상동	O
에스유머티리얼스㈜	2011. 08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	디스플레이 패널 부품 생산	37,027	상동	X
스테코㈜	1995. 06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20(백석동)	반도체 부품 생산	132,675	상동	O
세메스㈜	1993. 01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	반도체・FPD 장비 생산, 판매	2,187,919	상동	O
삼성전자서비스㈜	1998. 10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동)	전자제품 수리 서비스	795,640	상동	O

삼성전자서비스씨에스㈜	2018. 10	경기도 수원시 영통구 중부대로 324(매탄동)	고객상담서비스	23,897	상동	X
삼성전자판매㈜	1996. 07	경기도 성남시 분당구 백현로101번길 30	전자제품 판매	1,358,597	상동	O
삼성전자로지텍㈜	1998. 04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)	종합물류대행	465,079	상동	O
삼성메디슨㈜	1985. 07	강원도 홍천군 남면 한서로 3366	의료기기 생산 및 판매	629,302	상동	O
주식회사 희망별숲	2022. 12	경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, 프리미엄원희캐슬 2층	식품 제조 가공	7,255	상동	X
㈜미래로시스템	1994. 01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동)	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	39,931	상동	X
㈜도우인시스	2010. 03	충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 605-1(송절동)	디스플레이 패널 부품 생산	142,726	상동	O
지에프㈜	2015. 10	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 38	디스플레이 패널 부품 생산	8,418	상동	X
㈜하만인터내셔널코리아	2005. 01	서울특별시 강남구 테헤란로 223(역삼동), 큰길타워 17층	소프트웨어 개발 및 공급	16,696	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	82,411	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	17,438	상동	X
SVIC 26호 신기술투자조합	2014. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	27,631	상동	X
SVIC 28호 신기술투자조합	2015. 02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	337,949	상동	O
SVIC 29호 신기술투자조합	2015. 04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	34,222	상동	X
SVIC 32호 신기술투자조합	2016. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	223,258	상동	O
SVIC 33호 신기술투자조합	2016. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	315,348	상동	O
SVIC 37호 신기술투자조합	2017. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	22,559	상동	X
SVIC 40호 신기술투자조합	2018. 06	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	37,275	상동	X
SVIC 42호 신기술투자조합	2018. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	33,102	상동	X
SVIC 43호 신기술투자조합	2018. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	17,093	상동	X
SVIC 45호 신기술투자조합	2019. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	175,893	상동	O
SVIC 48호 신기술투자조합	2019. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	85,250	상동	O
SVIC 52호 신기술투자조합	2021. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	77,174	상동	O
SVIC 55호 신기술투자조합	2021. 09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	155,442	상동	O
SVIC 56호 신기술투자조합	2021. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	56,070	상동	X
SVIC 57호 신기술투자조합	2022. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	37,155	상동	X

SVIC 62호 신기술투자조합	2023. 03	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	3,715	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017. 03	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	58,356	상동	X
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	2020. 04	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	79,856	상동	O
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	2023. 07	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	753	상동	X

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'II.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(종속기업의 변동)

(단위 : 개사)

구 분	미주	유럽 · CIS	중동 · 아프리카	아시아 (중국 제외)	중국	국내	합계	변 동 내 역	
								증 가	감 소
제52기말 (2020년말)	55	75	19	30	33	29	241	-	-
제53기 증감	△9	△4	1	-	△3	2	△13	[중국: 1개사] · Samsung Semiconductor Investment L.P. I [중동 · 아프리카: 1개사] · Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) [국내: 3개사] · SVIC 52호 신기술투자조합 · SVIC 55호 신기술투자조합 · SVIC 56호 신기술투자조합	[미주: 9개사] · Viv Labs, Inc. · Stellus Technologies, Inc. · SigMast Communications Inc. · Prismview, LLC · Zhilabs, Inc. · TWS LATAM B, LLC · TWS LATAM S, LLC · SNB Technologies, Inc. Mexico, S.A. de C.V · RT SV CO-INVEST, LP [유럽 · CIS: 4개사] · Arcam Limited · A&R Cambridge Limited · Harman Connected Services Limited · Martin Manufacturing (UK) Ltd. [중국: 4개사] · Samsung Suzhou Module Co., Ltd. (SSM) · Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) · Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. (SEHZ) · Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.(SSET) [국내: 1개사] · SVIC 27호 신기술투자조합
제53기 (2021년말)	46	71	20	30	30	31	228	-	-
제54기 증감	△1	1	-	2	-	2	4	[유럽 · CIS: 4개사] · Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) · Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ) · Apostera GmbH · Apostera UA, LLC [아시아(중국 제외): 2개사] · DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED · Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. [국내: 2개사] · SVIC 57호 신기술투자조합 · ㈜희망별숲	[미주: 1개사] · Dacor Canada Co. [유럽 · CIS: 3개사] · AMX UK Limited · Harman International s.r.o · Apostera GmbH
제54기 (2022년말)	45	72	20	32	30	33	232	-	-

제55기 증감	2	△4	-	-	-	2	-	[미주: 4개사] ・Samsung Federal, Inc. (SFI) ・Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH) ・eMagin Corporation ・Roon Labs, LLC. [국내: 2개사] ・SVIC 62호 신기술투자조합 ・반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	[미주: 2개사] ・Dacor Holdings, Inc. ・Dacor, Inc. [유럽・CIS: 4개사] ・Red Bend Software Ltd. ・Harman Finance International GP S.a.r.l ・Harman Finance International, SCA ・Harman Automotive UK Limited
제55기 (2023년말)	47	68	20	32	30	35	232	-	-

[△는 부(-)의 값임]

2. 계열회사 현황(상세)

가. 국내 계열회사 현황

2023년말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 1개 회사가 증가하고 1개 회사가 감소하여 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	17	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)	1101118376893
		삼성엔지니어링(주)	1101110240509
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		(주)멀티캠퍼스	1101111960792
		(주)에스원	1101110221939
		(주)제일기획	1101110139017
		(주)호텔신라	1101110145519
비상장	46	삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		삼성자산운용(주)	1701110139833

		삼성전자로지텍(주)	1301110046797
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자서비스씨에스(주)	1358110352541
		삼성전자판매(주)	1801110210300
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140003466
		삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
		삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703
		삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
		세메스(주)	1615110011795
		수원삼성축구단(주)	1358110160126
		스테코(주)	1647110003490
		신라에이치엠(주)	1101115433927
		에스디플렉스(주)	1760110039005
		에스비티엠(주)	1101116536556
		에스원씨알엠(주)	1358110190199
		에스유머티리얼스(주)	1648110061337
		에스코어(주)	1101113681031
		에스티엠(주)	2301110176840
		에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
		오픈핸즈(주)	1311110266146
		제일패션리테일(주)	1101114736934
		(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
		(주)미래로시스템	1101111005366
		(주)삼성글로벌리서치	1101110766670
		(주)삼성라이온즈	1701110015786
		(주)삼성생명금융서비스	1101115714533
		(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		(주)삼우종합건축사사무소	1101115494151
		(주)서울레이크사이드	1101110504070
		(주)시큐아이	1101111912503
		(주)씨브이네트	1101111931686
		(주)에스에이치피코퍼레이션	1101118151310
		(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
		(주)휴먼티에스에스	1101114272706
		(주)희망별숲	1345110611259

※ 삼성코닝어드밴스드글라스는 2020년 10월 유한회사에서 주식회사로 변경하였다가, 2021년 2월 주식회사에서 유한회사로 재변경하였습니다.

나. 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	소재국
비상장	562	SAMOO AUSTIN INC	USA
		SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	Hungary
		SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	India
		SAMOO (KL) SDN. BHD.	Malaysia
		SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	China
		Samsung Green repower, LLC	USA
		Samsung Solar Construction Inc.	USA
		QSSC, S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Solar Energy LLC	USA
		Equipment Trading Solutions Group, LLC	USA
		SP Armow Wind Ontario LP	Canada
		SRE GRW EPC GP Inc.	Canada
		SRE GRW EPC LP	Canada
		SRE SKW EPC GP Inc.	Canada
		SRE SKW EPC LP	Canada
		SRE WIND PA GP INC.	Canada
		SRE WIND PA LP	Canada
		SRE GRS Holdings GP Inc.	Canada
		SRE GRS Holdings LP	Canada
		SRE K2 EPC GP Inc.	Canada
		SRE K2 EPC LP	Canada
		SRE KS HOLDINGS GP INC.	Canada
		SRE KS HOLDINGS LP	Canada
		SP Belle River Wind LP	Canada
		SRE Armow EPC GP Inc.	Canada
		SRE Armow EPC LP	Canada
		North Kent Wind 1 LP	Canada
		SRE Wind GP Holding Inc.	Canada
		South Kent Wind LP Inc.	Canada
		Grand Renewable Wind LP Inc.	Canada
		SRE North Kent 2 LP Holdings LP	Canada
		SRE Solar Development GP Inc.	Canada
		SRE Solar Development LP	Canada
		SRE Windsor Holdings GP Inc.	Canada
		SRE Southgate Holdings GP Inc.	Canada
		SRE Solar Construction Management GP Inc.	Canada

		SRE Solar Construction Management LP	Canada
		SRE BRW EPC GP INC.	Canada
		SRE BRW EPC LP	Canada
		SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	Canada
		SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	Canada
		SRE Belle River GP Holdings Inc	Canada
		SRE NK1 EPC GP Inc	Canada
		SRE NK1 EPC LP	Canada
		SRE Summerside Construction GP Inc.	Canada
		SRE Summerside Construction LP	Canada
		Monument Power, LLC	USA
		PLL Holdings LLC	USA
		Grand Renewable Solar GP Inc.	Canada
		KINGSTON SOLAR GP INC.	Canada
		SP Armow Wind Ontario GP Inc	Canada
		South Kent Wind GP Inc.	Canada
		Grand Renewable Wind GP Inc.	Canada
		North Kent Wind 1 GP Inc	Canada
		SP Belle River Wind GP Inc	Canada
		Samsung Solar Energy 1 LLC	USA
		Samsung Solar Energy 2 LLC	USA
		Samsung Solar Energy 3, LLC	USA
		CS SOLAR LLC	USA
		5S ENERGY HOLDINGS, LLC	USA
		SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	Germany
		POSS-SLPC, S.R.O	Slovakia
		Solluce Romania 1 B.V.	Romania
		S.C. Otelinox S.A	Romania
		WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	Malaysia
		Samsung Chemtech Vina LLC	Vietnam
		Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Thailand
		Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	Malaysia
		S&G Biofuel PTE.LTD	Singapore
		PT. Gandaerah Hendana	Indonesia
		PT. Inecda	Indonesia
		VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	Bangladesh
		Vista NEXT Limited	Bangladesh
		WELVISTA COMPANY LIMITED	Vietnam
		SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	Philippines
		SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	China
		Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	China

		Samsung Japan Corporation	Japan
		Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	Japan
		Samsung Electronics America, Inc.	USA
		Samsung Electronics Canada, Inc.	Canada
		Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Electronics Ltd.	United Kingdom
		Samsung Electronics (UK) Ltd.	United Kingdom
		Samsung Electronics Holding GmbH	Germany
		Samsung Electronics Iberia, S.A.	Spain
		Samsung Electronics France S.A.S	France
		Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Hungary
		Samsung Electronics Italia S.P.A.	Italy
		Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	Netherlands
		Samsung Electronics Benelux B.V.	Netherlands
		Samsung Electronics Overseas B.V.	Netherlands
		Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	Poland
		Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	Portugal
		Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Sweden
		Samsung Electronics Austria GmbH	Austria
		Samsung Electronics Slovakia s.r.o	Slovakia
		Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Netherlands
		Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
		Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
		Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Asia Pte. Ltd.	Singapore
		Samsung India Electronics Private Ltd.	India
		Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	India
		Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	Australia
		PT Samsung Electronics Indonesia	Indonesia
		Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Thailand
		Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	Malaysia
		Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
		Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	China
		Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	China
		Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
		Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	China
		Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	China
		Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	China

		Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	China
		Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	China
		Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Utd.Arab Emir.
		Samsung Electronics Egypt S.A.E	Egypt
		Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	South Africa
		Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Panama
		Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Brazil
		Samsung Electronics Argentina S.A.	Argentina
		Samsung Electronics Chile Limitada	Chile
		Samsung Electronics Rus Company LLC	Russian Fed.
		Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	Russian Fed.
		Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	China
		Samsung Biologics America, Inc.	USA
		Samsung Bioepis United States Inc.	USA
		SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	United Kingdom
		Samsung Bioepis NL B.V.	Netherlands
		Samsung Bioepis CH GmbH	Switzerland
		Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	Poland
		SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	Australia
		SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	New Zealand
		Samsung Biopeis TW Limited	Taiwan
		Samsung Bioepis HK Limited	Hong Kong
		SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	Israel
		SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	Brazil
		Intellectual Keystone Technology LLC	USA
		Samsung Display America Holdings, Inc	USA
		Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii	Slovakia
		Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Display Noida Private Limited	India
		Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	China
		Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	China
		Novaled GmbH	Germany
		SEMES America, Inc.	USA
		SEMES (XIAN) Co., Ltd.	China
		NeuroLogica Corp.	USA
		Samsung HVAC America, LLC	USA
		SmartThings, Inc.	USA
		Samsung Oak Holdings, Inc.	USA
		Joyent, Inc.	USA
		TeleWorld Solutions, Inc.	USA
		Samsung Semiconductor, Inc.	USA

		Samsung Research America, Inc	USA
		Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	USA
		Samsung International, Inc.	USA
		Harman International Industries, Inc.	USA
		Samsung Federal, Inc.	USA
		Samsung Austin Semiconductor LLC.	USA
		AdGear Technologies Inc.	Canada
		SAMSUNG NEXT LLC	USA
		SAMSUNG NEXT FUND LLC	USA
		Samsung Mexicana S.A. de C.V	Mexico
		Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	Mexico
		eMagin Corporation	USA
		Harman International Japan Co., Ltd.	Japan
		Harman International Industries Canada Ltd.	Canada
		Harman Becker Automotive Systems, Inc.	USA
		Harman Professional, Inc.	USA
		Harman Connected Services, Inc.	USA
		Harman Financial Group LLC	USA
		Roon Labs, LLC	USA
		Harman Belgium SA	Belgium
		Harman France SNC	France
		Red Bend Software SAS	France
		Harman Inc. & Co. KG	Germany
		Harman KG Holding, LLC	USA
		Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	Italy
		Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Mauritius
		Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Harman International Estonia OU	Estonia
		Harman Singapore Pte. Ltd.	Singapore
		Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
		Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
		Harman Connected Services Engineering Corp.	USA
		Harman Connected Services AB.	Sweden
		Harman Connected Services UK Ltd.	United Kingdom
		Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	India
		Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Mauritius
		Harman International (India) Private Limited	India
		Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Samsung Semiconductor Europe Limited	United Kingdom
		Samsung Semiconductor Europe GmbH	Germany
		Samsung Electronics GmbH	Germany

		Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	Czech Republic
		SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	Latvia
		Samsung Electronics West Africa Ltd.	Nigeria
		Samsung Electronics East Africa Ltd.	Kenya
		Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	Saudi Arabia
		Samsung Electronics Israel Ltd.	Israel
		Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	Tunisia
		Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	Pakistan
		Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	South Africa
		Samsung Electronics Turkiye	Turkiye
		Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	Turkiye
		Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	Israel
		Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	Jordan
		Samsung Electronics Maghreb Arab	Morocco
		Samsung Electronics Venezuela, C.A.	Venezuela
		Samsung Electronics Peru S.A.C.	Peru
		Samsung Electronics Ukraine Company LLC	Ukraine
		Samsung R&D Institute Ukraine	Ukraine
		Samsung R&D Institute Rus LLC	Russian Fed.
		Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Kazakhstan
		Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	Azerbaijan
		Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	Uzbekistan
		Corephotonics Ltd.	Israel
		Samsung Nanoradio Design Center	Sweden
		Harman Professional Denmark ApS	Denmark
		Studer Professional Audio GmbH	Switzerland
		Martin Professional Japan Ltd.	Japan
		Harman International Romania SRL	Romania
		Apostera UA, LLC	Ukraine
		Harman Becker Automotive Systems GmbH	Germany
		Harman Deutschland GmbH	Germany
		Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Hungary
		Harman RUS CIS LLC	Russian Fed.
		Harman Holding Gmbh & Co. KG	Germany
		Harman Management Gmbh	Germany
		Harman Hungary Financing Ltd.	Hungary
		Harman Connected Services OOO	Russian Fed.
		Harman Professional Kft	Hungary
		Harman Consumer Nederland B.V.	Netherlands
		Red Bend Ltd.	Israel
		Harman International Industries Limited	United Kingdom

		AKG Acoustics Gmbh	Austria
		Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Spain
		Harman Holding Limited	Hong Kong
		Harman Finland Oy	Finland
		Harman Connected Services GmbH	Germany
		Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Poland
		Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	China
		Harman International Industries PTY Ltd.	Australia
		Harman Connected Services Morocco	Morocco
		Samsung Electronics Switzerland GmbH	Switzerland
		Samsung Electronics Romania LLC	Romania
		SAMSUNG Zhilabs, S.L.	Spain
		Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	Italy
		Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	Poland
		Samsung Electronics Greece S.M.S.A	Greece
		Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	Netherlands
		FOODIENT LTD.	United Kingdom
		Samsung Denmark Research Center ApS	Denmark
		Samsung Cambridge Solution Centre Limited	United Kingdom
		Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	Japan
		Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Singapore
		Samsung Electronics New Zealand Limited	New Zealand
		Samsung Electronics Philippines Corporation	Philippines
		Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	Bangladesh
		Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	Nepal
		Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	India
		PT Samsung Telecommunications Indonesia	Indonesia
		Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	Laos
		iMarket Asia Co., Ltd.	Hong Kong
		Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	China
		Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	China
		Samsung R&D Institute China-Shenzhen	China
		Beijing Samsung Telecom R&D Center	China
		Samsung Electronics China R&D Center	China
		Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	China
		Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	China
		Harman (China) Technologies Co., Ltd.	China
		Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	China

		Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	China
		Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	USA
		Samsung Electronica Colombia S.A.	Colombia
		Samsung Electronics Panama. S.A.	Panama
		Samsung SDI Japan Co., Ltd.	Japan
		Samsung SDI America, Inc.	USA
		Samsung SDI Hungary., Zrt.	Hungary
		Samsung SDI Europe GmbH	Germany
		Samsung SDI Battery Systems GmbH	Austria
		Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	Malaysia
		Samsung SDI India Private Limited	India
		Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
		Samsung SDI China Co., Ltd.	China
		Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	China
		Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	China
		STARPLUS ENERGY LLC.	USA
		SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	China
		Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	China
		Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	Japan
		Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	USA
		Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Electro-Mechanics GmbH	Germany
		Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	Philippines
		Calamba Premier Realty Corporation	Philippines
		Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Singapore
		Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	India
		Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
		Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	China
		Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	China
		Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
		Batino Realty Corporation	Philippines
		Samsung Fire & Marine Management Corporation	USA
		SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	United Kingdom
		PT. Asuransi Samsung Tugu	Indonesia
		SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	Vietnam
		Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	Singapore
		삼성재산보험 (중국) 유한공사	China

		Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	Utd.Arab Emir.
		Camellia Consulting Corporation	USA
		Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	India
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	Malaysia
		삼성중공업(영성)유한공사	China
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	Nigeria
		Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	Mozambique
		Samsung Heavy Industries Rus LLC	Russian Fed.
		SHI - MCI FZE	Nigeria
		Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	Thailand
		Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	China
		Samsung Asset Management (New York), Inc.	USA
		Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	USA
		Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Asset Management(London) Ltd.	United Kingdom
		Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
		Samsung C&T Japan Corporation	Japan
		Samsung C&T America Inc.	USA
		Samsung E&C America, INC.	USA
		Samsung Renewable Energy Inc.	Canada
		Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	USA
		Samsung C&T Lima S.A.C.	Peru
		Samsung C&T Deutschland GmbH	Germany
		Samsung C&T U.K. Ltd.	United Kingdom
		Samsung C&T ECUK Limited	United Kingdom
		Whessoe engineering Limited	United Kingdom
		SAM investment Manzanilo.B.V	Netherlands
		Samsung C&T Corporation Poland LLC	Poland
		Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	Malaysia
		Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	Malaysia
		Erdsam Co., Ltd.	Hong Kong
		Samsung C&T India Private Limited	India
		Samsung C&T Corporation India Private Limited	India
		Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Singapore
		SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	Mongolia
		Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	Mongolia
		S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	Philippines

		VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	Vietnam
		Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Singapore
		CHEIL HOLDING INC.	Philippines
		Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	Australia
		Samsung C&T Hongkong Ltd.	Hong Kong
		Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
		SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	China
		Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	China
		SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	Saudi Arabia
		SAM Gulf Investment Limited	Utd.Arab Emir.
		Samsung C&T Chile Copper SpA	Chile
		SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	Chile
		Samsung C&T Corporation Rus LLC	Russian Fed.
		CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	Italy
		Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	China
		SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
		Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	Malaysia
		WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
		Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	China
		Shanghai Welstory Food Company Limited	China
		LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	USA
		PENGTAI CHINA CO.,LTD.	China
		PengTai Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
		PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	China
		Beijing Pengtai Borui E-commerce Co.,Ltd.	China
		Medialytics Inc.	China
		Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	China
		iMarket China Co., Ltd.	China
		Samsung Securities (America), Inc.	USA
		Samsung Securities (Europe) Limited.	United Kingdom
		Samsung Securities (Asia) Limited.	Hong Kong
		Samsung SDS America, Inc.	USA
		SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	Canada
		Samsung SDS Europe, Ltd.	United Kingdom
		Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	Hungary
		Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	Slovakia
		Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	Poland
		Samsung GSCL Sweden AB	Sweden
		Samsung SDS Global SCL France SAS	France
		Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	Italy
		Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	Spain

		Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Netherlands
		Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	Germany
		Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	Romania
		Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	Singapore
		Samsung Data Systems India Private Limited	India
		Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	Indonesia
		Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	Philippines
		Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	Thailand
		SAMSUNG SDS MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
		SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd.	Australia
		SDS-ACUTECH CO., Ltd.	Thailand
		ALS SDS Joint Stock Company	Vietnam
		SDS-MP Logistics Joint Stock Company	Vietnam
		Samsung SDS China Co., Ltd.	China
		Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
		SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	Egypt
		Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	South Africa
		Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	Turkiye
		Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	Utd.Arab Emir.
		Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda.	Brazil
		INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung SDS Rus Limited Liability Company	Russian Fed.
		Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	Mexico
		Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	Panama
		Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	Chile
		Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	Peru
		Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	Colombia
		Samsung Engineering America Inc.	USA
		Samsung Project Management Inc.	Canada
		Samsung Engineering Hungary Ltd.	Hungary
		Samsung Engineering Italy S.R.L.	Italy
		Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Malaysia
		PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	Indonesia
		Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
		Samsung Engineering India Private Limited	India
		Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Engineering Global Private Limited	India
		Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	China
		Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	China

		Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Saudi Arabia
		Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	Bahrain
		Muharraq STP Company B.S.C.	Bahrain
		Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Utd.Arab Emir.
		Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	Trinidad,Tobago
		Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	Mexico
		Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Engineering Bolivia S.A	Bolivia
		Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	Kazakhstan
		SEA Construction, LLC	USA
		SEA Louisiana Construction, L.L.C.	USA
		Samsung EPC Company Ltd.	Saudi Arabia
		Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Utd.Arab Emir.
		Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	Mexico
		S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	Hungary
		S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
		Samsung Beijing Security Systems	China
		Pengtai Greater China Company Limited	Hong Kong
		PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	China
		Cheil USA Inc.	USA
		Cheil Central America Inc.	USA
		Iris Worldwide Holdings Limited	United Kingdom
		CHEIL EUROPE LIMITED	United Kingdom
		Cheil Germany GmbH	Germany
		Cheil France SAS	France
		CHEIL SPAIN S.L	Spain
		Cheil Benelux B.V.	Netherlands
		Cheil Nordic AB	Sweden
		Cheil India Private Limited	India
		Cheil (Thailand) Ltd.	Thailand
		Cheil Singapore Pte. Ltd.	Singapore
		CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
		Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Philippines
		CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
		Cheil New Zealand Limited	New Zealand
		Cheil Worldwide Australia Pty Ltd	Australia
		CHEIL CHINA	China

		Cheil Hong Kong Ltd.	Hong Kong
		Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	China
		Cheil MEA FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
		Cheil South Africa (Pty) Ltd	South Africa
		CHEIL KENYA LIMITED	Kenya
		Cheil Communications Nigeria Ltd.	Nigeria
		Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	Jordan
		Cheil Ghana Limited	Ghana
		Cheil Egypt LLC	Egypt
		Cheil Maghreb LLC	Morocco
		Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	Brazil
		Cheil Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
		Cheil Chile SpA.	Chile
		Cheil Peru S.A.C.	Peru
		CHEIL ARGENTINA S.A.	Argentina
		Cheil Rus LLC	Russian Fed.
		Cheil Ukraine LLC	Ukraine
		Cheil Kazakhstan LLC	Kazakhstan
		Samsung Hospitality America Inc.	USA
		Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Singapore
		Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	China
		Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Hong Kong
		HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	China
		Samsung Hospitality U.K. Ltd.	United Kingdom
		Samsung Hospitality Europe GmbH	Germany
		SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	Romania
		Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Hospitality Philippines Inc.	Philippines
		Samsung Hospitality India Private Limited	India
		Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	China
		Iris (USA) Inc.	USA
		Iris Atlanta, Inc.	USA
		89 Degrees, Inc.	USA
		The Barbarian Group LLC	USA
		McKinney Ventures LLC	USA
		Iris Nation Worldwide Limited	United Kingdom
		Iris Americas, Inc.	USA
		Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Pricing Solutions Ltd	Canada
		Iris London Limited	United Kingdom

		Iris Promotional Marketing Ltd	United Kingdom
		Iris Ventures 1 Limited	United Kingdom
		Founded Partners Limited	United Kingdom
		Iris Digital Limited	United Kingdom
		Iris Amsterdam B.V.	Netherlands
		Iris Ventures (Worldwide) Limited	United Kingdom
		WDMP Limited	United Kingdom
		Iris Services Limited Dooel Skopje	Macedonia
		Irisnation Singapore Pte. ltd.	Singapore
		Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	India
		Iris Sydney PTY Ltd	Australia
		Iris Worldwide (Thailand) Limited	Thailand
		Iris Partners LLP	United Kingdom
		Holdings BR185 Limited	Brit.Virgin Is.
		Iris Germany GmbH	Germany
		Founded, Inc.	USA
		Pepper NA, Inc.	USA
		Beattie McGuinness Bungay Limited	United Kingdom
		Cheil Italia S.r.l	Italy
		Cheil Austria GmbH	Austria
		Centrade Integrated SRL	Romania
		Centrade Cheil HU Kft.	Hungary
		Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	Serbia/Monten.
		Experience Commerce Software Private Limited	India
		PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	Indonesia
		Cheil Philippines Inc.	Philippines
		Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	Singapore
		Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	China
		Shilla Retail Limited	Macau
		BNY Trading Hong Kong Limited	Hong Kong
		One Agency FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
		One RX Project Management Design and Production Limited Company	Turkiye
		Iris Korea Limited	United Kingdom
		One RX India Private Limited	India
		ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	Utd.Arab Emir.
		ONE AGENCY PRINTING L.L.C	Utd.Arab Emir.
		Brazil 185 Participacoes Ltda	Brazil
		Iris Router Marketing Ltda	Brazil

3. 타법인출자 현황(상세)

2023년말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 2,469억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득 금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부가액	취득(처분) 수량	취득(처분) 금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
삼성전기㈜	상장	1977.01.01	경영참여	250	17,693	23.7	445,244	-	-	-	17,693	23.7	445,244	11,657,872	450,482
삼성SDI㈜	상장	1977.01.01	경영참여	304	13,463	19.6	1,242,605	-	-	-	13,463	19.6	1,242,605	34,038,860	2,066,047
삼성중공업㈜	상장	1977.09.01	경영참여	125	134,027	15.2	684,879	-	-	353,832	134,027	15.2	1,038,711	15,593,400	-155,600
㈜호텔신라	상장	1979.12.01	경영참여	252	2,005	5.1	166,592	-	-	-35,483	2,005	5.1	131,108	3,006,539	85,978
㈜제일기획	상장	1988.09.01	경영참여	185	29,038	25.2	491,599	-	-	-	29,038	25.2	491,599	2,889,505	190,122
삼성에스디에스㈜	상장	1992.07.01	경영참여	6,160	17,472	22.6	560,827	-	-	-	17,472	22.6	560,827	12,321,025	701,326
삼성바이오로직스㈜	상장	2011.04.21	경영참여	30,000	22,217	31.2	1,595,892	-	-	-	22,217	31.2	1,595,892	16,046,197	857,691
삼성디스플레이㈜	비상장	2012.04.01	경영참여	16,009,547	221,969	84.8	18,509,307	-	-	-	221,969	84.8	18,509,307	65,328,568	8,268,314
스테코㈜	비상장	1995.06.29	경영참여	24,000	2,590	70.0	35,861	-	-	-	2,590	70.0	35,861	132,675	779
세메스㈜	비상장	1992.12.31	경영참여	1,000	2,173	91.5	71,906	-	-	-	2,173	91.5	71,906	2,187,919	58,754
삼성전자서비스㈜	비상장	1998.01.01	경영참여	30,000	6,000	99.3	48,121	-	-	-	6,000	99.3	48,121	795,640	10,348
삼성전자판매㈜	비상장	2000.12.21	경영참여	3,100	1,767	100.0	247,523	-	-	-	1,767	100.0	247,523	1,358,597	2,515
삼성전자로지텍㈜	비상장	1999.04.01	경영참여	76	1,011	100.0	46,669	-	-	-	1,011	100.0	46,669	465,079	16,540
삼성메디슨㈜	비상장	2011.02.16	경영참여	286,384	87,350	68.5	433,026	-	-	31,206	87,350	68.5	464,232	629,302	81,673
㈜삼성글로벌리서치	비상장	1991.05.01	경영참여	320	3,576	29.8	24,942	-	-	-	3,576	29.8	24,942	183,742	203
삼성벤처투자㈜	비상장	1999.11.01	경영참여	4,900	980	16.3	32,073	-	-	213	980	16.3	32,286	199,098	2,185
SVIC 21호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	970	-	-871	-	0	99.0	99	82,411	4,596
SVIC 22호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	49,520	-	-34,650	-	0	99.0	14,870	17,438	-3,932

SVIC 26호 신기술투자조합	비상장	2014.11.07	경영참여	19,800	1	99.0	75,653	-	-14,850	-	1	99.0	60,803	27,631	-7,983
SVIC 28호 신기술투자조합	비상장	2015.02.13	경영참여	7,425	0	99.0	35,486	-	-7,920	-	0	99.0	27,566	337,949	-24,526
SVIC 32호 신기술투자조합	비상장	2016.08.09	경영참여	19,800	1	99.0	143,421	-	-24,057	-	1	99.0	119,364	223,258	-35,160
SVIC 33호 신기술투자조합	비상장	2016.11.11	경영참여	4,950	1	99.0	122,622	-	-10,098	-	1	99.0	112,524	315,348	-9,228
SVIC 42호 신기술투자조합	비상장	2018.11.30	경영참여	4,950	0	99.0	43,477	-	967	-	0	99.0	44,444	33,102	-3,706
SVIC 45호 신기술투자조합	비상장	2019.05.10	경영참여	19,800	2	99.0	191,323	-	-32,577	-	2	99.0	158,746	175,893	-12,472
SVIC 52호 신기술투자조합	비상장	2021.05.17	경영참여	9,900	0	99.0	49,599	-	-	-	0	99.0	49,599	77,174	30,345
SVIC 56호 신기술투자조합	비상장	2021.11.12	경영참여	22,084	0	99.0	32,380	-	24,136	-	1	99.0	56,516	56,070	556
SVIC 57호 신기술투자조합	비상장	2022.08.10	경영참여	14,850	0	99.0	18,860	-	22,631	-	0	99.0	41,491	37,155	-4,393
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2017.03.03	경영참여	500	50,000,000	66.7	50,000	-17,693,020	-17,693	-	32,306,980	66.7	32,307	58,356	15,619
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2020.04.27	경영참여	25,000	50,000,000	62.5	50,000	-	-	-	50,000,000	62.5	50,000	79,856	194
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	비상장	2023.07.27	경영참여	500	-	-	-	-	500	-	500,000	66.7	500	753	-249
㈜희망별숲	비상장	2022.12.26	경영참여	900	180	100.0	900	-	-	-	180	100.0	900	7,255	1,227
㈜레인보우로보틱스	상장	2023.01.12	경영참여	58,982	-	-	-	2,854	58,982	-	2,854	14.8	58,982	132,611	-843
㈜아이마켓코리아	상장	2000.12.07	경영참여	1,900	647	1.9	6,538	-	-	-977	647	1.9	5,560	1,373,717	24,301
㈜케이티스카이라이프	상장	2001.12.01	단순투자	3,344	240	0.5	1,954	-	-	-533	240	0.5	1,421	1,220,732	-109,517
㈜용평리조트	상장	2007.05.11	단순투자	1,869	400	0.8	1,412	-	-	-192	400	0.8	1,220	1,004,552	9,079
에이테크솔루션㈜	상장	2009.11.26	단순투자	26,348	1,592	15.9	12,879	-	-	4,362	1,592	15.9	17,241	269,808	1,359
㈜원익홀딩스	상장	2013.12.18	경영참여	15,411	1,759	2.3	5,972	-	-	-44	1,759	2.3	5,928	1,830,611	-37,468
㈜원익아이피에스	상장	2016.04.01	경영참여	16,214	1,851	3.8	45,811	-	-	17,029	1,851	3.8	62,839	1,084,863	-13,508
㈜동진쎄미켐	상장	2017.11.01	경영참여	48,277	2,468	4.8	73,913	-	-	21,594	2,468	4.8	95,507	1,606,588	123,534
솔브레인홀딩스㈜	상장	2017.11.01	경영참여	30,752	462	2.2	10,989	-462	-15,515	4,526	-	-	-	-	-
솔브레인㈜	상장	2020.07.01	경영참여	24,866	373	4.8	81,357	64	15,515	36,079	437	5.6	132,951	996,470	129,491

㈜에스앤에스텍	상장	2020.08.14	경영참여	65,933	1,716	8.0	45,220	-	-	32,520	1,716	8.0	77,740	256,771	25,855
와이아이케이㈜	상장	2020.08.14	경영참여	47,336	9,602	11.7	26,933	-	-	20,932	9,602	11.7	47,864	479,837	13,436
㈜케이씨텍	상장	2020.11.16	경영참여	20,720	1,022	4.9	15,129	-	-	12,267	1,022	4.9	27,395	499,635	31,701
㈜엘오티베큠	상장	2020.11.16	경영참여	18,990	1,268	7.1	14,325	-	-	11,219	1,268	7.1	25,544	366,912	49,060
㈜뉴파워프라즈마	상장	2020.11.16	경영참여	12,739	2,141	4.9	7,579	-	-	3,661	2,141	4.9	11,240	673,589	14,825
㈜에프에스티	상장	2021.03.16	경영참여	43,009	1,523	7.0	23,758	-	-	13,783	1,523	7.0	37,541	412,550	-15,073
㈜디엔에프	상장	2021.08.11	경영참여	20,964	810	7.0	10,692	-	-	8,708	810	7.0	19,400	165,587	5,174
Marvell	상장	2021.10.05	단순투자	11,705	173	0.0	8,130	-	-	5,338	173	0.0	13,468	27,372,028	-1,219,132
한국경제신문㈜	비상장	1987.05.01	단순투자	150	72	0.4	365	-	-	-	72	0.4	365	707,762	33,516
㈜한국비지니스금융대부	비상장	1995.01.01	단순투자	5,000	1,000	17.2	2,964	-	-	-	1,000	17.2	2,964	86,700	1,164
㈜싸이버뱅크	비상장	2000.12.30	단순투자	8,000	1,083	7.5	-	-	-	-	1,083	7.5	-	-	-
화인칩스㈜	비상장	2001.12.01	단순투자	10	2	3.3	10	-	-	-	2	3.3	10	16,450	883
㈜인켈	비상장	2006.11.01	단순투자	130	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	11,123	972
인텔렉추얼디스커버리㈜	비상장	2011.05.13	단순투자	5,000	357	10.7	1,922	-	-	-	357	10.7	1,922	71,809	3,682
㈜말타니	비상장	2012.04.01	단순투자	16,544	45	15.0	7,431	-	-	460	45	15.0	7,891	86,711	750
㈜팬택자산관리	비상장	2013.06.19	단순투자	53,000	53,000	10.0	-	-	-	-	53,000	10.0	-	-	-
㈜인공지능연구원	비상장	2016.07.28	단순투자	3,000	600	14.3	3,000	-	-	-	600	14.3	3,000	4,107	1,832
㈜미코세라믹스	비상장	2020.11.16	경영참여	21,667	747	13.7	29,385	-	-	4,587	747	13.7	33,973	250,981	42,068
㈜신성건설	비상장	2010.07.29	단순투자	1	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	139,416	-9,416
㈜우방	비상장	2010.07.01	단순투자	-	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	514,572	-34,684
㈜삼보컴퓨터	비상장	2012.09.27	단순투자	-	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	49,422	-3,055
대우산업개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	-	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	149,587	-136,767
대우송도개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	-	9	0.0	0	-	-	-	9	0.0	0	19,369	-350
자일자동차판매㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	-	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	196,194	-23,417
성원건설㈜	비상장	2014.04.30	단순투자	-	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	27,744	-627

㈜인희	비상장	2014.04.30	단순투자	-	0	0.1	0	-	-	-	0	0.1	0	2,418	177
포인트애니빔㈜	비상장	2019.12.26	단순투자	61	12	3.5	61	-12	-61	-	-	-	-	-	-
JNT(반도체펀드)	비상장	2011.02.28	단순투자	1,800	0	24.0	1,758	-	-518	-	0	24.0	1,240	2,173	18
L&S(반도체펀드)	비상장	2012.07.30	단순투자	848	-	7.5	1	-	-	-	-	7.5	1	3,239	2
KTCNP-GC(반도체펀드)	비상장	2013.12.01	단순투자	960	-	3.6	222	-	-222	-	-	-	-	-	-
포스코사회적기업펀드	비상장	2013.12.01	단순투자	600	-	10.0	60	-	-60	-	-	-	-	-	-
베어포트리조트	비상장	2022.04.18	단순투자	-	51	0.5	0	-	-	-	51	0.5	0	115,380	-9,846
SEA	비상장	1978.07.01	경영참여	59,362	492	100.0	17,166,557	-	-	-	492	100.0	17,166,557	41,926,899	509,668
SECA	비상장	1992.08.13	경영참여	3,823	0	100.0	90,922	-	-	-	0	100.0	90,922	1,302,924	75,479
SEDA	비상장	1994.01.01	경영참여	13,224	77,205,709	87.0	647,620	-	-	-	77,205,709	87.0	647,620	5,542,627	333,812
SEM	비상장	1995.07.01	경영참여	3,032	3,837	63.6	165,638	-	-	-	3,837	63.6	165,638	2,153,032	148,873
SELA	비상장	1989.04.01	경영참여	319	40	100.0	86,962	-	-	-	40	100.0	86,962	649,150	45,612
SEASA	비상장	1996.06.01	경영참여	4,696	21,854	98.0	6,779	-	-	-	21,854	98.0	6,779	83,075	18,833
SECH	비상장	2002.12.19	경영참여	597	-	4.1	597	-	-	-	-	4.1	597	524,530	25,826
SEUK	비상장	1995.07.01	경영참여	33,908	109,546	100.0	433,202	-	-	-	109,546	100.0	433,202	2,902,722	185,113
SEL	비상장	1998.12.31	경영참여	8,280	4,393	100.0	-	-	-	-	4,393	100.0	-	7,212	-
SEHG	비상장	1982.02.01	경영참여	28,042	-	100.0	354,846	-	-	-	-	100.0	354,846	438,172	93,092
SEF	비상장	1991.08.21	경영참여	230	2,700	100.0	234,115	-	-	-	2,700	100.0	234,115	1,265,823	65,460
SEI	비상장	1993.05.24	경영참여	862	677	100.0	143,181	-	-	-	677	100.0	143,181	1,053,955	56,071
SESA	비상장	1989.01.01	경영참여	3,276	8,021	100.0	142,091	-	-	-	8,021	100.0	142,091	1,266,167	46,746
SEP	비상장	1982.09.01	경영참여	204	1,751	100.0	37,616	-	-	-	1,751	100.0	37,616	304,248	10,591
SEH	비상장	1991.05.31	경영참여	1,954	753	100.0	650,157	-	-	-	753	100.0	650,157	1,426,079	577,538
SELS	비상장	1991.05.01	경영참여	18,314	1,306	100.0	24,288	-	-	-	1,306	100.0	24,288	1,639,004	4,984
SEBN	비상장	1995.07.01	경영참여	236	539,138	100.0	914,751	-	-	-	539,138	100.0	914,751	1,794,552	140,313
SEEH	비상장	2008.01.01	경영참여	4,214	-	100.0	1,369,992	-	-	-	-	100.0	1,369,992	9,660,481	103,387

SENA	비상장	1992.03.01	경영참여	392	1,000	100.0	69,372	-	-	-	1,000	100.0	69,372	591,101	35,047
SESK	비상장	2002.06.01	경영참여	8,976	-	55.7	263,767	-	-	-	-	55.7	263,767	928,129	83,304
SEPOL	비상장	1996.04.01	경영참여	5,462	106	100.0	78,267	-	-	-	106	100.0	78,267	1,384,273	108,288
SEAG	비상장	2002.01.01	경영참여	40	-	100.0	32,162	-	-	-	-	100.0	32,162	519,776	166,348
SERC	비상장	2006.01.01	경영참여	24,877	-	100.0	188,290	-	-	-	-	100.0	188,290	839,493	40,845
SERK	비상장	2007.07.19	경영참여	4,600	-	100.0	204,555	-	-	-	-	100.0	204,555	1,030,743	64,771
SEO	비상장	1997.01.01	경영참여	120	0	100.0	-10,043	-	-	-	0	100.0	-10,043	1,913	50
SGE	비상장	1995.05.25	경영참여	827	0	100.0	32,836	-	-	-	0	100.0	32,836	1,027,977	-2,365
SEEG	비상장	2012.07.09	경영참여	23	-	0.1	39	-	-	-	-	0.1	39	1,348,469	156,005
SSA	비상장	1998.12.01	경영참여	263	2,000	100.0	32,622	-	-	-	2,000	100.0	32,622	527,416	23,826
SAPL	비상장	2006.07.01	경영참여	793	877,133	100.0	981,483	-	-	-	877,133	100.0	981,483	22,234,942	14,140,195
SME	비상장	2003.05.01	경영참여	4,796	17,100	100.0	7,644	-	-	-	17,100	100.0	7,644	618,803	18,490
SDMA	비상장	1995.03.01	경영참여	21,876	71,400	75.0	18,741	-	-	-	71,400	75.0	18,741	26,388	2,908
SEMA	비상장	1989.09.01	경영참여	4,378	16,247	100.0	103,402	-	-	-	16,247	100.0	103,402	313,767	23,877
SAVINA	비상장	1995.01.17	경영참여	5,839	-	100.0	28,365	-	-	-	-	100.0	28,365	110,276	18,161
SEIN	비상장	1991.08.28	경영참여	7,463	46	100.0	118,909	-	-	-	46	100.0	118,909	1,110,178	170,952
TSE	비상장	1988.01.01	경영참여	1,390	11,020	91.8	279,163	-	-	-	11,020	91.8	279,163	3,039,379	150,510
SEAU	비상장	1987.11.01	경영참여	392	53,200	100.0	111,964	-	-	-	53,200	100.0	111,964	612,161	44,768
SIEL	비상장	1995.08.01	경영참여	5,414	216,787	100.0	75,263	-	-	-	216,787	100.0	75,263	7,738,259	1,153,256
SRI-Bangalore	비상장	2005.05.30	경영참여	7,358	17	100.0	31,787	-	-	-	17	100.0	31,787	430,987	79,895
SJC	비상장	1975.12.01	경영참여	273	1,560	100.0	253,108	-	-	-	1,560	100.0	253,108	1,013,103	-5,381
SRJ	비상장	1992.08.25	경영참여	3,120	122	100.0	117,257	-	-	-	122	100.0	117,257	136,782	1,792
SCIC	비상장	1996.03.01	경영참여	23,253	-	100.0	640,452	-	-	-	-	100.0	640,452	10,222,557	189,887
SEHK	비상장	1988.09.01	경영참여	349	274,250	100.0	79,033	-	-	-	274,250	100.0	79,033	985,438	26,885
SET	비상장	1994.11.01	경영참여	456	27,270	100.0	112,949	-	-	-	27,270	100.0	112,949	1,797,627	56,467

TSEC	비상장	1993.04.01	경영참여	15,064	-	48.2	103,134	-	-	-	-	48.2	103,134	382,260	11,732
SSEC	비상장	1995.04.01	경영참여	32,128	-	69.1	130,551	-	-	-	-	69.1	130,551	636,160	84,614
SESC	비상장	2002.09.01	경영참여	5,471	-	73.7	34,028	-	-	-	-	73.7	34,028	94,528	10,678
TSTC	비상장	2001.03.01	경영참여	10,813	-	90.0	260,092	-	-	-	-	90.0	260,092	646,732	5,167
SSS	비상장	2001.01.01	경영참여	1,200	-	100.0	19,189	-	-	-	-	100.0	19,189	5,262,086	244,210
SCS	비상장	2012.09.19	경영참여	111,770	-	100.0	5,275,760	-	-	-	-	100.0	5,275,760	15,808,283	877,892
SSCX	비상장	2016.04.25	경영참여	1,141	-	100.0	1,141	-	-	-	-	100.0	1,141	854,932	47,820
SESS	비상장	1994.12.30	경영참여	18,875	-	100.0	504,313	-	-	-	-	100.0	504,313	869,225	95,067
TSLED	비상장	2012.04.01	경영참여	119,519	-	100.0	119,519	-	-	-	-	100.0	119,519	257,820	16,380
SSCR	비상장	2006.09.01	경영참여	3,405	-	100.0	9,332	-	-	-	-	100.0	9,332	89,911	16,465
TSST Japan	비상장	2004.03.29	경영참여	1,639	30	49.0	-	-	-	-	30	49.0	-	232,877	-
STE	비상장	1996.01.01	경영참여	4,206	2	49.0	-	-	-	-	2	49.0	-	7,405	-
Semiconductor Portal Inc.	비상장	2002.12.01	단순투자	38	0	1.2	10	-	-	-	0	1.2	10	2,016	9
Nanosys Inc.	비상장	2010.08.13	단순투자	4,774	2,000	0.6	1,082	-	-	-1,082	2,000	0.6	-	55,449	-164,399
One-Blue, LLC	비상장	2011.07.14	경영참여	1,766	-	16.7	1,766	-	-	-	-	16.7	1,766	25,051	563
TidalScale Inc.	비상장	2013.08.12	단순투자	1,112	2,882	4.3	1,112	-2,882	-	-1,112	-	-	-	-	-
Sentiance NV	비상장	2012.12.01	단순투자	3,422	7	7.2	3,422	-	-	-	7	7.2	3,422	5,015	-10,711
Mantis Vision Ltd.	비상장	2014.01.16	단순투자	1,594	355	2.1	1,980	-	-	-1,980	355	2.1	0	14,234	14
Leman Micro Devices SA	비상장	2014.08.14	단순투자	1,019	17	3.4	1,019	-	-	-1,019	17	3.4	0	1,868	-3,111
Sensifree LTD	비상장	2016.01.01	단순투자	2,111	666	9.5	2,111	-	-	-2,111	666	9.5	0	473	-1,552
Unispectral Ltd.	비상장	2016.02.29	단순투자	1,112	2,308	7.9	2,130	-	-	-1,327	2,308	7.9	803	5,076	-864
Quobyte, Inc.	비상장	2016.04.28	단순투자	2,865	729	11.8	2,865	-	-	-2,865	729	11.8	0	4,322	1,272
Afero, Inc.	비상장	2016.05.04	단순투자	5,685	723	5.5	5,685	-	-	-	723	5.5	5,685	46,935	-13,857
Graphcore Limited	비상장	2016.06.30	단순투자	3,494	12,000	1.4	3,494	-	-	-425	12,000	1.4	3,069	273,484	-259,662
SoundHound Inc.	상장	2016.12.01	단순투자	7,059	1,703	0.9	3,820	-	-	835	1,703	0.9	4,655	194,857	-116,162

Fasetto, Inc.	비상장	2019.01.29	단순투자	6,701	475	5.2	12,554	-	-	-12,554	475	5.1	0	5,160	-8,899
합 계					-	-	58,761,857	-17,693,458	-36,361	521,446	-	-	59,246,942	-	-

※ 별도재무제표 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 최초취득일자의 날짜는 일부 과거 취득시 자료 확보가 현실적으로 곤란한 경우 일괄적으로 1일로 기재하였습니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.

※ 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여, 성원건설㈜은 2016년 12월 31일, 대우송도개발㈜는 2017년 12월 31일, Mantis Vision은 2021년 12월 31일, Nanosys,Sentiance, Leman Micro Devices, Sensifree, Afero, Graphcore는 2022년 12월 31일, One-Blue는 2023년 3월 31일, ㈜인켈, Unispectral은 2023년 9월 30일, Quobyte는 2023년 10월 31일현재의 재무 현황을 기재하였습니다.

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상디스플레이	Neo QLED 8K (2021.03. ~2023.03.)	□ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65・75・85") - QN900 (65・75・85") / QN800 (65・75・85") / QN700 (55・65・75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실제를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - 'OTS Pro(Object Tracking Sound Pro)' 기능 추가
		Neo QLED 4K (2021.03. ~2023.03.)	□ Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43・50・55・65・75・85・98") □ Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 계조 표현력 4배 향상으로 밝고 어두운 영역을 더욱 자세하게 표현
		OLED TV (~2023.08.)	□ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55・65・77") - S95 (55・65・77") / S90 (55・65・77") - Quantum Dot 기반 self-emitting Display 고화질과 Sleek한 Blade Slim Design에 OTS 및 True Ch. ATMOS 까지 모두 적용된 진정한TV 가치를 제공하는 QD-Display TV □ White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (83") - S90 (83") - Neo QLED 外, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 內 포지셔닝 확대를 위해 자발광 디스플레이 특성 활용, 최박부 Slim함을 강조한 Laser Slim Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
		QLED TV (~2023.03.)	□ Flat QLED 4K TV (43・50・55・ 60・65・70・75・82・85・98") - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar 3.0을 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대
		UHD TV (~2023.03.)	□ Flat UHD TV (43・50・55・ 58・60・65・70・75・82・85") - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Home, IoT Hub, Watch/Chat together 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화
		Lifestyle TV (~2023.04.)	□ The Sero (43") - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32・43・50・55・65・75・85") - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 명화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용 - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 □ The Serif (43・49・55・65") - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화

			- 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 □ The Terrace (55・65・75") - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 □ The Premiere (100~130") - 초단초점・레이저・고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질・음질을 제공하는 프로젝터 □ The Freestyle (30～100") - 언제 어디서나 다양한 컨텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
		Micro-LED TV (~2023.12.)	□ The Wall 2.0 (110") - Tech. leadership 및 Micro-LED 시장 장악력 강화하기 위해 Micro-LED 완품형 출시 - 실제 세상을 화면에 재현하는 초대형 Home Screen - 해상도 제약없이, 실제를 보는 듯한 공간감 및 깊이감/입체감 있는 Micro-LED 화질 □ Micro-LED Screen (76・89・101・114") - 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족 시켜 주는 차세대 Flagship 모델 - TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시 - MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현
		Sound Bar (~2022.03.)	□ Sound Bar - TV와 조화로운 'Bar' 형태의 오디오 제품 - 음성 인식 AI Solution 채용 - 3D 서라운드 채용으로 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현 □ Sound Bar Q990B - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재
		모니터 (2021.01. ~2023.09.)	□ 스페이스 모니터 - 모니터가 차지하는 공간을 최소화한 일체형 Arm Stand 적용 □ Neo QLED 게이밍 모니터(49") - Neo QLED를 적용하여 향상된 명암비를 기반으로 블랙 표현력 강화 - 세계 최고 곡률 1000R을 적용하여 게이밍 몰입 강화 □ 고해상도 QHD 모니터(34") - Intelligent Eye Care 솔루션 등으로 눈에 편안한 화질 솔루션 제공 □ LCD 스마트 모니터: 스마트 TV 서비스를 활용하여 PC 없이 VOD 시청 (Netflix, Youtube 등) □ 스마트 모니터 M80B (32") - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) □ 게이밍 모니터 G85NB (32") - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) □ 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공

			- 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 □ QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 □ 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈 보호하는 Matte Display - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' □ DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57") - 신규 57"초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공 - 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
		사이니지 (~2023.06.)	□ LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall, Outdoor 등) (13・24・32・43・49・50・55・65・75・85・98") □ LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 □ 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항균 코팅 □ FLIP-Edu (75 / 85") 교육용 인터렉티브 제품
	생활가전	냉장고 (~2023.10.)	□ 1-Door Premium Kitchen Fit 냉장고 (냉동/냉장/김치/와인) - Premium Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용 - Auto Door Open - Water & Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Dual Auto Ice Maker(Cocktail Ice, Standard Ice) □ 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입 - 빌트인 패키지 라인업 확대 - 신규격 기준 에너지 최고등급 구현 - 간냉식 용량 우위 확보 - 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화 □ 북미 48"냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응 - 빌트인 27.4cf 대용량 구현 - Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker) - Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화 □ 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가) □ 한국 4Door 김치냉장고 도입 - 식재료 소분 저장/저온 숙성 가능한 별도 공간 제공 (김치숙성, 육류해동, 반죽발효등 다양한 모드로 활용성 강화) - 개정 에너지 규격 기준 1등급 고효율 모델 도입
		세탁기 (~2023.10.)	□ Agitator 세탁기 - 북미 Agitator 신규 시장 진입(Top Loader 시장 중 50% 점유) - ActiveWave™ Agitator 구현으로 소음, 진동 및 엉킴 줄이는 동시에 강력 세탁 가능 - 'Active Water Jet' 구현으로 애벌 세탁 가능 □ 구주향 친환경 신냉매 건조기 - 친환경 냉매 : 온실가스감축을 위한 친환경 냉매(R290) 적용 - 에너지 A+++ : 구주 에너지 최고 등급 달성

			- Sensor Dry : 건조행정 중 건조도 감지, 추가 건조부터 행정 종료까지 알아서 판단 - Simple UX : 제품 사용성 개선 (상세한 건조 정보 전달 및 맞춤형 패널 설정) - Hygiene Care : 유해 세균3종(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 99% 이상 살균 □ 그랑데 AI 24kg 세탁기 - 24kg, Flat Design (Glass Type) - 펫케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알러젠 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) □ BESPOKE 그랑데 AI 20kg 건조기 - 국내최초 최대 용량 20kg, Flat Design - 펫케어 코스 적용(털제거 특화), - Auto open door 적용(건조 종료 후 자동으로 문 열림) - 온/습도 센서추가하여 세탁실 주변 습도 감지하여 제습 솔루션 제공 □ BESPOKE 그랑데AI 원바디 Top-Fit - 한국향 BESPOKE 그랑데AI 일체형 Washer - 세탁기(21kg)와 건조기(17kg) 일체형 원바디 디자인 - 심플한 플랫 디자인
		에어컨 (~2023.08.)	□ BESPOKE 윈도우핏 에어컨(17㎡, 그린/블루/핑크/베이지/그레이) - 실내외기 일체형으로 셀프 간편 설치 - 2중 바람 날개로 냉기를 빠르게 순환하는 강력 회전 냉방 - 트윈 인버터 컴프레서로 도서관 수준의 37dB 저소음&저진동 - 저소음 모드 사용 시 소비전력 최대70% 절전 □ 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대 - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 □ BESPOKE 무풍에어컨 윈도우핏 - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨 - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엣지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A))
		청소기 (~2023.09.)	□ BESPOKE 제트 스틱 청소기(최고 흡입력 210W) - 일체형 자동 먼지배출기, 스마트한 정보전달(LCD Display) - 물분사 물걸레 브러시, 슬림 융 브러시 □ 제트봇 AI 로봇 청소기 - Active 3D 센서 개발 및 세계최초 적용하여 세계 최소(1㎠) 감지 실현으로 걸림 없는 주행 - 우리집 구조과 사물 종류까지 인식하는 AI 자율주행

			- 제트 싸이클론과 디지털 인버터모터로 강력한 흡입력 - 충전과 동시에 자동 먼지비움 일체형 청정스테이션 - SmartThings로 더욱 편리해진 청소(AI 스마트컨트롤) □ BESPOKE 슬림 스틱 청소기 - 강력한 싸이클론과 디지털 인버터모터로 최대 150W 흡입력 - 셀프 스탠딩 및 허리 부담없이 간편 먼지 비움(POP & SHOOT) - 손목에 무리없이 가볍게 청소(인체공학 설계) □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소
		조리기기 (2021.03.)	□ BESPOKE 큐커(Qooker) - 열원이나 온도/시간이 다른 식품을 한번에 맞춤 조리하는 "멀티쿡" - Multi Cook: 하나 이상의 조리가 동시에 완료되어지는 모드 적용 - 식품사(8개 회사)와 연계 큐커 전용 알고리즘 적용 - SmartThings 연계 스캔 한번으로 쉽게 자동 조리 구현 - 열효율 및 고급감 STS 조리실: 법랑 → STS 적용
		렌지후드 (2022.02.)	□ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대 - 기존 제품과의 성능 차별화 ・트리플 센서를 탑재하여 상시배기 시스템으로 최적의 풍량 운전 ・업계 최고 흡입력 780CMH 구현, 업계 최저 소음 (29dB, Quiet Mark 인증) - 전기레인지와 연동 및 스테인리스 필터에 이지 클린 코팅 적용으로 사용편의성 개선 - 소비자의 다양한 니즈 반영한 디자인(비스포크 컬러) - Easy Install 및 설치 프로세스 도입으로 B2C 시장 진입
		정수기 (2021.03.)	□ 가정용 Water Purifier - 소비자 라이프스타일에 따라 업그레이드하고 스스로 케어하는 모듈형 정수기 - 소비자 Needs에 따라 선택 가능한 모듈(정수/냉수/온수) - Smart AI 케어 및 직수형 최다항목 NSF 인증 필터 - 라이프 스타일과 공간 맞춤 『BESPOKE 정수기』
		의류관리기 (2021.05.)	□ 슈드레서 - 에어워시와 UV 냄새분해필터로 강력 탈취 - 매일 신는 신발 기분좋게 저온섬세 건조 - 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 99.9% 살균 - 제트슈트리로 다양한 신발 맞춤케어 관리
		인버터 제습기 (2022.05.)	□ 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 - 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습 - 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어 - 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조 - 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈 - 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드
		식기세척기 (2022.06.)	□ 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 - 구주 시장 Tall Tub 대응

			- 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보 - 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화 - Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화
		가스오븐 (~2023.08.)	□ 북미 Dacor 48" Pro-Range - 48" all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용 - 7" Pop-up display 적용 □ 북미 Dacor 48" Pro-Range (Dual Fuel) - 48" Dual Fuel Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Dual Fuel 연료 형태로 Oven(전기) + Cooktop(가스) - Cooktop부 6 Burners + Griddle 사양 적용 - Small oven 12" (신규 플랫폼), Big oven 36" (기존 플랫폼) 조합 - Steam Assist 기능 제공
	MX	갤럭시 폴더블 (~2023.08.)	□ Galaxy Z Fold3 5G (2021.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 158.2mm x 14.4~16.0mm (펼쳤을 때) 128.1mm x 158.2mm x 6.4mm - Platform(H/W, S/W): SDM888, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 7.6" 인피니티 플렉스 디스플레이 탑재 및 언더 디스플레이 카메라 (Under Display Camera) 적용 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 디스플레이 화면 약 29% 밝기 향상 - 메인 / 커버 디스플레이 모두 120Hz 화면 주사율 지원 - 폴더블폰 최초로 S펜 적용 - 플렉스 모드패널(Flex Mode Panel)로 최적화 되지 않은 앱도 원하는 각도에서 상하단 표시 지원 - 최대 3개 앱까지 화면 분할해 사용하는 멀티 액티브 윈도우 (Multi-Active Windows) 지원
			□ Galaxy Z Flip3 5G (2021.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 72.2mm x 86.4mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 72.2mm x 166mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): SDM888, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 커버 디스플레이 사용성 강화 : 알림/메시지 8줄까지 확인가능, 날씨/걸음수 위젯 지원, 삼성페이 결재 지원 - 플렉스 모드 활용 강화: 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절하는 자동 프레이밍(Auto Framing), 듀얼 프리뷰 (Dual Preview) 등 지원 - 메인 디스플레이120Hz 화면 주사율 지원
			□ Galaxy Z Fold4 (2022.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때)67.1mm x 155.1mm x 14.2~15.8mm (펼쳤을 때)130.1mm x 155.1mm x 6.3mm - Platform(H/W, S/W):Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1 - Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고 - Taskbar제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹 - 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우 - 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능

			□ Galaxy Z Flip4 (2022.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1 - 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공 - 다양한 각으로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원 - 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작 - 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등)
			□ Galaxy Z Fold5 (2023.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 154.9mm x 13.4mm (펼쳤을 때) 129.9mm x 154.9mm x 6.1mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 디자인 구현 : Dumbbell 방식(물방울형) Flex Hinge 적용 - 무게 절감과 두께 축소를 통한 단말 휴대성 및 그립감 향상 - 대화면 최적화를 통한 사용자 경험 개선 ・양손 활용 동작 : 한 손으로 앱/컨텐츠를 선택, 다른 손으로 원하는 동작 실행 ・Taskbar 최적화 : 최근 앱 표시 확대(2→4개), Navigation 영역 자동 확장 ・멀티윈도우 전환 강화 : 홈화면에서 팝업 윈도우를 손쉽게 멀티윈도우로 전환 ・Game 최적화 : 주요 Game에 대한 최적 해상도 사전 확보 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경 - 슬림하고 가벼운 S-Pen과 Case : S-Pen 및 Case 형상 변경으로 두께 및 무게 절감
			□ Galaxy Z Flip5 (2023.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 3.4" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 85.1mm x 15.1 mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.1mm x 6.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 설계 최적화를 통한 커버스크린 확대(1.9" →3.4") - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 및 두께 축소로 그립감 개선 - 대형 커버스크린 활용한 차별화된 사용자 경험 핵심 기능 제공 및 사용성 강화 ・주요 위젯13종(Music, Alarm 等), 주요 앱(삼성Wallet, 메시지 답장), Fast Scroll 기능 제공 ・Quick Setting 6종 →9종 확대(Mobile Data, Screen Recording, Modes 3종) - 대화면 커버스크린을 활용한 다양한 촬영 효과 및 기능 제공 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경
		갤럭시 S (~2023.02.)	□ Galaxy S21 5G・S21+ 5G・S21 Ultra 5G (2021.01.) - Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design - 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8" - 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm, S21 Ultra 5G 75.6 x 165.1 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): SDM888 / Exynos2100, Android 11.0, One UI 3.1 - 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6E 지원, 고화소 카메라 탑재 ・카메라: S21 Ultra 1억 8백만 화소, S21・S21+ 6,400만 화소, Multi Camera Recording 기능 ・최대 120Hz 가변 주사율 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 디스플레이 탑재 ・SmartTag와 연동한 쉬운 사물 등록・찾기 기능 지원 ・Digital Car Key 서비스 지원(S21+ 5G・S21 Ultra 5G only) ・S Pen 지원(S21 Ultra 5G only)

			□ Galaxy S22・S22+・S22 Ultra (2022.02.) - Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality - 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1 /Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1 - 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화 ・동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화 ・저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용 - S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra) - Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra) - All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+) - 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용 - Galaxy Foundation 경험 완성도 제고 ・One UI 4.1: 감성적 Interaction경험과 사용자 개인경험 고도화 ・Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화
			□ Galaxy S23・S23+・S23 Ultra (2023.02.) - Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond * Unrivalled Camera, Ultimate Gaming Eco-conscious Design - 인치 : S23 6.1", S23+ 6.6", S23 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm, S23+ 76.2 x 157.8 x 7.6 mm, 195g S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm, 233g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 강화된 AI기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고 ・AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 ・OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5°→ S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 ・S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 ・조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 ・소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공 ・단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화 - S23 Ultra, 내장된 S-Pen으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공 ・이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안 - 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC) ・폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능 - 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성 ・패키징 박스 100% 재생용지 사용 ・재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(28%) 사이드키 등 ・전/후면 글라스 재생유리 적용(22%), 메탈 가공시 천연염료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등 - Privacy와 Security 강화 ・보안 상태 시각화 / 이미지 공유시 민감 정보 알림 / 제품 수리시 개인 정보 접근 제한
		갤럭시 탭 (~2023.08)	□ Galaxy Tab S7 FE (2021.06.) - 인치 : 12.4" WQXGA (2560 x 1600) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 185mm x 284.8mm x 6.3mm, 610 g - Platform : 5G/LTE SDM750G, WIFI SDM778G - 12.4" 대화면 Display와 slim 베젤로 몰입감 있는 디스플레이

			- 긴 배터리 사용시간(10,090mAh, Up to 13 hours video play) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - Samsung Note 사용성 강화 ・간편하게 손글씨를 TEXT로 변환 ・입력창에 직접 S Pen으로 입력 - PENUP Drawing 기능 강화 ・Layer 구조 적용 및 컬러링 & 라이브 드로잉 제공 - 경량화 키보드 커버 (330g) - 3Mic를 통한 주변 Noise 50% 감소로 깨끗한 보이스 전달 - Device 연결성 강화 ・Second Screen : Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 ・Hand off : Phone에서 사용하던 걸 Tablet에서 바로 이어서 사용 (Internet, Samsung Notes) ・Copy & Paste : Phone과 Tablet 간 Text 및 이미지를 복사 & 붙이기 ・Auto Switching : 자동으로 Phone / Tablet 간 버즈 스위칭
			□ Galaxy Tab A8 (2021.12.) - 인치: 10.5" WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 161.9mm x 246.8mm x 6.9mm, 508 g - Platform(H/W, S/W): UniSOC T618, Android 11, One UI 3 - Memory : 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 4GB + 128GB, microSD 최대 1TB 전작 대비 RAM 4GB 및 ROM 128GB 옵션 신규 제공 - 당사 Tablet Design ID 확립 및 적용 (Samsung Logo, Camera 형상 및 위치, 측면 전후면 대칭), Tab S8 Flagship Family 와 동일 컬러 적용 (Gray, Silver, Pink Gold) - 당사 태블릿 표준 Display 비율 16:10 적용, 10.5"대화면 및 Slim Bezel로 몰입감 있는 멀티미디어 경험 제공 - Dolby Atmos 지원 및 Quad Speaker 탑재, Samsung TV Plus 등 컨텐츠 특화 앱 프리로드 (무료 Live Streaming 및 VOD 제공) - Multi-Active Window 로 2 Split Windows 및 Pop-up 창 지원, Fold3 적용된 Drag & Split 태블릿 최초 지원으로 멀티태스킹 경험 강화 - Tab A 시리즈 최초 Screen Recorder 지원으로 온라인 클래스 활용도 강화 - One UI 3.1.1 Galaxy Experience 확산 지원 (Copy&Paste, Auto Sync, Auto Switch)
			□ Galaxy Tab S8・S8+・S8 Ultra (2022.02.) - 인치 : Tab S8 11" WQXGA+ (2560 x 1600) Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 165.3mm x 253.8mm x 6.3mm, 503g Tab S8+ 185.0mm x 285.0mm x 5.7mm, 567g Tab S8 Ultra 208.6mm x 326.4mm x 5.5mm, 726g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1, Android 12, One UI 4.1 - Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB - 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공 - AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상 - S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancelation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상

			- 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축
			□ Galaxy Tab S9・S9+・S9 Ultra (2023.08.) - 인치 : Tab S9 11"WQXGA (2560 x 1600) Tab S9+ 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S9 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S9 165.8 x 254.3 x 5.9 mm, 498g Tab S9+ 185.4 x 285.4 x 5.7 mm, 581g Tab S9 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.5 mm, 732g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 풍부한 색감과 환경에 적응하는 대화면 경험 제공 ・Tab S9 시리즈 전 모델 선명하면서도 편안한 Dynamic AMOLED 2X 기술 채용 ・햇빛 아래에서도 선명한 화면을 보여주는 Vision Booster 기술 도입 - 어디서나 걱정 없이 사용 가능하도록 이동성 및 신뢰성 확보 ・최상의 방수/방진 인증 등급 IP68 획득 ・충격과 낙하에서 기기를 안전하게 보호하는 Armor Aluminum ・양방향 충전 적용 S-Pen 및 Ruggedized 액세서리 도입으로 사용성 Eco 확대 ・Tab FE 모델군과 키보드 및 액세서리 공용화로 호환성 강화 ・Vapor Chamber를 이용한 양방향 방열 신규 구조 도입 장시간 사용에도 불편함 없이 사용 - 다양한 분야에 걸친 풍성한 Android App Eco 확보 ・필기, 문서, 브라우징 등 생산성 강화 주요 안드로이드 앱 강화 : 삼성노트, 굿노트 등 ・그림, 사진 및 영상 편집 사용성 개선을 위한 주요 앱 확보 : 루마퓨젼, 클립스튜디오 등 - 외관 대형 플라스틱 부위 및 강화 유리 재활용으로 제품 전반에 걸친 친환경 소재 적용 ・S-PEN 부착 부위 대형 재활용 플라스틱 신규 적용 ・디스플레이 강화 유리 신규 재활용 도입 (10%, 고릴라 글래스5) ・패키징 박스 100% 재생 용지 및 재활용 Armor Aluminum 적용(20%), 재활용 플라스틱 내장 자재 사용 등
		갤럭시 A (~2023.10.)	□ Galaxy A52 LTE・5G (2021.03.) - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 75.1mm x 159.9mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM750G(5G) / SDM720G(LTE), Android 11, One UI 3.1 - Supreme smooth UX/Dynamic refresh rate and Brightest (6.5" sAMOLED with 120Hz(5G)/90Hz(LTE), 800nit) - High-resolution 64MP Quad Camera (64M OIS/12M UW/5M Depth/5M Macro) - Powerful AP with High Capacity Battery (4,500mAh)
			□ Galaxy A72 (2021.03.) - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 77.4mm x 165.0mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM720G, Android 11, One UI 3.1 - High refresh Rate Brightest Display (6.7" FHD+ sAMOLED with 90Hz, 800nit) - Advanced High-res/Multi Camera, More detail with blur-less (64M OIS/12M UW/8M Tele/5M Macro) - Long-lasting Battery with bigger capacity (5,000mAh)
			□ Galaxy A32 LTE・5G (LTE: 2021.03., 5G: 2021.01.) - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : LTE 6.4" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080) / 5G 6.5" HD+ TFT (1,600 x 720) - 사이즈(W x H x D) : LTE 73.6mm x 158.9mm x 8.4mm / 5G 76.1mm x 164.2mm x 9.1mm

			- Platform(H/W, S/W) : LTE G80 / 5G D720, Android 11, One UI 3.1 - LTE ・Brightest Display: 800nit Super AMOLED ・High Resolution Camera: 64MP Quad (64M W/8M UW/5M Macro/5M Depth) ・High Capacity Battery: 5,000mAh - 5G ・Rich Camera Experience of 48MP Quad(48M W/8M UW/5M Macro/2M Depth) ・High Capacity Battery: 5000mAh
			□ Galaxy Quantum2 A82 (2021.04.) - 인치 : 6.7" QHD+ (3200 x 1440) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 73.8mm x 161.9mm x 8.1mm, 176g - Platform(H/W, S/W) : SDM855+, Android 11, One UI 3.1 - QRNG 보안칩셋 적용 - 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원 - 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP)
			□ Galaxy A03-Core (2021.12.) - 인치 : 6.5" HD+(720x1600) TFT 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 75.9mm x 164.2mm x 9.1mm, 211g - Platform(H/W, S/W) : UniSOC SC9863A, Android 11(Android GO) ・전작 A01-Core(MT6739) 대비 CPU 성능 향상 - Entry 시장 대응을 위한 대화면/대용량 배터리 적용 초저가 제품 ・전작A01-Core 대비 디스플레이(5.3"→6.5" HD+), 배터리(3,000→5,000mAh) 강화
			□ Galaxy A23 (2022.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원
			□ Galaxy A13 5G (2022.01.) - 인치 : 6.5" HD+ (1600 x 720) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP 성능 강화 (P35 → D700) - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능
			□ Galaxy A13 LTE (2022.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공 - 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능
			□ Galaxy A73 5G (2022.04.) - 인치 : 6.7" FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g - Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1

			- 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A53 5G (2022.04.) - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작比 0.3t↓, 500mAh↑) - 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험 - Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A33 5G (2022.04.) - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz) - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원
			□ Galaxy A23 5G (2022.09.) - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (1080 x 2408) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g - Platform(H/W, S/W) : SDM695, Android 12, One UI 4.1 - SDM695 적용하여 전작(A22-5G D700) 대비 AP 성능 강화 - 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원) - 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" HD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원
			□ Galaxy A14 5G (2023.01.) - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : D700/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.0 - 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP → 13MP) - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			□ Galaxy A54 5G (2023.03.) - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.7 x 158.2 x 8.2mm, 202g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1380, Android 13, One UI 5.1 - AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상 - 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화 - Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공 - Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용) - One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A34 5G (2023.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 120Hz

			- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.1 x 161.3 x 8.2mm, 199g - Platform(H/W, S/W) : D1080, Android 13, One UI 5.1 - 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공 - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공
			□ Galaxy A14 (2023.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850/G80, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			□ Galaxy A24 (2023.05.) - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED U-Cut (1080 x 2340) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.6mm x 162.1mm x 8.3mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G99, Android 13, One UI core 5.1 - 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP →13MP) - 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공 - 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공
			□ Galaxy A05s (2023.10.) - 인치 : 6.7" FHD+ TFT LCD U-cut (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.8mm x 168.0mm x 8.8mm, 194g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 13, One UI core 5.1 - LTE Entry 시장 물량 및 M/S 견인 - 전작 A04S 比 고성능 AP 탑재 (Exynos850 8nm → SDM680 6nm), 고사양 Front Camera 적용 (5MP → 13MP) - Global 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 급속25W 충전 지원 (15W → 25W)
			□ Galaxy A05 (2023.10.) - 인치 : 6.7" HD+ TFT LCD U-cut (720 x 1600) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.2mm x 168.8mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G85, Android 13, One UI Core 5.1 - 6.7" 대화면과 50MP 고화소 카메라 지원으로 향상된 멀티미디어 경험 제공 - 고성능 AP 탑재하여 고객의 제품 사용성 향상 (전작比 CPU 33%↑, GPU 150%) - 25W 고속으로 30분 충전하여 장시간사용할 수 있는 배터리
		갤럭시북 (~2023.02.)	□ Galaxy Book Go (2021.04.) - 인치 : 14" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 323.9mm x 224.8mm x 14.9mm, 1,380 g - Platform : Snapdragon 7C Gen 2, Windows 10 - 언제 어디서나 인터넷이 가능한 LTE 지원 - 휴대에 최적화된 슬림 디자인 (14.9mm 두께) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - 긴 배터리 사용시간 (up to 18 hours battery life) - Tablet, Phone 연결성 강화 ・Quick Share : Phone, Tablet의 파일을 손쉽게 공유 ・Second Screen : Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 ・Galaxy Book Smart Switch : 기존 노트북의 데이터를 간편하게 전송 ・SmartThings : 스마트 기기 연동
			□ Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.)

			- 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg 13.3" 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (12세대), Windows 11 - sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD , Expendable SSD (M.2 2230) - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 ・QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book2 Pro (2022.04.) - 인치 : 15.6" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg 13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (12세대), Windows 11 - AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6" Only, M.2 2280) - WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6"Only) 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 ・QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.) - 인치 : 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : 323.9mm x 224.8mm x 15.5mm - Platform : Snapdragon 7C+ Gen 3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (Snapdragon 7C Gen 2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN →IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 - 보급형 ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원 - MIL-STD-810H 8개 항목 보증 ・Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity
			□ Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.) - 인치 : 13.3" FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS : Snapdragon 8cx Gen 3, Windows 11 Home - AMOLED : 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers : Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD : eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax)

			- Battery : 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem : Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security : 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI : Noise Reduction, Video Call with Neural Engine
			□ Galaxy Book3 Ultra (2023.02.) - 인치 : 16.0" OLED 120Hz, 370nit/500nit, 16:10 (2880 x 1800, 3K) - 사이즈(W x D x H) : 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg, - Intel ® Core™ Processor (13세대), Win 11, LPDDR5, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D AI, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (갤럭시 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 ・Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나, 문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 ・Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 ・Quick Share : 폰/태블릿 등 갤럭시 기기 간 무선 파일 공유
			□ Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.) - 인치 : 16.0" WQXGA+ AMOLED (16:10) 2880 x 1800, Touch Screen, DCI-P3 120%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16.0" 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD - WiFi 6E 지원 - Battery : 76Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book3 Pro (2023.02.) - 인치 : 16" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% 14" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14" 312.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280) - WiFi 6E 지원 - Battery : 16" 76Wh, 14" 63Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등

			- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book3 360 (2023.02.) - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.49kg 13.3" 304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6") - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh, 13.3" 61.1Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
		갤럭시 워치 (~2023.08.)	□ Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic(2021.08.) - 인치: Watch4 : (44mm) 1.4" (450 x 450), (40mm) 1.2" (396 x 396) Watch4 Classic : (46mm) 1.4" (450 x 450), (42mm) 1.2" (396 x 396) - 사이즈(W x H x D) : Watch4 : (44mm) 44.4 x 43.3 x 9.8mm, (40mm) 40.4 x 39.3 x 9.8mm Watch4 Classic : (46mm) 45.5 x 45.5 x 11.0mm, (42mm) 41.5 x 41.5 x 11.2mm - Platform(H/W, S/W) : AP Exynos W920 (5나노 64비트 Dual-Core), Wear OS Powered By Samsung, One UI Watch 버전 3.0 - Memory : 1.5GB RAM + 16GB ROM 탑재하여 성능 개선 및 사용자 가용량 확대 제공 - 330 ppi Display 적용을 통한 가독성 개선 - 체성분 측정 기능 최초 탑재 및 Health 사용성 강화로 차별화 추진 - 산소포화도, 코골이 등 수면 상태 모니터링 강화 - Wear OS 기반 App Eco 확장 및 Phone 연동 경험 강화 ・Play store/구글맵/YT Music 등 구글 주요 서비스 제공 ・최적화된 Fitness 전용 앱 및 다양한 서비스 앱 지원
			□ Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro(2022.08.) - 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g - Platform(H/W, S/W) : Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) - 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인 - 진화된 바이오액티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능 ・체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화 - Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용 - 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro) ・기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/싸이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고 ・마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출 ・경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유 ・트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공

			・큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능
			□ Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic(2023.08.) - 인치 : Watch6 Classic (47mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 Classic (43mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch6 (44mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 (40mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch6 Classic (47mm) : 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g Watch6 Classic (43mm) : 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0 g Watch6 (44mm) : 44.4 x 42.8 x 9.0 mm, 33.3g Watch6 (40mm) : 40.4 x 38.8 x 9.0 mm, 28.7g - Platform(H/W, S/W) : Exynos W930, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) - 시인성 향상을 구현한 디자인과 성능 ・전작 대비 베젤 축소 및 약 20% 넓어진 대화면 구현 ・고해상도 Super AMOLED 디스플레이 탑재 및 최대 2,000니트 밝기 지원 - 강화된 수면 관리 경험 제공 ・수면 점수를 구성하는 요인을 항목별 심층 분석 및 종합하여 수면 점수 제공 ・향상된 맞춤형 수면 코칭 프로그램 제공 - 보다 개인화된 피트니스 관리 기능 등 신기능 추가 ・심폐 역량에 따라 5가지 심박수 구간 측정으로 사용자에 개인화된 운동 가이드 제공 ・트랙 달리기 기능으로 레인 지정 등 트랙 운동 기록 ・불규칙 심장 리듬 알림 기능 적용 - One-Click 밴드 적용으로 보다 쉽고 편리하게 워치 스트랩 교체 - 배터리 용량 확대로 실사용 성능 강화 ・47/44mm 425mAh, 43/40mm 300mAh 적용
		갤럭시 버즈 (~2022.08.)	□ Galaxy Buds Pro (2021.01.) - Design : Intelligent ANC 기능을 갖춘 커널 타입 Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 20.5 x 19.5 x 20.8mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm - Platform(H/W, S/W) : BCM43015, RTOS - 2Way(Woofer + Tweeter) 11mm 스피커 탑재를 통한 사운드 품질 향상 ・3개의 마이크와 가속도 센서 (보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공 ・커널 타입 및 Intelligent ANC 기능 탑재 및 대화감지를 통해 주변소리 듣기로 자동 전환 ・영화관에 온 듯한 공간감을 느낄 수 있는 3D Audio 기능 제공 - IPx7 등급 방수 지원
			□ Galaxy Buds 2 (2021.08.) - 기본기능 강화와 ANC기능 추가로 Buds Mass모델의 경쟁력 강화 - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 17.0 x 20.9 x 21.1 mm (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8 mm - BES2500 ZP-83 (BT + Codec + Flash) 저전력 신규 솔루션 ・ANC 기능 제공 ・음악 재생 총 사용시간 29시간 확보 (Streaming, ANC OFF 기준) - Touch + BT Antenna FPCB 일체형 적용하여 RF 방사 성능 최적화 - Canal형 무선 이어폰 Audio 성능 고도화 ・DNN 활용 통화 잡음 제거 성능 극대화 알고리즘 적용(DNN + 3-Mic +VPU) * DNN : Deep Neural Network , VPU : Voice Pickup Unit ・자연스러운 주변소리듣기 모드 전환 지연 속도 개선(3.2ms→0.65ms) ・Woofer 진동판 신소재 적용을 통한 저역 강화

			・무결점 Mic 단품 도입으로 Mic 노이즈 차단 강화 ・통기홀 밀도 변경 및 FeedBack Mic 관로 개선을 통한 ANC 성능 및 음질 개선 ・Mic 챔버 공간 극대화 및 위치 최적화를 통한 Wind Noise 개선
			□ Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.) - 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm (Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm - Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip솔루션, RTOS ・당사 Buds 최초24bit/48kHz Hi-Fi기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한 고품질 사운드 경험All High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC ・멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는 360 Audio 청취 경험 강화 ・개선된 VPU와 개인화 Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공 - 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공 ・전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기홀 구조를 적용하여 착용감 개선 - Galaxy Device간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 ・오토 스위치 기능 제공을 폰, 태블릿, 워치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환
	네트워크	RAN S/W Package (~2023.11.)	□ SVR21B NR vDU SW Package (2021.06.) - TDD 기반 C-Band vDU ・H/W 변경없이 유연한 기지국Upgrade 및 자원 할당 가능 * vDU(virtual DU): 5G 기지국 기능을 상용 서버 기반의 S/W 개발로 구현 □ vRAN* SW Package (2023.11.) * vRAN(virtualized RAN):가상화 가지국 - 당사 vRAN SW Package에 l社 4세대 CPU 연동 개발로 업계 최초 vRAN 상용망 적용 ・당사는 3세대 CPU를 활용한 vRAN 대규모 상용을 旣완료한데 이어, 4세대 CPU를 적용한 vRAN으로 상용망에서 data call 성공
		기지국 (~2023.05.)	□ MMU Beam Forming SOC 개발 (2021.02.) - MMU 보드 내 Beam Forming FPGA가 수행하는 기능을 SOC로 구현 - 기존 소모 전력의 30% 수준으로 감축(최대 소모전력 40W 이하) □ 미주 ORAN* RU 5종 개발 (2021.09.) - DU-RU간 표준 interface를 정의하여, DU에서 RU 벤더에 상관없이 연동가능 - AWS/PCS, 700/850 4T4R 40W 2종, 320W 2종, C-Band 8T8R 320W □ 북미향 AWS/PCS Dual Band 16T16R FDD MMU (2021.10.) - 당사 최초16T16R FDD Dual Band MMU 상용 제품(자체 개발 Chip 적용) □ 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.) - 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용 * 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어 □ 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04) * RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로 * DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계 □ Dish향 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09) - ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발 * RU 지원 주파수 : n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS: 1.7GHz/1.9GHz) □ Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.) - 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발 - 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선 □ 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.)

			- 국내向 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발 - 기존 국내向 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가 □ 3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.) - 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 - Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국 - 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소형화 □ 북미向 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.) - 1세대 대비 고출력화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발
DS 부문	메모리	모바일용 DRAM (2021.11 ~2023.09.)	□ 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 - 기존 제품 대비 속도 30% 이상, 소비전력 효율 약 20% 개선 - 업계 최선단 14나노 기반, 단일 패키지 용량 64GB까지 확대 가능하여 모바일 외, 서버/Automotive 등 고성능 저전력 메모리 적용 분야 확대 - 퀄컴 스냅드래곤 모바일 플랫폼에 8GB LPDDR5X D램 패키지 탑재해 업계 최고 동작 속도(8.5Gbps) 검증 □ 업계 최초 LPCAMM 개발 - LPDDR 기반 모듈 개발로 PC·노트북 등 차세대 모듈 시장 선도 - SO-DIMM 대비 성능 50%↑ 전력 효율 70%↑ 탑재 면적 최대 60% 이상↓ 가능 및 교체・업그레이드 용이하여 제조 유연성 및 사용자 편의성 증대 - 주요 고객사와 차세대 시스템에서 검증 예정, 2024년 상용화 추진 및 차세대 PC・노트북부터 데이터센터 등으로 응용처 확대 기대
		서버용 DRAM (2021.03. ~2023.09.)	□ 업계 최초 HKMG 공정 적용 고용량 DDR5 메모리 개발 - High-K Metal Gate, 8단 TSV 적용으로 512GB DDR5 모듈 구현 - 기존 공정 대비 약 13% 전력소모 낮추고, 성능은 2배 이상 향상 - 차세대 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨터, 대용량 데이터센터 등에 적용 예정 □ 업계 최선단 12나노급 D램 양산 - 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로 차세대 컴퓨팅 최적화 - 고유전율 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성 - 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해, 다양한 응용처에 공급 예정 □ 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발 - 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만배 확대 - TSV 공정 적용 없이 128GB 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 동일 용량의 모듈 대비 소비 전력 10% 개선 - AI에 최적화된 고용량 D램 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 연내 양산 예정으로AI, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정
		그래픽 DRAM (2022.07. ~2023.07.)	□ 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 - 3세대 10나노급(1z) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D램 개발

			- 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 향상 - 패키지 신소재 적용·회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대
		HBM DRAM (2021.02. ~2023.10.)	□ 세계 최초로 AI 엔진을 탑재한 인공지능 HBM-PIM 개발 - 기존 HBM2 대비 성능 2배 이상 향상, 시스템 에너지 약 70% 이상 감소 - 반도체 분야 최고 권위 학회 ISSCC에서 논문 공개('21.2월) - 기존 메모리 인터페이스 사용으로 별도 시스템 변경없이 적용 가능 - 데이터센터, AI 고객들과 PIM 표준화, 에코 시스템 구축 협력 □ 인공지능 탑재 메모리 제품군 확대 (HBM-PIM 성능 평가결과 및 AXDIMM/LPDDR5-PIM 개발) - 지난 2월 개발한 HBM-PIM 실제 시스템 적용 사례 공개 (자일링스 AI 가속시스템에 탑재시 성능 2.5배, 에너지사용 60% 이상 감소) - D램 모듈에 AI 기능 탑재한 AXDIMM은 기존 대비 성능 2배, 에너지사용 40% 감소 - 모바일 D램과 PIM 기술을 결합한 LPDDR5-PIM 공개 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 감소 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합된 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며, 열전도를 극대화해 열 특성을 또한 개선 - 현재 HBM3 8단, 12단 제품을 양산 중이며, 차세대 제품인 HBM3E도 고객들에게 샘플을 전달 중
		NAND (2022.11.)	□ '8세대 V낸드' 양산 - 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산 - 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보 - 차세대 인터페이스 적용, 2.4Gbps 전송 속도 구현으로 기존대비 성능 1.2배 향상 - 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성을 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대
		eStorage (2022.05.)	□ 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 - UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선 - 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능 - 최신 보안 기술을 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선 - 스마트폰, Automotive 및 VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상
		서버용 SSD (2021.02. ~2022.07.)	□ 데이터센터 전용 고성능 OCP SSD 양산 - 6세대 V낸드로는 업계 최초로 OCP 규격의 SSD 양산 - 데이터센터 업계가 요구하는 성능, 전력효율, 신뢰성, 보안 모두 만족 - 업계 최고 전력효율 특성으로 비용 절감 및 탄소 저감 효과에 기여 □ 업계 최고 성능 SAS 24Gbps 서버용 SSD 양산 - 이전 세대 SSD 대비 약 2배 향상된 속도 지원 - 6세대 V낸드 기반으로 800GB 부터 30.72TB까지 고용량 제공 - 전력효율이 약40% 향상되어 서버 운영 비용 절감 및 탄소 저감 효과 기대 □ 차세대 기업 서버용 ZNS SSD 업계 최초 양산 - 데이터 성격에 따라 구역(Zone)별로 분류하여 저장하는 ZNS 기술 적용 - 기존 SSD 대비 수명연장 및 SSD 용량 최대 활용

			- AI, 빅데이터, IOT등 차세대 서버/스토리지 시스템 효율 제고에 기여 및 다양한 오픈소스 프로젝트 활동으로 ZNS SSD 저변 확대 □ PCIe 5.0 기반 고성능 SSD PM1743 개발 - PCIe 4.0 기반 SSD 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배 및 전력효율 약 30% 개선 - 듀얼포트 지원 및 최신 보안 기술 적용으로 서버 운영 안전성 보장 □ 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발 - 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97% - SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상 - 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응 - 컴퓨테이셔널 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대
		Client SSD (2023.01.)	□ 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 - 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상 - 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상 - DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원
		브랜드 SSD (2021.01. ~2023.11.)	□ 소비자용 SATA SSD 870 EVO 글로벌 출시 - 최신 V낸드, 컨트롤러 탑재, 인텔리전트 터보라이트 기술 적용 - 업계 최고 수준 내구성 보유, 지속성능 30% 이상 향상 - 250GB~4TB까지 5개 모델로, 한국・미국・독일・중국 등 40여개국 순차 출시 □ 성능과 경제성을 모두 만족한 고성능 NVMe SSD 980 출시 - 6세대 V낸드 탑재, SATA SSD 대비 최대 6배 빠른 성능 제공 - 비용을 고려한 DRAMless 설계와 컨트롤러, 펌웨어 최적화 기술 적용 - 하이엔드 제품에 적용되는 열 제어 기능 탑재 - 970 EVO 대비 전력효율 56% 향상, 소비자들 '착한 소비' 가능 □ 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시 - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송 □ 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개 - 최신 V낸드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현 - 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상 - 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공 □ 고성능 SSD '990 PRO' 4TB 출시 - 최첨단 '8세대 V낸드' 적용 및 업계 최고 수준 성능 구현으로 PCIe 4.0 기반 소비자용 SSD 중 가장 빠른 임의 읽기 속도 제공 - 고성능 게임, 3D/4K그래픽 작업 등 초고속 데이터 처리 작업 필요한 환경에 최적화 - 단면 설계, 열 분산 시트/히트싱크 장착으로 호환성, 방열 성능 강화 □ 초고속 포터블 SSD 'T9' 출시 - 최신 데이터 전송 인터페이스 'USB 3.2 Gen2x2' 지원으로 전세대 대비 연속읽기/쓰기 성능 약 2배 향상 - 대용량 파일 전송 시 발생하는 성능 저하, 발열 현상 개선을 위해 표면 소재 개선 및 S/W 최적화 □ 업계 최대 8TB 용량 포터블 SSD 신제품 'T5 EVO' 출시 - USB3.2 Gen1 기반 최대 460MB/s 연속 읽기?쓰기 성능 제공 - 컴팩트한 크기와 무게와 메탈링 적용하여 휴대성 강화 - 과열 방지 기술과 하드웨어 데이터 암호화 기술을 적용
		EUV (2021.10.)	□ 업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산 - EUV 멀티레이어 적용 및 업계 최고 웨이퍼 집적도 구현으로 생산성 약 20% 향상 - DDR4 대비 속도 2배 및 이전 공정 대비 소비전력 약 20% 개선
		CXL (2021.05.	□ 업계 최초 CXL 기반 DRAM 메모리 기술 개발 - 대용량 데이터센터가 요구하는 차세대 메모리 솔루션으로 DRAM 모듈의 물리적 한계 극복,

		~2023.05.)	용량 대역폭의 획기적인 확장 가능 - CXL 컨트롤러를 통해 인터페이스 컨버팅, 에러 관리 등 지원 - 데이터센터, 서버, 칩셋 업체들과 협력으로 CXL DRAM 메모리에 최적화된 컨트롤러, 소프트웨어 기술 개발 □ 업계 최초 CXL 메모리 오픈소스 소프트웨어 솔루션 개발 - 메인 메모리와 CXL 메모리가 최적으로 동작할 수 있도록 지원하여 시스템 메모리의 성능/용량 확장 가능 □ 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발 - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소 □ 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발 - PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는 병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선 - 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서 약 2배 이상 성능이 향상 □ 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발 - D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능 - CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감 - 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응으로 시장 선도
		복합칩 (2021.06.)	□ 업계 최고 성능의 uMCP5(LPDDR5 + UFS3.1) 멀티칩 패키지 양산 - 기존 LPDDR4X 대비 속도 1.5배, UFS2.2 대비 2배 향상 - 중저가 5G 스마트폰까지 탑재하여 5G 대중화 견인
		브랜드 Card (2021.09. ~2023.08.)	□ 성능・안정성을 강화한 마이크로 SD카드 신제품 출시 - 'PRO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.6배, 쓰기 속도 약 1.3배 - 'EVO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.3배 - 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라 4K UHD 영상과 같은 고사양의 컨텐츠를 제작, 고객까지 만족 기대 □ 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시 - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD・4K 고해상도 영상 연속 촬영 □ 속도와 안정성 강화한 메모리카드 'PRO Ultimate' 출시 - UHS-I 규격 최고 수준의 200MB/s 읽기 속도, 130MB/s 쓰기 속도 지원, 기존 대비 전력 효율 37% 향상 및 방수・낙하・마모・엑스레이・온도 등 극한의 외부 환경에서도 데이터 보호 - 전문 포토그래퍼, 크리에이터 및 드론, 액션캠, DSLR 카메라 등 고해상도 콘텐츠 작업에 최적의 SD카드/마이크로SD카드 제공
		Automotive (2021.12. ~2023.10.)	□ Automotive향 메모리 토탈 솔루션 양산 - IVI향 256GB SSD, 2GB DDR4/GDDR6 및 AD향 2GB GDDR6, 128GB UFS - 서버급에 탑재되는 고성능 SSD와 그래픽D램 공급 및 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 안전성 확보(영하 40℃~영상 105℃ 동작보증구간 지원) □ 초저전력 차량용 UFS 3.1 양산 - 업계 최저 소비 전력을 가진 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 양산으로 전기차,자율주행차 등에 최적화 - 전 세대 제품 대비 33% 낮은 소비 전력, 256GB 기준 최대 읽기 속도 2,000MB/s, 최대 쓰기 속도 700MB/s 제공

			- 고객의 다양한 요구 충족을 위한 128GB/256GB/512GB 라인업 구축으로 첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS)용 UFS 3.1 제품과 함께 전장 스토리지 제품 라인업 강화 □ 2025년 전장 메모리 시장 1위 달성을 위한 차량용 핵심 솔루션 공개 - 스토리지 가상화를 통해 하나의 SSD를 분할해 여러 개의 SoC가 사용할 수 있는 'Detachable AutoSSD(탈부착 가능한 차량용 SSD)' 공개, 최대 6,500MB/s의 연속 읽기 속도를 지원하며, 4TB 용량 제공 - 차량용 고대역폭 GDDR7 및 패키지 크기를 줄인 LPDDR5X 등도 선보임
	System LSI	이미지센서 (2021.01. ~2023.12)	□ 1억8백만화소 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시 (HM3, 0.8um/108Mp) - 0.8㎛ 크기 작은 픽셀 1억 8백만개를 '1/1.33인치'에 집적 - '스마트 ISO 프로'로 잔상 최소화, 밝고 선명한 이미지 촬영 가능 - 자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용… 초점 검출 능력 50% 향상 - 설계 최적화로 프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6% 절감 □ 사람 눈과 더욱 가까워진 이미지센서 '아이소셀 GN2' 출시 (GN2, 1.4um/50Mp) - 업계 최초, 픽셀을 대각선 분할하는 '듀얼 픽셀 프로' 적용 - 1.4um 픽셀 구조, 보다 밝고 선명한 이미지 촬영 - 스태거드 HDR, 기존 제품 대비 동작 전력 약 24% 감소 □ 업계 최초 0.64um 픽셀 적용 '아이소셀 JN1' 출시(JN1, 0.64um/50Mp) - 초소형 픽셀 크기 양산, 고화소 모바일 카메라 슬림 디자인 적용 - 어두운 곳에서 촬영 감도 높이는 최첨단 이미지센서 기술 적용 - 카메라 렌즈 모듈사 협력, 1/2.8" 제품과 호환 가능한 생태계 구축 □ 차량용 이미지센서 '아이소셀 오토 4AC' 본격 출시(4AC, 3.0um/1.2Mp) - 서라운드 뷰 모니터, 후방 카메라에 적용 예정 - 극한 환경에서도 운전자 보조, 사각지대를 최소화하는 안전 솔루션 □ 초격차 모바일 이미지센서 신기술 공개(HP1, 0.64um/200Mp 및 GN5, 1.0um/50Mp) - 업계 최초 '2억화소' 벽을 넘어선 '아이소셀 HP1' - 업계 최소 크기의 듀얼 픽셀 이미지셀'아이소셀 GN5' □ 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp) - 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소 - '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - AI기반의 화질처리 솔루션 구현으로 2억화소 화질 해상도 개선 및 5천만 화소 센서 줌 활용도 향상 □ 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp) - 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현 - '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원 □ 업계 최고 성능 자율주행 이미지센서 출시(1H1, 2.1um/8.3Mp) - 전장 120dB HDR, LFM(LED Flicker Mitigation) 및 Motion-Artifact Free 동시 구현 - 인접 픽셀 간섭 방지 DTI(Deep Trench Isolation) 적용, 저조도 SNR 강화 □ '아이소셀 비전 63D' iTOF(indirect Time of Flight) 센서 공개(63D, 3.5um/0.3Mp) - 빛의 파장을 감지해 사물의 3차원 입체 정보를 측정 - 업계 최초 원칩 iTOF 센서… 전작(33D) 대비 시스템 전력 소모량 40% 감소 - 면광원 및 점광원 모드 동시 지원… 최대 측정거리 10미터까지 확장 □ '아이소셀 비전 931' 글로벌 셔터(Global Shutter) 센서 공개(931, 2.2um/0.4Mp) - 사람 눈처럼 모든 픽셀 동시에 빛에 노출해 촬영 … 신속성 및 정확성 증가 - 사용자의 눈동자, 얼굴 표정, 손동작 같은 미세한 움직임 인식 가능

		엑시노스 (2021.01. ~2023.10.)	□ 5G 통합 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시(엑시노스 2100) - 최첨단 5나노 EUV 공정・최신 CPU/GPU 적용, 성능 대폭 향상 - 설계 최적화로 전작 대비 성능 CPU 30%, GPU 40% 이상 개선 - 온디바이스 AI 성능 강화, 초당 26조번 인공지능(AI) 연산 - 소비전력 최대 20% 감소, 자체 전력 관리 솔루션 'AMIGO'도 적용 - 초고주파 대역 5G 통신 지원, 최대 6개 이미지센서 처리 등 □ EUV(Extreme UltraViolet, 극자외선) 공정 기반 웨어러블용 '엑시노스 W920' 출시 - 최신 5나노 EUV 공정 및 설계 기술 적용으로 성능과 전력효율 향상 - 최첨단 패키지 기술을 적용, 웨어러블용 초소형 패키지로 구현 - 최신 ARM 코어 적용, 전세대(Exynos 9110) 대비 CPU 성능 20%, 그래픽 성능 10배 향상 - 저전력 디스플레이용 코어 탑재, AOD(Always On Display) 모드에서 프로세서 전력소모 97% 개선 □ 업계 최초 5G 통신 서비스 제공하는 차량용 통신칩 '엑시노스 오토 T5123' 출시 - 초당 5.1Gb 다운로드 지원, 주행 중에도 끊김없이 고용량・고화질 콘텐츠 이용 가능 - 최신 5G 기반 멀티모드 통신칩 내장돼 5G 단독망 및 LTE 혼합망 모두 지원 □ 차량 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V7' 출시 - 신경망처리장치(NPU), 카메라 센서의 불량화소 및 왜곡 보정 기술, 이미지 압축기술 등 최신 차량용 기술 적용 - 그래픽 장치는 디지털 계기판, 중앙 정보 디스플레이(CID, Center Information Display), 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 독립된 4개 디스플레이 구동 및 최대 12개의 카메라 센서 지원 - 보안 프로세서 탑재해 차량 주요 정보를 안전하게 보관 및 물리적 복제 방지 기술 제공 □ 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시 - AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화 - 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현 - ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화 - NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상 □ 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) - 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영 - 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용 - 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능 □ UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개 - 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능 - 저전력 원칩으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화 - 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용 - UWB 표준 단체 'FiRa 컨소시엄' 국제 공인 인증 □ 최첨단 모바일 AP '엑시노스 2400' 공개 - 업계 최고 수준의 레이 트레이싱 성능, 전작 대비 2.1배 성능 향상 - 향상된 AI성능으로 인터넷 연결없이 온디바이스 생성형 AI 기능 제공 - 비지상 네트워크(NTN : Non-Terrestrial Network) 기술, 엑시노스 최초 탑재
		LSI (2021.01. ~2023.03.)	□ DDR5 D램 모듈용 전략관리반도체(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01) - 차세대 기기 성능향상 및 전력절감에 핵심, 전력관리반도체 3종 - 전력 소비 및 발열 낮추는 자체 기술 적용, 동작 효율 최고 91%까지 향상 - 메모리용 전력관리반도체 라인업 지속확대 및 기술 리더십 강화 □ 차량 인포테인먼트 프로세서용 전력공급반도체(S2VPS01) - 차량용 시스템 안전기준 '에이실-B' 인증 획득, 기능 안전성 강화 - 발열 차단 기능, 자가 진단 기능 등 시스템 안정성 강화 □ 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C)

			- 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합 - 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득, 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증
	Foundry	2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.)	□ 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 □ 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 - 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용 □ 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상
		8나노 RF 공정 (2021.06.)	□ 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 - 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공 □ 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 - 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화 □ 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 - RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소
		2.5D 반도체 패키지 기술 'H-Cube' (2021.11.)	□ 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube' - 인터포저 위에 로직과 고대역폭 메모리(HBM)를 배치, 최대 6HBM 집적 구현 - 하이브리드 기판은 상단의 고사양 메인 기판이 로직/메모리 칩을 연결하고, 대면적 구현이 용이한 하단의 보조 기판이 시스템 보드 연결을 전담하는 이중 구조 - 두 기판을 전기적으로 연결하는 솔더볼(Solder ball) 간격을 35% 좁혀 기판 크기 감소 - 칩 분석기술 적용해 안정적으로 전원을 공급하고 신호의 왜곡 및 손실을 축소 - 고성능/대면적이 요구되는 데이터센터, AI, 네트워크 등 분야 반도체에 최적화
		세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	□ 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산 - 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화 - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓ □ GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술 - 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소 - 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상 - 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상 □ 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중 □ 고성능・저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획
SDC	디스플레이 패널	갤럭시 S21용 저소비전력 OLED (2021.01.)	□ 저소비전력, 고휘도 혁신 OLED 디스플레이 양산 - S21 시리즈: 6.24"・6.67"・6.81" QHD+(3,200×1,440) - 신규 유기재료 적용으로 발광효율 개선: 전작 대비 소비전력 16% 개선 - 휘도・명암비 향상으로 우수한 야외시인성 확보 (Max/HBM 420/800 →500/1100nit, Peak 1,785nit) → Sunlight Visibility 인증(UL, 글로벌 안정인증회사)
		갤럭시Z 폴드3용 폴더블 OLED개발 (2021.08.)	□ 다양한 신기술의 폴더블 최초 적용 - 7.6" QXGA+7.55" (2,208×1,768) - 언더 패널 카메라(Under Panel Camera) 기술로 화면 사각지대 제거 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 전작 대비 배터리 소모 절감
		55/65" QD-Display (2022.01.)	□ 세계 최초 TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
		34" QD-Display (2022.03.)	□ 세계 최초 모니터향 QD-Display (34" QHD) - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화
		갤럭시Z 폴드4용 폴더블 OLED개발	□ 전작비 추가적인 개선 진행 - 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조

		(2022.08.)	- 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가 - FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감
		갤럭시북3 프로용 14/16" OLED개발 (2023.02.)	□ 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상품화 - 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용 - 신규재료 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화 - 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소
		HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.)	□ OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성 - 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10) - 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제공
		Google Pixel 8pro용 OLED개발 (2023.10.)	□ 고효율, 장수명 OLED 신규재료 적용으로 고휘도 (HBM 1,600nits, Peak 2,400nits), 저소비전력 구현 - 6.7" WQXGA+ (1,344 x 2,992) - 1~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 및 Dead Space 최소화 기술 적용

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계